

科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

浙江金连接科技股份有限公司

ZHEJIANG GOLDLINK TECH CO., LTD.

(浙江省嘉兴市经济技术开发区华云路 111 号)



首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (申报稿)



声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 302-1、302-2、303-3 室)

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

公司是一家全球知名的微细精密零件提供商，致力于为不同领域客户提供具备国际竞争力的微细精密零件。目前，公司主要产品为芯片测试探针零件，是芯片后道测试的关键核心零件，公司已拥有从成品零件加工至后处理、核心原材料制备的全流程自主生产能力。

公司主要产品芯片测试探针零件的性能参数已全面对标甚至部分超越国外主要竞争对手产品。根据沙利文咨询发布的行业报告显示，2024年公司测试探针零件市场份额位居全球第五位，亦是唯一跻身全球前五的中国本土测试探针零件厂商。在高端芯片测试探针零件长期由境外厂商主导的产业背景下，公司通过生产全流程核心技术的自主化突破，成为国产芯片测试产业链中的“补链者”和“强链者”，为我国芯片产业的战略安全与竞争力提升奠定坚实基础。

通过本次公开发行上市，公司将进一步拓宽融资渠道，利用募集资金持续加大技术创新投入、丰富产品矩阵、扩大生产规模、加强团队体系建设、完善公司治理水平，提升公司整体竞争优势，为客户、股东和产业创造长期价值。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、经营管理层规范运作，各项规章制度有效执行。未来，公司将持续完善相关制度并严格执行，确保公司股东利益尤其是中小股东利益得到有效保障。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将投资于“半导体芯片检测用探针零件扩产项目”“医疗器械精密零件制造基地建设项目”“研发中心升级项目”和“补充流动资金”。发行人本次募集资金投向属于科技创新领域且围绕主营业务开展，符合国家产业政策和公司发展规划，也将进一步丰富公司产品矩阵，增强公司资金实力和抗风险能力。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

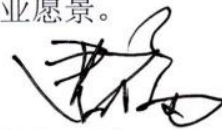
我国芯片行业在政策扶持与市场需求的驱动下，已形成较为完整的产业链布局，并在 AI/HPC 芯片、成熟制程、封装测试等领域取得显著突破。我国已将芯片产业列为国家战略性新兴产业的核心领域，坚持自主可控和进口替代的发展方向，通过加大研发投入、优化产业生态、突破关键核心技术，不断提升芯片自给率，保障产业链供应链安全稳定。芯片行业作为支撑数字经济、智能社会建设的基石，将成为推动我国科技自立自强和经济高质量发展的重要引擎。

芯片测试探针作为芯片测试不可或缺的部分，其技术进步对提升我国芯片产业的全球竞争力至关重要。长期以来，高端芯片测试探针零件被境外厂商主导。随着公司在芯片测试探针零件制造等技术上的突破，测试探针零件的性能参数已全面对标甚至部分超越国外竞争对手产品，并实现市场份额的不断提升。

经过持续研发创新与业务发展，公司的技术实力、产品品质与规模化制造能力已获得 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等全球知名芯片测试插座及探针厂商的认可。公司产品最终配套服务于国内外主要芯片厂商的 GPU、CPU、ASIC 等芯片测试环节，深度参与全球高端芯片的供应链体系。

未来，公司将持续深耕微细精密零件领域，以技术创新与迭代为核心驱动力，不断巩固并提升行业领先地位。一方面，公司将稳步推进芯片测试探针零件的产能扩张计划，以充分满足全球 AI 及高性能芯片产业快速增长带来的测试需求增加；另一方面，公司将发挥在微细精密制造领域积累的工艺经验与技术创新优势，积极拓展业务边界，加快推进医疗器械精密零件和晶圆测试探针零件等赛道的业务布局，不断丰富产品矩阵，构建多元化、高壁垒的业务发展格局，为公司长期可持续发展奠定坚实基础，实现成为全球微细零件领导者的企业愿景。

董事长、总经理：



曹 镭

本次发行概况

| | |
|-------------|--|
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 发行股数 | 不超过 13,650,000 股，不低于本次发行后总股本的 25%；本次发行不进行原股东公开发售股份 |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 每股发行价格 | 【】元 |
| 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 |
| 拟上市证券交易所和板块 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行后总股本 | 不超过 54,595,882 股 |
| 保荐人（主承销商） | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 【】年【】月【】日 |

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 发行人声明 | 1 |
| 致投资者的声明 | 2 |
| 一、发行人上市的目的 | 2 |
| 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 | 2 |
| 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 | 2 |
| 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 | 3 |
| 本次发行概况 | 4 |
| 目录 | 5 |
| 第一节 释义 | 9 |
| 一、普通术语 | 9 |
| 二、专业术语 | 11 |
| 第二节 概览 | 14 |
| 一、重大事项提示 | 14 |
| 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 | 15 |
| 三、本次发行概况 | 16 |
| 四、发行人主营业务经营情况 | 17 |
| 五、发行人符合科创板定位的说明 | 20 |
| 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 | 21 |
| 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 | 21 |
| 八、发行人选择的具体上市标准 | 22 |
| 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 | 22 |
| 十、募集资金用途与未来发展规划 | 22 |
| 十一、其他对发行人有重大影响的事项 | 22 |
| 第三节 风险因素 | 23 |
| 一、与发行人相关的风险 | 23 |
| 二、与行业相关的风险 | 26 |
| 三、其他风险 | 27 |
| 第四节 发行人基本情况 | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 一、发行人基本情况 | 28 |
| 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况 | 28 |
| 三、发行人成立以来的重大事件（含报告期内重大资产重组） | 40 |
| 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 | 40 |
| 五、发行人的股权结构图 | 40 |
| 六、发行人控股子公司、参股公司情况 | 41 |
| 七、持有 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 | 43 |
| 八、发行人特别表决权股份情况 | 48 |
| 九、发行人协议控制架构情况 | 48 |
| 十、控股股东、实际控制人报告期内的合法合规情况 | 48 |
| 十一、发行人股本情况 | 49 |
| 十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 | 56 |
| 十三、发行人与董事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况 | 61 |
| 十四、公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 | 62 |
| 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年内的变动情况 | 63 |
| 十六、董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人业务相关的对外投资情况 | 63 |
| 十七、董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 | 63 |
| 十八、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 | 65 |
| 十九、发行人员工及社会保障情况 | 68 |
| 第五节 业务与技术 | 73 |
| 一、主营业务及主要产品 | 73 |
| 二、所处行业基本情况 | 84 |
| 三、发行人在行业中的竞争地位 | 109 |
| 四、发行人销售情况和主要客户 | 115 |
| 五、发行人采购情况和主要供应商 | 119 |
| 六、发行人的主要资源要素 | 122 |

| | |
|--|------------|
| 七、发行人的资质与许可情况..... | 127 |
| 八、发行人核心技术和研发情况 | 128 |
| 九、环境保护和安全生产..... | 138 |
| 十、境外经营情况..... | 139 |
| 第六节 财务会计信息与管理层分析 | 140 |
| 一、合并财务报表..... | 140 |
| 二、会计师事务所审计意见和关键审计事项..... | 144 |
| 三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准..... | 147 |
| 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况..... | 147 |
| 五、主要会计政策和会计估计 | 148 |
| 六、非经常性损益..... | 168 |
| 七、主要税种、税率及享受的税收优惠政策..... | 169 |
| 八、主要财务指标..... | 171 |
| 九、经营成果分析..... | 173 |
| 十、资产质量分析..... | 197 |
| 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 | 217 |
| 十二、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项..... | 230 |
| 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项..... | 231 |
| 十四、盈利预测信息 | 232 |
| 第七节 募集资金运用与未来发展规划..... | 233 |
| 一、募集资金运用概述..... | 233 |
| 二、募集资金投资项目的具体情况 | 234 |
| 三、未来发展规划..... | 245 |
| 第八节 公司治理与独立性..... | 248 |
| 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况 | 248 |
| 二、发行人内部控制情况..... | 248 |
| 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况..... | 248 |
| 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况..... | 249 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力..... | 249 |
| 六、同业竞争..... | 251 |
| 七、关联方与关联关系..... | 251 |
| 八、关联交易情况..... | 255 |
| 九、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见..... | 258 |
| 十、确保关联交易公允和减少关联交易的措施..... | 259 |
| 第九节 投资者保护..... | 260 |
| 一、本次发行完成前滚存利润的分配情况..... | 260 |
| 二、发行人的股利分配政策..... | 260 |
| 三、特别表决权股份、协议控制的特殊安排..... | 263 |
| 第十节 其他重要事项..... | 264 |
| 一、重大合同..... | 264 |
| 二、对外担保情况..... | 267 |
| 三、诉讼或仲裁事项..... | 267 |
| 第十一节 声明..... | 269 |
| 一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明..... | 269 |
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明..... | 271 |
| 三、保荐机构（主承销商）声明..... | 272 |
| 四、发行人律师声明..... | 275 |
| 五、审计机构声明..... | 276 |
| 六、资产评估机构声明..... | 277 |
| 七、验资机构声明..... | 278 |
| 第十二节 附件..... | 279 |
| 一、备查文件..... | 279 |
| 二、查阅地点及时间..... | 280 |
| 三、与投资者保护相关的承诺..... | 280 |

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

| | | |
|---------------------|---|---|
| 发行人、公司、浙江金连接 | 指 | 浙江金连接科技股份有限公司 |
| 金连接有限 | 指 | 浙江金连接科技有限公司 |
| 北京金连接 | 指 | 北京金连接科技有限公司，发行人全资子公司 |
| 日本金连接 | 指 | ゴールドリンク株式会社，发行人全资子公司 |
| 香港金连接 | 指 | 香港金连接科技有限公司，发行人全资子公司 |
| 金连接医疗 | 指 | 浙江金连接医疗器械有限公司，发行人全资子公司 |
| 麦克凯利 | 指 | 成都麦克凯利科技有限公司，发行人参股公司 |
| 奥斯贝申 | 指 | 嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 扬州贝果 | 指 | 扬州贝果投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 远宁奕鑫 | 指 | 杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 远宁之鑫 | 指 | 杭州远宁之鑫创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 远宁荟智 | 指 | 杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙），发行人股东 远宁奕鑫、远宁之鑫的执行事务合伙人 |
| 远宁合丰 | 指 | 杭州远宁合丰企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 嘉欣丝绸 | 指 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司，发行人股东 |
| 吉六零基金 | 指 | 长三角吉六零科创走廊私募基金（上海）合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 浙创启晨 | 指 | 杭州浙创启晨科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 浙创新兴 | 指 | 平湖市浙创新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 浙嘉产装 | 指 | 浙嘉产装高端装备股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙），发行人股东 |
| 杭州科祥 | 指 | 杭州科祥股权投资有限公司，发行人股东 |
| 半导体基金 | 指 | 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），曾为发行人股东 |
| 惟明投资 | 指 | 宁波梅山保税港区惟明创业投资合伙企业（有限合伙），曾为发行人股东 |
| 有宁投资 | 指 | 杭州有宁创业投资合伙企业（有限合伙），曾为发行人股东 |
| 海南嘉旭 | 指 | 海南嘉旭股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾为发行股东 |
| 海南申宏元 | 指 | 海南申宏元企业管理有限公司，曾为发行人股东 |
| 上海申宏元 | 指 | 上海申宏元企业管理有限公司，曾为发行人股东 |
| Smiths Interconnect | 指 | Smiths Interconnect Group Limited，国际知名的连接器和芯片测 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | 试产品生产商，其下属公司安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司和 Smiths Interconnect Americas, Inc.系发行人客户 |
| Leeno | 指 | Leeno Industrial Co., Ltd, 成立于 1978 年，总部位于韩国，专业从事半导体测试耗材的生产，是该领域内的主要企业。 |
| WinWay | 指 | 颖崴科技股份有限公司，国际知名芯片测试产品生产商，注册于中国台湾 |
| KITA | 指 | 株式会社喜多制作所，成立于 1969 年，总部位于日本 |
| Bel Fuse | 指 | Bel Fuse, Inc., 国际知名的连接器生产商，其子公司东莞创宝达电器制品有限公司和 Cinch Connectivity Solutions, Inc.为发行人客户 |
| 和林微纳 | 指 | 苏州和林微纳科技股份有限公司，发行人客户 |
| 日拓电子 | 指 | 浙江日拓电子股份有限公司，发行人客户 |
| 韬盛科技 | 指 | 苏州韬盛电子科技有限公司，发行人客户 |
| 迪克微 | 指 | 苏州迪克微电子电子有限公司，发行人客户 |
| 捷策创 | 指 | 上海捷策创电子科技有限公司，发行人客户 |
| Yokowo | 指 | 日本 Yokowo 株式会社，国际知名的芯片测试产品生产商，发行人客户 |
| Yamaichi | 指 | 日本山一（Yamaichi）电机株式会社，国际知名的芯片测试产品生产商，发行人客户 |
| 励福环保 | 指 | 励福（江门）环保科技股份有限公司，发行人客户、供应商 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 发行人现行有效的《浙江金连接科技股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 经发行人 2025 年年度股东会审议通过，并将于发行人本次发行上市后正式生效的《浙江金连接科技股份有限公司章程（草案）》 |
| 本次发行 | 指 | 发行人根据本招股说明书所载条件首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的行为 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 长江保荐、保荐机构、保荐人、主承销商 | 指 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 发行人律师、天册律师 | 指 | 浙江天册律师事务所 |
| 申报会计师、天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2023 年、2024 年及 2025 年 |
| 报告期各期末 | 指 | 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2025 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

二、专业术语

| | | |
|-------------|---|--|
| IC、集成电路、芯片 | 指 | Integrated Circuit 的简称，是一种微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的电子器件 |
| 芯片焊盘、焊球及引脚 | 指 | 芯片与外部连接的焊接节点，实现芯片与外部电路的物理和电气连接 |
| 晶圆 | 指 | 硅基半导体集成电路制作所用的单晶硅片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之集成电路产品 |
| SoC | 指 | 将一个完整电子系统的所有核心功能模块，集成在单一颗硅芯片上的集成电路设计方案 |
| CPU | 指 | Central Processing Unit，即中央处理器，是计算机等电子设备的运算核心和控制核心 |
| GPU | 指 | Graphics Processing Unit，即图形处理器，最初设计用于高效处理计算机图形渲染，目前也被广泛地应用于 AI 模型训练、大数据分析等场景 |
| ASIC | 指 | Application-Specific Integrated Circuit，即专用集成电路，是为特定应用场景或功能专门设计、定制的集成电路，与通用型芯片（如 CPU、GPU）相对 |
| AI | 指 | Artificial Intelligence，即人工智能，是通过构建算法、模型与系统，让机器具备感知、理解、学习、推理、决策、创造等类人能力，以解决特定或通用问题 |
| HPC | 指 | High-Performance Computing，即高性能计算，是利用超级计算机、并行计算架构与优化算法，处理常规计算机无法胜任的超大规模、高复杂度计算任务，以实现极高运算速度与数据处理能力 |
| IDM 厂商 | 指 | 在半导体行业中，独立完成芯片设计、晶圆制造、封装测试全产业链环节，并销售自有品牌芯片的企业 |
| 晶圆代工厂 | 指 | 仅专注于晶圆制造环节，为无厂设计公司（Fabless）、IDM 等客户提供芯片生产代工服务，不从事芯片设计与自有品牌销售的半导体企业 |
| 封测厂 | 指 | 半导体产业链中负责芯片封装与芯片测试的专业制造企业 |
| 芯片封装 | 指 | 芯片的封装，是半导体器件制造的最后阶段，之后将进行芯片性能测试 |
| 传统封装/引线键合封装 | 指 | 以引线框架（Lead Frame）为核心载体，采用打线键合（Wire Bonding）实现芯片与外部电路连接的封装技术，是半导体封装行业中应用最广泛、技术最成熟的基础类型，主要用于满足中低端及通用型芯片的需求 |
| 先进封装 | 指 | 采用覆晶、扇入/扇出、2.5D/3D 堆叠等高密度、高性能互连技术，实现芯片与封装基板或芯片与芯片之间高效连接的封装工艺。 |
| 覆晶封装 | 指 | Flip Chip Packaging，简称 FC，又称倒装芯片封装，是一种将芯片有源面（有电路的一面）朝下，通过芯片上的金属凸点（Bump）直接与封装基板进行互连的先进封装技术 |
| 封装基板 | 指 | Package Substrate，也称 IC 载板，是半导体先进封装的核心基础材料，本质是高密度、高精度、高性能的特种印制电路板，位于裸芯片（Die）与 PCB 之间，承担芯片与外部电路的电气互连、机械支撑、散热传导及环境防护，是连接芯片微观电路与宏观系统的“承上启下”关键载体，已在先进封装中全面取代传统引线框架 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 晶圆级封装 | 指 | Wafer-Level Packaging, 简称 WLP, 是指在整片晶圆尚未切割成单颗芯片时, 通过集成再分布层 (RDL) 结构完成再布线、凸点制作、保护涂覆等全部封装工艺, 最后切割分离形成成品封装单元的先进封装技术 |
| RDL | 指 | Redistribution Layer, 即再分布层, 是晶圆级封装中实现高密度互连的核心工艺结构, 本质是通过光刻、电镀、沉积等半导体前道工艺, 在晶圆表面制作的金属布线层 (通常为铜), 用于重新规划、延伸芯片焊盘的位置与布局, 解决芯片引脚与外部封装/基板的互连匹配问题 |
| 系统级封装 | 指 | System-in-Package, 简称 SiP, 是将多个不同功能的芯片 (如逻辑、存储、射频、传感器、MEMS 等) 以及无源元件 (电阻、电容、电感), 通过先进封装工艺集成在同一个封装外壳内, 形成一个具备完整系统功能的模块化封装单元 |
| 异构集成 | 指 | 将不同工艺节点、不同材料体系、不同功能类型的芯片或器件, 通过先进封装技术在封装层级进行高密度集成, 形成功能更强大的系统级方案 |
| Chiplet | 指 | 将原本集成在单颗 SoC 上的不同功能模块, 按功能拆解为多个独立设计、制造的裸芯片 (Die), 再通过先进封装技术 (如 2.5D/3D、Hybrid Bonding 等) 进行高密度异构集成, 最终形成一个完整的系统级芯片 |
| 2.5D/3D 封装 | 指 | 通过中介层 (Interposer) 或硅通孔 (TSV) 等技术, 实现芯片间垂直高密度互连的先进封装方案, 是异构集成与 Chiplet 的核心载体, 用于突破平面布线限制, 实现高带宽、低延迟、高算力密度 |
| CoWoS 封装 | 指 | Chip-on-Wafer-on-Substrate, 即芯片-晶圆-封装基板封装, 是台积电主导开发的 2.5D/3D 先进封装技术, 核心是通过硅中介层 (Silicon Interposer) 实现逻辑芯片 (GPU/CPU/AI 加速器) 与高带宽内存 (HBM) 等多颗异质芯片的高密度、高带宽、低延迟集成, 是当前高端 AI/HPC 芯片的主流封装方案 |
| 芯片测试 | 指 | 芯片设计、制造、封装等全流程中, 通过专业设备与测试方案, 对芯片的功能、性能、可靠性、电气特性等进行验证与筛选的技术过程, 包括晶圆测试和封装后测试。公司主营产品应用于封装后测试, 如无特殊说明, 本招股说明书所指的芯片测试均为封装后测试 |
| 晶圆测试 | 指 | 是晶圆在切割和封装前进行的一种电性能与功能验证的芯片测试, 以识别出有缺陷的芯片晶粒 |
| 封装后测试/芯片阶段测试 | 指 | 是芯片晶粒封装为完整芯片后需经历的一种芯片测试, 以验证其在不同环境和条件下的功能与性能, 包括老化测试、成品测试和系统级测试 |
| 老化测试 | 指 | 旨在通过加速应力条件 (如高温、高电压、长时间运行) 来筛选芯片早期失效、验证长期可靠性的测试环节 |
| 成品测试 | 指 | 也称为 FT 测试或 Final Test, 是在芯片出厂前对单颗成品芯片进行的全面电气与功能验证 |
| 系统级测试 | 指 | 也称为 SLT 测试或 System Level Test, 在接近真实应用的系统环境下, 对芯片进行的综合性验证测试, 通过运行实际应用场景与负载, 全面验证芯片在真实系统中的功能、性能、稳定性与兼容性。系统级测试目前已广泛应用于 AI/HPC 等高功耗芯片, 需求随着 AI 产业发展而快速增长。 |
| 测试接口 | 指 | 测试接口是芯片测试系统中, 实现被测芯片 (DUT) 与测试设备 (ATE) 之间物理连接、机械支撑及电信号传输的核心组件, 是确保测试信号准确、稳定传输的关键桥梁。根据应用场景与封装类型的不同, 主要分为探针卡和测试插座两大类 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| 芯片测试插座、测试插座 | 指 | 也称为 Test Socket，一种集成电路测试使用的配件，用于封装后测试 |
| 探针卡 | 指 | 也称为 Probe Card，一种应用于集成电路晶圆测试的、能实现与晶圆连接的电路板 |
| 芯片测试探针、测试探针、探针 | 指 | 在芯片测试环节，用于连接被测晶圆或封装后芯片与测试设备之间的核心连接部件，以传递电信号，进而判定晶圆或芯片的性能、功能及稳定性。根据测试阶段不同，测试探针可分为晶圆测试探针和封装后测试探针。晶圆测试探针分为悬臂式探针、垂直式探针和 MEMS 探针。芯片阶段测试探针根据材质不同，主要分为弹簧测试探针和硅橡胶测试探针。公司主要生产的测试探针零件应用于弹簧测试探针，如无特殊说明，本招股说明书所指的芯片测试探针、测试探针、探针均为弹簧测试探针 |
| 芯片测试探针零件、测试探针零件、探针零件 | 指 | 根据材质不同，芯片测试探针零件主要包括弹簧测试探针零件和硅橡胶测试探针零件。如无特殊说明，本招股说明书所指芯片测试探针零件均为弹簧测试探针零件，包括顶柱头、底柱头、套筒和微弹簧，其通过精密组装可形成完整的弹簧测试探针 |
| 射频连接器 | 指 | 连接电器线路的机电元件，起到使传输电气连接或断开的作用，是通信网络系统中所必需的用于传输射频信号的核心基础元器件 |
| 线缆组件 | 指 | 由导电芯体与绝缘层构成，用于传输电信号的纯线体传输载体 |
| 拉拔 | 指 | 将金属棒材通过特定模具孔道进行拉伸，使其直径逐渐变细的塑性加工过程 |
| 矫直 | 指 | 经塑性加工后，通过外力作用矫正金属棒材的弯曲、翘曲等形变缺陷，提高其直线度与形位精度，满足后续加工精度要求的工艺过程 |
| 回/退火、热处理 | 指 | 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工生产工艺 |
| CNC 机床 | 指 | Computer Numerical Control Machine，即计算机数字控制机床，是一种通过计算机执行预编程的数字与符号指令，自动控制刀具与工件的运动、转速、进给及加工顺序，实现高精度、高效率、高一一致性自动化加工的机床 |
| 车加工 | 指 | 通过工件旋转、刀具直线进给，对金属棒材进行外圆、端面等切削的加工过程 |
| 铣加工 | 指 | 通过刀具旋转、工件移动，对金属棒材进行沟槽、平面等铣削的加工过程 |
| 过程能力指数 CPK | 指 | 衡量过程输出（如零件尺寸、产品重量）的一致性和合格能力的量化指标，即生产过程能否稳定地生产出符合规格要求的产品。数值越高，表示过程越稳定可靠，出现不合格品的风险越低，一般 CPK>1.33 即表示过程控制能力良好 |

注：本招股说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大风险和重要事项：

（一）客户集中度高的风险

报告期各期，公司前五大客户销售收入占公司当期营业收入比例分别为63.90%、76.10%和80.82%。其中，公司向第一大客户 Smiths Interconnect 的销售金额分别为 3,368.19 万元、7,836.38 万元和 13,231.22 万元，占营业收入的比例分别为 36.91%、49.55%和 47.89%，占比较高。

2026 年 4 月 Smiths Interconnect 的控股方从英国史密斯集团变更为美国莫仕电子技术控股有限公司（Molex）。若未来发行人现有主要客户，尤其是第一大客户 Smiths Interconnect 发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，进而减少对发行人产品的采购，而发行人未能及时开拓新客户，则将对发行人盈利能力产生重大不利影响。

（二）经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为-990.09 万元、-21.18 万元和 5,147.13 万元。公司未来的业务发展及业绩表现受到宏观经济、市场环境、下游行业景气度、主要客户业务发展情况以及新客户拓展情况等多方面因素的影响。若半导体行业景气度出现周期性波动，使得芯片测试市场需求持续低迷、市场竞争愈发激烈，或新客户开拓不及预期、重要客户合作关系发生变化等不确定因素使公司市场竞争力发生变化，导致芯片测试探针零件出现售价下降、销售量降低等不利情形，公司经营业绩则将面临下滑的风险。

（三）核心技术泄密风险

公司在微细精密零件领域深耕超二十年，通过长期的技术研发掌握了多项微细精密零件及核心原材料生产制备的核心技术，并实现产业化。核心技术是公司的核心竞争力之一，系公司可持续发展的重要保证，公司通过申请专利、与研发人员签署保密协议等方式对关键核心技术进行保护。如果公司核心技术泄密，将对公司在行业内的竞争力造成不利影响。

（四）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 5,666.47 万元、5,739.11 万元和 5,956.92 万元，主要包括原材料、库存商品和在产品。公司存货跌价准备分别为 1,102.04 万元、1,190.82 万元和 1,339.63 万元，总体呈增长趋势，主要是由于战略备货等因素导致公司部分存货库龄增长。公司根据客户订单及预测需求提前采购各类原材料并组织生产，但由于下游半导体封测行业更新换代速度较快，公司存货面临着一定的跌价风险。

（五）宏观经济波动和行业周期性的风险

报告期各期，发行人芯片测试探针零件的销售收入分别为 6,583.11 万元、12,112.76 万元和 22,385.63 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 77.74%、85.56% 和 92.14%，下游客户主要集中在芯片测试领域，受半导体行业发展的影响较大。半导体行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气度会随着宏观经济周期出现波动。若全球经济出现衰退，将对半导体行业相关产品造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

| （一）发行人基本情况 | | | |
|------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 发行人名称 | 浙江金连接科技股份有限公司 | 成立日期 | 2017 年 7 月 21 日 |
| 注册资本 | 40,945,882 元 | 法定代表人 | 曹镭 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区华云路 111 号 | 主要生产经营地址 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区华云路 111 号 |
| 控股股东 | 曹镭 | 实际控制人 | 曹镭 |
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无 |

| (二) 本次发行的有关中介机构 | | | |
|---|---------------------|--------|------------------|
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 发行人律师 | 浙江天册律师事务所 | 其他承销机构 | 无 |
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 评估机构 | 坤元资产评估有限公司 |
| 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 | | 无 | |
| (三) 本次发行其他有关机构 | | | |
| 股票登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 收款银行 | 中国农业银行上海市浦东分行营业部 |
| 其他与本次发行有关的机构 | | 无 | |

三、本次发行概况

| (一) 本次发行的基本情况 | | | |
|---------------|--|-----------|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | |
| 发行股数 | 不超过 13,650,000 股 | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 其中：发行新股数量 | 不超过 13,650,000 股 | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 股东公开发售股份数量 | 无 | 占发行后总股本比例 | / |
| 发行后总股本 | 不超过 54,595,882 股（不含使用超额配售权发行的股票数量） | | |
| 每股发行价格 | 【】元 | | |
| 发行市盈率 | 【】倍（发行价格除以发行后每股收益） | | |
| 发行前每股净资产 | 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） | 发行前每股收益 | 【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） | 发行后每股收益 | 【】元（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | |
| 预测净利润（如有） | 不适用 | | |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式 | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 发行对象 | 符合中国证监会、上交所规定的资格的询价对象和符合投资者适当性要求且在上交所开立科创板账户的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金总额 | 【】万元 |
| 募集资金净额 | 【】万元 |
| 募集资金投资项目 | 半导体芯片检测用探针零件扩产项目 医疗器械精密零件制造基地建设项目 研发中心升级项目 补充流动资金 |
| 发行费用概算 | 保荐承销费用【】万元，审计费用【】万元，律师费用【】万元，与本次发行相关的信息披露费用【】万元，发行手续费及其他费用【】万元，发行费用合计【】万元（以上费用均不含增值税） |
| 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 | 若公司决定实施高级管理人员及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露 |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 | 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 |
| 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 | 无 |
| （二）本次发行上市的重要日期 | |
| 刊登发行公告日期 | 【】年【】月【】日 |
| 开始询价推介日期 | 【】年【】月【】日 |
| 刊登定价公告日期 | 【】年【】月【】日 |
| 申购日期和缴款日期 | 【】年【】月【】日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |

四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司是一家全球知名的微细精密零件提供商，目前主要为 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等国内外主要芯片测试耗材厂商提供核心零件，产品最终应用于国内外主要芯片厂商 GPU、CPU、ASIC 等高端芯片的测试环节，是全球高端芯片供应链体系的重要一环。此外，公司亦积极拓展业务边界，战略性布局医疗器械精密零件和晶圆测试探针零件，持续丰富自身产品矩阵。

作为国内少数具备测试探针零件规模化制造能力的企业，公司可实现最小直径

0.03mm、尺寸公差 $\pm 2\mu\text{m}$ 的测试探针零件稳定批量生产，并能够在最小直径0.04mm的探针顶柱头完成复杂几何结构的镜面级加工，产品参数已全面对标甚至部分超越国内外竞争对手产品。根据沙利文咨询发布的行业报告显示，2024年公司在测试探针零件行业的市占率位居全球第五位，亦是唯一跻身全球前五的中国本土测试探针零件厂商。在高端芯片测试探针零件长期由境外厂商主导的产业背景下，公司通过探针零件超精密微细加工、高效收集与清洗以及探针材料制备的全流程技术突破，成功量产高端芯片测试探针零件，成为国内芯片测试产业链中的“补链者”和“强链者”，为我国芯片产业的战略安全与竞争力提升奠定坚实基础。

截至本招股说明书签署日，公司共拥有已授权专利60项，其中发明专利30项，并成功入选为国家级专精特新重点“小巨人”企业。此外，公司积极引领行业技术发展，“芯片测试用关键电子材料研发与产业化项目”被浙江省科技厅评定为2023年度浙江省“尖兵”研发攻关计划项目，“半导体芯片测试探针零件制造项目”入选浙江省产业链协同创新项目，公司产品“测试探针用合金精微部件”成功入选2023年度浙江省首批次新材料名单。公司先后被授予浙江省高新技术企业研究开发中心、嘉兴市高新技术研究开发中心、嘉兴市技术中心等荣誉称号，入选浙江省科技型中小企业、全国首批制造业新型技术改造试点城市试点项目。

报告期内，公司主营业务收入及构成情况如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2025年度 | | 2024年度 | | 2023年度 | |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 芯片测试探针零件 | 22,385.63 | 92.14% | 12,112.76 | 85.56% | 6,583.11 | 77.74% |
| 射频互连部件 | 1,469.90 | 6.05% | 1,771.30 | 12.51% | 1,679.97 | 19.84% |
| 其他 | 438.75 | 1.81% | 273.80 | 1.93% | 204.82 | 2.42% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

（二）所需主要原材料及重要供应商

公司生产使用的主要原材料有钽片、磷青铜毛细金属管、铍铜棒料等。公司主要根据客户需求、生产计划、安全库存、市场价格及采购周期等因素综合确定原材料采购计划。公司重要原材料供应商包括励福（江门）环保科技股份有限公司、贵研金属（上海）有限公司、贺利氏金属香港有限公司等。

公司主要采购情况及重要供应商情况详见本招股说明书“第五节 业务与技

术”之“五、发行人采购情况和主要供应商”。

（三）主要生产模式

公司实行“以销定产、适当备货”的生产模式，即公司生产部门根据销售部门提供的客户订单或客户需求预测，结合产品库存量、车间生产能力制定生产计划。公司已自主掌握精密刀具设计与制造、精密机械加工、零件产品收集及清洗及热处理、核心原材料制备等生产工艺，但零件产品电镀等工序需委外加工。

1、自主生产

公司制定了《生产管理制度》《消防安全管理制度》《不合格品管理制度》等生产管理制度。公司生产部门根据销售部门提供的客户订单或客户需求预测，结合相应产品的库存量、车间生产能力制定生产计划，并制定物料需求，向仓储部门申请领料，各车间管理人员根据生产计划组织生产；品保部门按照规范进行过程控制，质检员按照企业标准对成品进行检验，检验合格方可入库；如出现不合格产品则进行标识、隔离、报废。

经过多年的生产实践与管理沉淀，公司已搭建起现代化、自动化、智能化的全流程自主生产体系。核心机加工环节，通过对送料机、机床主轴单元的自主改造，可完成直径小于 1mm 材料的自动上下料与连续稳定加工，实现 7×24 小时不间断作业，降低人工依赖；质量管控环节，构建起首件检验、过程巡检、批次小终检、成品大终检的多级全流程质检体系，配合自动化检测仪器，可完成零件关键尺寸的快速、精准检测；后道零件收集、清洗环节，均采用自动化设备作业，显著提升回收效率与回收产品良率，实现生产全链路的自动化闭环。

此外，公司建立了科学与高效的排产机制，合理调配生产资源，推动高效生产与精细化产能调度，提升整体生产效能与产品品质。

2、委外加工

公司存在将精密零件电镀等工序委外生产的情况。公司已建立委外加工的相关管理制度，对委托加工供应商的遴选、评估和日常业务合作进行管理。生产部门在下达委外订单时需对供应商进行询价议价，经相关管理人员审批后最终确定委外供应商。确定委外加工厂商后，仓储部门负责编制委外出库单并联系物流将相关物料送至委外加工厂商处。委外加工完成后，品保部门按照公司品质管理的

要求对加工完成的产品进行品质检验，检验合格后由仓储人员办理入库。

（四）销售模式和重要客户

销售渠道建设方面，在业务发展初期，公司主要通过参加行业展会、销售人员主动拜访、客户转介绍等方式获得业务机会，相关的销售活动和客户服务工作主要由销售部负责执行。随着公司产品质量不断提高、行业地位稳步提升，公司进一步优化获客体系，推行大客户绑定战略，通过及时响应大客户反馈，实现与行业内大客户的长期深度绑定。与此同时，凭借优秀的零件产品质量与不断提升的行业认可度，公司也吸引众多客户主动对接洽谈、建立合作关系。销售模式方面，报告期内公司采取直销模式。

公司重要客户包括 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等，均为境内外主要测试探针或测试插座厂商。

公司销售情况及重要客户情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人销售情况和主要客户”。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

芯片测试探针行业，尤其是高端芯片测试探针，设计和制造工艺复杂、门槛较高，现阶段市场份额主要被境外厂商主导。根据沙利文咨询发布的行业报告显示，2024 年公司测试探针零件市场份额位居全球第五位，亦是唯一跻身全球前五的中国本土测试探针零件厂商。

五、发行人符合科创板定位的说明

（一）发行人符合科创板行业领域要求

| | | |
|----------|---|--|
| 公司所属行业领域 | <input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术 | 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，芯片测试探针零件属于新一代信息技术产业中“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”，因此属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路领域”。 |
| | <input type="checkbox"/> 高端装备 | |
| | <input type="checkbox"/> 新材料 | |
| | <input type="checkbox"/> 新能源 | |
| | <input type="checkbox"/> 节能环保 | |
| | <input type="checkbox"/> 生物医药 | |
| | <input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域 | |

（二）发行人符合科创属性指标要求

| 科创属性相关指标 | 是否符合 | 公司具体情况 |
|---|--|---|
| 最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或者最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司研发费用分别为 971.76 万元、1,061.17 万元和 2,061.67 万元，最近三年，研发投入占营业收入比例 7.79%。 |
| 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10% | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至 2025 年 12 月 31 日，公司的研发人员为 56 人，占员工总数的比例为 14.36%，超过 10%。 |
| 应用于公司主营业务的发明专利 7 项以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至本招股说明书签署日，应用于公司主营业务的发明专利共 30 项，超过 7 项。 |
| 最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2023 年度、2024 年度和 2025 年度，营业收入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，复合增长率为 74.00%，超过 25%。 |

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

| 项目 | 2025.12.31 或 2025 年度 | 2024.12.31 或 2024 年度 | 2023.12.31 或 2023 年度 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 资产总额（万元） | 71,018.06 | 66,462.08 | 44,806.63 |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 41,627.70 | 35,929.63 | 20,889.51 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 40.30 | 45.70 | 53.31 |
| 营业收入（万元） | 27,628.15 | 15,815.29 | 9,125.36 |
| 净利润（万元） | 5,868.82 | 524.12 | -475.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 5,868.82 | 524.12 | -475.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 5,147.13 | -21.18 | -990.09 |
| 基本每股收益（元） | 1.43 | 0.14 | -0.13 |
| 稀释每股收益（元） | 1.43 | 0.14 | -0.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.13 | 2.13 | -2.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 9,510.21 | 4,712.14 | 3,248.23 |
| 现金分红（万元） | - | - | 2,000.00 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.46 | 6.71 | 10.65 |

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，发行人主要经营状况正常，主要业务开展情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。

八、发行人选择的具体上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条，公司选择的具体上市标准为：“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

公司股份均为普通股份，股份具有相同的表决权，不存在特别表决权股份或类似的公司治理特殊安排。

十、募集资金用途与未来发展规划

经公司2025年第二次临时股东会审议通过，公司拟公开发行不超过13,650,000股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市，发行股份占发行后总股本的比例不低于25.00%，实际募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | 半导体芯片检测用探针零件扩产项目 | 48,831.12 | 48,831.12 |
| 2 | 医疗器械精密零件制造基地建设项目 | 23,658.61 | 23,658.61 |
| 3 | 研发中心升级项目 | 5,135.00 | 5,135.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | 102,624.73 | 102,624.73 |

十一、其他对发行人有重大影响的事项

报告期内其他对发行人有重大影响的事项详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）客户集中度高的风险

报告期各期，公司前五大客户销售收入占公司当期营业收入比例分别为 63.90%、76.10%和 80.82%。其中，公司向第一大客户 Smiths Interconnect 的销售金额分别为 3,368.19 万元、7,836.38 万元和 13,231.22 万元，占营业收入的比例分别为 36.91%、49.55%和 47.89%，占比较高。

2026 年 4 月 Smiths Interconnect 的控股方从英国史密斯集团变更为美国莫仕电子技术控股有限公司（Molex）。若未来发行人现有主要客户，尤其是第一大客户 Smiths Interconnect 发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，进而减少对发行人产品的采购，而发行人未能及时开拓新客户，则将对发行人盈利能力产生重大不利影响。

（二）经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为-990.09 万元、-21.18 万元和 5,147.13 万元。公司未来的业务发展及业绩表现受到宏观经济、市场环境、下游行业景气度、主要客户业务发展情况以及新客户拓展情况等多方面因素的影响。若半导体行业景气度出现周期性波动，使得芯片测试市场需求持续低迷、市场竞争愈发激烈，或新客户开拓不及预期、重要客户合作关系发生变化等不确定因素使公司市场竞争力发生变化，导致芯片测试探针零件出现售价下降、销售量降低等不利情形，则公司经营业绩将面临下滑的风险。

（三）毛利率下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 29.79%、28.67%和 45.92%，公司主营业务毛利率的变化主要受产品结构的变化以及主要产品毛利率变化的影响。报告期内，芯片测试探针零件的毛利率分别为 33.72%、32.07%和 49.48%，该产品占公司主营业务收入的比重分别为 77.74%、85.56%和 92.14%，芯片测试探针零件毛利率上升较快。若未来芯片测试探针零件产品相关技术研发未能契合下游行业的

最新发展或高毛利率产品客户需求发生改变，将对公司主营业务毛利率产生较为不利的影响。

（四）技术迭代风险

公司主要产品最终应用于芯片后道测试领域。近年来，随着 AI/HPC 芯片行业、先进封装行业的快速发展，使得芯片测试日趋复杂，呈现高功耗、大电流、测试间距精细化，单颗芯片测试引脚数量不断增加。这一发展趋势要求测试探针零件尺寸日趋精微、公差严格控制，并不断追求更优异的机械和电气性能。

因此，公司需要对行业下游乃至终端应用的技术需求发展趋势进行准确预测与快速响应，并配合行业需求调整创新与研发方向，适应相关产品的技术迭代。若未来下游行业对于芯片测试的技术需求发生较大的调整，而公司无法保持技术先进性，可能对公司未来的经营产生不利影响。

（五）募投项目新增产能消化的风险

本次发行募集资金投资项目中，半导体芯片检测用探针零件扩产项目系公司现有核心业务的扩产项目，项目达产后将大幅提高芯片测试探针零件的产能；医疗器械精密零件制造基地建设项目系公司基于多年的微细精密零件生产加工经验和技术积累，横向拓展的新应用领域。

上述募投项目的建设需要一定周期，达产后也需经过一段消化期后才可实现盈利，公司对募投项目的可行性进行了深入的研究和审慎的判断，但仍然无法完全规避政策风向变化、客户需求转移、创新技术替代、技术研发失败等风险，可能导致募投项目新增产能的消化不及预期，对公司的盈利能力产生一定不利影响。

（六）进口设备依赖的风险

公司的微细精密零件产品主要依靠 CNC 机床进行加工制造。报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有生产设备以进口设备为主，主要供应商包括日本西铁城（CITIZEN）、日本津上（TSUGAMI）等国际知名精密机床厂商。截至本招股说明书签署日，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦冲突加剧，美国、日本进一步加大对半导体相关生产设备的出口管制力度和范围，从而使本公司所需的 CNC 机床出现进口受限的情形，将对本公司生产经营产生重大不利影响。

（七）委外加工成本较高的风险

报告期内，公司主营业务成本中委外加工的金额分别为 662.47 万元、1,374.93 万元和 2,779.54 万元，占主营业务成本的比例分别为 11.14%、13.62%和 21.16%，占比较高。委外加工是公司部分产品必要的环节，若未来委外加工采购单价上升，将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

（八）核心技术泄密风险

公司在微细精密零件领域深耕超二十年，通过长期的技术研发掌握了多项微细精密零件制造及核心原材料制备的核心技术，并实现产业化。核心技术是公司的核心竞争力之一，系公司可持续发展的重要保证，公司通过申请专利、与研发人员签署保密协议等方式对关键核心技术进行保护。如果公司核心技术泄密，将对公司在行业内的竞争力造成不利影响。

（九）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 5,666.47 万元、5,739.11 万元和 5,956.92 万元，主要包括原材料、库存商品和在产品。公司存货跌价准备分别为 1,102.04 万元、1,190.82 万元和 1,339.63 万元，总体呈增长趋势，主要是由于战略备货等因素导致公司部分存货库龄增长。公司根据客户订单及预测需求提前采购各类原材料并组织生产，但由于下游半导体封测行业更新换代速度较快，公司存货面临着一定的跌价风险。

（十）经营规模快速增长带来的管理风险

报告期各期末，公司资产总额分别为 44,806.63 万元、66,462.08 万元和 71,018.06 万元，各期营业收入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元。报告期内，公司资产规模和销售规模均保持较快的增长速度。尽管公司已建立了较为规范的管理体系和完善的治理结构，但随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，公司销售规模将进一步扩大。若公司管理团队的人员配备及管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，公司的日常运营将面临一定的管理风险。

（十一）税收优惠政策变动的风险

报告期内，发行人母公司被认定为高新技术企业，享受减按 15%的税率缴纳

企业所得税。若公司未来不能通过高新技术企业认证或相应的税收优惠政策发生变化,使得公司无法继续享受相关税收优惠政策,公司的所得税费用会有所上升,将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济波动和行业周期性的风险

报告期各期,发行人芯片测试探针零件的销售收入分别为 6,583.11 万元、12,112.76 万元和 22,385.63 万元,占当期主营业务收入的比例分别为 77.74%、85.56% 和 92.14%,下游客户主要集中在芯片测试领域,受半导体行业发展的影响较大。半导体行业和宏观经济周期具有较强的关联性,其景气度会随着宏观经济周期出现波动。若全球经济进一步衰退或市场复苏不及预期,将对半导体行业相关产品造成不利影响,进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）原材料价格波动风险

报告期内,公司直接原材料占主营业务成本的比例较高,分别为 29.93%、20.83% 和 19.90%。公司生产经营所使用的主要原材料包括钽片、磷青铜毛细金属管、镀铜棒料等。近年来钽等贵金属价格波动较大,若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨,而公司未能通过向下游转移或技术创新等方式应对价格上涨的压力,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）贸易摩擦的风险

报告期内,公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例分别为 21.79%、16.48% 和 10.50%,同时公司主要原材料及设备供应商多数为境外公司。近年来,随着全球半导体产业格局的深度调整,加之部分国家正在实施科技和贸易保护措施,对中国半导体相关产业的发展造成不利影响。未来,如果相关国家与中国的贸易摩擦持续升级,限制进出口或提高关税,公司可能面临设备、原材料短缺和客户流失等风险,进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加,对公司的业务和经营产生不利影响。

（四）汇率波动的风险

报告期内,公司主营业务收入中外销收入分别为 1,845.48 万元、2,333.03 万

元和 2,550.73 万元，各期占比分别为 21.79%、16.48%和 10.50%。公司外销收入主要以美元作为结算货币，报告期各期，美元兑换人民币的平均汇率分别为 7.0467、7.1217 和 7.1429，同比分别上升 4.77%、1.06%和 0.30%。若未来美元兑人民币汇率出现大幅下降，将影响公司海外市场销售的价格竞争力，并造成汇兑损失，从而对公司的营业收入和利润产生不利影响。

三、其他风险

（一）前瞻性陈述可能不准确的风险

本招股说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及行业市场规模、行业未来发展趋势、公司未来发展规划等方面的预测、预期或讨论。公司提醒投资者注意，前述预测、预期或讨论涉及的内容存在一定的不确定性，可能存在不准确的风险，相关内容不应视为公司的承诺或声明。

（二）股票市场风险

本次发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市。除公司的经营和财务状况之外，公司股票价格还受到国际政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多重因素的影响。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股票市场投资的风险有充分的了解，并作出审慎判断。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 中文名称 | 浙江金连接科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Zhejiang Goldlink Tech Co., Ltd. |
| 注册资本 | 40,945,882.00 元 |
| 法定代表人 | 曹镭 |
| 有限公司成立日期 | 2017 年 7 月 21 日 |
| 股份公司成立日期 | 2021 年 12 月 22 日 |
| 住所 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区华云路 111 号 |
| 邮政编码 | 314033 |
| 联系电话 | 0573-83693388 |
| 传真号码 | 0573-83996399 |
| 互联网网址 | www.goldlink-tech.com |
| 电子信箱 | IR@goldlink-tech.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会秘书办公室 |
| 信息披露负责人 | 袁玉兰 |
| 信息披露负责人电话 | 0573-83693388 |

二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况

（一）有限公司设立情况

发行人前身为浙江金连接科技有限公司。

2017 年 7 月 21 日，金连接有限在嘉兴市市场监督管理局注册成立，成立时公司名称为“浙江金连接科技有限公司”，住所为浙江省嘉兴市秀洲区禾平街食品标准厂房园区 12# 厂房，注册资本为 3,000.00 万元，经营范围为“研发、生产、销售精密机械加工零组件、电子测试探针零组件、电子连接器零组件、数据通信电缆线组件、光机电一体化产品、通信及计算机产品，金属材料的销售，货物进出口、技术进出口、代理进出口”。

金连接有限成立时，其股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|-----------|---------|
| 1 | 曹镭 | 2,700.00 | 90.00% |
| 2 | 官世炎 | 150.00 | 5.00% |
| 3 | 赵立松 | 150.00 | 5.00% |
| 合计 | | 3,000.00 | 100.00% |

根据天健会计师出具的“天健验（2021）627号”“天健验（2021）629号”《验资报告》，截至2021年9月23日止，金连接有限已累计收到上述股东以货币方式缴纳的出资合计3,000万元。

（二）股份公司设立情况

2021年11月20日，金连接有限股东会作出决议，全体股东一致同意金连接有限以2021年10月31日为审计、评估基准日，整体变更为股份有限公司。

2021年11月30日，天健会计师出具“天健审（2021）8695号”《审计报告》，经其审计，截至2021年10月31日，金连接有限经审计的净资产为88,854,078.06元。2021年12月1日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报（2021）818号”《资产评估报告》，经其评估，截至2021年10月31日，金连接有限净资产的评估价值为90,848,096.02元。

2021年12月3日，金连接有限股东会作出决议，全体股东一致同意以金连接有限截至2021年10月31日经审计的净资产88,854,078.06元按照2.59:1的比例，折合股份34,285,714股，每股1元，剩余的54,568,364.06元计入资本公积。

2021年12月13日，曹镭、奥斯贝申、远宁奕鑫、赵立松、官世炎、王建南、何烽、杨熙春、黄湘萍、徐荣兵、扬州贝果、邱友红等12名股东共同签署《发起人协议书》，同意将金连接有限变更设立为股份有限公司。

2021年12月19日，天健会计师出具“天健验（2021）789号”《验资报告》，经其审验，截至2021年12月13日止，浙江金连接已收到全体出资者所拥有的截至2021年10月31日止金连接有限经审计的净资产88,854,078.06元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本34,285,714.00元，资本公积54,568,364.06元。

2021年12月19日，浙江金连接召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起

人出席本次大会，并选举产生第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。

2021年12月22日，发行人完成本次整体变更设立为股份有限公司的工商变更登记。股份公司设立时，公司股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,835,715 | 46.1875% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 20.0000% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 10.0000% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 4.3750% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 4.3750% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 4.0000% |
| 7 | 何烽 | 857,143 | 2.5000% |
| 8 | 杨熙春 | 750,000 | 2.1875% |
| 9 | 黄湘萍 | 750,000 | 2.1875% |
| 10 | 徐荣兵 | 750,000 | 2.1875% |
| 11 | 扬州贝果 | 342,857 | 1.0000% |
| 12 | 邱友红 | 342,857 | 1.0000% |
| 合计 | | 34,285,714 | 100.00% |

（三）报告期内股本、股东变化情况

截至2022年12月31日，发行人总股本为37,714,285股，其股本结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,835,715 | 41.9886% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 18.1818% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 9.0909% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.9773% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.9773% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 3.6364% |
| 7 | 半导体基金 | 1,371,428 | 3.6364% |
| 8 | 惟明投资 | 1,028,572 | 2.7273% |
| 9 | 何烽 | 857,143 | 2.2727% |
| 10 | 高雁峰 | 752,381 | 1.9949% |
| 11 | 杨熙春 | 750,000 | 1.9886% |
| 12 | 徐荣兵 | 750,000 | 1.9886% |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|---------|
| 13 | 有宁投资 | 416,667 | 1.1048% |
| 14 | 嘉欣丝绸 | 376,190 | 0.9975% |
| 15 | 扬州贝果 | 342,857 | 0.9091% |
| 16 | 邱友红 | 342,857 | 0.9091% |
| 17 | 海南申宏元 | 133,333 | 0.3535% |
| 18 | 海南嘉旭 | 100,000 | 0.2652% |
| | 合计 | 37,714,285 | 100.00% |

1、2024年9月，发行人增资及股份转让

2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司进行C轮融资的议案》，同意公司与浙创启晨、吉六零基金、浙嘉产装分别签署《浙江金连接科技股份有限公司C轮融资协议》，并同意浙江省创业投资集团有限公司旗下管理的基金于2024年12月31日前以上述C轮融资协议相同的价格和条件向公司增资不超过5,000万元；审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，向上述3名投资人新增发行股票2,366,387股，公司总股本变更为40,080,672股。公司本轮增资的价格为45.0758元/股，对应投前估值为17.00亿元。

2024年7月29日，公司与吉六零基金签订《关于浙江金连接科技股份有限公司之C轮融资协议（二）》，约定吉六零基金以2,666.6667万元认购公司新发股份59.1597万股，其中59.1597万元计入公司注册资本，其余2,607.5070万元计入资本公积。

2024年8月20日，公司与浙创启晨签订《关于浙江金连接科技股份有限公司之C轮融资协议（一）》，约定浙创启晨以4,000.00万元认购公司新发股份88.7395万股，其中88.7395万元计入公司注册资本，其余3,911.2605万元计入资本公积。

2024年9月14日，公司与浙嘉产装签订《关于浙江金连接科技股份有限公司之C轮融资协议（三）》，约定浙嘉产装以4,000.00万元认购公司新发股份88.7395万股，其中88.7395万元计入公司注册资本，其余3,911.2605万元计入资本公积。

2025年3月27日，天健会计师出具了“天健验（2025）65号”《验资报告》，经其审验，截至2024年9月30日止，发行人已收到前述股东以货币方式缴纳的增资款合计106,666,667元。

2024年7月29日，公司控股股东、实际控制人曹镭与吉六零基金签订《股权转让协议书》，约定将其所持有公司31.4286万股股份以1,333.3333万元的价格转让给吉六零基金；2024年8月20日，曹镭与浙创启晨签订《股权转让协议书》，约定将其所持公司47.1429万股股份以2,000.00万元的价格转让给浙创启晨。上述股权转让的价格为42.4242元/股，即按前述增资前公司整体估值16.00亿元作价。

2024年9月23日，公司就上述事项完成工商变更登记，变更完成后公司股本结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,050,000 | 37.5493% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 17.1084% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 8.5542% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.7425% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.7425% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 3.4217% |
| 7 | 半导体基金 | 1,371,428 | 3.4217% |
| 8 | 浙创启晨 | 1,358,824 | 3.3902% |
| 9 | 惟明投资 | 1,028,572 | 2.5663% |
| 10 | 吉六零基金 | 905,883 | 2.2601% |
| 11 | 浙嘉产装 | 887,395 | 2.2140% |
| 12 | 何烽 | 857,143 | 2.1385% |
| 13 | 高雁峰 | 752,381 | 1.8772% |
| 14 | 杨熙春 | 750,000 | 1.8712% |
| 15 | 徐荣兵 | 750,000 | 1.8712% |
| 16 | 有宁投资 | 416,667 | 1.0396% |
| 17 | 嘉欣丝绸 | 376,190 | 0.9386% |
| 18 | 扬州贝果 | 342,857 | 0.8554% |
| 19 | 邱友红 | 342,857 | 0.8554% |
| 20 | 海南申宏元 | 133,333 | 0.3327% |
| 21 | 海南嘉旭 | 100,000 | 0.2495% |
| 合计 | | 40,080,672 | 100.00% |

本次股份转让受让方已足额支付股权转让价款，转让方已缴纳相应个人所得税

税，各方就本次股权转让事宜不存在任何争议或潜在纠纷。

2、2024年12月，发行人增资及股份转让

2024年12月2日，杭州有宁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“有宁投资”）与夏卫芳、吴铮、远宁合丰签订《关于浙江金连接科技股份有限公司之股份转让协议》，约定将其持有公司33.3335万股股份转让给夏卫芳、4.1666万股股份转让给吴铮、4.1666万股股份转让给远宁合丰，转让价格均为每股42.42元，转让价款合计为1,767.50万元。

2024年12月，公司召开股东大会，同意浙江省创业投资集团有限公司旗下管理的基金-平湖市浙创新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）出资3,900.00万元以每股45.0758元的价格认购公司新发的股份865,210股，其中865,210元计入注册资本，其余38,134,790元计入资本公积。本次股份发行完成后，公司总股本增加至40,945,882股。

2025年3月28日，天健出具了“天健验〔2025〕66号”《验资报告》，经其审验，截至2024年12月31日止，发行人已收到前述股东以货币方式缴纳的增资款39,000,000元。

2025年1月14日，公司就上述事项完成工商变更登记，变更完成后公司股本结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,050,000 | 36.7558% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 16.7468% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 8.3734% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 3.3494% |
| 7 | 半导体基金 | 1,371,428 | 3.3494% |
| 8 | 浙创启晨 | 1,358,824 | 3.3186% |
| 9 | 惟明投资 | 1,028,572 | 2.5120% |
| 10 | 吉六零基金 | 905,883 | 2.2124% |
| 11 | 浙嘉产装 | 887,395 | 2.1672% |
| 12 | 浙创新兴 | 865,210 | 2.1131% |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|-------------------|----------------|
| 13 | 何烽 | 857,143 | 2.0934% |
| 14 | 高雁峰 | 752,381 | 1.8375% |
| 15 | 杨熙春 | 750,000 | 1.8317% |
| 16 | 徐荣兵 | 750,000 | 1.8317% |
| 17 | 嘉欣丝绸 | 376,190 | 0.9187% |
| 18 | 扬州贝果 | 342,857 | 0.8373% |
| 19 | 邱友红 | 342,857 | 0.8373% |
| 20 | 夏卫芳 | 333,335 | 0.8141% |
| 21 | 海南申宏元 | 133,333 | 0.3256% |
| 22 | 海南嘉旭 | 100,000 | 0.2442% |
| 23 | 吴铮 | 41,666 | 0.1018% |
| 24 | 远宁合丰 | 41,666 | 0.1018% |
| 合计 | | 40,945,882 | 100.00% |

3、2025年4月，发行人股份转让

2025年4月8日，海南申宏元企业管理有限公司（以下简称“海南申宏元”）与上海申宏元企业管理有限公司（以下简称“上海申宏元”）签订《股份转让协议》，约定将其持有公司133,333股股份转让给上海申宏元，转让价格为每股42.42元，转让价款合计为565.6551万元。

2025年4月24日，发行人就前述股份转让事项变更股东名册，本次股份转让完成后公司股本结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,050,000 | 36.7558% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 16.7468% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 8.3734% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 3.3494% |
| 7 | 半导体基金 | 1,371,428 | 3.3494% |
| 8 | 浙创启晨 | 1,358,824 | 3.3186% |
| 9 | 惟明投资 | 1,028,572 | 2.5120% |
| 10 | 吉六零基金 | 905,883 | 2.2124% |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|---------|
| 11 | 浙嘉产装 | 887,395 | 2.1672% |
| 12 | 浙创新兴 | 865,210 | 2.1131% |
| 13 | 何烽 | 857,143 | 2.0934% |
| 14 | 高雁峰 | 752,381 | 1.8375% |
| 15 | 杨熙春 | 750,000 | 1.8317% |
| 16 | 徐荣兵 | 750,000 | 1.8317% |
| 17 | 嘉欣丝绸 | 376,190 | 0.9187% |
| 18 | 扬州贝果 | 342,857 | 0.8373% |
| 19 | 邱友红 | 342,857 | 0.8373% |
| 20 | 夏卫芳 | 333,335 | 0.8141% |
| 21 | 上海申宏元 | 133,333 | 0.3256% |
| 22 | 海南嘉旭 | 100,000 | 0.2442% |
| 23 | 吴铮 | 41,666 | 0.1018% |
| 24 | 远宁合丰 | 41,666 | 0.1018% |
| | 合计 | 40,945,882 | 100.00% |

4、2025年11月，发行人股份转让

2025年11月，半导体基金、上海申宏元决定退出投资，杭州远宁之鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远宁之鑫”）、杭州科祥股权投资有限公司（以下简称“杭州科祥”）、远宁合丰、夏卫芳、陈伟、闵诗阳、原永丹、陈莉莉等看好公司未来发展，有意持有或增持公司股份，综合考虑公司行业、经营业绩、资产规模等因素，双方协商确定以公司整体估值17.50亿元作价。

2025年11月10日，半导体基金与远宁之鑫、杭州科祥、远宁合丰、夏卫芳、陈伟、闵诗阳、原永丹签订《股份转让协议》，约定将其持有公司1,371,428股股份以每股42.7393元的价格转让给上述7名受让人，其中远宁之鑫受让505,115股、杭州科祥受让225,909股、远宁合丰受让225,909股、夏卫芳受让225,909股、陈伟受让112,954股、闵诗阳受让45,182股、原永丹受让30,450股。

2025年11月10日，上海申宏元与原永丹、陈莉莉签订《股份转让协议》，约定将其持有公司133,333股股份以每股42.7393元的价格转让给上述2名受让人，其中原永丹受让99,447股、陈莉莉受让33,886股。

2025年11月24日，发行人就前述股份转让事项变更股东名册，上述股份转让完成后，公司股本结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,050,000 | 36.7558% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 16.7468% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 8.3734% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 3.3494% |
| 7 | 浙创启晨 | 1,358,824 | 3.3186% |
| 8 | 惟明投资 | 1,028,572 | 2.5120% |
| 9 | 吉六零基金 | 905,883 | 2.2124% |
| 10 | 浙嘉产装 | 887,395 | 2.1672% |
| 11 | 浙创新兴 | 865,210 | 2.1131% |
| 12 | 何烽 | 857,143 | 2.0934% |
| 13 | 高雁峰 | 752,381 | 1.8375% |
| 14 | 杨熙春 | 750,000 | 1.8317% |
| 15 | 徐荣兵 | 750,000 | 1.8317% |
| 16 | 夏卫芳 | 559,244 | 1.3658% |
| 17 | 远宁之鑫 | 505,115 | 1.2336% |
| 18 | 嘉欣丝绸 | 376,190 | 0.9187% |
| 19 | 扬州贝果 | 342,857 | 0.8373% |
| 20 | 邱友红 | 342,857 | 0.8373% |
| 21 | 远宁合丰 | 267,575 | 0.6535% |
| 22 | 杭州科祥 | 225,909 | 0.5517% |
| 23 | 原永丹 | 129,897 | 0.3172% |
| 24 | 陈伟 | 112,954 | 0.2759% |
| 25 | 海南嘉旭 | 100,000 | 0.2442% |
| 26 | 闵诗阳 | 45,182 | 0.1104% |
| 27 | 吴铮 | 41,666 | 0.1018% |
| 28 | 陈莉莉 | 33,886 | 0.0828% |
| | 合计 | 40,945,882 | 100.00% |

5、2026年2月，发行人股份转让

2026年1月，惟明投资、海南嘉旭综合考虑投资策略、投资收益、持有时间等因素决定退出投资，远宁之鑫、杭州科祥、远宁合丰、夏卫芳、陈伟、闵诗阳、原永丹、陈莉莉等投资人看好公司未来发展，有意增持公司股份，综合考虑公司行业、经营业绩、资产规模等因素，双方协商确定以公司整体估值25.00亿元作价。

2026年1月29日，惟明投资与远宁之鑫、杭州科祥、远宁合丰、夏卫芳、陈伟、闵诗阳、原永丹签订《股份转让协议》，约定将其持有公司1,028,572股股份以每股61.0562元的价格转让给上述7名受让人，其中远宁之鑫受让378,839股、杭州科祥受让169,431股、远宁合丰受让169,431股、夏卫芳受让169,431股、陈伟受让84,716股、闵诗阳受让33,886股、原永丹受让22,838股。

2026年1月29日，海南嘉旭与原永丹、陈莉莉签订《股份转让协议》，约定将其持有公司100,000股股份以每股61.0562元的价格转让给上述2名受让人，其中原永丹受让74,585股、陈莉莉受让25,415股。

2026年2月26日，发行人就前述股份转让事项变更股东名册，上述股份转让完成后，公司股本结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,050,000 | 36.7558% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 16.7468% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 8.3734% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 3.3494% |
| 7 | 浙创启晨 | 1,358,824 | 3.3186% |
| 8 | 吉六零基金 | 905,883 | 2.2124% |
| 9 | 浙嘉产装 | 887,395 | 2.1672% |
| 10 | 远宁之鑫 | 883,954 | 2.1588% |
| 11 | 浙创新兴 | 865,210 | 2.1131% |
| 12 | 何烽 | 857,143 | 2.0934% |
| 13 | 高雁峰 | 752,381 | 1.8375% |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|-------------------|----------------|
| 14 | 杨熙春 | 750,000 | 1.8317% |
| 15 | 徐荣兵 | 750,000 | 1.8317% |
| 16 | 夏卫芳 | 728,675 | 1.7796% |
| 17 | 远宁合丰 | 437,006 | 1.0673% |
| 18 | 杭州科祥 | 395,340 | 0.9655% |
| 19 | 嘉欣丝绸 | 376,190 | 0.9187% |
| 20 | 扬州贝果 | 342,857 | 0.8373% |
| 21 | 邱友红 | 342,857 | 0.8373% |
| 22 | 原永丹 | 227,320 | 0.5552% |
| 23 | 陈伟 | 197,670 | 0.4828% |
| 24 | 闵诗阳 | 79,068 | 0.1931% |
| 25 | 陈莉莉 | 59,301 | 0.1448% |
| 26 | 吴铮 | 41,666 | 0.1018% |
| 合计 | | 40,945,882 | 100.00% |

（四）特殊权利条款及清理情况

2020年12月25日，金连接有限与当时的相关股东签署了《关于浙江金连接科技有限公司之投资协议》（以下简称《A轮投资协议》），基于《A轮投资协议》，A轮投资方远宁奕鑫、何烽享有优先认购权、优先购买权、随售权、反稀释权、知情权、建议权、优先清算权、回购请求权等股东特别权利，及其他保护性权利（包括针对部分股东会审议事项的否决权、针对部分董事会审议事项A轮投资方委派董事的否决权等）。

2021年12月17日，发行人与当时的相关股东签署了《关于浙江金连接科技有限公司之投资协议》（以下简称《B轮投资协议》），基于《B轮投资协议》，B轮投资方半导体基金、惟明投资、高雁峰、嘉欣丝绸享有优先认购权、优先购买权、随售权、反稀释权、知情权、建议权、优先清算权、回购请求权等股东特别权利，及其他保护性权利（包括针对公司部分事项的否决权等）。（《A轮投资协议》《B轮投资协议》合称为《投资协议》）

2022年12月29日，发行人与发行人当时全体股东共同签署了《有关浙江金连接科技股份有限公司之投资协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），对前述相关股东特别权利条款进行了清理，主要约定如下：

“在不影响附件股本结构的前提下，各方一致同意，《A轮投资协议》第6.1.3条（董事会一票否决权）、第7.1条（优先认购权）、第7.2条（优先购买权和随售权）、第7.3条（反稀释权）、第7.4条（知情权及建议权）、第7.5条（优先清算权）、第8条（经营目标及业绩承诺）、第9条（回购请求权）、第10条（参与上市公司并购重组）；及《B轮投资协议》第6.1.3条（董事会一票否决权）、第7.1条（优先认购权）、第7.2条（优先购买权和随售权）、第7.3条（反稀释权）、第7.4条（知情权及建议权）、第7.5条（优先清算权）、第7.6条（解散及清算义务）、第7.8条（最惠国待遇）、第8条（经营目标及业绩承诺）、第9条（回购请求权）、第10条（参与上市公司并购重组）；以及《投资协议》项下任何其他有违‘同股同权’要求并可能构成公司首次公开发行股票并上市的实质法律障碍或对公司上市进程造成重大不利影响的条款将于本补充协议签署之日起不可撤销、不可恢复地终止且应视为自始无效。公司董事会组成、董事会及股东大会议事规则等公司治理及经营管理事项均应以公司章程约定为准。在任何情形下，投资方不会基于《投资协议》中的上述条款向公司主张任何权利。此外，各方同意并确认，各方之间不存在、也不会单独或共同地另行达成与前述《投资协议》原条款所涉的任何特别权利安排相同或类似的其他安排，各方将遵循并根据法律、法规、规章、规范性文件和浙江金连接公司章程的规定享有相应权利和承担相应义务。”“任意一方均不存在违反《投资协议》项下约定的情形，《投资协议》的履行以及本补充协议相关事项也不存在任何争议、纠纷，各方亦不会就此向其他方追究任何违约责任或其他法律责任。”

2022年12月29日至本招股说明书签署日，发行人及其实际控制人未再签署其他给予股东特殊权利的协议。

截至本招股说明书签署日，发行人股东特殊权利条款已全部清理并自始无效，且回售责任“自始无效”相关协议签订日在财务报告出具日之前，上述协议中股东特殊权利条款的清理方案满足《监管规则适用指引——发行类第4号》的要求，符合科创板发行上市相关规则。

（五）发行人历史上的股权代持及解除情况

金连接有限设立后，发行人实际控制人曹镭因个人资金需求拟转让少量股权。黄湘萍在综合考虑公司行业、经营业绩、未来发展潜力等因素后，决定受让部分

曹锺拟转让的股权。黄湘萍家庭内部商量后安排其配偶的母亲张钰菊代为受让并持有金连接有限股权。2018年7月，曹锺将其持有的金连接有限75.00万元出资额转让给张钰菊。

2021年8月，张钰菊与黄湘萍之间拟通过股权转让的形式实现代持股权还原，黄湘萍指示名义股东张钰菊将其持有的金连接有限75.00万元出资额转让给她配偶孙宏，再由孙宏将前述所受让股权转让给黄湘萍，至此前述股权代持解除。

2021年12月，金连接有限整体变更为股份公司，黄湘萍所持75.00万元出资额折算为公司75.00万股股份。

2022年11月，黄湘萍将其所持75.00万股股份转让给有宁投资、海南申宏元、海南嘉旭、高雁峰、嘉兴丝绸等5名投资人，本次转让完成后，黄湘萍不再持有公司股份。

三、发行人成立以来的重大事件（含报告期内重大资产重组）

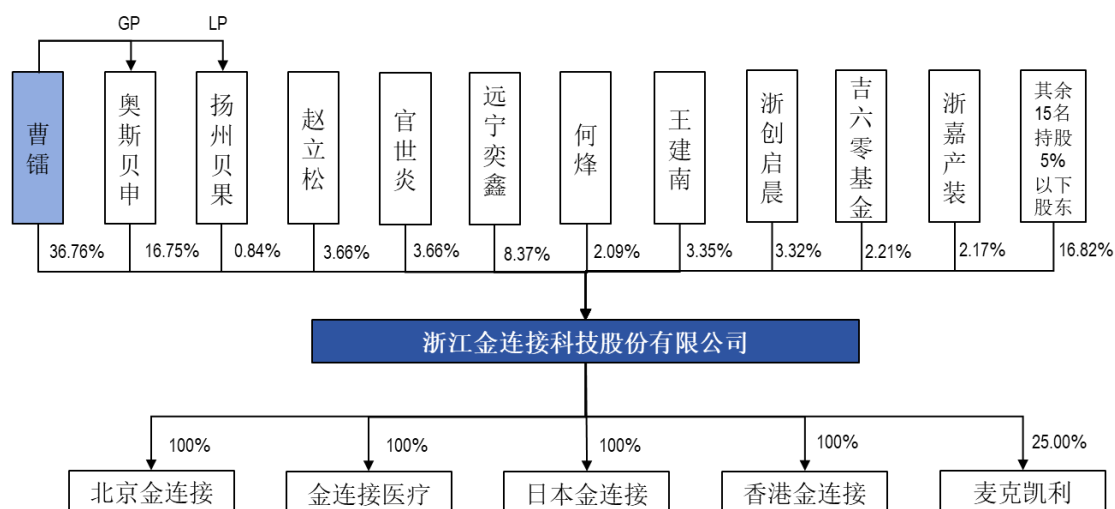
发行人成立以来，未曾发生重大资产重组等重要事件。

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。

五、发行人的股权结构图

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下图所示：



六、发行人控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 4 家全资子公司，1 家参股公司，具体情况如下：

（一）控股子公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 4 家全资子公司，具体情况如下：

1、北京金连接

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| 公司名称 | 北京金连接科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 1998 年 12 月 21 日 | | |
| 法定代表人 | 曹镭 | | |
| 注册资本 | 400 万元 | 实收资本 | 400 万元 |
| 注册地/主要生产经营地 | 北京市海淀区中关村大街 27 号 11 层 | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| | 浙江金连接科技股份有限公司 | 400.00 | 100.00% |
| | 合计 | 400.00 | 100.00% |
| 控制情况 | 发行人控制 | | |
| 主营业务 | 射频互连部件的销售 | | |
| 在发行人业务板块中定位 | 发行人从事射频互连部件销售的子公司 | | |
| 2025 年末/2025 年度 | | | |
| 总资产（万元） | 486.88 | 净资产（万元） | 411.20 |
| 营业收入（万元） | 292.96 | 净利润（万元） | -32.74 |
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |

2、日本金连接

| | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 公司名称 | ゴールドリンク株式会社 | | |
| 成立时间 | 2021 年 11 月 18 日 | | |
| 注册资本 | 26,500 万日元 | 实收资本 | 26,500 万日元 |
| 注册地/主要生产经营地 | 东京都港区新桥四丁目 21 番 3 号新桥东急大楼 2 楼 | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额（万日元） | 出资比例 |
| | 浙江金连接科技股份有限公司 | 26,500.00 | 100.00% |
| | 合计 | 26,500.00 | 100.00% |
| 控制情况 | 发行人控制 | | |

| | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------|----------|
| 主营业务 | 半导体测试探针零件的研发、生产和销售 | | |
| 在发行人业务板块中定位 | 负责探针弹簧、探针套筒的研发、生产和销售，与发行人形成业务协同 | | |
| 2025 年末/2025 年度 | | | |
| 总资产（万元） | 2,030.12 | 净资产（万元） | 1,282.52 |
| 营业收入（万元） | 795.07 | 净利润（万元） | -831.70 |
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |

3、香港金连接

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 公司名称 | 香港金连接科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 2024 年 12 月 27 日 | | |
| 注册资本 | 3,000 万港元 | 实收资本 | 3,000 万港元 |
| 注册地/主要生产经营地 | 香港新界葵涌青山公路 585-609 号嘉民葵涌物流中心 2 楼 A 座 | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额(万港元) | 出资比例 |
| | 浙江金连接科技股份有限公司 | 3,000.00 | 100.00% |
| | 合计 | 3,000.00 | 100.00% |
| 控制情况 | 发行人控制 | | |
| 主营业务 | 金属棒材的生产、销售 | | |
| 在发行人业务板块中定位 | 负责金属棒材的研发、生产和销售，与发行人形成业务协同 | | |
| 2025 年末/2025 年度 | | | |
| 总资产（万元） | 2,952.52 | 净资产（万元） | 2,688.82 |
| 营业收入（万元） | 625.12 | 净利润（万元） | -21.11 |
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |

4、金连接医疗

| | | | |
|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 公司名称 | 浙江金连接医疗器械有限公司 | | |
| 成立时间 | 2026 年 1 月 21 日 | | |
| 注册资本 | 5,000 万元 | 实收资本 | 0 万元 |
| 注册地/主要生产经营地 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉北街道华云路 111 号南楼二层 | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| | 浙江金连接科技股份有限公司 | 5,000.00 | 100.00% |
| | 合计 | 5,000.00 | 100.00% |
| 控制情况 | 发行人控制 | | |
| 主营业务 | 医疗器械精密零件的研发、生产和销售 | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------|---|
| 在发行人业务板块中定位 | 负责医疗器械精密零部件的研发、生产和销售，拓展发行人产品矩阵 | | |
| 2025 年末/2025 年度 | | | |
| 总资产（万元） | - | 净资产（万元） | - |
| 营业收入（万元） | - | 净利润（万元） | - |
| 审计机构 | - | | |

（二）参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人有 1 家参股公司，具体情况如下：

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 公司名称 | 成都麦克凯利科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 2022 年 1 月 13 日 | | |
| 法定代表人 | 张刚 | | |
| 注册资本 | 714.2857 万元 | 实收资本 | 314.2857 万元 |
| 注册地/主要生产经营地 | 四川省成都市金堂县白果街道绍元路 8 号 | | |
| 股权结构 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| | 张刚 | 450.0000 | 63.00% |
| | 浙江金连接科技股份有限公司 | 178.5714 | 25.00% |
| | 成都凡铖企业管理合伙企业（有限合伙） | 50.0000 | 7.00% |
| | 刘伟坚 | 35.7143 | 5.00% |
| | 合计 | 714.2857 | 100.00% |
| 控制情况 | 发行人未取得其控制权，但可对其施加重大影响 | | |
| 主营业务 | 精密金属管的研发、生产和销售 | | |
| 在发行人业务板块中定位 | 负责精密金属管的研发、生产、销售，与发行人产品形成协同效应 | | |
| 2025 年末/2025 年度 | | | |
| 总资产（万元） | 1,929.32 | 净资产（万元） | 1,323.68 |
| 营业收入（万元） | 2,649.45 | 净利润（万元） | 477.55 |
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |

七、持有 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人为曹镭先生。曹镭先生直接持有发行人 36.7558% 股份；通过员工持股平台奥斯贝申控制发行人 16.7468% 股权，通过扬州贝果控制发行人 0.8373% 股权，合计实际控制发行人 54.34%

股权。目前，曹镭担任金连接董事长、总经理。

曹镭先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号110108196112*****。

（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或者间接持有的公司的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

1、嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业（有限合伙）

截至本招股说明书签署日，奥斯贝申持有公司6,857,143股股份，持股比例为16.7468%。奥斯贝申的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330402MA2LBC9K3L |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立时间 | 2021年8月18日 |
| 住所 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼175室-2 |
| 执行事务合伙人 | 曹镭 |
| 出资额 | 1,400万元 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

截至本招股说明书签署日，奥斯贝申的出资比例情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 是否为公司员工 | 合伙人类别 |
|----|-------|----------|----------|---------|-------|
| 1 | 曹镭 | 124.8333 | 8.9167% | 是 | 普通合伙人 |
| 2 | 李红 | 153.1250 | 10.9375% | 是 | 有限合伙人 |
| 3 | 戴念念 | 153.1250 | 10.9375% | 是，已退休离职 | 有限合伙人 |
| 4 | 李云峰 | 137.8125 | 9.8438% | 是 | 有限合伙人 |
| 5 | 韩广秀 | 137.8125 | 9.8438% | 是 | 有限合伙人 |
| 6 | 郑宽蘋 | 122.5000 | 8.7500% | 是 | 有限合伙人 |
| 7 | 刘涛 | 122.5000 | 8.7500% | 是 | 有限合伙人 |
| 8 | 王京松 | 76.5625 | 5.4688% | 是 | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 是否为公司员工 | 合伙人类别 |
|----|-------|----------|---------|---------|-------|
| 9 | 俞晓静 | 70.0000 | 5.0000% | 是 | 有限合伙人 |
| 10 | 戴忠琴 | 61.2500 | 4.3750% | 是，已退休离职 | 有限合伙人 |
| 11 | 袁玉兰 | 35.0000 | 2.5000% | 是 | 有限合伙人 |
| 12 | 蒲坤 | 35.0000 | 2.5000% | 是 | 有限合伙人 |
| 13 | 张宝娟 | 30.6250 | 2.1875% | 是 | 有限合伙人 |
| 14 | 胡雪芬 | 30.6250 | 2.1875% | 是 | 有限合伙人 |
| 15 | 张莹 | 30.6250 | 2.1875% | 是 | 有限合伙人 |
| 16 | 殷骏 | 15.3125 | 1.0938% | 是 | 有限合伙人 |
| 17 | 马连兵 | 15.3125 | 1.0938% | 是 | 有限合伙人 |
| 18 | 霍苗 | 15.3125 | 1.0938% | 是 | 有限合伙人 |
| 19 | 李婧 | 15.3125 | 1.0938% | 是 | 有限合伙人 |
| 20 | 郑仲国 | 15.3125 | 1.0938% | 是 | 有限合伙人 |
| 21 | 骆爱群 | 2.0417 | 0.1458% | 是 | 有限合伙人 |
| 合计 | | 1,400.00 | 100.00% | / | / |

2、杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

截至本招股说明书签署日，远宁奕鑫持有公司 3,428,571 股股份，持股比例为 8.3734%。远宁奕鑫的基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330102MA2J224423 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立时间 | 2020 年 10 月 15 日 |
| 住所 | 浙江省杭州市上城区甘水巷 46 号 217 室 |
| 执行事务合伙人 | 杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙） |
| 出资额 | 48,100 万元 |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

截至本招股说明书签署日，远宁奕鑫的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 合伙人类别 |
|----|----------|----------|---------|-------|
| 1 | 远宁荟智 | 100.00 | 0.2079% | 普通合伙人 |
| 2 | 陈伟 | 4,800.00 | 9.9792% | 有限合伙人 |
| 3 | 胡建东 | 4,800.00 | 9.9792% | 有限合伙人 |
| 4 | 陈云龙 | 3,200.00 | 6.6528% | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 合伙人类别 |
|----|----------------|-----------|---------|-------|
| 5 | 陈密 | 3,200.00 | 6.6528% | 有限合伙人 |
| 6 | 黄剑震 | 2,800.00 | 5.8212% | 有限合伙人 |
| 7 | 张世杰 | 2,000.00 | 4.1580% | 有限合伙人 |
| 8 | 赵宁 | 2,000.00 | 4.1580% | 有限合伙人 |
| 9 | 徐永忠 | 2,000.00 | 4.1580% | 有限合伙人 |
| 10 | 陈芳珍 | 1,600.00 | 3.3264% | 有限合伙人 |
| 11 | 王鹏 | 1,600.00 | 3.3264% | 有限合伙人 |
| 12 | 许秀红 | 1,600.00 | 3.3264% | 有限合伙人 |
| 13 | 李晓芳 | 1,600.00 | 3.3264% | 有限合伙人 |
| 14 | 王立峰 | 1,600.00 | 3.3264% | 有限合伙人 |
| 15 | 黄炳庚 | 1,600.00 | 3.3264% | 有限合伙人 |
| 16 | 蒋来根 | 1,600.00 | 3.3264% | 有限合伙人 |
| 17 | 山松涛 | 1,280.00 | 2.6611% | 有限合伙人 |
| 18 | 骆美英 | 1,200.00 | 2.4948% | 有限合伙人 |
| 19 | 宋晓波 | 1,200.00 | 2.4948% | 有限合伙人 |
| 20 | 虞雅利 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 21 | 陈珍荣 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 22 | 温相和 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 23 | 何若虚 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 24 | 童云洪 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 25 | 娄震 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 26 | 潘春江 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 27 | 李宇锋 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 38 | 杭州远宁投资管理有限公司 | 800.00 | 1.6632% | 有限合伙人 |
| 29 | 蒋丞涛 | 400.00 | 0.8316% | 有限合伙人 |
| 30 | 北京瑞福私募基金管理有限公司 | 400.00 | 0.8316% | 有限合伙人 |
| 31 | 金力 | 320.00 | 0.6653% | 有限合伙人 |
| 合计 | | 48,100.00 | 100.00% | / |

3、何烽

截至本招股说明书签署日，金连接股东何烽直接持有发行人 2.0934%股份；其控制的杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）系发行人股东远宁奕鑫、远宁之鑫的执行事务合伙人，远宁奕鑫持有发行人 8.3734%股份，远宁之鑫持有

发行人 2.1588%股份；何烽持有发行人股东远宁合丰 99.00%出资额，并为远宁合丰之执行事务合伙人远宁投资的实际控制人，远宁合丰持有发行人 1.0673%股份。综上，何烽实际控制发行人 13.6929%股份表决权。

何烽先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 310110197312*****。

4、浙创启晨、浙创新兴

截至本招股说明书签署日，浙创启晨持有发行人 3.3186%股份，浙创新兴持有发行人 2.1131%股份，上述两股东合计持有发行人 5.4316%股份。浙创启晨、浙创新兴为私募投资基金，其私募基金管理人均为浙江省创业投资集团有限公司。

截至本招股说明书签署日，浙创启晨的基本情况如下：

| | | | | |
|----------|---|-------|-------------|----------|
| 企业名称 | 杭州浙创启晨科技创新股权投资合伙企业（有限合伙） | | | |
| 统一社会信用代码 | 91330106MACJDCCR7T | | | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 | | | |
| 住所 | 浙江省杭州市西湖区教工路 198 号 9 幢 1 层 122 室 | | | |
| 执行事务合伙人 | 浙江省创业投资集团有限公司 | | | |
| 出资总额 | 59,689.272216 万元 | | | |
| 合伙人及出资比例 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类别 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| | 浙江省创业投资集团有限公司 | 普通合伙人 | 99.3166 | 0.1664% |
| | 杭州浙发秋实股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 23,835.9824 | 39.9334% |
| | 浙江浙盐控股有限公司 | 有限合伙人 | 19,863.3184 | 33.2779% |
| | 杭州资证富浙股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 9,931.6594 | 16.6389% |
| | 桐乡市磊鸿酒店管理有限公司 | 有限合伙人 | 1,986.3318 | 3.3278% |
| | 陈卫通 | 有限合伙人 | 993.1659 | 1.6639% |
| | 海南锐华投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 993.1659 | 1.6639% |
| | 嘉兴楨安股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 993.1659 | 1.6639% |
| | 浙江中晖实业投资有限公司 | 有限合伙人 | 993.1659 | 1.6639% |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | |
| 成立日期 | 2023 年 5 月 18 日 | | | |

| | |
|------|---------------|
| 经营期限 | 无固定期限 |
| 登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局 |

截至本招股说明书签署日，浙创新兴的基本情况如下：

| | | | | |
|----------|---|-------|-----------|----------|
| 企业名称 | 平湖市浙创新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙） | | | |
| 统一社会信用代码 | 91330482MAE2RE6N6J | | | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 | | | |
| 住所 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海港路 1333 号 6 号楼 212 室 | | | |
| 执行事务合伙人 | 浙江省创业投资集团有限公司 | | | |
| 出资总额 | 50,100.00 万元 | | | |
| 合伙人及出资比例 | 合伙人名称 | 合伙人类别 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| | 浙江省创业投资集团有限公司 | 普通合伙人 | 100.00 | 0.1996% |
| | 浙江省国有资本运营有限公司 | 有限合伙人 | 24,900.00 | 49.7006% |
| | 平湖市鑫翼东湖创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 12,500.00 | 24.9501% |
| | 长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 9,900.00 | 19.7605% |
| | 平湖金港股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 2,500.00 | 4.9900% |
| | 浙江嘉创盛宇资产管理有限公司 | 有限合伙人 | 200.00 | 0.3992% |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | |
| 成立日期 | 2024 年 10 月 14 日 | | | |
| 经营期限 | 至 2034 年 10 月 13 日 | | | |
| 登记机关 | 平湖市市场监督管理局 | | | |

八、发行人特别表决权股份情况

截至本招股说明书签署日，公司无特别表决权股份或类似安排的情况。

九、发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，公司无协议控制架构情况。

十、控股股东、实际控制人报告期内的合法合规情况

报告期内，控股股东、实际控制人曹镭先生不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信

息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十一、发行人股本情况

（一）本次发行前的股本情况

本次发行前公司的总股本为 40,945,882 股，本次拟公开发行人民币普通股不超过 13,650,000 股，本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例不低于 25%。

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|----------|
| 1 | 曹镭 | 15,050,000 | 36.7558% |
| 2 | 奥斯贝申 | 6,857,143 | 16.7468% |
| 3 | 远宁奕鑫 | 3,428,571 | 8.3734% |
| 4 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 5 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 6 | 王建南 | 1,371,428 | 3.3494% |
| 7 | 浙创启晨 | 1,358,824 | 3.3186% |
| 8 | 吉六零基金 | 905,883 | 2.2124% |
| 9 | 浙嘉产装 | 887,395 | 2.1672% |
| 10 | 远宁之鑫 | 883,954 | 2.1588% |
| 合计 | | 33,743,198 | 82.4092% |

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况

本次发行前，公司前十名自然人股东持股及任职情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | 任职情况 |
|----|------|------------|----------|-----------|
| 1 | 曹镭 | 15,050,000 | 36.7558% | 董事长、总经理 |
| 2 | 赵立松 | 1,500,000 | 3.6634% | 副董事长、副总经理 |
| 3 | 官世炎 | 1,500,000 | 3.6634% | 副董事长、副总经理 |
| 4 | 王建南 | 1,371,428 | 3.3494% | 无 |
| 5 | 何烽 | 857,143 | 2.0934% | 无 |
| 6 | 高雁峰 | 752,381 | 1.8375% | 无 |
| 7 | 杨熙春 | 750,000 | 1.8317% | 无 |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | 任职情况 |
|----|------|------------|----------|------|
| 8 | 徐荣兵 | 750,000 | 1.8317% | 无 |
| 9 | 夏卫芳 | 728,675 | 1.7796% | 无 |
| 10 | 邱友红 | 342,857 | 0.8373% | 无 |
| 合计 | | 23,602,484 | 57.6432% | / |

（四）发行人国有股东或外资股东的持股情况

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）等规定，截至本招股说明书签署日，发行人股东中不存在需标注为“SS”或“CS”的国有股东。

截至本招股说明书签署日，发行人股东中不存在外资股东。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

1、新增股东的基本情况

申报前十二个月，发行人新增股东为远宁之鑫、杭州科祥、陈伟、闵诗阳、原永丹、陈莉莉。此外，远宁合丰、夏卫芳为申报前十二个月之前即持有发行人股份的股东，在申报前十二个月通过受让股份而增持发行人股份。

上述新增股东的入股原因、入股价格和定价依据详见本节“二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“（三）报告期内股本、股东变化情况”。上述新增股东入股均具有真实、合理的背景，系各方真实意思表示，入股价格的定价公允，具有合理性。

上述新增股东的基本情况如下：

（1）远宁之鑫

| | | | | |
|----------|----------------------|-------|---------|---------|
| 企业名称 | 杭州远宁之鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | | | |
| 统一社会信用代码 | 91330102MAEXH0XQ8L | | | |
| 企业类型 | 有限合伙企业 | | | |
| 住所 | 浙江省杭州市上城区甘水巷46号219室 | | | |
| 执行事务合伙人 | 杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙） | | | |
| 出资总额 | 4,510.00 万元 | | | |
| 合伙人及出资比例 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类别 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| | 远宁荟智 | 普通合伙人 | 10.00 | 0.2217% |

| | | | | |
|------|---|-------|----------|----------|
| | 胡建东 | 有限合伙人 | 2,500.00 | 55.4324% |
| | 陈密 | 有限合伙人 | 1,000.00 | 22.1729% |
| | 张运来 | 有限合伙人 | 1,000.00 | 22.1729% |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | |
| 成立日期 | 2025年9月29日 | | | |
| 经营期限 | 无固定期限 | | | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | | | |

（2）杭州科祥

| | | | |
|----------|--------------------|----------|--------|
| 公司名称 | 杭州科祥股权投资有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91330100580272634X | | |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | |
| 住所 | 浙江杭州市上城区甘水巷46号205室 | | |
| 法定代表人 | 陈伟 | | |
| 注册资本 | 4,000.00 万元 | | |
| 股东及出资比例 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 股权比例 |
| | 德清科特创业投资有限责任公司 | 1,462.00 | 36.55% |
| | 杭州远宁投资管理有限公司 | 731.20 | 18.28% |
| | 安吉柯达投资管理有限公司 | 731.20 | 18.28% |
| | 杭州余杭兴龙房地产开发有限公司 | 365.60 | 9.14% |
| | 杭州雷米电子有限公司 | 365.60 | 9.14% |
| | 陈伟 | 138.00 | 3.45% |
| | 阮正富 | 68.80 | 1.72% |
| | 何烽 | 68.80 | 1.72% |
| | 陈云龙 | 34.40 | 0.86% |
| 徐永忠 | 34.40 | 0.86% | |
| 经营范围 | 股权投资。 | | |
| 成立日期 | 2011年8月24日 | | |
| 经营期限 | 无固定期限 | | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | | |

（3）远宁合丰

| | |
|----------|----------------------|
| 企业名称 | 杭州远宁合丰企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330102MA27WLE757 |

| | | | | |
|----------|---|-------|----------|--------|
| 企业类型 | 有限合伙企业 | | | |
| 住所 | 浙江杭州市上城区甘水巷46号202室 | | | |
| 执行事务合伙人 | 杭州远宁投资管理有限公司 | | | |
| 出资额 | 1,500.00 万元 | | | |
| 合伙人及出资比例 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类别 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| | 何烽 | 有限合伙人 | 1,485.00 | 99.00% |
| | 杭州远宁投资管理有 限公司 | 普通合伙人 | 15.00 | 1.00% |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | | |
| 成立日期 | 2015年12月30日 | | | |
| 经营期限 | 无固定期限 | | | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | | | |

（4）夏卫芳

夏卫芳，中国国籍，无境外居留权，身份证号 3307221972*****。

（5）陈伟

陈伟，中国国籍，无境外居留权，身份证号 3301051977*****。

（6）闵诗阳

闵诗阳，中国国籍，无境外居留权，身份证号 3305011977*****。

（7）原永丹

原永丹，中国国籍，无境外居留权，身份证号 3710821978*****。

（8）陈莉莉

陈莉莉，中国国籍，无境外居留权，身份证号 6528231971*****。

2、新增股东与发行人其他股东、董事、高级管理人员的关联关系

新增股东与发行人其他股东、董事、高级管理人员的关联关系如下：

| 新增股东 | 持股比例 | 关联股东 | 关联关系 |
|------|---------|---------|---|
| 远宁之鑫 | 2.1588% | 何烽、远宁奕鑫 | 何烽控制的远宁荟智系远宁之鑫、远宁奕鑫的执行事务合伙人 |
| 远宁合丰 | 1.0673% | 何烽 | 何烽持有远宁合丰 99.00% 财产份额，何烽控制的远宁投资系远宁合丰的执行事务合伙人 |

| 新增股东 | 持股比例 | 关联股东 | 关联关系 |
|------|---------|-----------|---|
| 杭州科祥 | 0.9655% | 陈伟、何烽 | 陈伟控制的德清科特创业投资有限责任公司持有杭州科祥 36.55%股权，陈伟持有杭州科祥 3.45%股权，何烽控制的远宁投资持有杭州科祥 18.28%股权，何烽持有杭州科祥 1.72%股权 |
| 夏卫芳 | 1.7796% | 何烽 | 远宁荟智系杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，夏卫芳为杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人 |
| 陈伟 | 0.4828% | 远宁奕鑫、杭州科祥 | 陈伟系远宁奕鑫的有限合伙人，陈伟控制的德清科特创业投资有限责任公司持有杭州科祥 36.55%股权，陈伟直接持有杭州科祥 3.45%股权 |
| 闵诗阳 | 0.1931% | 远宁奕鑫、远宁之鑫 | 闵诗阳系远宁奕鑫提名的公司董事，间接持有远宁奕鑫、远宁之鑫的执行事务合伙人远宁荟智 10.00%的财产份额 |
| 原永丹 | 0.5552% | 远宁奕鑫、远宁之鑫 | 原永丹间接持有远宁奕鑫、远宁之鑫的执行事务合伙人远宁荟智 10.00%的财产份额 |

除上述关系外，发行人的新增股东与发行人其他股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系

申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

4、新增股东是否存在股份代持情形

申报前十二个月新增股东不存在股份代持情形。

5、新增股东是否属于战略投资者

申报前十二个月新增股东不属于战略投资者。

6、新增股东股份的锁定承诺

远宁之鑫、杭州科祥、陈伟、原永丹、陈莉莉已出具《股份限制流通及自愿锁定承诺函》如下：

“自本人/本企业取得发行人股份之日（即公司股东名册变更之日）起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准），本人/本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人/本企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人/本企业同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

远宁合丰、夏卫芳已出具《股份限制流通及自愿锁定承诺函》如下：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业在发行人本次发行申报 12 个月前已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

自本人/本企业在发行人本次发行申报前 12 个月内新增取得发行人股份之日（即公司股东名册变更之日）起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准），本人/本企业不转让或者委托他人管理该等新增取得的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人/本企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人/本企业同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

闵诗阳已出具《股份限制流通及自愿锁定承诺函》如下：

“自本人取得发行人股份之日（即公司股东名册变更之日）起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准，以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人直接持有的发行人股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如遇除权除息事项，发价作相应调整，

下同）；发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在担任公司董事任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内将继续遵守前述限制。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例

截至本招股说明书签署日，发行人的现有股东之间的重要关系如下：

| 股东姓名/名称 | 持股比例 | 关联关系 |
|---------|----------|--|
| 曹镭 | 36.7558% | 曹镭系奥斯贝申的执行事务合伙人，并持有扬州贝果 99.90% 财产份额，奥斯贝申、扬州贝果为曹镭的一致行动人 |
| 奥斯贝申 | 16.7468% | |
| 扬州贝果 | 0.8373% | |
| 远宁奕鑫 | 8.3734% | 1、何烽系远宁荟智的实际控制人，闵诗阳、原永丹间接持有远宁荟智 10.00% 的财产份额，远宁荟智为远宁奕鑫、远宁之鑫的执行事务合伙人； 2、何烽持有远宁合丰 99.00% 的财产份额，何烽控制的远宁投资系远宁合丰的执行事务合伙人； 3、陈伟持有远宁奕鑫 9.9792% 的财产份额； 4、陈伟控制的德清科特创业投资有限责任公司持有杭州科祥 36.55% 股权，陈伟持有杭州科祥 3.45% 股权，何烽控制的远宁投资持有杭州科祥 18.28% 股权，何烽持有杭州科祥 1.72% 股权； 5、夏卫芳、陈伟、吴铮系杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，远宁荟智为杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人 |
| 何烽 | 2.0934% | |
| 夏卫芳 | 1.7796% | |
| 远宁之鑫 | 2.1588% | |
| 远宁合丰 | 1.0673% | |
| 杭州科祥 | 0.9655% | |
| 原永丹 | 0.5552% | |
| 陈伟 | 0.4828% | |
| 闵诗阳 | 0.1931% | |
| 吴铮 | 0.1018% | |
| 浙创启晨 | 3.3186% | 浙创启晨、浙创新兴的执行事务合伙人均为浙江省创业投资集团有限公司 |
| 浙创新兴 | 2.1131% | |

| 股东姓名/名称 | 持股比例 | 关联关系 |
|---------|---------|-----------------------|
| 王建南 | 3.3494% | 王建南系发行人实际控制人曹镭儿子配偶的舅舅 |

除上述关系外，发行人的现有股东之间不存在其他重要关系。

（七）发行人股东公开发售股份的情况

本次发行不存在发行人股东公开发售股份的情况。

（八）本次发行前发行人股东中的私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 26 名股东，其中 6 名股东属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规所规范的私募投资基金，该等股东均已完成私募投资基金备案。具体情况如下：

| 序号 | 私募投资基金名称 | 备案编号 | 基金管理人名称 |
|----|----------|--------|----------------------|
| 1 | 远宁奕鑫 | SNC127 | 杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙） |
| 2 | 浙创启晨 | SB5412 | 浙江省创业投资集团有限公司 |
| 3 | 吉六零基金 | SVJ030 | 海富产业投资基金管理有限公司 |
| 4 | 浙嘉产装 | SAAN12 | 嘉兴长投创业投资有限公司 |
| 5 | 浙创新兴 | SAQB37 | 浙江省创业投资集团有限公司 |
| 6 | 远宁之鑫 | SBJG48 | 杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙） |

发行人的其他机构股东不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，亦未委托基金管理人管理，该等股东不属于相关法律法规所规定的私募投资基金，无需进行私募投资基金备案。

十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至本招股说明书签署日，公司共有董事 7 名（其中独立董事 3 名），高级管理人员 5 名，核心技术人员 3 名，简要情况如下：

（一）董事

公司董事基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名人 | 任职期限 |
|----|-----|------|-----|------------------------------------|
| 1 | 曹镭 | 董事长 | 曹镭 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |
| 2 | 官世炎 | 副董事长 | 曹镭 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |
| 3 | 赵立松 | 副董事长 | 曹镭 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 提名人 | 任职期限 |
|----|-----|------|------|-------------------------|
| 4 | 闵诗阳 | 董事 | 远宁奕鑫 | 2021年12月19日至2027年12月18日 |
| 5 | 胡旭微 | 独立董事 | 曹镭 | 2022年8月12日至2027年12月18日 |
| 6 | 肖佳佳 | 独立董事 | 曹镭 | 2022年8月12日至2027年12月18日 |
| 7 | 陈自力 | 独立董事 | 曹镭 | 2022年8月12日至2027年12月18日 |

公司董事简历如下：

1、**曹镭**先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年7月至1985年7月，任北方交通大学（现北京交通大学）机械工程系助教；1985年7月至1987年7月，在北方交通大学经济管理系学习，并获取硕士研究生学历；1987年7月至1988年7月，任北方交通大学铁道部宏观管理与决策中心助教；1988年7月至1998年11月，任北方交通大学校办产业处职工；1998年12月至今，任北京金连接董事长、总经理；2017年7月至2021年12月，任金连接有限董事长、总经理；2021年12月至今，任公司董事长、总经理。

2、**官世炎**先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年6月至1998年9月，历任广东省深圳市宝安区西乡爱威电子厂职员、课长助理、制造部三课课长；1998年12月至2013年8月，任北京金连接线缆生产部经理；2013年8月至今，任北京金连接董事；2017年7月至2021年12月，任金连接有限副董事长、副总经理；2021年12月至今，任公司副董事长、副总经理。

3、**赵立松**先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年7月至1998年12月，任北京台皇电子有限公司职员；1998年12月至2013年8月，任北京金连接监事会主席；2013年8月至今，任北京金连接董事；2017年7月至2021年12月，任金连接有限副董事长、副总经理；2021年12月至今，任公司副董事长、副总经理。

4、**闵诗阳**先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。1999年8月至2015年11月，历任坤元资产评估有限公司项目经理、部门经理、总经理助理；2015年12月至2016年3月，任浙江聚有财金融外包服务有限公司副总裁；2016年4月至今，任杭州远宁荟智

投资管理合伙企业（普通合伙）合规风控负责人；2021年8月至今，任公司董事。

5、胡旭微女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。1989年1月至2024年11月，任浙江理工大学经济管理学院会计学教授；2005年11月至2015年9月，任浙江理工大学经济管理学院副院长；2022年11月至今，任远信工业股份有限公司独立董事，2022年8月至今，任公司独立董事。

6、肖佳佳女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2014年1月，历任浙江凯麦律师事务所律师、主办律师；2014年1月至2024年2月，历任北京观韬中茂（杭州）律师事务所主办律师、合伙人；2024年3月至今，任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合伙人；2022年10月至今，任贝达药业股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任银都餐饮设备股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任公司独立董事。

7、陈自力先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1983年8月至1988年8月，任中国矿业大学矿机系讲师；1988年9月至1991年1月，在中国矿业大学北京研究生部读研，并获取工学硕士学位；1991年1月至1995年12月，任煤炭工业部生产司工程师；1996年4月至1999年3月，在丰桥技术科学大学留学，并获取工学博士学位；1999年4月至2001年3月，任中部电力株式会社职员；2001年5月至2004年12月，任中国国际经济咨询有限公司高级咨询师；2004年12月至2010年10月，任中和住信咨询（北京）有限公司董事、副总经理；2010年1月至今，任科信力环保技术（北京）有限公司董事长、经理；2022年8月至今，任公司独立董事。

（二）审计委员会委员

报告期内，公司设置了监事会，监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事。2025年10月，公司召开了2025年第一次临时股东大会，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司审计委员会委员的基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|-----------|
| 1 | 胡旭微 | 审计委员会主任委员 |
| 2 | 陈自力 | 审计委员会委员 |
| 3 | 闵诗阳 | 审计委员会委员 |

上述各位审计委员会委员的简历参见本节之“十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事”。

（三）高级管理人员

公司共有 5 名高级管理人员，其基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职期限 |
|----|-----|-------|------------------------------------|
| 1 | 曹镭 | 总经理 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |
| 2 | 官世炎 | 副总经理 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |
| 3 | 赵立松 | 副总经理 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |
| 4 | 袁玉兰 | 董事会秘书 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |
| 5 | 俞晓静 | 财务总监 | 2021 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 18 日 |

公司高级管理人员简历如下：

1、**曹镭**先生，简历参见本节之“十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事”。

2、**官世炎**先生，简历参见本节之“十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事”。

3、**赵立松**先生，简历参见本节之“十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事”。

4、**袁玉兰**女士，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 8 月至 2016 年 12 月，任嘉兴市开明中学团委书记、年级组长；2017 年 1 月至 2020 年 10 月，任嘉兴经济技术开发区制造业招商局项目经理；2020 年 10 月至 2021 年 5 月，任敏实集团总工会主席、公共关系经理；2021 年 6 月至今，任公司董事会秘书。

5、**俞晓静**女士，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1997 年 10 月至 2003 年 12 月，任嘉兴银行股份有限公司记账会计；

2004年1月至2005年11月，任好又多百货有限公司总账会计；2005年12月至2010年8月，任嘉兴红忠精工有限公司成本会计；2010年9月至2016年10月，任嘉兴红忠钢板加工有限公司成本会计；2016年11月至2018年1月，任浙江兴土桥梁临时钢结构工程有限公司成本会计；2018年2月至今，任公司财务总监。

（四）核心技术人员

公司共有3名核心技术人员，其基本情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|------------|
| 1 | 曹镭 | 董事长、总经理 |
| 2 | 王京松 | 研发中心总监 |
| 3 | 李云峰 | 精密加工事业部总经理 |

公司核心技术人员简历如下：

1、曹镭先生，简历参见本节之“十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事”。

2、王京松先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年12月，任罗森伯格亚太电子有限公司职工；2005年1月至2017年7月，任北京金连接技术主管；2017年8月至今，任公司研发中心总监；2021年12月至2025年10月，任公司监事。

3、李云峰先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月至2000年12月，任北京通州米伦铸件厂职工；2001年1月至2004年10月，任罗森伯格亚太电子有限公司工段长；2004年11月至2017年7月，任北京金连接机加工部经理；2017年7月至今，任公司精密加工事业部总经理。

（五）董事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况（在发行人及子公司的任职除外）如下：

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 兼职单位 | 在兼职单位职务 | 兼职单位与发行人的关系 |
|----|----|---------|------|---------|-------------|
| 1 | 曹镭 | 董事长、总经理 | 奥斯贝申 | 执行事务合伙人 | 发行人股东 |

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 兼职单位 | 在兼职单位职务 | 兼职单位与发行人的关系 |
|----|-----|------|----------------------|---------|------------------------|
| 2 | 闵诗阳 | 董事 | 杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙） | 合规风控负责人 | 发行人董事闵诗阳担任高级管理人员的企业 |
| | | | 上海万位数字技术股份有限公司 | 董事 | 发行人董事闵诗阳担任董事的公司 |
| | | | 杭州君岭教育科技股份有限公司 | 董事 | |
| | | | 杭州当虹科技股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | | 广东通元精密电路有限公司 | 董事 | |
| 3 | 胡旭微 | 独立董事 | 远信工业股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
| 4 | 肖佳佳 | 独立董事 | 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 | 合伙人 | 无关联关系 |
| | | | 银都餐饮设备股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | | 贝达药业股份有限公司 | 独立董事 | |
| 5 | 陈自力 | 独立董事 | 科信力环保技术（北京）有限公司 | 董事、总经理 | 发行人独立董事陈自力担任董事长、总经理的公司 |
| | | | 科理浩鸿（聊城）环保科技有限公司 | 执行董事 | 发行人独立董事陈自力担任执行董事的公司 |

（六）董事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

（七）最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

十三、发行人与董事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况

（一）董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议情况

公司与在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心技术人员签订了劳动合同（或劳务合同）、保密协议、竞业限制协议，与独

立董事签订了聘任协议。此外，在奥斯贝申担任合伙人的董事、高级管理人员和核心技术人员签订了《嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。截至本招股说明书签署日，上述协议履行情况正常，不存在违约情形。

除上述协议外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

（二）重要承诺

公司董事、高级管理人员及核心技术人员的重要承诺请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”。

十四、公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

（一）直接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下：

| 姓名 | 公司职务或与董事、高级管理人员、核心技术人员的关系 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|-----|---------------------------|------------|----------|
| 曹镭 | 公司董事长、总经理 | 15,050,000 | 36.7558% |
| 官世炎 | 公司副董事长、副总经理 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 赵立松 | 公司副董事长、副总经理 | 1,500,000 | 3.6634% |
| 闵诗阳 | 公司董事 | 79,068 | 0.1931% |

（二）间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下：

| 姓名 | 公司职务或与董事、高级管理人员、核心技术人员的关系 | 间接持股主体 | 间接持股数量（万股） | 间接持股比例 |
|-----|---------------------------|--------|------------|--------|
| 曹镭 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 奥斯贝申 | 61.14 | 1.49% |
| | | 扬州贝果 | 34.25 | 0.84% |
| 郑宽蘋 | 曹镭配偶 | 奥斯贝申 | 60.00 | 1.47% |
| | | 扬州贝果 | 0.03 | 0.00% |
| 袁玉兰 | 董事会秘书 | 奥斯贝申 | 17.14 | 0.42% |
| 俞晓静 | 财务总监 | 奥斯贝申 | 34.29 | 0.84% |

| 姓名 | 公司职务或与董事、高级管理人员、核心技术人员的关系 | 间接持股主体 | 间接持股数量（万股） | 间接持股比例 |
|-----|---------------------------|--------|------------|--------|
| 李云峰 | 精密加工事业部总经理、核心技术人员 | 奥斯贝申 | 67.50 | 1.65% |
| 王京松 | 研发中心总监、核心技术人员 | 奥斯贝申 | 37.50 | 0.92% |
| 蒲坤 | 曹镭之子配偶 | 奥斯贝申 | 17.14 | 0.42% |
| 张宝娟 | 李云峰配偶 | 奥斯贝申 | 15.00 | 0.37% |

截至本招股说明书签署日，除上述情形外，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有公司股份的情形。此外，上述股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年内的变动情况

2025年10月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<浙江金连接科技股份有限公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》等议案，决定取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

除上述情况外，最近三年内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生其他变动。

综上，最近三年内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动系完善公司治理的实际需要，履行了必要的法律程序，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。

十六、董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司及其业务相关的对外投资。

十七、董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

（一）薪酬组成、确定依据及所履行程序

报告期内，在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由

基本工资、津贴、奖金、社会保险、住房公积金及其他补助等组成，独立董事可享有固定独立董事津贴。

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事及高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

（二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员税前薪酬总额占各期公司利润总额的比例如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|------|----------|---------|---------|
| 薪酬总额 | 605.22 | 566.78 | 520.35 |
| 利润总额 | 6,821.31 | 529.53 | -722.71 |
| 占比 | 8.87% | 107.03% | - |

注：监事薪酬统计至 2025 年 10 月公司取消监事止

（三）最近一年薪酬及其他待遇情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员及核心技术人员从发行人及其控股子公司领取税前薪酬的情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 姓名 | 发行人处职务 | 2025 年度税前薪酬总额 |
|----|-----|----------------|---------------|
| 1 | 曹镭 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 76.31 |
| 2 | 官世炎 | 副董事长、副总经理 | 61.30 |
| 3 | 赵立松 | 副董事长、副总经理 | 43.12 |
| 4 | 闵诗阳 | 董事，审计委员会委员 | - |
| 5 | 胡旭微 | 独立董事，审计委员会主任委员 | 8.00 |
| 6 | 肖佳佳 | 独立董事 | 8.00 |
| 7 | 陈自力 | 独立董事，审计委员会委员 | 8.00 |
| 8 | 袁玉兰 | 董事会秘书 | 67.71 |
| 9 | 俞晓静 | 财务总监 | 65.66 |
| 10 | 李云峰 | 核心技术人员 | 59.34 |

| 序号 | 姓名 | 发行人处职务 | 2025 年度税前薪酬总额 |
|----|-----|--------|---------------|
| 11 | 王京松 | 核心技术人员 | 47.66 |

董事（不含外部董事）、高级管理人员及核心技术人员不存在自公司关联方（不含公司控股子公司）领取薪酬的情况。

在公司及其子公司任职领薪（不含领取津贴的独立董事）的上述董事、高级管理人员、核心技术人员按国家有关规定享受社会保险及住房公积金待遇。除此以外，公司董事、高级管理人员与核心技术人员未享受其他待遇和退休金计划等。

十八、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

（一）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励

1、员工持股平台情况

为奖励部分员工对公司的历史贡献，以及为了吸引和留住优秀人才，实现公司长期稳定发展，公司设立了员工持股平台对员工进行股权激励，实现团队利益和公司长远利益的有机结合。

2021 年 8 月，为实施股权激励，曹镭与奥斯贝申签署《股权转让协议书》，将其持有的金连接有限 685.7143 万元出资额以 1,436.87 万元的价格转让给奥斯贝申。根据《嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人关于出资事宜的协议》，曹镭已于 2021 年 8 月代奥斯贝申全体合伙人履行出资义务，全体合伙人作为受激励对象无偿取得对应的财产份额，但曹镭因上述股权转让产生的个人所得税 209.39 万元由奥斯贝申全体合伙人按照持有的财产份额比例承担。

2026 年 3 月，曹镭与公司员工骆爱群签署《关于嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，将其持有的奥斯贝申 2.0417 万元财产份额转让给骆爱群，以实施股权激励。双方约定转让税费由骆爱群承担，但未对骆爱群的服务期进行限制。2026 年 4 月 30 日，奥斯贝申完成上述财产份额转让的工商变更登记。

截至本招股说明书签署日，奥斯贝申持有发行人 6,857,143 股股份，占发行人总股本的 16.7468%。

奥斯贝申具体情况参见本节“七、持有 5%以上股份或表决权的主要股东及

实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”。

2、规范运行情况及履行登记备案程序情况

奥斯贝申系依法经市场监督管理部门核准设立并有效存续的有限合伙企业，并且已依照《中华人民共和国合伙企业法》和合伙协议等规定就其工商变更情况在市场监督管理部门履行了变更登记和备案等程序。

奥斯贝申不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，其资产不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金及私募投资基金管理人，不需要按照前述规定履行私募投资基金及私募投资基金管理人的备案登记程序。

3、股权激励相关安排

（1）激励对象服务期

根据奥斯贝申的《合伙协议》及相关当事人的确认，就股权激励事宜，未对激励对象设服务期。

（2）人员离职后的股份处理

根据奥斯贝申的《合伙协议》，有限合伙人因个人原因离职、死亡或丧失民事行为能力（包括无民事行为能力或限制行为能力）的，除奥斯贝申执行事务合伙人曹镭同意保留外，该有限合伙人持有的合伙份额应当全部转让给其他合伙人或候选合伙人，转让价格由双方参考公允价值协商确定。同等条件下，金连接实际控制人曹镭享有优先购买权。受让方根据其受让的合伙份额类别相应享有本合伙协议项下相应类别有限合伙人的权利和义务。

（3）在发行人上市后的减持安排

奥斯贝申已出具《股份限制流通及自愿锁定承诺函》如下：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如本企业直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如遇除权除息事项，发价作相应调整，下同）；发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。其中，“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准，“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份；若此前年度净利润情况未触发对应延长锁定期条件的，则当年触发延长锁定期时不额外累计未触发年度拟延长的锁定期。

如法律法规、部门规章或中国证监会、证券交易所对本企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本企业同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。”

（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

1、对公司经营情况的影响

发行人实施的股权激励旨在增强公司凝聚力、吸引以及留住人才，兼顾员工与公司长远利益，有利于发行人长期稳定发展，激发被激励对象的工作积极性，最终实现股东、公司及员工各方利益的平衡和统一。

2、对公司财务状况的影响

由于实施股权激励，被激励员工入股价格低于同期公允价格，形成股份支付。2021 年度，公司一次性确认股份支付费用 18,034.70 万元。

2026 年 3 月，因实际控制人曹镭通过转让奥斯贝申财产份额的方式对骆爱群

进行股权激励，公司一次性确认股份支付费用 59.16 万元。

3、对公司控制权的影响

员工持股平台由公司实际控制人曹镭担任执行事务合伙人，因此不会对公司控制权造成重大不利影响。

综上所述，公司的员工股权激励不会对公司的经营状况、财务状况、控制权产生重大不利影响。

（三）正在执行或计划实施的股权激励

除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦不存在上市后的行权安排。

十九、发行人员工及社会保障情况

（一）员工情况

1、员工人数及变化情况

报告期各期末，公司员工人数及变化情况如下：

| 项目 | 2025 年末 | 2024 年末 | 2023 年末 |
|---------|---------|---------|---------|
| 员工人数（人） | 390 | 312 | 266 |

2、员工专业结构

截至 2025 年末，公司员工专业结构如下：

| 项目 | 人数（人） | 比例 |
|------|-------|---------|
| 管理人员 | 43 | 11.03% |
| 生产人员 | 278 | 71.28% |
| 销售人员 | 13 | 3.33% |
| 研发人员 | 56 | 14.36% |
| 合计 | 390 | 100.00% |

3、员工学历结构

截至 2025 年末，公司员工学历结构如下：

| 项目 | 人数（人） | 比例 |
|-----|-------|-------|
| 研究生 | 9 | 2.31% |

| 项目 | 人数（人） | 比例 |
|-------|-------|---------|
| 本科 | 75 | 19.23% |
| 大专 | 109 | 27.95% |
| 高中及以下 | 197 | 50.51% |
| 合计 | 390 | 100.00% |

4、员工年龄结构

截至 2025 年末，公司员工年龄结构如下：

| 项目 | 人数（人） | 比例 |
|------------|-------|---------|
| 30 岁及以下 | 221 | 56.67% |
| 31 岁至 40 岁 | 111 | 28.46% |
| 41 岁至 50 岁 | 42 | 10.77% |
| 51 岁及以上 | 16 | 4.10% |
| 合计 | 390 | 100.00% |

（二）社会保险和住房公积金缴纳情况

公司根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规要求与员工签订劳动合同，并为员工办理了社会保险，缴纳了住房公积金。具体情况如下：

1、社会保险缴纳情况

报告期各期末，公司及子公司社会保险缴纳人数情况如下：

单位：人

| 时间 | 员工总数 | 缴纳人数 | 未缴人数 | 未缴纳原因 |
|---------|------|------|------|-----------------------|
| 2025 年末 | 390 | 377 | 13 | 7 人为退休返聘人员，6 名为当月入职人员 |
| 2024 年末 | 312 | 304 | 8 | 7 人为退休返聘人员，1 名为当月入职人员 |
| 2023 年末 | 266 | 259 | 7 | 7 人均为退休返聘人员 |

注 1：日本金连接、香港金连接按照当地法规为员工缴纳社会保险

除员工已达到退休年龄、新员工正在办理入职及缴存手续外，截至 2025 年末，公司应缴纳社保人员已全部缴纳。

2、住房公积金缴纳情况

截至报告期末，公司及子公司住房公积金缴纳人数情况如下：

单位：人

| 时间 | 员工总数 | 缴纳人数 | 未缴人数 | 未缴纳原因 |
|---------|------|------|------|--------------------------------------|
| 2025 年末 | 390 | 359 | 31 | 7 人为退休返聘人员, 6 名为当月入职人员, 18 人为境外子公司员工 |
| 2024 年末 | 312 | 299 | 13 | 7 人为退休返聘人员, 1 名为当月入职人员, 5 人为境外子公司员工 |
| 2023 年末 | 266 | 256 | 10 | 7 人为退休返聘人员, 3 人为境外子公司员工 |

截至 2025 年末, 除境外员工、员工已达到退休年龄、新员工正在办理入职及缴存手续外, 公司应缴纳住房公积金人员已全部缴纳。

3、主管部门关于社会保险及住房公积金缴纳情况的证明

根据 2026 年 1 月 15 日浙江省公共信用信息平台出具的《企业专项信用报告》, 浙江金连接报告期内在人力资源社会保障领域不存在违法违规情况。

根据 2026 年 2 月 10 日北京市公共信用信息中心出具的《法人和非法人组织公共信用信息报告》, 北京金连接在人力资源社会保障领域不存在违法违规情况。

根据日本瓜生丝贺律师事务所出具的《法律意见书》, 日本金连接按照法律法规为员工缴纳医疗保险、养老保险以及雇佣保险等日本法律法规需要为员工缴纳的保险金。

根据香港李绪峰律师行出具的《法律意见书》, 香港金连接已经缴付一切应缴的雇员强制性公积金供款, 不存在违法劳动用工、社会福利保险方面的法律法规情况。

（三）劳务外包情况

报告期内, 公司业务快速发展, 生产规模持续扩大, 用工需求随之增加, 为提高生产组织灵活性, 降低突发性用工需求对公司生产经营的影响, 公司根据生产经营和订单情况将部分产品检测、分拣及组装等基层操作岗位的工作委托劳务公司实施, 外包工作岗位既不涉及关键工序的设定、监督和管理, 亦不涉及关键技术研发等。此外, 自 2024 年下半年起, 公司将厂区安保、保洁工作外包给专业公司完成。

报告期内, 公司合作的劳务外包单位共计 3 家, 劳务外包单位基本情况如下:

1、嘉兴市嘉汇人力资源有限公司

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 嘉兴市嘉汇人力资源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330402551785676Y |
| 成立日期 | 2010年3月15日 |
| 公司住所 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉良大厦1幢1302室-2 |
| 法定代表人 | 吕泽慧 |
| 注册资本 | 200万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 劳务派遣服务；职业中介、职业指导；劳务外包；企业管理咨询；家庭服务；保洁服务；劳动和社会保障事务代理；人力搬运装卸服务；教育咨询服务；房地产经纪服务；会议及展览服务；计算机信息服务；贸易代理；企业形象策划；网络技术开发；计算机软件开发；自有房屋租赁；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

2、浙江慧聘人力资源有限公司

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 浙江慧聘人力资源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330411MA2BBTDU82 |
| 成立日期 | 2018年9月26日 |
| 公司住所 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场E座402-2L室 |
| 法定代表人 | 王建新 |
| 注册资本 | 1000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；机械设备租赁；办公用品销售；园林绿化工程施工；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；病人陪护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

3、浙江锦睿综合服务有限公司

| | |
|----------|--------------------------------|
| 公司名称 | 浙江锦睿综合服务有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330411MAC7TFA168 |
| 成立日期 | 2023年2月8日 |
| 公司住所 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区商务金融大厦1幢办C1501-A室 |

| | |
|-------|--|
| 法定代表人 | 陈锦亮 |
| 注册资本 | 1,000 万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 一般项目：商业综合体管理服务；创业空间服务；供应链管理服务；合同能源管理；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；物业服务评估；品牌管理；集贸市场管理服务；城市公园管理；单位后勤管理服务；城市绿化管理；停车场服务；市政设施管理；工程管理服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；工业设计服务；专业设计服务；市场营销策划；商业、饮食、服务专用设备销售；办公用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；消防技术服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

报告期内，公司计入生产成本的劳务外包费用具体情况如下：

| 期间 | 主要外包内容 | 劳务外包费用(万元) | 劳务外包费用占营业成本的比例 |
|--------|-----------|------------|----------------|
| 2025 年 | 探针零件分拣、检测 | 55.74 | 0.34% |
| 2024 年 | 探针零件分拣、检测 | 56.49 | 0.48% |
| 2023 年 | 探针零件分拣、检测 | 35.58 | 0.54% |

报告期内，与发行人合作的劳务外包公司均为独立经营的主体，主要为发行人提供探针零件分拣、检测等辅助性工序以及安保、保洁服务，从事上述劳务的人员无需具备特殊资质，从事上述业务的劳务外包公司亦无需特殊资质。报告期各期，公司劳务外包相关费用占当期营业成本比重分别为 0.54%、0.48%和 0.34%，占比较低，对公司的日常经营不存在重大影响。

发行人采用少量劳务外包的用工制度符合相关法律、法规及规范性文件的规定；报告期内，发行人不存在因劳务外包行为而受到行政处罚的情形。

第五节 业务与技术

一、主营业务及主要产品

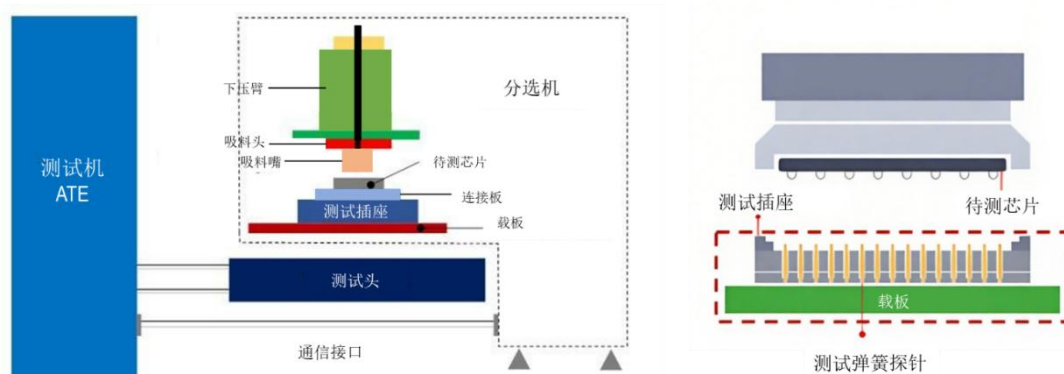
（一）主营业务、主要产品及主营业务收入构成

1、主营业务基本情况

公司是一家全球知名的微细精密零件提供商，目前主要为 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等国内外主要芯片测试耗材厂商提供核心零件，产品最终应用于国内外主要芯片厂商 GPU、CPU、ASIC 等高端芯片的测试环节，是全球高端芯片供应链体系的重要一环。此外，公司亦积极拓展业务边界，战略性布局医疗器械精密零件和晶圆测试探针零件，持续丰富自身产品矩阵。

作为国内少数具备测试探针零件规模化制造能力的企业，公司可实现最小直径 0.03mm、尺寸公差 $\pm 2\mu\text{m}$ 的测试探针零件稳定批量生产，并能够在最小直径 0.04mm 的探针顶柱头完成复杂几何结构的镜面级加工，产品参数已全面对标甚至部分超越国外竞争对手产品。根据沙利文咨询发布的行业报告显示，2024 年公司在测试探针零件行业的市占率位居全球第五位，亦是唯一跻身全球前五的中国本土测试探针零件厂商。在高端芯片测试探针零件长期由境外厂商主导的产业背景下，公司通过探针零件超精密微细加工、高效收集与清洗以及探针材料制备的全流程技术突破，成功量产高端芯片测试探针零件，成为国内芯片测试产业链中的“补链者”和“强链者”，为我国芯片产业的战略安全与竞争力提升奠定坚实基础。

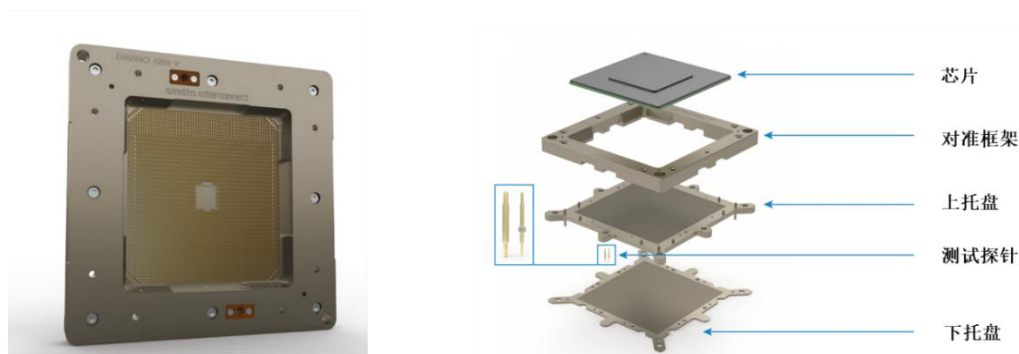
测试探针作为芯片后道测试的核心部件，由顶柱头、底柱头、套筒和微弹簧经高精度组装成型，并精密安装于测试插座内，形成完整的芯片测试插座。测试探针作为被测芯片与测试设备之间的唯一接口，芯片测试过程中，测试设备均需通过测试探针与芯片引脚建立电信号连接，从而完成芯片性能、功能及可靠性的测试，因此测试探针的性能水平是保障芯片测试准确性的关键。



从产业链分工视角来看，测试探针制造可分为上游探针材料制造、中游探针零件生产、下游探针零件组装。探针零件的超精密加工及探针材料制备能力，是决定测试探针性能边界的核心技术壁垒。具体来看：

在 AI/HPC 芯片与先进封装行业高速发展的产业背景下，芯片集成度和功能复杂性的持续提升，单颗高端芯片的引脚规模达数千乃至数万个。高集成度复杂芯片的可靠测试，有赖于测试插座内部大规模测试探针阵列以微米级间距与芯片引脚建立稳定接触。因此，测试探针的性能、尺寸与公差控制是决定芯片测试有效性的关键因素。

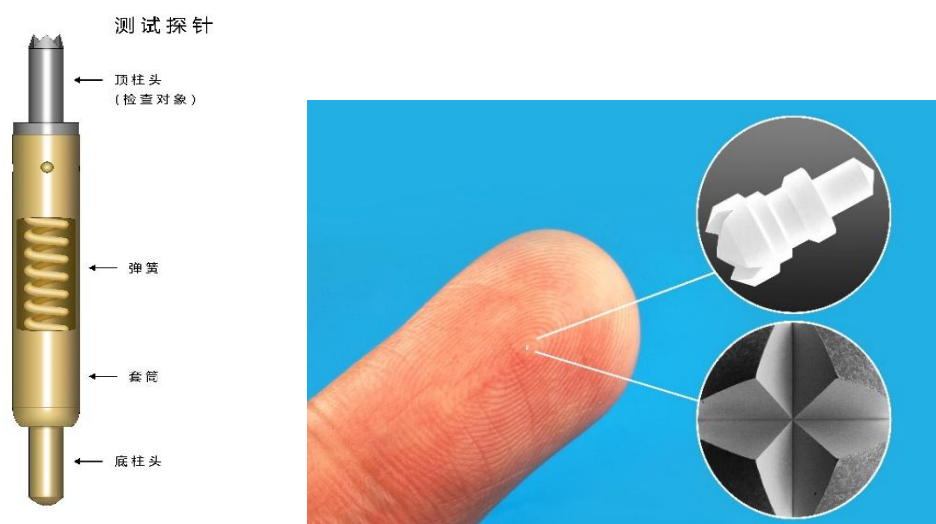
史密斯英特康适用于AI芯片测试的新一代Davinci Gen V测试插座



资料来源：史密斯英特康官网

芯片测试行业的这一发展趋势对测试探针提出了更高的要求：一方面，需持续推动探针尺寸微缩，将尺寸公差严格控制在微米级，才能实现数万根级的探针阵列与芯片引脚阵列的高精度对位，这是建立稳定电接触的基础；另一方面，探针需具备优异的物理及机械属性，包括低电阻率、高硬度、高耐磨性和高强度等，才能在高频、高负载、持续施压测试工况下，维持电气性能长期稳定，保障高速测试信号完整性与长期测试可靠性。

上述探针性能的突破，有赖于探针零件精密加工和高性能探针材料制备技术。零件加工层面，需依赖长期实践积累的超精密微细零件加工技术和专门设计制造的精密刀具，同时依赖技术人员对 CNC 数控机床运行的深刻理解与长期工艺调试，才能实现探针零件更小外径、更精密尺寸公差、镜面级表面光洁度，从而持续满足高端芯片测试对更微细、更精密探针的要求。材料层面，需研制出低电阻率的探针材料，满足各种芯片的测试场景，避免探针自身电阻过高引发的电压压降而导致的信号失真、测试功耗高等问题；同时，探针材料需具备高硬度、高耐磨性及抗形变能力，才能保障与芯片引脚的稳定接触，并在高频施压测试中仍能能够保证自身结构稳定；探针材料需具备高精度、高直线度、高圆度和高一致性，才能为超精密微细加工奠定基础。





截至本招股说明书签署日，公司共拥有已授权专利 60 项，其中发明专利 30 项，并成功入选为国家级专精特新重点“小巨人”企业。此外，公司积极引领行业技术发展，“芯片测试用关键电子材料研发与产业化项目”被浙江省科技厅评定为 2023 年度浙江省“尖兵”研发攻关计划项目，“半导体芯片测试探针零件制造项目”入选浙江省产业链协同创新项目，公司产品“测试探针用合金精微部件”成功入选 2023 年度浙江省首批次新材料名单。公司先后被授予浙江省高新技术企业研究开发中心、嘉兴市高新技术研究开发中心、嘉兴市技术中心等荣誉称号，并入选为浙江省科技型中小企业、全国首批制造业新型技术改造试点城市试点项目。

2、主要产品基本情况

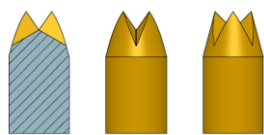
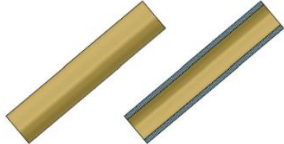
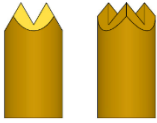
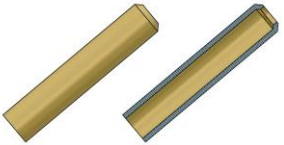

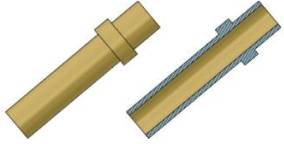

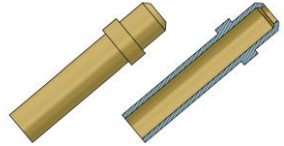

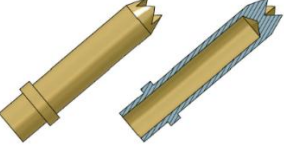
(1) 芯片测试探针零件

公司可采用钽合金、铍铜、磷青铜、碳钢等多种材料，加工制造各类微细精密探针零件，具体产品如下表所示。其中，公司生产的钽合金测试探针零件拥有高硬度、低电阻率、耐腐蚀、高抗拉强度的优良特性，可在数十万次芯片测试中保持结构与性能稳定，目前已广泛应用于高端芯片测试领域。

| 产品类型 | 产品名称 | 产品图示 | 产品材质 | 产品规格 | 主要用途 |
|----------|------|---|------------|---|--|
| 芯片测试探针零件 | 顶柱头 |  | 钽合金、铍铜、碳钢等 | 外径： 0.03-0.5mm 长度： 0.2-5.0mm | 直接与被测芯片的引脚或焊球实现精准点接触，通过适配不同测试场景的头型设计刺穿引脚/焊球表面的氧化层，保障测试信号稳定高效传输，是实现芯片电性能精准检测的关键接触部件 |
| | 底柱头 |  | 钽合金、铍铜、碳钢等 | | 与测试载板的引脚建立稳定的机械与电学连接，其球面针头设计配合内部微弹簧的弹性能实现稳定接触压力，既保证测试信号传输顺畅、维持测试信号的完整性，又避免损伤测试载板触点，从而提升探针的测试准确度与使用寿命，是探针与测试系统后端连接的核心转接部件 |
| | 套筒 |  | 磷青铜、钽合金等 | 外径： 0.18-0.6mm 内径： 0.124-0.5mm | 作为芯片测试探针的核心承载与导向结构，可精准约束顶柱头、底柱头及内部微弹簧的轴向运动，确保微弹簧伸缩的同轴度与稳定性，为电性能测试提供可靠的结构支撑，同时保障探针在高频次测试循环中的结构一致性 |

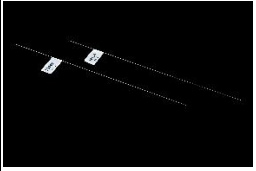
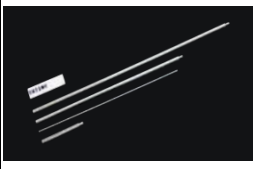
公司可在探针零件表面进行复杂几何结构的加工，并实现镜面级光洁度，零件产品精准匹配 GPU、CPU、ASIC 等主流芯片的不同引脚形态，满足多样化的芯片测试需求。

| 几何结构类型 | 产品图示 | 几何结构类型 | 产品图示 |
|--------|---|------------|---|
| 直皇冠头 |  | 偏 Kelvin 头 |  |
| 锥皇冠头 |  | Kelvin 皇冠头 |  |

| 几何结构类型 | 产品图示 | 几何结构类型 | 产品图示 |
|--------|--|---------|--|
| 斜皇冠头 |  | 直套筒 |  |
| 偏皇冠头 |  | 收口直套筒 |  |
| 锥头 |  | 带法兰套筒 |  |
| 圆弧头 |  | 带法兰收口套筒 |  |
| 扁圆弧头 |  | 皇冠套筒 |  |

（2）特种高性能合金材料

公司特种高性能合金材料可应用于生产芯片测试探针零件以及医疗器械精密零件。

| 产品类型 | 产品名称 | 产品图示 | 产品规格 | 应用领域 | 简介 |
|--------------|--------|---|--------------|----------|---|
| 贵金属及有色金属合金材料 | 钨合金棒材 |  | 直径：0.4-0.8mm | 测试探针零件 | 具有优异的导电性、高硬度、耐磨性和抗腐蚀能力，并实现高精度、直线度和圆度，可确保测试探针在高频、高强度重复测试中，始终保持接触稳定、不易磨损，保障测试信号稳定、低损耗传输，是支撑测试探针实现高一一致性、长寿命测试的核心基础材料 |
| | 铂铱合金棒材 |  | 直径：0.5-5mm | 精密医疗器械零件 | 拥有极高的生物相容性、优异的耐生理腐蚀性、高机械强度及X射线可显影特性，是加工植入式、介入式精密医疗器械核心功能部件的关键材料 |

（3）射频互连部件

公司射频互连部件包括精密连接器零件及线缆组件，核心应用于通信系统、基站天线、毫米波射频等场景，为信号传输提供高可靠性连接解决方案。

| 产品类型 | 产品图示 | 简介 |
|---------|---|--------------------|
| 精密连接器零件 |  | 适用于通信系统的多通道射频连接器 |
| 线缆组件 |  | 主要用于网络数据信号传输、音视频传输 |

3、主营业务收入构成及特征

公司主营业务收入及构成情况如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 芯片测试探针零件 | 22,385.63 | 92.14% | 12,112.76 | 85.56% | 6,583.11 | 77.74% |
| 射频互连部件 | 1,469.90 | 6.05% | 1,771.30 | 12.51% | 1,679.97 | 19.84% |
| 其他 | 438.75 | 1.81% | 273.80 | 1.93% | 204.82 | 2.42% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务收入主要来自芯片测试探针零件、射频互连部件及其他，芯片测试探针零件收入占比逐年提高。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司专注于测试探针零件的研发、生产和销售，主要通过向客户销售测试探针零件实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入为测试探针零件销售，同时存在射频互连部件的销售及少量钽合金棒材、微细医疗器械零件等的销售。其他业务收入主要为贵金属废沫处置收入。

2、采购模式

公司的主要原材料为钽片、铍铜棒料、磷青铜毛细金属管等，采用“以销定产、以产定采”的采购模式。公司建立了稳定的原材料采购渠道以保证原材料的及时、充足供应，并根据生产经营计划和存货库存规模采用持续分批量的方式采购原材料。

（1）采购计划的制定与实施

生产部门根据客户订单、生产计划、原材料和成品库存情况确定物料需求，由采购部门从供应商名单中选择适当供应商并提出采购申请，获得批准后生成采购订单，材料到货后由仓库根据采购订单负责收货，经品质中心检验合格后办理入库手续。采购部门根据采购订单、送货单、入库单、供应商对账单与供应商进行对账，双方确认无误后，由供应商开具发票，按照合同约定的付款期限和结算方式向供应商支付货款。

（2）供应商的选择和管理

公司制定了《供应商管理制度》，公司首先对供应商进行资质查验，对供应商的产能、产品质量、信誉、资信等进行初评，然后通过样品检测、实地考察等程序后，审慎选择符合要求的供应商并列入选合格供应商名单。公司定期对供应商进行考评，对达不到要求的供应商要求其整改甚至暂停合作，直至达到公司标准。经过多年发展，公司已建立了较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了稳定的合作关系。

3、生产模式

公司实行“以销定产、适当备货”的生产模式，即公司生产部门根据销售部门提供的客户订单或客户需求预测，结合产品库存量、车间生产能力制定生产计划。公司自主掌握原材料制备、刀具设计与制造、精密机械加工、零件产品收集及清洗及热处理等核心生产工艺，但零件产品电镀等需委外加工。

（1）自主生产

公司制定了《生产管理制度》《消防安全管理制度》《不合格品管理制度》等生产管理制度。公司生产部门根据销售部门提供的客户订单或客户需求预测，结合相应产品的库存量、车间生产能力制定生产计划，并制定物料需求，向仓储部门申请领料，各车间管理人员根据生产计划组织生产；品保部门按照规范进行过程控制，质检员按照企业标准对成品进行检验，检验合格方可入库；如出现不合格产品则进行标识、隔离、报废。

经过多年的生产实践，公司已搭建起现代化、自动化、智能化的全流程自主生产体系。核心机加工环节，通过对送料机、机床主轴单元的改造与适配，公司

可实现直径小于 1mm 超细材料的自动上下料与连续稳定加工，保证 7×24 小时不间断作业，显著降低人工依赖；质量管控环节，公司构建了首件检验、过程巡检、批次小终检、成品大终检的多级全流程质检体系，配合自动化检测仪器，可完成微细零件关键尺寸的快速、精准检测；后道微细零件收集、清洗环节，均采用自动化设备作业，显著提升回收效率与良率，实现生产全流程的自动化闭环。

此外，公司建立了科学与高效的排产机制，合理调配生产资源，推动高效生产与精细化产能调度，提升整体生产效能与产品品质。

（2）委外加工

公司存在将精密零件电镀等工序委外生产的情况。公司已建立委外加工的相关管理制度，对委托加工供应商的遴选、评估和日常业务合作进行管理。生产部门在下达委外订单时需对供应商进行询价议价，经相关管理人员审批后最终确定委外供应商。确定委外加工厂商后，仓储部门负责编制委外出库单并联系物流将相关物料送至委外加工厂商处。委外加工完成后，品保部门按照公司品质管理的要求对加工完成的产品进行品质检验，检验合格后由仓储人员办理入库。

4、销售模式

销售渠道建设方面，在业务发展初期，公司主要通过参加行业展会、销售人员主动拜访、客户转介绍等方式获得业务机会，相关的销售活动和客户服务工作主要由销售部负责执行。随着公司产品质量不断提高、行业地位稳步提升，公司进一步优化获客体系，推行大客户绑定战略，通过及时响应大客户需求，实现与行业内大客户的长期深度绑定。与此同时，凭借优秀的零件产品质量与不断提升的行业认可度，公司也吸引众多客户主动对接洽谈、建立合作关系。

销售模式方面，报告期内公司采取直销模式。

5、研发模式

公司及时追踪行业前沿工艺趋势、研判下游客户对产品性能的最新需求，并以此为导向，一方面积极推进微细零件产品迭代与创新、核心材料生产工艺持续创新；另一方面自主研制辅助工装与精密刀具，持续提升生产自动化水平，最终形成“产品升级-工艺精进-成本优化”的正向循环。同时，公司亦凭借在测试探针零件积累的精密加工经验，向精密医疗器械零件领域拓展，不断丰富自身微细

零件产品矩阵，提升自身市场竞争力。

6、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司目前采用的经营模式是根据行业特性、产业政策、客户需求、市场竞争及公司资源要素构成等因素综合确定的。公司发展战略、微细精密零件行业市场竞争格局及产业政策，决定了公司的整体经营方针。下游客户的集中度、需求特点、市场整体规模影响了公司的销售模式。公司技术优势、资金规模、设备产能等资源要素构成，影响公司采购、生产、销售、研发的具体模式。公司拥有的核心技术和研发能力，使得公司在产品生产和销售中拥有更大的自主权，并且能更好满足客户需求。

报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司的经营模式在短期内亦不会发生重大变化。

（三）成立以来主营业务、主要产品与主要经营模式的演变情况

发行人（含北京金连接）自成立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的演变主要经历以下阶段：

1、业务积累阶段（1998-2017年）

1998年，北京金连接正式成立，主要从事线缆组件的生产与销售业务，旨在替代中国台湾地区的进口产品，产品主要应用于通讯设备领域。

2004年，北京金连接成立机械加工事业部，通过引进专业技术人才、采购先进精密机械加工设备，切入精密连接器零件生产领域。经过持续的研发投入与技术攻关，北京金连接成功实现直径小于1mm射频连接器零件批量生产，积累了丰富的微细精密加工技术经验，为后续业务升级奠定了坚实基础。

2、业务拓展阶段（2017-2023年）

2016年底，公司在参加行业展会过程中，了解到芯片测试探针存在较大市场需求，而当时该产品及其核心零件主要由国外厂商主导，国内相关生产企业鲜少。基于此，公司把握市场机遇并依托前期积累的精密零件加工经验，于2017年初启动芯片测试探针零件研发相关工作，并成功实现从样品试制到大批量生产的全

流程技术突破，产品质量通过客户验证，达到国内外厂商同类产品标准，正式切入芯片测试探针零件领域。

自 2022 年起，公司进一步拓展测试探针材料和精密医疗器械零件的研发与技术积累。

3、快速发展阶段（2024 年至今）

自 2024 年起，公司自建 32,500 平方米现代化研发制造基地正式投入运营，CNC 机床规模超 400 台、同时搭建起完整的自主刀具研发制造体系，并配备全套辅助工艺设备，形成规模化、高精度、快速响应的自动化制造平台。截至本招股说明书签署日，公司芯片测试探针零件的月产量近 4,000 万件，产能规模与产品出货量稳居全球行业前列，公司已拥有在国际竞争中的规模化制造优势与高效稳定的交付实力。

其他微细精密零件领域，公司已于 2025 年 12 月顺利通过医疗器械质量管理体系（GB/T 42061-2022/ISO 13485:2016）认证，并获得国内外知名医疗客户的认可，未来有望成为公司新的核心利润增长点。此外，公司亦积极开展晶圆测试探针的研发与技术储备工作。

（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

1、主要业务经营情况

公司主营业务为微细精密零件的研发、生产、销售，目前聚焦于芯片测试探针零件领域。公司紧密围绕核心业务开展经营，深度受益于 AI 芯片及先进封装行业的快速发展，报告期各期，公司主营业务收入分别为 8,467.90 万元、14,157.86 万元和 24,294.28 万元。其中，测试探针零件销售收入分别为 6,583.11 万元、12,112.76 万元和 22,385.63 万元，占主营业务收入比重分别为 77.74%、85.56%和 92.14%，占比逐年提高。经过多年的市场拓展，公司积累了较为丰富的测试探针零件客户资源，主要经营业务快速发展。

2、核心技术产业化情况

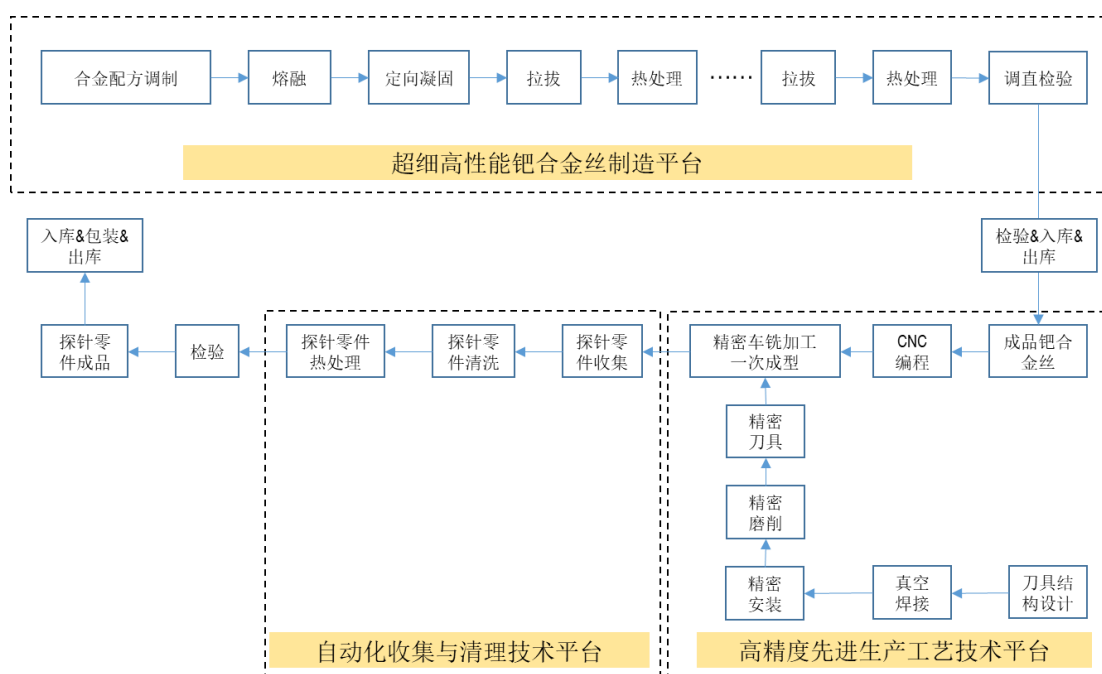
在芯片测试探针零件领域，公司以自主创新、产品对标国际竞品为核心目标，搭建起三大核心技术平台：高精度先进生产工艺技术平台、自动化收集与清洗技

术平台以及超细高性能钼合金棒制备平台。

依托以上三大技术平台的协同，公司构筑起坚实的核心竞争优势：一是通过对 CNC 机床的自主改造与加工工艺的持续优化，实现超细钼合金棒材的稳定自动化加工，显著提升探针零件成品率；二是具备微米级精密零件高效加工能力，可实现最小直径 0.03mm、公差控制在 $\pm 2\mu\text{m}$ 的超精密微细加工，同时能在最小直径 0.04mm 的探针顶柱头完成复杂几何结构的镜面级加工，满足高端芯片测试的严苛要求；三是掌握超细高性能钼合金棒的核心材料配方，实现关键原材料的自主制备，产品性能已达到国际先进水平；四是自主研发专用于微细零件加工的精密刀具，并形成成熟稳定的刀具制造工艺，有效降低了核心加工环节的生产成本；五是全面掌握钼合金、铍铜、磷青铜等多种材质微细探针零件的制造技术，自主开发覆盖自动收集与清洗的全流程工艺体系，建立起规模化生产与质量控制体系，形成一体化的高端测试探针零件的加工制造能力。

目前，上述所有核心技术均已全面应用于公司芯片测试探针零件的规模化量产，实现了核心技术产业化。

（五）主要产品的工艺流程图



（六）报告期各期具有代表性的业务指标

近年来，全球半导体产业市场规模总体保持增长，尤其是 AI/HPC 芯片与先进封装行业的快速发展，推动芯片测试需求的不断增长。报告期内，公司营业收

入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，复合增长率为 74.00%，呈快速增长趋势，系公司代表性业务指标。

作为芯片后道测试环节的核心部件，厂商需要持续研发创新才能满足下游客户对持续微缩的测试间距、测试信号完整性、高频测试稳定性等的测试需求。报告期内，公司研发费用分别为 971.76 万元、1,061.17 万元和 2,061.67 万元，占营业收入的比例分别为 10.65%、6.71%和 7.46%，保持较高比例的研发投入。

（七）公司符合产业政策和国家经济发展战略的情况

发行人主要从事微细精密零件制造业务，主营的芯片测试探针零件产品系应用于芯片测试领域的关键元器件核心零部件。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司主要业务属于“二十八、信息产业”之“4、集成电路设计……集成电路装备及关键零部件制造”，系“鼓励类”产业。

芯片测试探针零件所应用的芯片测试领域系芯片封装的重要节点，是直接影响芯片良率及制造成本的关键工序，对于半导体产业具有重要意义。半导体产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》在培养壮大新兴产业和未来产业、加强原始创新和关键核心技术攻关两个章节中均明确提及了发展半导体及人工智能产业的规划和要求，发展半导体及人工智能产业系落实国家经济发展战略的重要举措之一。

综上所述，公司主要业务符合产业政策和国家经济发展战略。

二、所处行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为微细精密零件的研发、生产和销售，目前聚焦于芯片测试探针零件领域。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的“鼓

励类”产业。

（二）行业监管体制和行业法规政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部，行业自律组织为中国电子元件行业协会（CECA），由于公司主要产品应用芯片测试领域，亦受中国半导体行业协会自律管理。

国家工业和信息化部主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

中国电子元件行业协会（CECA）是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，其主要职能是：在政府部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行业调查研究；加强行业自律；履行好服务企业的宗旨；帮助企业开拓市场；经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。

中国半导体行业协会由从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的企、事业单位自愿组成的、行业性的、全国性非营利性社会组织，是中国集成电路行业的行业自律管理机构。协会在工信部的指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、行业主要法律法规和产业政策

公司所处行业涉及的主要法律法规和产业政策如下：

| 文件名称 | 发布单位 | 发布时间 | 主要内容 |
|------------------------------|----------|-------|---|
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》 | 中共中央、国务院 | 2026年 | 采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键 |

| 文件名称 | 发布单位 | 发布时间 | 主要内容 |
|----------------------------|-----------|-------|---|
| | | | 核心技术攻关取得决定性突破 |
| 《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 | 国务院 | 2025年 | 支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。加强智能算力互联互通和供需匹配，创新智能算力基础设施运营模式，鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务，推动智能算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全 |
| 《2025年数字经济发展工作要点》 | 发改委、国家数据局 | 2025年 | 1、筑牢数字基础设施底座。统筹“东数西算”工程与城市算力建设，以全国一体化算力网建设优化算力资源布局，推动建设国家数据基础设施，加快统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求等标准规范建设，抓好隐私计算、区块链等数据流通利用基础设施先试先行 2、提升数字经济核心竞争力。促进科技创新和产业创新深度融合，梯次培育布局具有国际竞争力、区域支柱型、区域特色型数字产业集群，推动数据产业、数据标注产业高质量发展，支持人工智能技术创新和产业应用 |
| 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 | 工信部等七部委 | 2024年 | 1、加强前瞻谋划部署，其中前瞻部署新赛道包括未来信息。推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用，加快量子、光子等计算技术创新突破，加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能，加速培育智能产业 2、打造标志性产品，其中创新标志性产品包括超大规模新型智算中心。加快突破GPU芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术，建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求 |
| 《数字中国建设整体布局规划》 | 中共中央、国务院 | 2023年 | 系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局 |
| 《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》 | 工信部、财政部 | 2023年 | 聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应 |

| 文件名称 | 发布单位 | 发布时间 | 主要内容 |
|--|-----------|-------|--|
| | | | 链稳定性 |
| 《算力基础设施高质量发展行动计划》 | 工信部等六部委 | 2023年 | 1、结合人工智能产业发展和业务需求，重点在西部算力枢纽及人工智能发展基础较好地区集约化开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比 2、加强产业链协同联动，逐步形成自主可控解决方案，鼓励算力基础设施采用安全可信的基础软硬件进行建设，保障供应链安全。加强关键技术研发和创新，提升软硬件协同和安全保障能力 |
| 《质量强国建设纲要》 | 中共中央、国务院 | 2023年 | 加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展 |
| 《“十四五”数字经济发展规划》 | 国务院 | 2021年 | 瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性、前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力。完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系 |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 中共中央、国务院 | 2021年 | 培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展 |
| 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 | 国家发改委等四部门 | 2020年 | 加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用 |
| 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 | 国务院 | 2020年 | 聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的關鍵核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制 |

3、行业主要法律法规及产业政策对公司经营发展的影响

发行人产品主要应用于芯片测试领域，该领域系受国家、地方政府鼓励和支持发展的产业，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等一系列国家、地方产业政策的推出，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，同时为发行人经营发展提供了有力的法律

保障及政策支持，对发行人的经营发展带来积极影响，为企业创造了良好的经营环境。

（三）行业发展概况

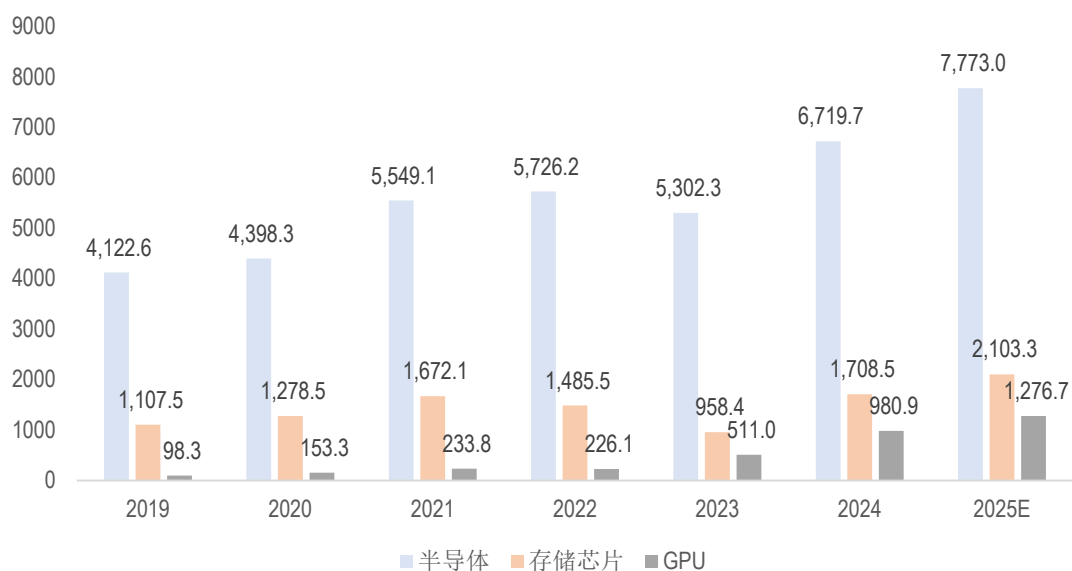
报告期内，公司核心产品聚焦于芯片测试领域，相关行业发展概况具体如下：

1、半导体行业发展概况

受半导体行业库存周期调整影响，2023 年全球半导体市场呈现阶段性下滑态势，全年市场规模达 5,302.3 亿美元，同比下降 7.40%。进入 2024 年-2025 年，随着 AI/HPC 芯片及其配套高带宽存储芯片（HBM）需求的快速增长，推动半导体行业复苏与快速增长。2024 年全球半导体行业市场规模增至 6,719.7 亿美元，同比增长 26.73%；2025 年进一步攀升至 7,773.0 亿美元，同比增长 15.67%。

细分领域来看，2024 年和 2025 年 GPU 芯片市场规模分别达到 980.9 亿美元和 1,276.7 亿美元，同比增长 91.98%和 30.15%；存储芯片市场规模分别达到 1,708.5 亿美元和 2,103.3 亿美元，同比增长 78.26%和 23.11%，均保持高速增长态势。

全球半导体行业市场规模及主要细分情况（亿美元）



数据来源：Yole

根据世界半导体贸易统计组织 WSTS 的预计，随着 AI 与数据中心带来的逻辑芯片与存储器需求的持续增长，2026 年全球半导体市场规模预计将达到 9750 亿美元。

2、芯片封测行业发展概况

（1）芯片封测的概念

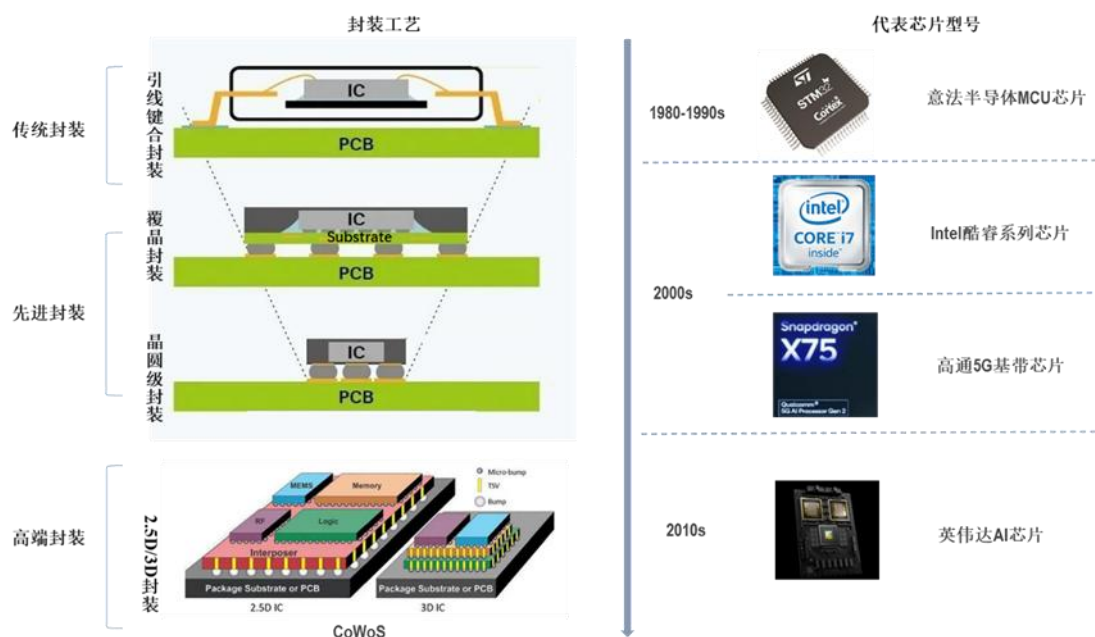
“封测”指芯片封装与测试两个环节。芯片封装是指用特定材料、工艺技术对芯片进行安放、固定、密封，并将芯片引脚连接到封装外壳上的工艺流程。传统的芯片封装主要起到对其内部的芯片进行保护、支撑、对外连接、散热的作用。而随着后摩尔时代的到来，芯片封装进一步起到提升芯片产品性能、降低技术成本、提高芯片产品良率的效果。

芯片测试是半导体制造中的关键环节，其核心是在芯片交付消费端之前，通过测试接口与测试设备建立稳定的电气连接，对晶圆或封装后芯片的功能、性能和可靠性进行全面验证，从而完成筛选与分级，确保其符合设计标准与规范。

（2）芯片封装产业发展持续推动芯片测试需求增加和技术迭代

摩尔定律由英特尔创始人戈登·摩尔于 1965 年提出，即集成电路上的晶体管数量每 18 至 24 个月翻倍，对应芯片性能翻倍，成本下降一半。随着芯片制程进入 2nm 并逼近硅基物理极限，纯靠制程工艺微缩已难以带来显著性能增益，且成本持续攀升。业界普遍认为，后摩尔时代提升算力、能效并降低成本的关键路径，是通过异构集成与先进封装技术将不同功能芯片集成于同一封装体，从而缩短芯片间信号传输距离，提升芯片互连密度，从系统层面突破性能瓶颈。

回顾芯片封装技术的发展历程，从引线键合到 2.5D/3D 封装的每一次迭代，都对芯片测试提出了更严格的要求，并推动芯片测试需求的不断增长。



1) 传统封装

传统封装以引线键合封装为代表，是指以引线框架为基础、以打线键合为核心互联方式的封装技术，包括 DIP、QFP、SOP 等多种形式。测试探针通过接触引线框架的外引脚来完成芯片测试。由于此类封装的引脚数量相对有限，且沿封装体外围分布，单次测试所需的探针数量较少，对测试探针精度及性能的要求也相对较低。

2) 先进封装

先进封装是 21 世纪初逐渐发展起来的封装技术，其省去传统封装的长引线结构，转为通过焊球阵列或重布线层（RDL）实现信号传输，有效缩短信号传输路径，实现芯片功耗与性能的优化。

先进封装主要包括覆晶封装（FCBGA）和晶圆级封装（WLP）。覆晶封装是将芯片倒置于封装基板上，基板内部通过微孔制作、电镀铜等工艺形成高密度互连结构，并通过下方植入焊球阵列完成对外信号传输。这种阵列排布形式使芯片对外引脚数量显著增加，对应单片测试的测试探针需求可达数千根，芯片引脚阵列高密度特性，进一步要求测试探针尺寸持续微缩，公差需严格控制在数十微米甚至更小范围内，以确保稳定可靠的电气连接。

晶圆级封装是直接在整片晶圆上通过半导体前道工艺制作更细密的 RDL 结构，通过在接近芯片尺寸或稍大于芯片尺寸内植入高密度焊球阵列，实现高效互

连与带宽提升。对应地，探针测试间距因 RDL 结构进一步压缩至 0.2mm。

3) 高端封装

为进一步提高不同芯片间的互连效率，系统级封装（SIP）逐渐普及使用，其通过将多个异质芯片集成于同一封装体，实现芯片间更短距离、更高效率的互连与信号传输。2.5D/3D 封装则是目前最先进的成熟系统级封装工艺，台积电的 CoWoS 封装是典型代表。

CoWoS 封装通过增设硅中介层，并将经 Chiplet 工艺形成的 CPU、GPU 等多种异质芯片排布其上、多颗存储芯片垂直堆叠，显著提升芯片集成度与复杂度，从而实现更高带宽、更低信号延迟，是目前高性能 AI/HPC 芯片的主流封装方案。

这一高集成度的封装形式推动芯片引脚数量大幅增加。以英伟达 GB200 系列为例，其通过 CoWoS 封装集成 1 颗 CPU、2 颗 GPU 及 16 颗 HBM，测试点密度达上万级，从而使用于单颗芯片测试的探针需求量显著增加；同时，芯片测试间距压缩至 0.35mm，对测试探针尺寸精度要求进一步控制在数个微米级。此外，更大尺寸、更复杂的封装结构使 AI/HPC 芯片测试的复杂度显著提升，测试时间从传统最高几百秒延长到 1500 至 2000 秒，这要求测试厂商采购更多测试插座及探针以保证测试效率，从而进一步推升芯片测试耗材的需求。



资料来源：Wikichip

综上所述，随着芯片性能要求持续提升，尤其是 AI/HPC 芯片行业的快速发展，推动芯片封装朝着高集成度、大尺寸、高功耗、高引脚数方向迭代，芯片互连密度与功耗持续提升。这一演进趋势使芯片测试复杂度显著提升，它要求测试

间距持续微缩且需遵循更严苛的精度要求，以满足更精密的芯片引脚阵列；另一方面，芯片封装高集成度、信号互连复杂度提升也使得单颗芯片的测试时间显著增加，进而推升测试插座及探针需求的快速增长。

| 定义 | QFP | FCBGA | WLCSP | CoWoS |
|-------|---|----------------|-----------------|---|
| 封装类型 | 传统封装 | 先进封装 | 先进封装 | 高端封装 |
| 封装基板 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 需要 |
| 封装尺寸 | 5×5-32×32mm | 10×10-60×60mm | 0.4×0.4-12×12mm | 硅中介层尺寸 3.3 倍光罩（2831mm ² ），封装基板最大尺寸 80×80mm |
| 封装复杂度 | 低 | 中 | 中 | 高 |
| 测试点数量 | 数十~数百 | 数百~数千 | 数十~数百 | 数千~数万个 |
| 测试时间 | 30-150 秒 | 200-600 秒 | 60-200 秒 | 1500-2500 秒 |
| 测试间距 | 1.2mm 微缩至 0.35mm，向 0.3mm 过渡；无基板封装最小间距 0.2mm，并向 0.1mm 过渡 | | | |
| 应用场景 | 汽车电子、家电 | PC 处理器芯片、游戏显卡等 | 基带、射频、传感器芯片等 | AI/HPC 芯片 |

资料来源：Amkor 官网、日月光官网、长电科技官网、台积电官网、Yole

（3）芯片封测行业的发展情况

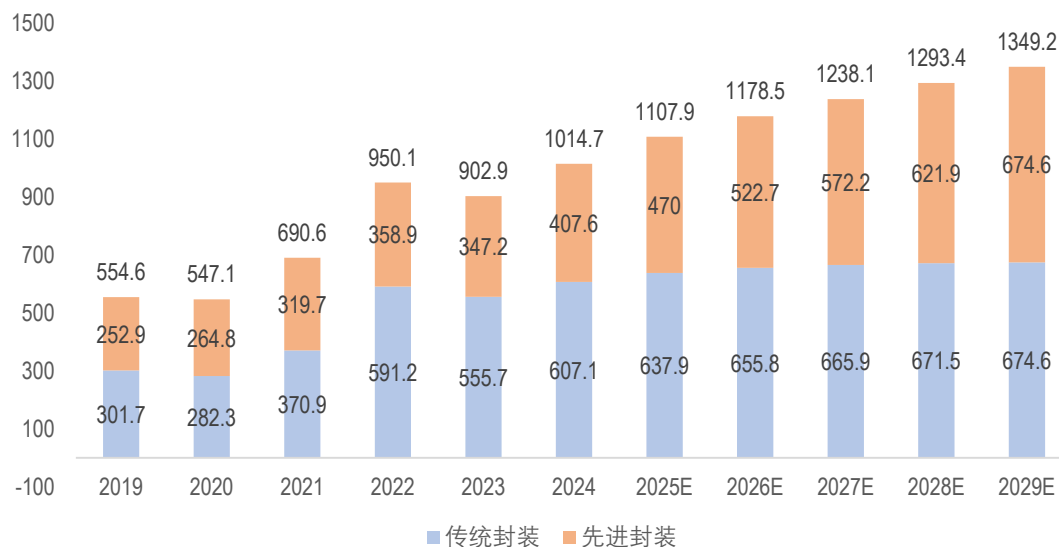
1) 芯片封装行业的市场规模

全球芯片封装行业市场规模从 2019 年的 554.6 亿美元增长至 2024 年的 1,014.7 亿美元，期间复合增长率达到 12.84%。尽管 2023 年受消费电子需求疲软、库存周期调整及宏观经济不确定性等因素影响，行业经历短期回调。但随着传统消费电子需求逐步复苏叠加 AI 算力需求的爆发式增长，同比增速 12.38%，其中先进封装市场规模 407.6 亿美元，同比增速 17.40%。2025 年芯片封装行业持续快速增长，市场规模达到 1,107.9 亿美元，同比增速 9.18%，其中先进封装市场规模为 470.0 亿美元，同比增长 15.31%。

随着 AI 时代的到来，以人工智能、云计算、物联网为代表的 AI 基础设施建设的持续推进以及端侧 AI 发展所带来的对手机、智能电脑等消费电子以及自动驾驶等智能终端更新式需求的驱动，预计全球芯片封装市场规模将在 2029 年达到 1,349.2 亿美元，2024 年至 2029 年复合增长率为 5.86%。其中，先进封装作为后摩尔时代的重要选择，将成为推动全球芯片封装行业持续发展的重要动力，预计 2024 年至 2029 年全球先进封装市场将保持 10.60% 的复合增长率，2029 年全球

先进封装占全球封装市场的比重将达到 50.00%。

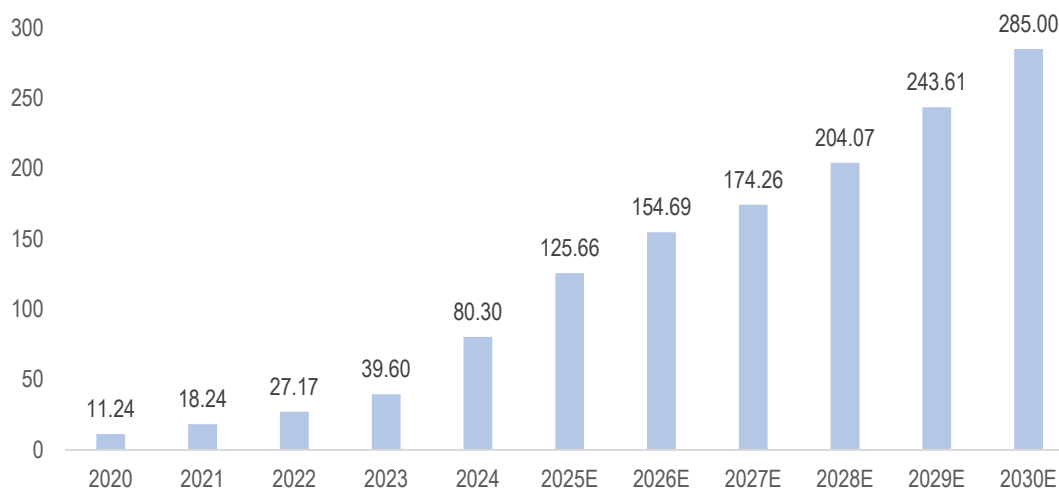
全球封装市场规模及细分情况（亿美元）



资料来源：Yole、灼识咨询

高端封装以 2.5D/3D 集成封装技术为核心，用于解决最尖端算力需求。深度受益 AI 算力需求的爆发式增长，2024 年全球高端封装市场规模 80.30 亿美元，同比增长 102.78%。随着 AI/HPC 芯片需求的持续增长，预计 2030 年全球高端封装市场规模将达到 285.00 亿美元，2024 年至 2030 年复合增速将高达 23.51%。

全球高端封装市场规模（亿美元）



资料来源：Yole

2) 芯片测试行业的市场规模

芯片性能的稳定可靠，离不开其进入消费市场前严苛的测试验证环节。这是因为，芯片一旦在实际应用场景中发生故障，所引发的后果往往极其严重：对芯

片厂商而言，不仅将蒙受高昂的经济损失，更会对品牌信誉造成难以挽回的损害；而在汽车电子、工业控制、航空航天及医疗设备等安全关键领域，芯片故障更可能引发致命性的系统性失效，甚至直接危及人身安全。正因如此，全流程芯片测试以保证芯片在生命周期内功能完整、性能达标与运行稳定，已成为芯片制造产业链中的必要环节。

①芯片测试行业的主要构成

芯片测试分为晶圆测试和芯片阶段测试。晶圆测试是晶圆在切割和封装前进行的电性能与功能验证，以识别出有缺陷的芯片晶粒。芯片阶段测试也称为封装后测试，是芯片晶粒封装为完整芯片后需经历的一系列测试，以验证其在不同环境下的功能与性能，是芯片进入系统集成或消费市场前的最终质量关口，直接决定产品出厂质量与生命周期内的可靠性。

探针卡是晶圆测试环节的核心接口，其通过接触晶圆表面凸块，在晶圆与测试设备之间建立稳定的信号连接。测试插座是芯片阶段测试的关键接口，其通过提供稳定可靠的电气连接，实现芯片的老化测试、成品测试（FT）与系统级测试（SLT）。其中，老化测试是通过高压、极端温度等严苛条件对芯片进行的应力测试，旨在消除芯片早期失效风险；成品测试是对芯片进行的一系列全功能测试，旨在对芯片功能与性能进行全面评估，筛选出符合规格要求的芯片；系统级测试则主要验证高性能、复杂封装结构芯片在真实工作场景下的性能表现，目前AI/HPC芯片普遍增设系统级测试环节，从而显著增加单颗芯片的测试时间。

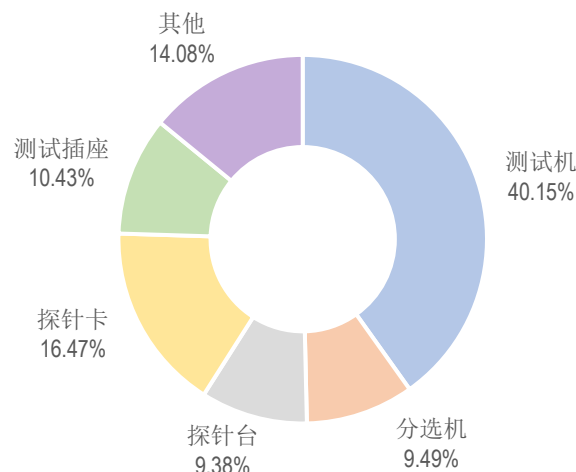


资料来源：高盛研报

②芯片测试行业的市场规模

2024年芯片测试行业的市场规模为154.15亿美元，芯片测试设备的市场规模99.29亿美元，占比64.41%；芯片测试耗材的市场规模54.86亿美元，占比35.58%。其中，探针卡和测试插座作为芯片测试中的关键耗材，2024年市场规模分别为25.39亿美元和16.07亿美元，占比分别为16.47%和10.43%。

2024年全球测试设备及耗材的市场份额占比



资料来源：Yole

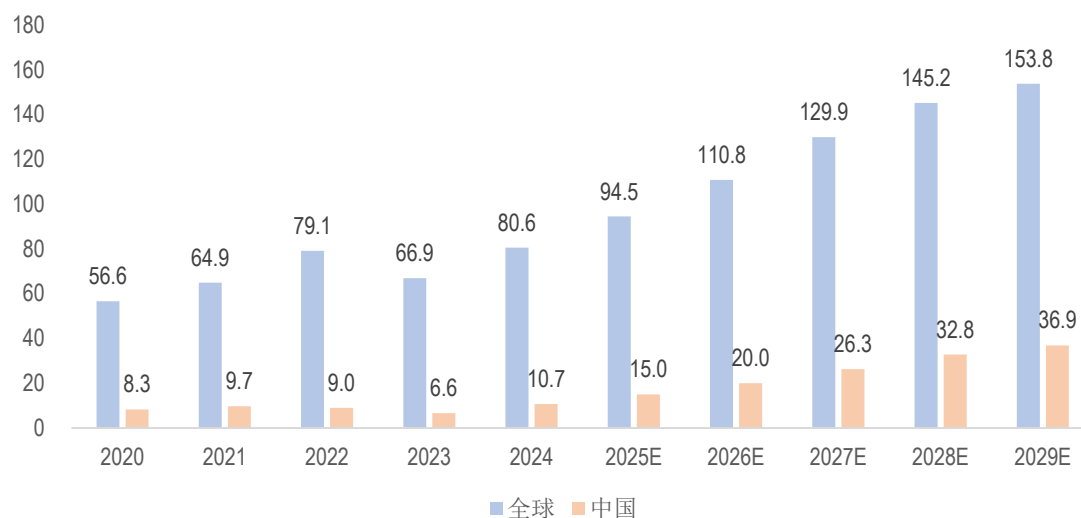
3、芯片测试探针及零件的发展概况

（1）芯片测试探针的市场规模

在全球市场层面，2020年至2024年，芯片测试探针市场规模由56.6亿元提升至80.6亿元，期间年复合增长率达9.24%。受益于先进制程与复杂封装工艺对测试强度要求的提升，预计至2029年，全球市场规模将进一步扩张至153.8亿元，2024年至2029年的复合增长率将显著提升至13.80%。

在中国市场方面，2020年至2024年，芯片测试探针的市场规模由8.3亿元增至10.7亿元，年复合增长率为6.56%，处于蓄势阶段。随着国内封测产业链的日益成熟及高端测试探针国产化渗透率的快速提升，预计到2029年，国内市场规模将实现跨越式增长，达到36.9亿元，2024年至2029年的复合增长率有望达到28.09%，展现出较强的后期增长潜能与爆发力。

全球及中国芯片测试探针市场规模（按市场空间计，亿元）



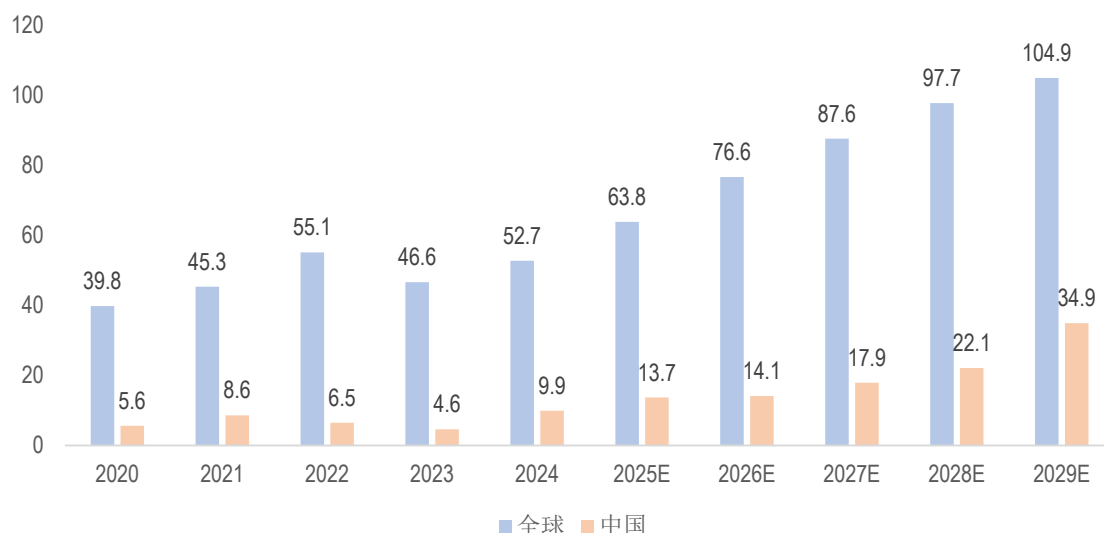
资料来源：沙利文咨询

（2）芯片测试探针零件的市场规模

在全球市场层面，2020年至2024年，芯片测试探针零件市场规模由39.8亿元稳步升至52.7亿元，期间年复合增长率为7.27%。受益于全球半导体产业链复苏及包括AI在内的终端应用需求增长，预计至2029年，全球市场规模将进一步扩张至104.9亿元，2024年至2029年复合增长率预估将提升至14.76%。

在中国市场方面，2020年至2024年，国内市场规模由5.6亿元稳步增长至9.9亿元，年复合增长率达15.31%，展现出显著高于全球平均水平的增长韧性。展望未来，受本土封测产业扩产及核心零件国产化提速的双重驱动，预计到2029年，中国市场规模将实现跨越式增长，达到34.9亿元；2024年至2029年的复合增长率有望高达28.66%，国内市场在全球版图中的重要性将进一步凸显。

全球及中国芯片测试探针零件市场规模（按市场空间计，亿元）



资料来源：沙利文咨询

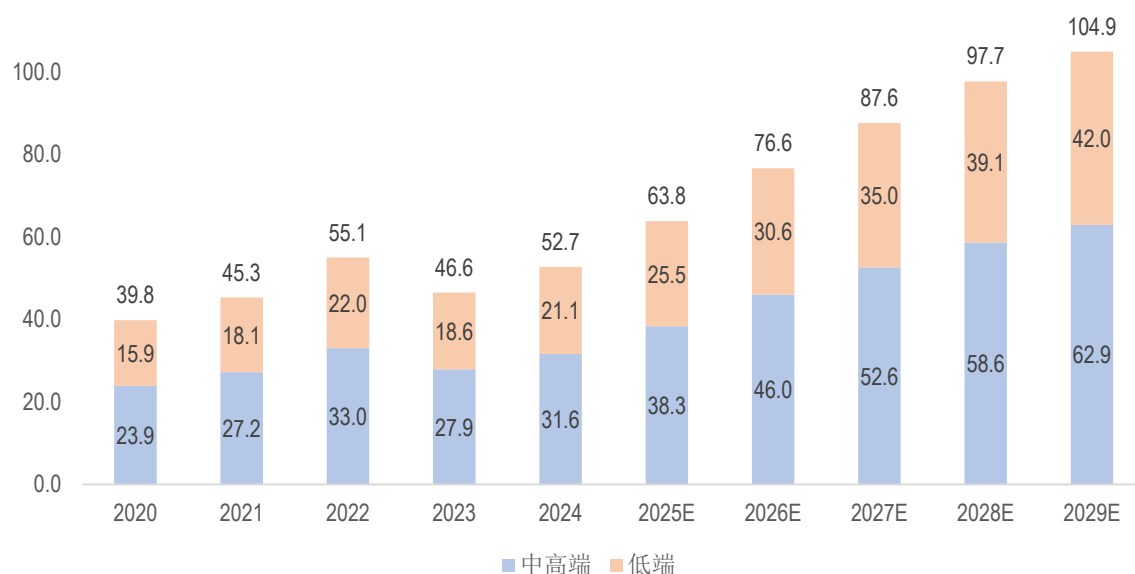
（3）芯片测试探针零件的细分结构情况

1) 高中低端芯片测试探针零件的市场规模

随着芯片制程与封装工艺的持续升级，对芯片测试探针的精度要求不断提高，通常测试间距在 0.5mm 及以下的探针被视为中高端产品。其中，钨合金测试探针具备高硬度、低电阻与优异抗形变能力，可实现更微细尺寸，机械和电气综合性能突出，逐步成为高端芯片测试的主流选择，并广泛应用于 AI/HPC 芯片等高引脚数、高功耗的测试场景。

2020 年至 2024 年，全球中高端芯片测试探针零件市场规模从 23.9 亿元稳步增长至 31.6 亿元，复合增长率为 7.23%。伴随着全球芯片产业链复苏以及 AI/HPC 芯片行业爆发式增长，预计到 2029 年，全球中高端芯片测试探针零件市场规模将进一步扩大至 62.9 亿元，2024 年至 2029 年的复合增长率预计将提升至 14.76%。

全球芯片测试探针零件市场规模（按市场空间计，分等级，亿元）



资料来源：沙利文咨询

2) 钼合金测试探针凭借多重性能优势成为高端芯片测试探针的代表

为进一步提升芯片性能，以 AI/HPC 为代表的高端芯片在信号传输过程中呈现出更高带宽、更高频的特性，这要求测试探针持续保持更低的自身电阻和接触电阻，才能在高频信号测试过程中维持低阻抗，从而降低对信号传输及测试结果的干扰，提高芯片测试的可靠性。

钼合金测试探针凭借多重性能优势，高频信号测试工况下，可显著降低并长期保持低阻抗水平，成为高端芯片测试的优选材料。具体来看：①优异的抗氧化性与耐腐蚀性：能有效抑制测试探针表面高阻值氧化物的生成，避免因氧化物滋生导致阻抗升高或异常波动；②高硬度、高耐磨性：确保测试探针在接触时有效刺破芯片引脚表面的氧化膜而不损伤芯片引脚，形成纯净的金属接触，从而降低接触阻抗；同时，高耐磨性和高强度可保证测试探针在长期高频次测试中保持稳定的几何结构，避免因磨损或变形引发阻抗漂移；③采用高性能钼合金棒材加工的探针零件可达到镜面级光洁度，大幅减少“粘锡”、锡料残留及污染物吸附，有效应对高频信号测试中的“趋肤效应”，最终实现持续低阻抗，为芯片测试的精度、信号完整性与长期可靠性提供有力保障。

（四）所属行业的主要壁垒

1、技术壁垒

芯片测试探针零件行业属于技术密集型行业，其技术与芯片行业的先进制程、先进封装工艺发展深度绑定。随着半导体技术不断突破，芯片测试正持续向测试间距微缩、高引脚数量、高功耗方向演进，这对测试探针零件的机械与电气性能提出了严苛的要求。

首先，测试探针零件机械性能要求不断提高，具体体现为：一是尺寸持续微缩。探针零件尺寸需持续微缩，以适配芯片引脚阵列间距不断缩小的发展趋势。二是更精密的尺寸公差控制。在高端芯片测试中，探针零件的尺寸公差需控制在微米级，从而确保在高密度测试中，始终与被测芯片引脚精准对位，避免因尺寸偏差引发的短路或接触失效；三是高频次测试下的力学稳定性。探针零件需始终保持高硬度、高抗形变能力，确保高频使用后仍能保持几何形状与接触性能，避免因磨损或形变导致测试可靠性下降。

在电气性能方面，为满足高端芯片的高带宽、高频特性，探针零件需具备低电阻率、高耐磨性、高强度以及镜面级表面光洁度，防止因氧化、腐蚀或“粘锡”等引发的阻抗漂移。

对探针零件持续提升的机械及电气性能要求，倒逼探针零件加工工艺及探针材料研制的不断升级。材料端，需通过合金配方研制、合金比例精准调配、制备工艺的持续优化，实现具有高硬度、低电阻率、高抗形变能力的合金原材料；加工端，需依赖与微细零件加工匹配的精密刀具、超精密微细零件加工工艺，以实现零件尺寸、精度、表面粗糙度的精准控制；后道收集与清洗环节，微细探针零件的自动化无损伤收集、清洗及检测工艺，亦是确保零件一致性、洁净度与可靠性的关键环节，从而有效保证探针批量供应的稳定性。

探针零件制造工艺既依赖材料学、机械工程、电子学等多学科知识的深度融合，更依赖企业长期积累的工艺经验、技术沉淀以及行业龙头客户严格验证后形成的反馈迭代机制。这种多维度、全流程的技术门槛，使得新进入企业很难在短时间内掌握相关核心技术与工艺精髓，从而在行业内构筑了较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

测试探针零件行业需要大量资金来支持技术研发、设备购置和产线建设等。一方面，探针材料制备、探针零件加工工艺迭代需要长期持续的研发资金投入；另一方面，测试探针零件生产依赖大量精密数控机床等设备，此类设备通常价格较为昂贵，需要大量的资金投入。对于行业新进入者，短期内获得充足的资金支持难度较高。

3、人才壁垒

测试探针零件行业涉及多学科、多领域的交叉，对专业人才的知识背景、研发能力及经验要求较高，拥有高端专业人才是测试探针零件厂商保持市场竞争力的关键。目前，行业内经验丰富的高端专业人才相对稀缺，主要来自于行业内领先企业的长期培养。对于行业新进入者，短期内培养具备深刻行业认知、丰富生产及研发经验的技术人员的难度较高。

4、客户资源壁垒

测试探针是芯片测试的核心耗材，其性能优劣影响测试数据的准确性，直接关系到芯片产品的质量。因此，下游客户在选择探针零件供应商时往往较为审慎，通常需要经过多轮严格的产品验证、小批量试产及规模化量产测试，全面考核供应商产品性能与稳定性、大批量供应能力与服务水平，直至确认完全符合自身测试需求后，才会建立正式合作关系。

一旦供应商通过客户的全面验证并建立合作关系，客户通常会形成较强的供应链依赖。这是因为，若中途更换供应商，客户不仅需要重新投入大量时间、人力与物力，以对新供应商的产品进行全流程验证，还将面临测试参数重新校准、研发及生产周期延误等额外成本与风险，影响自身生产经营的稳定性。

此外，探针的关键尺寸、材料配方及性能参数，往往与客户的芯片测试策略乃至芯片设计细节深度绑定，承载着客户的部分核心技术信息。出于对自身技术信息保密的需求，下游客户更倾向于与经过长期合作检验、值得信赖的现有供应商保持长期稳定的战略合作关系，从而进一步提升了行业的客户壁垒。

（五）所属行业的发展态势

1、AI 驱动先进封装需求并带动测试探针零件行业进入新增长周期

AI 算力需求的爆发式增长，持续驱动先进封装与测试技术的迭代。为突破单芯片功耗限制，满足大规模并行计算需求，高端 AI/HPC 芯片已普遍采用 Chiplet、HBM 堆叠的 2.5D/3D 先进封装技术，这一趋势使芯片引脚数量、密度显著增加，这要求测试插座配备高密度、高性能的测试探针阵列，以满足复杂信号传输环境下，仍能够保障测试信号完整可靠，以实现芯片性能的精准检测。

在此背景下，AI/HPC 芯片也从“量”与“质”两方面重构测试探针零件的市场需求。数量上，首先，单颗 AI/HPC 芯片所需探针数量可达传统芯片的数倍甚至数十倍，从而提高测试探针使用数量；其次，2.5D/3D 异质芯片堆叠架构提升芯片测试的复杂性，使单颗芯片测试时间从传统的几百秒显著增加到 1,500 至 2,500 秒，从而增加芯片测试探针及插座的需求量，以提升芯片测试效率；此外，持续攀升的算力需求推动 AI/HPC 芯片产品的迭代周期大幅缩短，更快速的产品更新要求测试插座同步调整，进而形成持续增量的探针测试需求，为行业规模增长注入长期动力。

在质量层面，AI/HPC 芯片测试环境的复杂性，对测试探针零件的机械及电气性能、高频次测试稳定性提出了更为严格的标准。这一需求倒逼探针产品在核心材料、精密制造工艺上全面升级，进而提升芯片测试产品附加值。

综上，AI 算力需求的持续增长及产品快速迭代，驱动测试探针零件进入技术持续革新、量价齐升的全新增长周期，也为具有全流程生产制造核心技术的探针零件企业带来了广阔的市场发展空间。

2、定制化 AI 芯片的开发推动研发测试探针的需求增长

为追求更高的芯片能效比、更低功耗并实现成本优化，匹配不同客户特定应用场景的定制化芯片开发需求显著增长，其中以 ASIC 芯片为代表的定制化芯片快速崛起，逐渐成为 AI/HPC 芯片市场的重要组成部分。

具体来看，ASIC 芯片的优势在于，可深度匹配特定算法与应用场景，从而实现更优的运行性能与能效表现，同时契合客户降本诉求。这类定制化需求呈现高度碎片化特征，从云端数据中心、自动驾驶汽车、工业机器人到边缘智能设备

的不同行业，乃至同一行业不同企业，均存在不同的芯片定制需求，这一需求趋势驱动定制化芯片开发项目数量快速增长，进而推升开发阶段测试探针的需求。与此同时，芯片开发项目通常需经历多次原型设计、流片与验证迭代，在此过程中，需频繁借助测试插座开展芯片性能验证与功能调试，这类研发场景对测试探针的精度、稳定性往往要求更高，有助于提升开发阶段所需探针的销售价格。

另一方面，芯片开发阶段测试探针的高需求，还源于其测试生命周期与芯片量产阶段的显著差异。在芯片开发验证环节，测试探针主要用于原型样品调试，每个测试周期的使用次数有限，生命周期相对较短；而芯片量产阶段的测试探针，往往达到数万次甚至更高频次的长期持续性测试，生命周期更长。这种短周期、高迭代速度的特性，促使芯片开发企业更频繁地替换测试插座及探针，从而增加开发阶段测试探针的市场需求。

3、端侧 AI 驱动智能设备革新并成为测试探针市场新的增长引擎

端侧 AI 是指在智能手机、PC、可穿戴设备、智能汽车、人形机器人、智能家居等终端设备上，本地化运行人工智能算法和模型的技术形态。其核心优势在于将数据处理、模型推理过程从云端转移至设备本身，具有低延迟、高隐私性保护、低网络依赖的优势，有助于提升用户使用体验。随着 DeepSeek 等高效、开源的“蒸馏”大模型逐步落地应用，端侧 AI 的普及进程加速，其对芯片测试需求的带动作用日益凸显。

首先，从需求量看，端侧 AI 的快速发展，同时激发了研发与量产两大环节的测试需求。一方面，主流芯片厂商为持续提升终端设备的 AI 使用体验，正积极布局并开发集成更强 AI 算力的新一代 SoC 芯片，芯片设计验证、性能调试等开发测试需求大幅增加，推动测试探针需求增加；另一方面，端侧 AI 所打造的全新智能化体验，将催生新一轮终端换机与设备更新浪潮，这一趋势将在智能手机、PC、自动驾驶汽车等终端市场形成庞大的芯片出货基数，进而推升量产环节测试探针需求的增加。

其次，从测试探针的产品附加值来看，为支撑复杂的端侧 AI 运算、保障运算效率与稳定性，新一代端侧 AI 芯片普遍采用更先进的制程工艺、更高的引脚密度以及更复杂的封装形式。这一技术升级趋势，对测试插座的引脚密度、信号

传输完整性与稳定性亦提出了更高要求，进而推升高端测试探针的市场需求，提升测试探针产品附加值。

综上，端侧 AI 的发展与普及，对测试探针行业形成了量价双升的格局，一方面通过持续芯片开发与终端换机潮，从“量”上推动测试探针市场需求增加；另一方面通过芯片技术升级从“价”上提升测试探针的产品附加值。未来，随着端侧 AI 应用场景持续拓展、普及度进一步提升，测试探针行业将持续充分享受行业发展红利，实现高质量增长。

（六）所属行业面临的机遇与挑战

1、所属行业面临的机遇

（1）下游 AI 算力及先进封装行业的发展拉动芯片测试需求

随着下游人工智能行业的蓬勃发展和 AI/HPC 芯片在智能终端市场的加速渗透，芯片产业需求显著提升，并推动高端芯片向更微缩制程工艺、高带宽、低延迟等技术方向演进。这一趋势持续推动先进封装的技术革新与市场需求，进而带动芯片测试探针及零件行业需求增加与技术发展。

（2）国家产业政策扶持将推动芯片测试行业持续健康发展

近年来，国际半导体供应链安全事件频发，促使我国芯片行业深刻认识到自主可控的战略意义。半导体技术的自主创新能力，不仅关乎产业竞争力，更与国家安全紧密相连，推进半导体全链条国产化已刻不容缓。

近年来，我国政府已把集成电路产业上升至国家战略高度，并出台一系列产业支持政策。比如，2020 年国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，旨在进一步优化集成电路产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量；国务院“十四五”数字经济发展规划也提出要提高集成电路等战略性前瞻性领域的基础研发能力和关键技术创新能力，完善集成电路等重点产业的供应链体系。

在此背景下，政策扶持、市场需求与资本投入共同驱动芯片产业链国产化，从芯片设计、制造到封装测试，各环节本土厂商的技术均得以持续提升。芯片测试探针及其零件作为芯片测试环节的关键物理接口，将充分受益芯片产业链国产

化进程，释放巨大的发展潜力。

（3）下游应用的持续扩张与创新为芯片测试领域带来可观的市场增长空间

当前，芯片测试市场规模充分受益下游应用场景的持续扩张。一方面，智能手机、可穿戴设备等消费电子产品深度融合 AI，为用户带来全新使用体验，这一趋势有望驱动智能设备换机潮，进而推动芯片测试需求增长；另一方面，随着人工智能、云计算、物联网等数字经济新兴场景的快速发展，市场对 AI/HPC 芯片、先进封装需求持续提升，进一步驱动芯片测试需求增长与测试技术迭代升级。

2、所属行业面临的挑战

（1）部分关键设备仍依赖国外

芯片测试探针零件作为微米级高精度产品，其制造过程中所需的关键加工设备——高精密度数控机床，目前仍主要依赖进口。国产数控机床在长期运行稳定性、重复定位精度等方面与国际先进水平仍存在一定差距，制约了探针零件加工的一致性与可靠性。

总体来看，芯片测试探针在关键设备环节仍在一定程度上受制于海外供应链，加快推进高精度数控机床的国产化进程，已成为提升该细分领域自主可控能力、保障产业稳健发展的紧迫任务。

（2）高端人才供应不足

芯片测试探针零件的制造高度依赖高端技术型人才，这不仅要求从业者具备扎实的理论基础，更需拥有长期实践积累形成的工艺经验。然而，当前行业内既懂理论又精于实践的高端技术人才供给明显不足，难以匹配行业快速发展的需求。

芯片测试探针加工领域对人才的要求体现于三方面：首先，测试探针零件属于多学科交叉的高端技术产品，涉及材料学、机械工程等多个领域，要求人才具备复合型知识结构和跨学科工程实现能力；其次，从业人员需深入理解上下游产业链，包括设备特性、材料性能及客户具体应用场景，才能实现从设计到制造的有效衔接；最后，该领域技术人才的培养周期较长，往往需要长期一线实践与持续学习，方能熟练掌握精密加工等关键工艺。

因此，随着行业技术迭代发展与市场需求的持续扩张，高端技术人才缺口日

益凸显，已成为制约我国测试探针零件行业向更高技术层级发展的关键因素之一。

（七）所属行业周期性特征

芯片测试探针零件是芯片测试所需的核心部件，芯片测试是芯片制造过程中的必要环节，因此其需求与芯片行业发展具有高度相关性。此外，由于芯片产品已广泛应用于 AI 算力基础设施、消费电子、汽车以及工业等国民经济各领域，因此芯片测试探针零件行业的周期性变化与国民经济周期具有相关性。

（八）发行人在产业链中的地位和作用

芯片测试探针是芯片后道测试的核心部件，作为连接测试设备与被测芯片之间的唯一接口，所有测试信号均需通过探针传输，其性能水平是保障测试准确性的关键。而测试探针性能的实现，有赖于测试探针零件的尺寸、精度、机械及电气性能等的共同提升。

在测试间距与机械强度层面，测试探针需满足芯片引脚更高密度、更大规模引脚数的要求。一方面，为适配先进制程芯片测试间距的持续微缩，探针零件的尺寸必须不断小型化并具备微米级精度，才能确保在大规模并行测试中能够精准接触每一个芯片引脚，避免因接触偏差导致的测试失效、芯片短路等风险；另一方面，探针零件必须具备高硬度、高强度和抗形变能力，才能保证在高频次测试中始终维持稳定的几何结构，避免出现磨损、变形而导致阻抗漂移，保障芯片测试的可靠性。

在信号传输层面，高性能 AI/HPC 芯片的高带宽、信号高频特性，要求测试探针具备优异的机械及电气属性，以降低芯片测试过程中的阻抗水平。这一方面要求测试探针自身电阻需持续优化，该目标的实现，有赖于探针材料配方优化与制备工艺提升；另一方面，它要求测试探针零件具备高硬度与高耐磨性，确保能有效刺破锡球表面的氧化层，保证充分稳定接触，同时避免“粘锡”的发生。

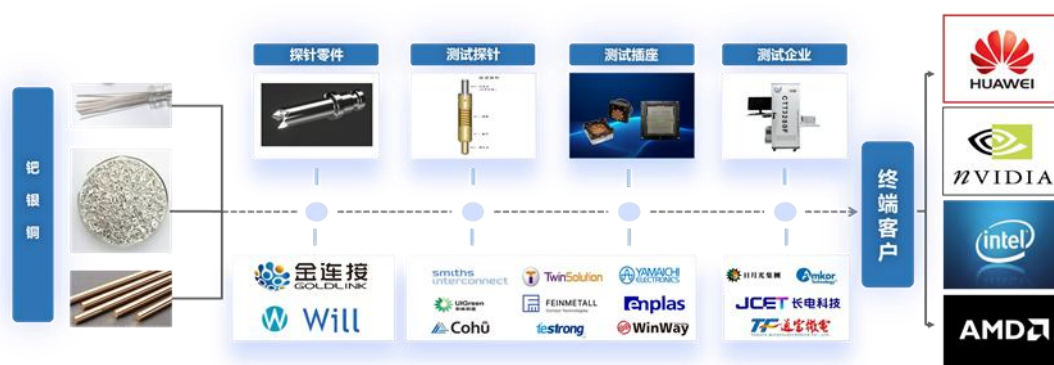
此外，各测试探针需精准设计并进行微米级精度的加工，才能保证后道精密组装，最大程度降低各探针零件在接触界面上的阻抗水平，确保电信号在探针内部传输的稳定与可靠。

综上，测试探针性能的实现有赖于探针零件在尺寸、精度、机械及电气性能的综合协同。只有具备低电阻率、高硬度、镜面级表面光洁度、高精度与高批次

一致性的测试探针，才能在高频信号传输工况下精准传递测试信号，为芯片质量管控提供坚实保障。

（九）所属行业与上、下游行业的关联性

公司的芯片测试探针零件应用于芯片后道测试阶段。上游主要为钽合金、铍铜、磷青铜等金属材料、加工设备及耗材；下游主要为测试探针及测试插座厂商，应用于封测厂、晶圆代工厂及 IDM 厂商，以完成芯片的高效测试。



1、与上游行业的关联性

公司上游主要为测试探针原材料、加工耗材及设备三大类。其中，公司已成功实现关键原材料——钽合金棒材与关键加工耗材——精密刀具的自主制造。

在原材料方面，公司主要采购钽片、铍铜棒、磷青铜毛细金属管等金属材料，并具备将钽片通过精密加工制备成超细钽合金棒材的能力，该技术有效减少进口依赖，并显著降低原材料成本。

在加工耗材方面，公司主要采购刀坯、刀具基体、刀杆等。公司已掌握刀具的真空焊接与组装、高精度磨削工艺，可自主生产精密刀具，大幅降低加工成本。

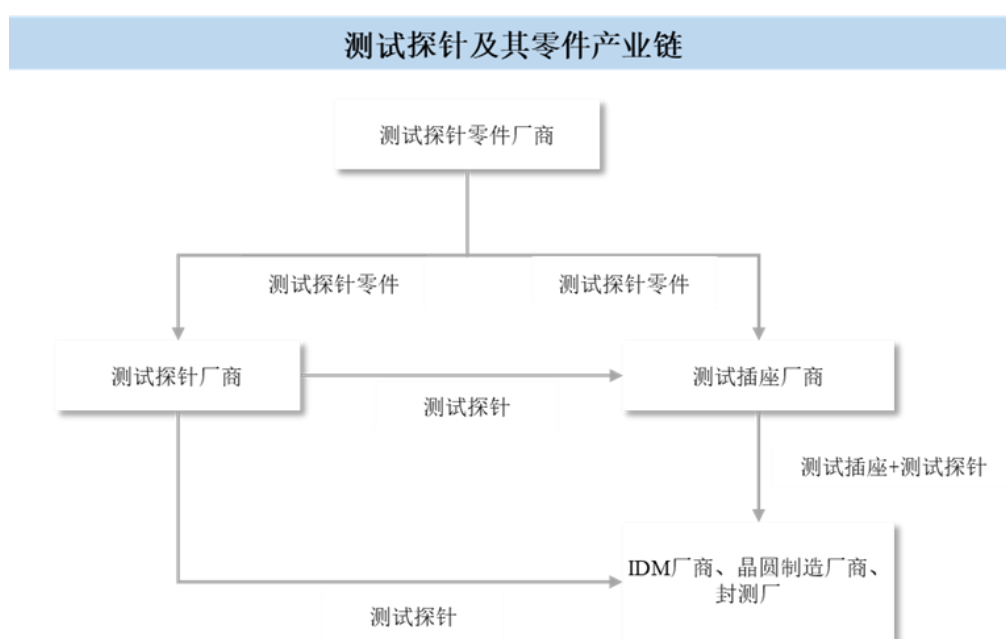
设备方面，材料制备环节主要配置金属熔铸、拉拔及回退火设备；刀具生产环节主要配置以精密磨床、真空焊接设备为核心的精密刀具生产线；零件加工环节以精密数控机床为核心。

综上，上游钽、银、铜等金属价格波动会对公司原材料采购成本产生一定影响，公司通过钽合金棒材的自主生产实现了成本优化与稳定供应；通过精密刀具的自主研发与生产，公司在关键耗材方面实现了成本优化。在核心加工设备方面，目前仍以进口为主。

2、与下游行业的关联性

公司测试探针零件产品主要面向下游测试探针和测试插座厂商。测试探针厂商是指以销售测试探针为主营业务的企业，其采购或自产测试探针零件后组装成测试探针成品对外销售；主要测试插座厂商往往兼具组装测试探针和生产测试插座的能力，其主营业务包括：一是销售集成测试探针的测试插座，二是销售测试探针。

测试插座厂商将测试插座成品出售给下游封测厂商、晶圆代工厂及 IDM 厂商，用于芯片测试环节。



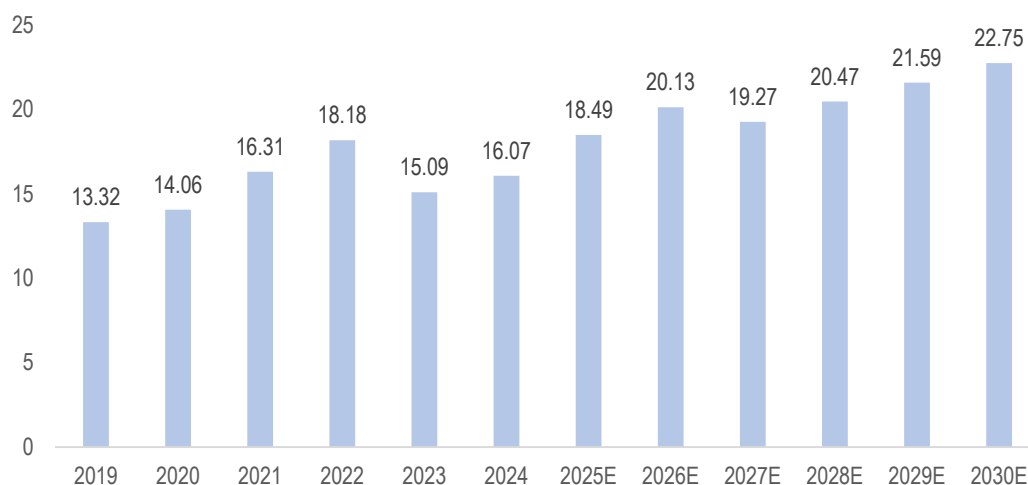
（1）测试探针行业的发展概况

具体情况参见本节之“二、所处行业基本情况”之“（三）行业发展概况”之“3、芯片测试探针及零件的发展概况”。

（2）测试插座行业的发展概况

受益于消费电子复苏及 AI/HPC 芯片行业的快速发展，2024 年全球测试插座市场规模为 16.07 亿美元，同比增长 6.46%，预计 2025 年全球测试插座市场规模将进一步达到 18.49 亿美元，同比增长 15.07%。随着全球在 AI 基础设施的持续投资，预计 2030 年全球测试插座市场规模将达到 22.75 亿美元，2024 年至 2030 年均复合增长率 5.96%。

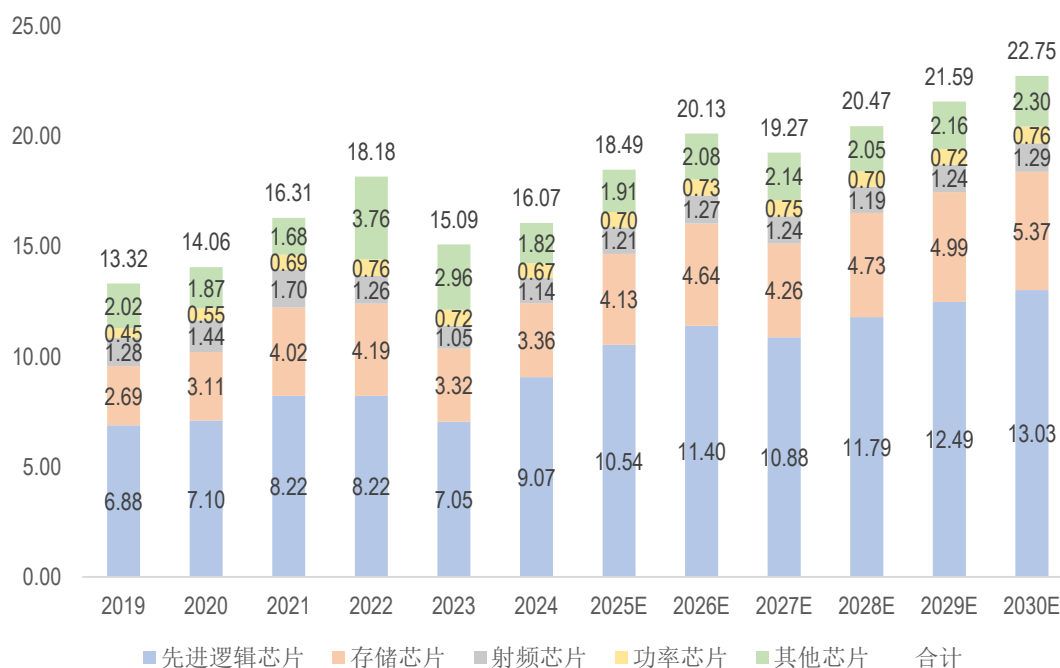
全球测试插座市场规模（亿美元）



资料来源：Yole

从应用领域来看，测试插座可应用于先进逻辑芯片、存储芯片、射频芯片、功率芯片等。以 CPU、GPU 和 ASIC 为代表的先进逻辑芯片是测试插座最大的细分应用领域，2024 年对应的市场规模达到 9.07 亿美元，同比增长 28.67%。预计随着 AI/HPC 行业带动高端芯片需求的持续增长，2030 年应用于先进逻辑芯片的测试插座市场规模将达到 13.03 亿美元，2024 年至 2030 年复合增速将达到 6.22%。

全球测试插座市场规模（亿美元，按应用领域）



资料来源：Yole

（3）测试插座行业的竞争格局

长期以来，测试插座行业被境外厂商主导，主要由于其进入市场较早，与下游芯片代工厂、封测厂的绑定较深。根据 Yole 的数据，2024 年全球前十大测试插座厂商合计占据 61.14% 的市场份额。

境内方面，主要测试插座厂商包括韬盛科技、凯智通、捷策创、法特迪等，科创板上市公司和林微纳近年来亦布局测试插座相关业务。

2024 年全球测试插座市场占有率的排名情况

| 排名 | 厂商名称 | 国家/地区 | 市场份额 |
|----|--------------------|-------|-------|
| 1 | Yamaichi | 日本 | 9.82% |
| 2 | WinWay | 中国台湾 | 9.11% |
| 3 | Leeno | 韩国 | 7.21% |
| 4 | Cohu | 美国 | 7.01% |
| 5 | Enplas | 日本 | 6.29% |
| 6 | ISC | 韩国 | 5.28% |
| 7 | Advantest | 日本 | 4.98% |
| 8 | Yokowo | 日本 | 4.57% |
| 9 | Smith Interconnect | 英国 | 3.92% |
| 10 | BOYD | 美国 | 2.96% |

资料来源：Yole

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）所属行业竞争格局

芯片测试探针零件市场主要包括两类厂商：一类是测试探针和测试插座厂商，其自产测试探针零件，但主要自用于生产测试探针和测试插座，比如韩国 Leeno、中国台湾 WinWay、日本 KITA、和林微纳等；一类是专门从事测试探针零件生产和销售厂商，不自产测试探针和测试插座，而将测试探针零件销售给测试探针和测试插座厂商，包括日本 Will、发行人。

根据沙利文咨询发布的行业报告显示，2024 年公司在测试探针零件市场的市场占有率位居全球第五位，亦是唯一跻身全球前五的中国本土测试探针零件厂商。

2024 年全球测试探针零件市占率的排名情况

| 排名 | 国家 | 企业名称 | 市场份额 |
|----|------|--------|-------|
| 1 | 韩国 | Leeno | 11.0% |
| 2 | 中国台湾 | WinWay | 9.1% |
| 3 | 日本 | Will | 4.0% |
| 4 | 日本 | KITA | 3.4% |
| 5 | 中国大陆 | 金连接 | 2.3% |

资料来源：沙利文咨询

（二）行业内主要企业

| 企业名称 | 简介 |
|-------------|--|
| 韩国 Leeno | Leeno (Leeno Industrial Co.,Ltd) 成立于 1978 年，总部位于韩国，专业从事半导体测试耗材的生产，是该领域内的主要企业。核心产品为半导体测试探针和芯片测试插座。 |
| 中国台湾 WinWay | WinWay (颖崴科技股份有限公司) 成立于 2001 年，公司总部位于中国台湾地区，为 IC 芯片测试接口主要供应商之一，在全球各地都设有销售据点，跨足半导体光通讯、资讯科技和光电技术等领域。 |
| 日本 KITA | 株式会社喜多制作所成立于 1969 年，公司总部位于日本，公司业务围绕精密电子零部件及金属加工展开，主要生产测试探针等电子相关部件及精密金属件，同时可以提供硬质合金模具/刀具加工以及电镀处理服务。 |
| 日本 Will | 日本 Will 株式会社成立于 1993 年，总部位于日本东京，主要生产超细规格的金属零件，包括顶柱头、底柱头、套筒、微弹簧以及组装的探针成品、其他电子零件、汽车零件、医疗零件，是为数不多的、规模领先的对外供应超细探针零件的公司，是发行人在国内外市场最直接的竞争对手。 |
| 和林微纳 | 和林微纳 (苏州和林微纳科技股份有限公司) 成立于 2012 年，和林微纳从事微型精密制造，主要产品包括测试探针、测试插座及精密结构件等。 |

（三）发行人产品或服务的市场地位

公司是全球少数专业从事芯片测试探针零件生产并能够提供全品类高品质测试探针零件的厂商。

凭借良好的品牌声誉、强大的研发实力、领先的产品性能，公司已获得 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等全球知名芯片测试探针及插座厂商的认可，产品最终配套服务于国内外主要芯片厂商的 GPU、CPU、ASIC 芯片测试环节，深度参与全球芯片供应链体系。

（四）发行人的主要竞争优势与劣势

1、公司竞争优势

（1）公司掌握多项关键核心技术并构建强大的技术优势

公司立足于芯片测试探针领域，以自主创新为核心驱动力，构建高精度先进生产工艺、自动化收集与清洗以及超细高性能钨合金材料制备在内的三大技术平台。在此技术体系支撑下，公司形成了探针零件精密加工工艺、探针零件自主收集与清洗以及关键探针材料制备的全流程生产加工能力。具体来看：

首先，公司建立了超精密、高自动化的微细零件加工至后处理能力。通过自主研发精密机床的配套工装、不断改进微细探针零件车铣加工工艺，公司实现超细钨合金棒的稳定自动化加工，形成最小尺寸 0.03mm、最小尺寸公差 $\pm 2\mu\text{m}$ 的微米级加工能力，并能在最小直径 0.04mm 的顶柱头上完成复杂几何结构的镜面级加工。同时，公司掌握了钨合金、铍铜、磷青铜、高碳钢等多种材质微细探针零件制造技术，并自主开发了涵盖自动收集与清洗的全流程后处理体系，构建其规模化、高一致性的一体化制造与质量控制体系。

其次，公司实现了关键原材料与加工耗材的自主生产。一方面，公司通过持续攻关探针材料配方与制备工艺，成功量产高圆度及直线度、具有优异机械及电气属性的超细钨合金棒，保障原材料稳定供应，有效降低生产成本；另一方面，公司自主设计并生产精密刀具，有效降低刀具的对外依赖及生产成本。

目前，上述核心技术已全面应用于芯片测试探针零件的批量生产，实现了从技术研发到产业转化的闭环，有力地实现了国产高端测试探针的性能突破与供应链自主可控。

（2）公司已建立完善的技术研发体系并具有高效的持续研发能力

公司秉承市场为导向的研发创新机制，建立了完善的技术研发体系，在核心业务领域拥有完整的技术布局，并且形成了较强的自主创新能力和规模化工序开发能力。

基于高效的研发体系，公司取得了丰富的研发成果。截至目前，公司共拥有已授权专利 60 项，其中发明专利 30 项，并成功入选为国家级专精特新重点“小

巨人”企业。此外，公司积极引领行业技术发展，“芯片测试用关键电子材料研发与产业化项目”被浙江省科技厅评定为 2023 年度浙江省“尖兵”研发攻关计划项目，“半导体芯片测试探针零件制造项目”入选浙江省产业链协同创新项目，公司产品“测试探针用合金精微部件”成功入选 2023 年度浙江省首批次新材料名单。公司先后被授予浙江省高新技术企业研究开发中心、嘉兴市高新技术研究开发中心、嘉兴市技术中心等荣誉称号，入选浙江省科技型中小企业、全国首批制造业新型技术改造试点城市试点项目。

（3）公司拥有经验丰富的人才队伍和规模化制造能力

公司凭借深厚的人才积淀与领先的制造实力，在芯片测试探针零件领域构筑起坚实的核心竞争优势。公司核心团队拥有超过二十年的精密加工行业经验，技术底蕴扎实；其中多名核心成员持有公司股权，形成了激励有效、结构稳定、执行力强的高层次人才梯队。

公司拥有 32,500 平方米的自建现代化研发制造基地，配备超 400 台精密 CNC 机床、完整的自主刀具研发制造体系及全套辅助工艺设备，构建了规模化、高精度、快速响应的智能制造平台。截至本招股说明书签署日，公司芯片测试探针零件的月产能近 4,000 万件，产能规模与出货量持续位居全球行业前列，具备在国际竞争中的规模化优势与强劲交付实力。

（4）公司下游客户与市场认可度显著提高

公司紧抓全球半导体与 AI 行业的发展机遇，依托高标准的制造与管理体系，成功进入多家行业头部客户的供应链，并在交付能力、质量与技术等方面获得了国内外一流客户的高度认可。目前，公司测试探针零件已稳定供应于 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等全球知名芯片测试探针及插座厂商，并最终应用于国内外主要芯片厂商的高端 GPU、CPU、ASIC 芯片测试服务中。

通过跻身全球高端测试插座及芯片测试供应链，公司逐步构建起坚实的客户壁垒：1) 行业头部客户认证标准严苛、认证周期长，部分全球业务的客户在中国大陆的供应链布局较为集中，对于特定采购项目通常只会认证引入个别合格供应商；2) 公司通过持续工艺优化与技术攻关，不断增强合作粘性与服务深度；3)

公司长期服务于下游行业头部客户，成为其全球战略合作伙伴，已经形成良好的行业声誉，有利于优质客户的进一步拓展；4）与优质客户的合作能够帮助公司更好地把握下游需求的发展方向，从而在技术路线上作出更精准的前瞻性布局。

2、公司竞争劣势

（1）融资渠道亟待拓展

公司所处微细精密零件行业属于技术与资本密集型行业，公司需要通过技术研发、工艺革新、设备开发与生产线智能化改造等方式不断缩短产品设计与生产周期，降低制造与管理成本，提升产能与良率，并适时扩大优势产品产能以抢占市场份额，或根据市场反馈信息快速推出新品以获取先发优势。

在产品参数、交期与成本占优的窗口期，公司有望快速抢占全球芯片测试探针零件市场份额，但目前公司产能利用率已接近饱和。公司主要依靠私募股权融资与银行信贷，需要更多融资渠道进一步提升公司的生产规模以满足下游快速增长的需求。

（2）客户存在采购惯性与思维定势

高端芯片测试探针零件及核心钼合金原材料长期由境外企业主导，形成了一定的采购惯性与思维定势。公司作为我国内地企业，需要持续提供高质量产品，保持良好信誉，不断提高自身知名度与影响力，打破全球客户对我国内地企业微细精密加工能力薄弱的刻板印象，逐步获取国内外客户信任，形成稳定的产品配套与关键技术支撑，方能进一步开拓国内外市场。

（五）发行人与同行业公司的对比分析

发行人主营芯片测试探针零件的研发、生产和销售，主要产品为测试探针零件。日本 Will 与发行人主营业务和主要产品一致，是发行人的直接可比公司，但其为非上市公司。其他可比公司包括韩国 Leeno（058470.KS）、中国台湾 WinWay（6515.TW）、日本 KITA 及和林微纳（688661.SH），均从事测试探针零件生产但不作为产品直接对外销售。

根据可获取的最新数据，公司与主要境内外可比公司的经营情况对比如下表所示：

| 公司名称 | 主营产品类型 | 报告日期 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 |
|----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Leeno (058470.KS) | 测试插座、测试探针等 | 2025年12月31日 | 3,725.34 亿韩元 | 1,519.61 亿韩元 | 7,919.28 亿韩元 | 7,312.19 亿韩元 |
| WinWay (6515.TW) | 测试插座、测试探针等 | 2025年12月31日 | 78.57 亿新台币 | 16.73 亿新台币 | 90.44 亿新台币 | 64.45 亿新台币 |
| KITA | 测试探针 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 和林微纳 (688661.SH) | 精密结构件、精密屏蔽罩、测试探针等 | 2025年12月31日 | 8.68 亿元 (半导体芯片测试探针收入 2.59 亿元) | 0.30 亿元 | 14.76 亿元 | 12.28 亿元 |
| Will | 测试探针零件 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 发行人 | 测试探针零件 | 2025年12月31日 | 2.76 亿元 | 0.59 亿元 | 7.10 亿元 | 4.16 亿元 |

1、公司产品的技术水平及同行业对比情况

(1) 公司产品的技术水平

顶柱头是芯片测试探针直接与芯片引脚进行物理接触并建立电气连接的部件，其性能的优劣直接影响接触电阻大小、接触的稳定性及测试信号的完整性。因此，顶柱头在尺寸、精度、机械及电气性能等方面遵循探针系统最为严苛的标准，是衡量探针零件制造商技术水平的关键。基于此，发行人选择顶柱头产品，列示其技术水平并与同行业进行技术比较。

发行人顶柱头产品的关键技术指标包括最小加工外径、最小皇冠头加工外径、最小外径加工公差、表面光洁度水平以及零件关键尺寸的过程能力指数 CPK。

| 技术指标 | 最小加工外径 | 最小皇冠头加工外径 | 最小外径加工公差 | 表面光洁度水平 | 零件关键尺寸的过程能力指数 CPK |
|------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|--|
| 指标说明 | 随着芯片小型化，要求更小的探针直径 | | 芯片测试探针要求严格的公差制造水平，以确保探针成品的高品质 | 顶部接触面更光滑，避免芯片引脚锡料堆积 | 过程能力指数一方面反映探针零件批量生产的质量水平，另一方面也保证客户批量装配的良好适用性 |
| 发行人 | φ0.03mm | φ0.04mm | ±2μm | Ra<0.025μm 的镜面级光洁度 | CPK≥1.67 |

(2) 与同行业的技术对比情况

具体情况参见本节之“八、发行人核心技术和研发情况”之“（一）核心技术情况”之“3、发行人主要产品的先进性及与同行业对比情况”之“（1）芯片测试探针零件产品的技术参数对比”。

2、可比公司的选取依据及相关业务可比程度

公司主要产品为芯片测试探针零件，目前境内外上市公司不存在与公司在产品种类、经营模式等方面完全可比的公司。基于此，发行人立足自身所处行业的上下游企业，最终选择能够自主生产测试探针零件、主要产品聚焦在测试探针及测试插座、具有一定行业代表性、经营信息以及财务数据可获取的上市企业作为可比公司，选取标准具有客观性。

根据以上标准，公司选取 Leeno（058470.KS）、WinWay（6515.TW）及和林微纳（688661.SH）作为可比公司。

3、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

上述情况在报告期内未发生重大不利变化，未来亦无可预见的会对公司产生重大不利影响的变化趋势。

四、发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品产能、产量、销量

1、主要产品产能、产量、销量及产能利用率情况

报告期内，公司主要产品芯片测试探针零件的产能、产量及销量情况如下：

| 产品类型 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 芯片测试探针零件 | 产能（万件） | 30,025.28 | 28,873.49 | 19,917.62 |
| | 产量（万件） | 26,539.32 | 15,077.05 | 8,510.82 |
| | 产能利用率 | 88.39% | 52.22% | 42.73% |

注：芯片测试探针零件的核心加工工序为 CNC 机床加工，亦为公司的瓶颈工序。为匹配公司 CNC 机床产能，以上产量数据为各期 CNC 机床加工完成的探针零件数量（包括无需进一步电镀的探针零件和尚需进一步电镀的探针零件半成品）

从产能利用率来看，2023 年和 2024 年，公司芯片测试探针零件的产能利用率分别为 42.73%和 52.22%，该变动趋势主要受全球半导体行业周期性波动及公司前瞻性产能布局策略共同影响。

根据 Yole 发布的行业数据，受半导体库存周期调整影响，2023 年全球半导体市场规模为 5,302.25 亿美元，同比下降 7.40%。行业景气度下行传导至芯片测试探针零件领域，导致订单需求显著收缩，使 2023 年设备产能利用率维持在较低水平。

尽管行业处于周期低谷，但公司坚定看好半导体行业长期发展前景，主动把握设备交期、采购成本具备相对优势的窗口期，实施前瞻性产能扩张，加大生产设备的资本投入，进一步扩大产能规模。2024 年全球半导体行业逐步复苏，公司芯片测试探针零件的订单量及产量实现较大幅度增长，但因产量增长幅度小于产能增长幅度，当期产能利用率仍处于相对偏低水平。

2025 年，公司受益 AI 芯片与先进封装市场需求的高速增长，芯片测试探针零件订单量增加显著，带动产能利用率提升至 88.39%，其中 2025 年下半年进一步达到 96.03%，回归至合理较高水平。

2、主要产品的产销率情况

报告期内，公司产销率分别为 93.32%、104.21%和 95.27%，均维持在较高水平。

| 产品类型 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 芯片测试探针零件 | 产量（万件） | 26,670.69 | 12,192.23 | 6,607.89 |
| | 销量（万件） | 25,408.52 | 12,704.99 | 6,166.34 |
| | 产销率 | 95.27% | 104.21% | 93.32% |

注：以上产量数据为各期达到销售状态的探针零件产量，包括无需电镀的成品探针零件产量、已电镀完工入库的成品探针零件产量等

（二）主营业务收入的构成情况

1、按产品分类

报告期内，公司主营业务收入分产品的构成情况如下表所示：

单位：万元

| 产品类别 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 芯片测试探针零件 | 22,385.63 | 92.14% | 12,112.76 | 85.56% | 6,583.11 | 77.74% |
| 射频互连部件 | 1,469.90 | 6.05% | 1,771.30 | 12.51% | 1,679.97 | 19.84% |
| 其他 | 438.75 | 1.81% | 273.80 | 1.93% | 204.82 | 2.42% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

其中，射频互连部件主要包括射频连接器零件及电缆组件，其他主要包括绝缘件、自产钽合金材料以及医疗器械精密零件。

2、按季度分类

报告期内，公司主营业务收入按季度划分的情况如下：

单位：万元

| 季度 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-----|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 一季度 | 3,916.41 | 16.12% | 2,394.67 | 16.91% | 2,022.08 | 23.88% |
| 二季度 | 5,853.97 | 24.10% | 3,276.47 | 23.14% | 2,014.87 | 23.79% |
| 三季度 | 7,270.13 | 29.93% | 4,125.15 | 29.14% | 1,981.48 | 23.40% |
| 四季度 | 7,253.77 | 29.86% | 4,361.56 | 30.81% | 2,449.47 | 28.93% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

3、按销售区域分类

报告期内，公司主营业务收入按区域划分的情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 境内销售 | 21,743.55 | 89.50% | 11,824.82 | 83.52% | 6,622.43 | 78.21% |
| 境外销售 | 2,550.73 | 10.50% | 2,333.03 | 16.48% | 1,845.48 | 21.79% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

（三）前五大客户销售情况

报告期内，公司前五大客户销售情况如下表所示：

单位：万元

| 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
|---------------------|----------|------------------|---------------|
| 2025 年度 | | | |
| Smiths Interconnect | 芯片测试探针零件 | 13,231.22 | 47.89% |
| 励福环保 | 贵金属废沫 | 3,286.41 | 11.90% |
| 韬盛科技 | 芯片测试探针零件 | 3,000.32 | 10.86% |
| 日拓电子 | 芯片测试探针零件 | 1,624.81 | 5.88% |
| 和林微纳 | 芯片测试探针零件 | 1,186.95 | 4.30% |
| 合计 | | 22,329.72 | 80.82% |
| 2024 年度 | | | |
| Smiths Interconnect | 芯片测试探针零件 | 7,836.38 | 49.55% |
| 励福环保 | 贵金属废沫 | 1,321.54 | 8.36% |

| 客户名称 | 主要销售内容 | 销售金额 | 占营业收入比例 |
|---------------------|----------|------------------|---------------|
| 日拓电子 | 芯片测试探针零件 | 1,293.62 | 8.18% |
| 迪克微 | 芯片测试探针零件 | 847.53 | 5.36% |
| Bel Fuse, Inc. | 精密连接器零件 | 735.88 | 4.65% |
| 合计 | | 12,034.94 | 76.10% |
| 2023 年度 | | | |
| Smiths Interconnect | 芯片测试探针零件 | 3,368.19 | 36.91% |
| S&B Packaging, Inc. | 线缆组件 | 740.05 | 8.11% |
| 日拓电子 | 芯片测试探针零件 | 588.73 | 6.45% |
| 励福环保 | 贵金属废沫 | 580.33 | 6.36% |
| Bel Fuse, Inc. | 精密连接器零件 | 553.90 | 6.07% |
| 合计 | | 5,831.20 | 63.90% |

注 1：上表中销售金额已将受同一方控制或共同控制的销售客户合并计算，Smiths Interconnect 项目下包含安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司、SMITHS INTERCONNECT AMERICAS, INC.，Bel Fuse, Inc.项下包括东莞创宝达电器制品有限公司、CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, INC.

注 2：史密斯集团与美国莫仕电子技术控股有限公司（以下简称“Molex”）达成协议，将子公司 Smith Interconnect 出售给 Molex。2026 年上半年该股权转让已完成

报告期内，公司不存在向单个客户销售占比超过 50%或严重依赖少数客户的情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占权益亦无关联关系。

（四）产品销售价格及变动情况

公司产品主要为芯片测试探针零件、射频互连部件，报告期内平均售价变化的情况如下：

单位：元/个

| 产品 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 平均售价 | 变动率 | 平均售价 | 变动率 | 平均售价 |
| 芯片测试探针零件 | 0.88 | -7.59% | 0.95 | -10.70% | 1.07 |
| 射频互连部件 | 2.97 | -10.23% | 3.31 | -10.50% | 3.70 |

报告期内，公司产品价格波动主要系销售产品细分类型及对应收入结构、原材料价格波动等因素所致。

五、发行人采购情况和主要供应商

（一）报告期内主要原材料采购情况

1、主要原材料采购情况

公司生产使用的主要原材料主要有钯片、磷青铜毛细金属管、刀具、铍铜棒料等。报告期内，公司主要原材料采购金额及占比如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 采购额 | 占比 | 采购额 | 占比 | 采购额 | 占比 |
| 钯片 | 4,374.31 | 25.24% | 2,368.41 | 17.18% | 1,324.41 | 7.04% |
| 磷青铜毛细金属管 | 945.20 | 5.45% | 351.62 | 2.55% | 197.25 | 1.05% |
| 刀具 | 494.50 | 2.85% | 603.71 | 4.38% | 480.70 | 2.56% |
| 铍铜棒料 | 113.45 | 0.65% | 365.66 | 2.65% | 230.48 | 1.23% |
| 合计 | 5927.46 | 34.19% | 3689.40 | 26.76% | 2232.84 | 11.88% |

注：占比为采购金额占当期采购总金额的比例

2、主要原材料价格变动情况及趋势

报告期内，公司主要原材料平均采购价格情况如下：

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 平均价格 | 同比 | 平均价格 | 同比 | 平均价格 |
| 钯片（元/克） | 258.63 | 15.75% | 223.43 | -30.66% | 322.24 |
| 磷青铜毛细金属管（元/米） | 17.30 | -10.15% | 19.25 | -9.57% | 21.29 |
| 刀具（元/个） | 176.49 | -38.77% | 288.23 | -2.87% | 296.74 |
| 铍铜棒料（元/米） | 6.75 | 23.96% | 5.45 | -21.33% | 6.93 |

公司钯片的采购价格，与贵金属钯的市场价格走势保持一致。从贵金属钯的市场走势来看，2023 年呈持续下降趋势，2024 年至 2025 年第一季度维持低位震荡态势，自 2025 年第二季度逐步进入上涨通道。对应地，钯片采购价格随贵金属钯价格同步变动：2024 年采购价格较 2023 年下降 30.66%，主要受 2023 年贵金属钯价格持续下行及 2024 年低位震荡的影响；2025 年，受贵金属钯自第二季度起价格上涨的带动，钯片采购价格同比上涨 15.75%。

2024 年和 2025 年，公司刀具采购价格呈下降趋势，主要系公司持续推动刀具自主研发并增加刀具设备产能，从而有效降低相关采购成本，带动采购单价下

降。

报告期内，磷青铜毛细金属管、镀铜棒料的采购价格波动情况主要系采购原材料品种、型号和规格存在差异所致，属于正常采购过程中的合理波动。

（二）报告期内委托加工情况

报告期内，公司主要委托加工供应商采购金额以及占比如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 加工内容 | 金额 | 占比 |
|----------------|-------------------|-------|-----------------|---------------|
| 2025 年度 | | | | |
| 1 | 上海广弘实业有限公司 | 电镀加工 | 2,336.83 | 78.43% |
| 2 | 上海银木电器制造有限公司 | 电镀加工 | 391.51 | 13.14% |
| 3 | Surtrek CO., Ltd. | 电镀加工 | 152.42 | 5.12% |
| 4 | SUN-YOU CO., Ltd. | 电镀加工 | 42.85 | 1.44% |
| 5 | 北京博轮达精密仪器有限公司 | 绝缘件加工 | 42.58 | 1.43% |
| 合计 | | | 2,966.20 | 99.55% |
| 2024 年度 | | | | |
| 1 | 上海广弘实业有限公司 | 电镀加工 | 781.67 | 52.54% |
| 2 | 上海银木电器制造有限公司 | 电镀加工 | 263.64 | 17.72% |
| 3 | SUN-YOU CO., Ltd. | 电镀加工 | 218.91 | 14.71% |
| 4 | Surtrek CO., Ltd. | 电镀加工 | 153.13 | 10.29% |
| 5 | 沧州亿诚电气制造有限公司 | 电缆加工 | 32.28 | 2.17% |
| 合计 | | | 1,449.64 | 97.43% |
| 2023 年度 | | | | |
| 1 | 上海广弘实业有限公司 | 电镀加工 | 306.48 | 44.62% |
| 2 | 上海银木电器制造有限公司 | 电镀加工 | 179.39 | 26.11% |
| 3 | SUN-YOU CO., Ltd. | 电镀加工 | 93.00 | 13.54% |
| 4 | Surtrek CO., Ltd. | 电镀加工 | 66.45 | 9.67% |
| 5 | 北京博轮达精密仪器有限公司 | 绝缘件加工 | 30.82 | 4.49% |
| 合计 | | | 676.13 | 98.43% |

注：占比为委外加工金额占当期委外加工采购总额的比重

报告期各期，公司委托加工供应商相对稳定，前五大委托加工商占当期委托加工服务采购总额的比例超过 97.00%。

（三）报告期内能源采购情况

报告期内，公司能源采购主要为电力，采购金额分别为 264.29 万元、399.04 万元和 499.09 万元。用电量分别为 374.81 万度、574.30 万度和 772.66 万度，对应平均采购单价分别为 0.71 元/度、0.69 元/度和 0.65 元/度，以上用电均由市政供应，供应较为充足，价格较为稳定。报告期内，公司电力采购金额大幅增长，主要系公司根据客户需求快速提高产能所致。

（四）前五大供应商采购情况

报告期内，公司各期前五大供应商（不含建设工程类供应商）名称、采购金额及占当期采购总额的比例如下：

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 采购内容 | 金额 | 占比 |
|----------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|
| 2025 年度 | | | | |
| 1 | 励福环保 | 钯片、铂片、银粒 | 3,243.72 | 18.72% |
| 2 | 上海广弘实业有限公司 | 电镀加工 | 2,336.83 | 13.48% |
| 3 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 机床 | 2,056.34 | 11.86% |
| 4 | 贵研金属 | 钯片、铂片、铱粉 | 1,133.53 | 6.54% |
| 5 | 优耐特高精（上海）机床有限公司 | 机床 | 678.14 | 3.91% |
| 合计 | | | 9,448.55 | 54.52% |
| 2024 年度 | | | | |
| 1 | 励福环保 | 钯片、银粒 | 1,274.13 | 9.24% |
| 2 | 贵研金属 | 钯片 | 1,096.39 | 7.95% |
| 3 | 上海广弘实业有限公司 | 电镀加工 | 781.67 | 5.67% |
| 4 | 上海弋力机械科技有限公司 | 刀具 | 480.97 | 3.49% |
| 5 | 浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 | 电力 | 386.20 | 2.80% |
| 合计 | | | 4,019.35 | 29.15% |
| 2023 年度 | | | | |
| 1 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 机床 | 7,397.64 | 39.33% |
| 2 | 贵研金属 | 钯片、检测费 | 735.33 | 3.91% |
| 3 | 励福环保 | 钯片 | 609.54 | 3.24% |
| 4 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 磨刀设备等 | 511.98 | 2.72% |
| 5 | 上海弋力机械科技有限公司 | 刀具 | 430.79 | 2.29% |
| 合计 | | | 9,685.28 | 51.49% |

注 1：上表中采购金额已将受同一方控制或共同控制的供应商合并计算，贵研金属包括贵研金属（上海）有限公司、上海贵研实业发展有限公司和贵研检测科技（云南）有限公司；励福环保包括励福（江门）环保科技股份有限公司和励福（香港）环保科技有限公司

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购占比超过 50%或严重依赖少数供应商的情形。报告期内，发行人与前五大原材料供应商之间不存在关联关系，发行人董事、监事、高级管理人员和主要关联方未在前五大原材料供应商中占有权益。

六、发行人的主要资源要素

（一）固定资产情况

1、固定资产概况

截至报告期末，公司拥有的固定资产情况具体如下：

单位：万元

| 类别 | 原值 | 账面价值 | 成新率 |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 房屋建筑物 | 12,822.23 | 12,000.98 | 93.60% |
| 专用设备 | 29,897.98 | 19,906.26 | 66.58% |
| 通用设备 | 460.66 | 280.22 | 60.83% |
| 运输工具 | 512.08 | 212.10 | 41.42% |
| 合计 | 43,692.95 | 32,399.56 | 74.15% |

公司各项固定资产使用状态良好，能够满足公司目前生产经营活动的需要，不存在闲置状况，不存在减值迹象。

2025 年 9 月 29 日，发行人与中国建设银行嘉兴科技支行签署《最高额抵押合同》，以 146 台西铁城数控车床为发行人对建设银行嘉兴支行的相关债务提供抵押担保。

2、房产土地情况

公司及子公司拥有的主要房产土地情况如下：

| 序号 | 证书编号 | 位置 | 面积 | 用途 | 权利人 | 使用期限 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|--------------------------|---------------------|--|------|---------------|--------------------------------------|------|------|
| 1 | 浙（2024）嘉开不动产权第 0008044 号 | 嘉兴市秀洲区嘉北街道华云路 111 号 | 房屋建筑面积：32,267.21 平方米； 土地使用权面积：13,022.00 | 工业用地 | 浙江金连接科技股份有限公司 | 2022 年 2 月 15 日起 2072 年 2 月 14 日止 | 出让 | 已抵押 |

| 序号 | 证书编号 | 位置 | 面积 | 用途 | 权利人 | 使用期限 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|----|-----|----|-----|------|------|------|
| | | | 平方米 | | | | | |

2024年5月8日，发行人与中国建设银行嘉兴科技支行签署《最高额抵押合同》，以上述不动产为发行人对中国建设银行嘉兴科技支行的相关债务提供抵押担保。

3、租赁房产

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司承租的用于生产经营的主要房产情况如下：

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 坐落 | 面积(m ²) | 主要用途 | 租赁备案 | 租赁期限 |
|----|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------|------|-----------------------|
| 1 | 沈晨 | 北京金连接 | 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦11层11号房间 | 110 | 办公 | 已完成 | 2025.11.26-2028.12.31 |
| 2 | Regus Japan K.K. | 日本金连接 | 东京都港区新桥四丁目21番3号新桥东急大楼2楼 | - | 办公 | 不适用 | 2025.10.1-2027.9.30 |
| 3 | 安全输送株式会社 | 日本金连接 | 日本神奈川县横滨市金泽区鸟浜町11-13 | 655.59 | 厂房、办公 | 不适用 | 2024.3.1-2027.2.28 |
| 4 | Castle Peak Investments No.4 Limited | 香港金连接 | 香港新界葵涌青山公路585-609号嘉民葵涌物流中心2楼A座 | 905.25 | 厂房、办公 | 不适用 | 2025.5.1-2028.4.30 |
| 5 | 嘉兴经济技术开发区建设投资有限公司 | 金连接医疗 | 嘉兴市经济技术开发区禾平街食品标准厂房区12#标准厂房 | 5,108.74 | 厂房 | 办理中 | 2026.5.21-2028.12.31 |

除上述外，截至本招股说明书签署日，发行人承租的其他房产情况如下：

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 坐落 | 面积(m ²) | 主要用途 | 租赁期限 |
|----|-------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------|------|----------------------|
| 1 | 嘉兴经济技术开发区建设投资有限公司 | 发行人 | 嘉兴市经济技术开发区嘉北街道禾平街688号邻里中心综合楼厂房4-6层宿舍楼 | 2,488.05 | 宿舍 | 2026.2.1-2027.4.30 |
| 2 | 嘉兴经济技术开发区建设投资有限公司 | 发行人 | 嘉兴市振兴公寓5号楼 | - | 宿舍 | 2026.2.1-2026.6.30 |
| 3 | 黄强 | 发行人 | 嘉兴市信达东郡10幢 | 87.89 | 宿舍 | 2025.12.10-2027.12.9 |
| 4 | 顾月萍 | 发行人 | 嘉兴市阳海景怡南区31幢 | 110（外加自行车库10m ² ） | 宿舍 | 2025.9.1-2026.8.31 |
| 5 | 东洋 Estate Service | 日本金 | 日本神奈川县横滨市 | - | 宿舍 | 2024.7.20-2026.7.19 |

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 坐落 | 面积（m ² ） | 主要用途 | 租赁期限 |
|----|------|-------|-------------------------|---------------------|------|--------------------|
| | 株式会社 | 连接 | 中区末吉町 1-1-2 | | | |
| 6 | 李树江 | 香港金连接 | 香港新界葵涌葵涌道1001号德昌大厦20楼0室 | 54.40 | 宿舍 | 2025.7.1-2027.6.30 |

根据境外律师出具的法律意见书，日本金连接、香港金连接与出租方之间的租赁合同合法有效。

前述发行人租赁部分用作员工宿舍的房产（上表第 1-2 项）未办理租赁登记备案手续，不符合《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》的相关规定，其中违反商品房屋租赁登记备案要求的，可能引发被当地行政主管部门责令限期改正以及在逾期不改正的情况下处 1,000 元以上 10,000 元以下罚款的风险。

根据《民法典》第七百零六条“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力”之规定，未办理商品房屋租赁登记备案并不影响发行人根据该等租赁合同使用相关房屋，相应房屋租赁合同合法有效，且未备案房屋并不用于发行人生产经营，不会对发行人生产经营造成重大不利影响。此外，公司未办理商品房屋租赁登记备案的不规范情形并非重大违法行为且可能涉及的行政处罚金额较小，截至本招股说明书签署日，尚未有行政主管部门向公司提出责令限期改正，该情形不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

（二）主要无形资产和重要资质证书

1、专利

截至本招股说明书签署日，公司已取得 60 项专利，其中发明专利 30 项，实用新型专利 30 项。具体情况如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 |
|----|--------------------------|------|------------------|-----------|
| 1 | 高硬度低电阻钼合金线及其制造方法和芯片测试用探针 | 发明专利 | ZL202610226028.X | 2026.2.26 |
| 2 | 一种高精度线性钼合金丝及其制备方法和高精度探针 | 发明专利 | ZL202610196915.7 | 2026.2.11 |
| 3 | 一种用于刀具组件的精密磨削方法及刀具组件和应用 | 发明专利 | ZL202610152199.2 | 2026.2.3 |
| 4 | 一种微针用视觉缓冲取放装置及微针视觉缓冲取放方法 | 发明专利 | ZL202610149162.4 | 2026.2.3 |

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 |
|----|---------------------------|------|------------------|------------|
| 5 | 用于钼合金的定向凝固系统、方法及高纯低氧钼合金棒 | 发明专利 | ZL202610013652.1 | 2026.1.7 |
| 6 | 高硬高强免削铂铱合金棒材的制备方法及其铂铱合金棒 | 发明专利 | ZL202511807688.9 | 2025.12.3 |
| 7 | 一种连续式微管精密加工系统及加工方法 | 发明专利 | ZL202511788496.8 | 2025.12.1 |
| 8 | 医用钼铂合金棒的热锻免削成型工艺及医用钼铂合金棒 | 发明专利 | ZL202511756711.6 | 2025.11.27 |
| 9 | 利用缩径模锻的无损纯铂棒材制备工艺及无损纯铂棒材 | 发明专利 | ZL202511667750.9 | 2025.11.14 |
| 10 | 一种探针用高硬高强钼银铜镍四元合金棒及其制备方法 | 发明专利 | ZL202511659395.0 | 2025.11.13 |
| 11 | 一种探针用微细精密零件清洗装置及清洗方法 | 发明专利 | ZL202511657884.2 | 2025.11.13 |
| 12 | 一种刀具晶体焊接用调节定位装置及调节定位方法 | 发明专利 | ZL202511268371.2 | 2025.9.5 |
| 13 | 一种线材无损矫直装置及线材无损矫直方法 | 发明专利 | ZL202511216777.6 | 2025.8.28 |
| 14 | 一种芯片测试探针用高导电率钼合金及其制备方法 | 发明专利 | ZL202511080506.2 | 2025.8.4 |
| 15 | 一种半导体芯片测试探针分选与缺陷检测设备及检测方法 | 发明专利 | ZL202410036437.4 | 2024.1.10 |
| 16 | 一种半导体芯片测试用钼合金探针套筒及其制造方法 | 发明专利 | ZL202311626124.6 | 2023.11.30 |
| 17 | 一种芯片测试探针套筒用钼合金棒及其制造方法 | 发明专利 | ZL202311574807.1 | 2023.11.23 |
| 18 | 一种半导体芯片测试探针用钼合金及其制备方法 | 发明专利 | ZL202311293795.5 | 2023.10.09 |
| 19 | 一种直线式探针套筒的自动吹屑装置及方法 | 发明专利 | ZL202211073254.7 | 2022.9.2 |
| 20 | 一种探针收集装置及方法 | 发明专利 | ZL202211073249.6 | 2022.9.2 |
| 21 | 一种旋转式探针套筒的自动清洁装置及方法 | 发明专利 | ZL202211067989.9 | 2022.9.1 |
| 22 | 一种铂铱合金棒定向凝固装置、定向凝固方法及成型方法 | 发明专利 | ZL202211067988.4 | 2022.9.1 |
| 23 | 一种半导体芯片测试探针用钼合金丝的加工装置 | 发明专利 | ZL202210307975.3 | 2022.3.26 |
| 24 | 一种半导体芯片测试探针用钼合金套筒及其加工设备 | 发明专利 | ZL202210307974.9 | 2022.3.26 |
| 25 | 一种半导体测试探针用带有法兰止位的探针套筒 | 发明专利 | ZL202110283944.4 | 2021.3.17 |
| 26 | 一种精密探针套筒一次成型装置及其成型方法 | 发明专利 | ZL202110280482.0 | 2021.3.16 |
| 27 | 一种半导体芯片测试探针用钼合金皇冠顶柱的成型装置 | 发明专利 | ZL202110152750.0 | 2021.2.3 |
| 28 | 一种测试探针用钼合金底柱头加工装置 | 发明专利 | ZL202110152236.7 | 2021.2.3 |
| 29 | 一种测试探针用磷青铜套筒 | 发明专利 | ZL201810908821.3 | 2018.8.10 |

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 申请日期 |
|----|-----------------------------|------|-------------------|------------|
| 30 | 一种精密测试探针用铍青铜底柱头 | 发明专利 | ZL201810908802.0 | 2018.8.10 |
| 31 | 一种偏 Kelvin 皇冠头探针顶柱头及芯片测试用探针 | 实用新型 | ZL202422299358.0 | 2024.9.20 |
| 32 | 一种内凹式皇冠头探针顶柱头及探针 | 实用新型 | ZL202422299356.1 | 2024.9.20 |
| 33 | 一种刀盘及切削装置 | 实用新型 | ZL202422111549.X | 2024.8.29 |
| 34 | 一种探针加工用刀具调节检具 | 实用新型 | ZL202322871293.8 | 2023.10.24 |
| 35 | 一种折弯装置 | 实用新型 | ZL202322822904.X | 2023.10.19 |
| 36 | 一种多角度径向微孔加工机构 | 实用新型 | ZL202322580938.2 | 2023.9.21 |
| 37 | 一种微型探针套筒缩管成型设备 | 实用新型 | ZL202322580084.8 | 2023.9.21 |
| 38 | 斜皇冠头芯片测试探针顶柱头 | 实用新型 | ZL202223338014.3 | 2022.12.9 |
| 39 | 带皇冠测头的套管 | 实用新型 | ZL202223337121.4 | 2022.12.9 |
| 40 | 一种半导体探针用的电铸镍管加工装置 | 实用新型 | ZL202020624491.8 | 2020.4.23 |
| 41 | 一种用于半导体测试的晶片作表面清理装置 | 实用新型 | ZL202020624465.5 | 2020.4.23 |
| 42 | 一种用于射频连接器中心导体的加工设备 | 实用新型 | ZL202020624463.6 | 2020.4.23 |
| 43 | 一种工业以太网用便于安装的电涌保护器 | 实用新型 | ZL202020623984.X | 2020.4.23 |
| 44 | 一种用于半导体测试探针的清洗装置的蓄水机构 | 实用新型 | ZL202020623958.7 | 2020.4.23 |
| 45 | 一种具有脱落报警功能的 OBD 数据连接器 | 实用新型 | ZL201921576729.8 | 2019.9.20 |
| 46 | 一种便于固定使用的测试探头 | 实用新型 | ZL201921570920.1 | 2019.9.20 |
| 47 | 一种网络电涌保护器 | 实用新型 | ZL201921570908.0 | 2019.9.20 |
| 48 | 一种微型探针针头加工用刀具 | 实用新型 | ZL201921570400.0 | 2019.9.20 |
| 49 | 一种耐腐蚀的数据线缆 | 实用新型 | ZL201921570399.1 | 2019.9.20 |
| 50 | 一种探针用钽合金皇冠顶柱头 | 实用新型 | ZL201821289132.0 | 2018.8.10 |
| 51 | 一种测试探针用铍青铜皇冠顶柱头 | 实用新型 | ZL201821289128.4 | 2018.8.10 |
| 52 | 一种测试探针用磷青铜套筒 | 实用新型 | ZL201821288932.0 | 2018.8.10 |
| 53 | 一种带多态保护电路的网络电涌保护器 | 实用新型 | ZL201821288899.1 | 2018.8.10 |
| 54 | 一种精密针头防漏收集装置 | 实用新型 | ZL201821288898.7 | 2018.8.10 |
| 55 | 一种精密探针碳钢皇冠顶柱头 | 实用新型 | ZL201821288444.X | 2018.8.10 |
| 56 | 一种同轴以太网电涌保护器 | 实用新型 | ZL201821288425.7 | 2018.8.10 |
| 57 | 一种集成电路芯片探测针精密加工设备 | 实用新型 | ZL201821288072.0 | 2018.8.10 |
| 58 | 一种微型探针针头加工用刀具 | 实用新型 | ZL201821287848.7 | 2018.8.10 |
| 59 | 一种精密测试探针用铍青铜底柱头 | 实用新型 | ZL201821287847.2 | 2018.8.10 |
| 60 | 一种组合式精密探针套筒 | 实用新型 | ZL201821.288916.1 | 2018.8.10 |

上述专利均系发行人申请取得，权属明确、清晰，上述专利无被终止、被宣

布无效以及侵害他人权利的情形。相关专利使用情况良好。截至报告期末，公司上述专利的账面价值为零。上述专利为公司生产经营中主要使用的资产，不存在抵押、质押等权利限制，不存在权属纠纷或其他潜在纠纷。

2、商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有 8 项商标，具体情况如下：

| 序号 | 注册商标 | 注册号 | 申请人 | 类别 | 有效期限 | 取得方式 |
|----|--|----------|-------|-------------|-------------|------|
| 1 |  | 54830296 | 发行人 | 14 | 至 2032.3.6 | 原始取得 |
| 2 | GOLDLINK | 54814676 | 发行人 | 6、14 | 至 2032.1.27 | 原始取得 |
| 3 | 金连接 | 54848910 | 发行人 | 6、7、9、10、14 | 至 2032.1.27 | 原始取得 |
| 4 |  | 54848881 | 发行人 | 7、10、14 | 至 2032.1.6 | 原始取得 |
| 5 | GPAC1400 | 60627706 | 发行人 | 6、7、9、10、14 | 至 2032.9.13 | 原始取得 |
| 6 | GPAC1200 | 60625943 | 发行人 | 6、7、9、10、14 | 至 2032.9.6 | 原始取得 |
| 7 | GPAC1100 | 60605715 | 发行人 | 6、7、9、10、14 | 至 2032.9.20 | 原始取得 |
| 8 | 金连接 | 18815328 | 北京金连接 | 9 | 至 2027.8.20 | 原始取得 |

上述注册商标用于发行人产品包装、企业宣传等环节。截至报告期末，上述注册商标不存在抵押、质押等权利限制，不存在权属纠纷或其他潜在纠纷，其账面价值为零。

七、发行人的资质与许可情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。公司及子公司取得的与生产经营相关的主要资质及认证证书情况如下：

（一）资质、许可、荣誉

| 序号 | 资质证书名称 | 编号/注册编码 | 持有人 | 发证机构 | 有效期至 |
|----|--------|---------|-----|------|------|
|----|--------|---------|-----|------|------|

| 序号 | 资质证书名称 | 编号/注册编码 | 持有人 | 发证机构 | 有效期至 |
|----|-----------------|------------------------|-------|----------------------------|-------------|
| 1 | 高新技术企业证书 | GR202533009002 | 发行人 | 浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | 2028年12月18日 |
| 2 | 排污许可证 | 91330401MA29GGX0XU001X | 发行人 | 嘉兴市生态环境局 | 2029年9月12日 |
| 3 | A类注册人注册证明书 | A-B-25-06-09404 | 香港金连接 | 香港海关 | 2027年6月8日 |
| 4 | 废物产生者登记证 | 3723-326-G3116-01 | 香港金连接 | 香港环境保护署 | - |
| 5 | 专精特新“小巨人”企业 | - | 发行人 | 工业和信息化部 | 2026年6月30日 |
| 6 | 2023年度浙江省首批次新材料 | - | 发行人 | 浙江省经济和信息化厅 | - |
| 7 | 省级高新技术企业研究开发中心 | 浙科发高[2021]71号 | 发行人 | 浙江省科学技术厅 | - |
| 8 | 浙江省科技型中小企业 | 20193304000300 | 发行人 | 浙江省科学技术厅 | - |

（二）认证证书

| 序号 | 证书名称 | 认证产品/覆盖范围 | 符合标准 | 持有人 | 有效期至 |
|----|----------------|---|----------------------------------|-----|------------|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | 数据通信连接组件及精密探针零件的生产和销售（3C产品除外） | ISO9001:2015 | 发行人 | 2027.6.20 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | 数据通信连接组件及精密探针零件的生产和销售（3C产品除外） | ISO14001:2015 | 发行人 | 2028.7.9 |
| 3 | 医疗器械质量管理体系认证证书 | 临时心脏起搏电极导线、一次性使用心脏射频消融导管、一次性使用固定弯型心脏电生理标测导管电极接头的生产和销售 | GB/T42061-2022/ ISO13485:2016 | 发行人 | 2028.11.30 |

八、发行人核心技术和研发情况

（一）核心技术情况

1、核心技术概述

公司以市场及客户需求为导向，聚焦自主创新、技术突破，逐渐积累起较强的核心技术壁垒，并主要通过申请专利以及技术秘密的方式对相关技术进行保护，截至本招股说明书签署日，公司掌握13项核心技术，取得了授权发明专利30项。目前，公司研发的各项核心技术主要应用于公司已量产的芯片测试探针零件及核心原材料钼合金棒材中，为公司经营规模不断增长起到了积极贡献。

具体来看，基于从微细零件材料至微细零件成品的全流程自主生产，公司构建了三大核心技术平台：高精度先进生产工艺技术平台、自动化收集与清洗技术平台以及超细高性能钽合金棒制备平台。以上平台协同作用，共同强化了公司在微细零件产品一致性、可靠性及生产效率方面的优势，形成了可持续的技术壁垒与核心竞争力。

对于高精度先进生产工艺技术平台，公司形成了精密刀具设计技术、刀具精密焊接定位技术、精密刀具磨削技术、机床同步稳定送料与无损导向技术等 8 项核心技术。针对芯片测试探针零件尺寸微细的特点，公司通过多年试验积累了大量刀具结构、角度的数据，并攻克了刀具精密焊接定位技术、精密刀具磨削技术，可自主生产符合加工微米级尺寸精度要求的超精密刀具，在降低生产成本的同时，显著提升了切削质量与加工精度。在探针零件加工方面，公司通过对 CNC 机床进行自主改造，并自主研发配套工装，形成机床同步稳定送料与无损导向技术，实现了钽合金材料自动上下料、连续稳定加工，大幅提高生产效率。同时，利用自产刀具并结合自主开发的切削方案，形成包括高精度探针零件圆弧成型技术、高精度探针零件镜面劈花技术、高精度探针套筒圆弧收口技术、带皇冠头套筒一次成型技术等在内的一系列高精度车铣复合加工技术，有效提升了微细零件的精度及成品率。

对于自动化收集与清洗技术平台，面对微细零件在收集与清洗方面的挑战，公司开发了微细零件无损收集技术。该技术采用自研真空辅助回收系统，实现微细探针零件的高效回收，同时显著降低收集过程中因碰撞导致的良率损失。此外，公司还自主研发了微细零件清洗技术，利用自研特殊材质清洗罐，搭配多层嵌套复合清洗工艺，显著提高了清洗效率与零件品质。

对于超细高性能钽合金棒制备平台，公司形成了钽合金材料配方开发技术、精密拉丝模拉拔技术以及无损精矫技术。凭借以上技术，公司成功自主生产出超细高质量钽合金棒，其硬度、电阻率、杨氏模量及抗拉强度等多项性能参数显著优于同类竞品，并能够实现优异的直线度、圆度、一致性和表面光洁度，为后续高精度机加工奠定材料基础。

以上核心技术均应用于公司已量产的芯片测试探针零件及其核心原材料钽合金棒材中，为公司经营规模的不断增长起到了积极作用。

2、核心技术的先进性及具体表征

| 核心技术平台名称 | 核心技术名称 | 技术来源 | 核心技术描述 | 核心技术保护措施 | 核心技术所处阶段 | 核心技术先进性 |
|---------------|-----------------|------|---|-----------|----------|--|
| 超细高性能钼合金棒制备平台 | 钼合金材料配方开发技术 | 吸收创新 | 基于钼-铜-银三元体系,持续优化材料配比与微量元素配方,改进熔铸及定向凝固工艺,提升材料机械强度、导电性与成型性 | 授权发明专利5项 | 大批量生产阶段 | 所开发钼合金综合性能优异,机械与电气关键指标达到业内领先水平 |
| | 精密拉丝模拉拔技术 | 自主研发 | 采用自主开发精密拉丝模,通过多道次渐进拉拔工艺,制备高圆度、高一一致性的超细钼合金棒材 | 授权发明专利4项 | 大批量生产阶段 | 可稳定制备直径<1mm、圆度公差 $\pm 1\mu\text{m}$ 的超细高精度钼合金棒材,表面粗糙度 $R_a < 0.05\mu\text{m}$ 达到类镜面效果,尺寸精度与一致性水平处于行业领先地位,是实现探针零件最小外径与高精度的关键保障之一 |
| | 无损精矫技术 | 自主研发 | 采用自主研发无损精矫工艺,在不损伤材料表面与内部组织的前提下,精准矫正棒材弯曲,显著提升成品直线度与平直度 | 授权发明专利4项 | 大批量生产阶段 | 实现直线形位公差<0.05mm/m的高直线度,满足精密零件加工对棒材直线度的严苛使用要求 |
| 高精度先进生产工艺技术平台 | 精密刀具设计技术 | 自主研发 | 自主设计用于微细零件加工的超精密车铣刀具,设计内容涵盖刀具结构、刃口角度、排屑槽型等多项关键要素;针对劈花铣刀,围绕动平衡、圆跳动等指标开展专项结构优化设计,为刀具的优异动态性能奠定结构基础 | 以技术秘密形式保护 | 大批量生产阶段 | 自主设计的刀具结构能够满足微细精密零件的稳定加工要求;劈花铣刀通过专项结构优化,有效保障加工尺寸的高一致性以及无振纹、无毛刺的表面质量,加工的微细零件可达到镜面级表面光洁度 |
| | 刀具精密焊接定位技术 | 自主研发 | 自研高精度多自由度焊接定位系统,可实现微细刀具组件微米级精准对位与高质量精密焊接 | 授权发明专利1项 | 大批量生产阶段 | 可实现秒级旋转微调、微米级平移定位与多角度倾斜调节,定位精度达到行业先进水平 |
| | 精密刀具磨削技术 | 自主研发 | 自研辅助夹持工装和高精度磨削工艺,有效抑制高速磨削过程中共振问题,制备的车铣刀具可满足超精密微细加工要求 | 授权发明专利1项 | 大批量生产阶段 | 实现刀具平面度 $\leq 0.015\mu\text{m}$ 、左右刀面的表面粗糙度 $\leq 0.05\mu\text{m}$,刃径公差 $\pm 10\mu\text{m}$ (特殊 $\pm 5\mu\text{m}$)、角度公差 $\leq 0.3^\circ$ (特殊 $\leq 0.2^\circ$) |
| | 机床同步稳定送料与无损导向技术 | 自主研发 | 自主开发进给控制工装与精密导向部件,实现超细棒材连续稳定送料、高速旋转工况下无损伤稳定加工 | 以技术秘密形式保护 | 大批量生产阶段 | 实现超细棒材超高速旋转下的平稳精密加工,是实现加工零件最小直径和尺寸公差的关键因素之一 |

| 核心技术平台名称 | 核心技术名称 | 技术来源 | 核心技术描述 | 核心技术保护措施 | 核心技术所处阶段 | 核心技术先进性 |
|--------------|----------------|------|---|------------|----------|--|
| | 高精度探针零件圆弧成型技术 | 自主研发 | 采用自研的超精密刀具与微细零件圆弧加工工艺, 实现探针底柱头的高精度圆弧成型, 圆弧过渡光滑且连续, 有效保障测试接触的稳定性与可靠性 | 授权发明专利 2 项 | 大批量生产阶段 | 最小加工外径 0.03mm、最小外径加工公差 $\pm 2\mu\text{m}$; 圆弧表面粗糙度 $Ra < 0.05\mu\text{m}$, 达到类镜面效果 |
| | 高精度探针零件镜面劈花技术 | 自主研发 | 采用自研的超精密劈花刀具和微细零件劈花加工工艺, 实现探针顶柱头一次劈花成型, 所制皇冠头达到镜面级表面光洁度, 保证芯片测试接触面电阻稳定维持在较低水平、高频次测试的信号传输准确性 | 授权发明专利 1 项 | 大批量生产阶段 | 最小加工外径 0.03mm、最小外径加工公差 $\pm 2\mu\text{m}$; 可实现最小尺寸 0.04mm 的皇冠头加工; 皇冠头内壁表面粗糙度 $Ra < 0.025\mu\text{m}$, 达到镜面效果 |
| | 高精密切探针套筒圆弧收口工艺 | 自主研发 | 采用自研的超精密刀具与圆弧收口工艺, 有效抑制薄壁套筒收口变形、毛刺缺陷, 确保圆弧过渡面光滑连续、无微观裂纹, 实现测试信号稳定高效传导 | 授权发明专利 2 项 | 大批量生产阶段 | 外径表面粗糙度达到 $Ra < 0.05\mu\text{m}$ 的类镜面效果; 圆弧收口过渡面光滑, 表面粗糙度达到 $Ra < 0.05\mu\text{m}$ 的类镜面效果 |
| | 带皇冠头套筒一次成型技术 | 自主研发 | 采用自研精密模具与一体复合加工工艺, 实现皇冠头与套筒整体成型, 消除分体式结构固有装配偏差, 显著提升产品尺寸一致性与整体精度 | 以技术秘密形式保护 | 小批量生产阶段 | 省去组装成本、大幅降低装配废品率, 皇冠头内壁表面粗糙度 $Ra < 0.025\mu\text{m}$, 达到镜面效果, 尺寸一致性与装配精度满足高端芯片测试探针的严苛要求 |
| 自动化收集与清洗技术平台 | 微细零件无损收集技术 | 自主研发 | 基于 CNC 机床适配开发真空辅助回收系统, 采取真空吸附与双路气动协同控制结构, 实现微细零件与切削油的高效分离, 最终实现微细零件自动化、无损伤高效收集 | 授权发明专利 1 项 | 大批量生产阶段 | 无损综合回收率 $\geq 98\%$, 显著提升生产良率与回收稳定性 |
| | 微细零件清洗技术 | 自主研发 | 自研特殊材质清洗罐, 搭配多层嵌套复合清洗工艺, 保障清洗剂顺畅循环, 实现微细零件深度除污、低冲击、高回收率的高效洁净清洗 | 授权发明专利 3 项 | 大批量生产阶段 | 实现微细探针零件深度洁净清洗, 杜绝碰撞损伤与零件丢失, 有效解决行业清洗痛点, 满足高端精密零件严苛洁净度要求 |

3、发行人主要产品的先进性及与同行业对比情况

公司在微细零件领域所取得的核心技术、发明专利等，本质上都是为了提升探针零件及材料的性能，探针零件及材料性能的优劣是检验公司核心技术先进性的重要指标。

（1）芯片测试探针零件产品的技术参数对比

随着芯片小型化及高集成度，对测试探针尺寸及公差要求越来越高，而优秀的探针尺寸及公差水平由高品质的钽合金棒材、机床的稳定加工能力、高品质的精密刀具、成熟的加工工艺综合决定。公司掌握从钽合金棒材自制到成品超精密微细加工到后道收集清洗的一站式核心技术，探针零件尺寸及公差水平居于业内领先水平。

以顶柱头产品为例，其与同行业可比公司的具体对比情况如下表所示：

| 公司名称 | 最小加工外径 | 最小外径加工公差 | 皇冠头最小加工尺寸 |
|-------|---------|----------|-----------|
| Will | φ0.03mm | ±5μm | 未披露 |
| Leeno | 未披露 | 未披露 | φ0.08mm |
| 和林微纳 | 未披露 | 5μm 以内 | 未披露 |
| KITA | 未披露 | 未披露 | φ0.07mm |
| 发行人 | φ0.03mm | ±2μm | φ0.04mm |

注：根据各可比公司的官网、招股说明书、行业网站等汇总整理

（2）钽合金棒的技术参数对比

Tokuriki Honten（以下简称“Tokuriki”）注册成立于1934年，是全球老牌工业贵金属主要供应商，其钽合金棒材产品主要供应给全球各大主要测试探针零件生产商。在发行人实现钽合金棒材自产前，亦主要向其采购钽合金棒材。因此Tokuriki可被视为发行人的主要可比公司。

发行人生产并主要使用的钽合金棒材与Tokuriki所产的同类产品的性能参数对比如下表所示：

| 主要产品 | 关键指标 | 关键指标选取说明 | Tokuriki | 发行人 |
|------|------|----------------------------------|------------|----------------|
| 钽合金棒 | 维氏硬度 | 硬度决定探针的耐磨损性能和抗塑性变形能力 | 290-460HV | 510-540HV |
| | 电阻率 | 电阻率决定材料导电性能，探针低电阻率保证测试信号的完整性和准确性 | 14~23μΩ·cm | 10.5-11.5μΩ·cm |

| 主要产品 | 关键指标 | 关键指标选取说明 | Tokuriki | 发行人 |
|------|----------|---|--------------------|--------------------|
| | 杨氏模量 | 杨氏模量表明材料的刚度或弹性变形抗力,意味着材料在受力时不易发生弯曲或弹性变形,能够提供稳定的支撑性,系维持探针整体机械结构稳定性、防止微弯曲及保证顶柱头与套筒建的精确定位的重要指标 | 110-120GPa | 100-110GPa |
| | 抗拉强度 | 抗拉强度反应材料在断裂前所能够承受的最大拉伸应力,高抗拉强度保证探针具备高机械可靠性和韧性,能够承受测试过程中可能出现的意外过载、侧向力或插拔应力,防止探针断裂 | 1000-1400MPa | 1300-1500Mpa |
| | 圆度形状公差 | 棒材的高圆度、高直线度是保障后续CNC加工能够实现最小外径及尺寸公差的关键基础 | 0.001mm | 0.001mm |
| | 直线形状公差 | | 0.042mm/m | 0.038mm/m |
| | 表面粗糙度 Ra | 表面粗糙度影响其在高速旋转时与机床导套之间的摩擦程度,进而影响最终测试探针零件成品的精度 | Ra<0.025μm, 达到镜面效果 | Ra<0.025μm, 达到镜面效果 |

注：根据可比公司官网披露数据、第三方测试报告汇总得到

首先，通过钽合金材料配方开发技术的研发和持续迭代，公司实现钽合金棒材的维氏硬度、电阻率、杨氏模量和抗拉强度指标的全面提升。以上指标决定了测试探针在测试过程中的耐磨性、导电性能及对测试信号的干扰程度、长期高频测试下的性能稳定性，是衡量最终测试探针性能的关键指标。对比来看，发行人钽合金棒材产品的维氏硬度达到 510-540HV，耐磨性显著优于可比公司产品。同时，其电阻率为 10.5-11.5μΩ·cm，低于可比公司的 14-23μΩ·cm，体现出更优异的导电性能；此外，发行人产品的抗拉强度与杨氏模量与可比公司持平，在长期高频测试下仍能够维持自身结构与性能稳定。

其次，通过公司自研的精密拉丝模拉拔技术、无损精矫技术，实现钽合金棒材的高直线度、高圆度、高表面光洁度与高一一致性，有效保证棒材在高速旋转加工中的稳定性，是保证实现最小探针零件尺寸与高精度的关键因素。

4、核心技术在主营业务及产品中的应用和贡献情况

公司的核心技术主要应用于芯片测试探针零件。报告期内，公司核心技术产品收入占比情况如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|------|---------|---------|---------|
|------|---------|---------|---------|

| 产品类别 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 核心技术产品销售收入 | 22,385.63 | 12,112.76 | 6,583.11 |
| 主营业务收入 | 24,294.28 | 14,157.86 | 8,467.90 |
| 核心技术产品收入占主营业务收入比例 | 92.14% | 85.56% | 77.74% |

报告期内，发行人核心技术产品收入占主营业务收入的比例较高，核心技术产品收入对主营业务收入的贡献占比较高，核心技术的产业化情况良好。

（二）科研人员情况

1、研发人员及核心技术人员情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司在册员工 390 人，其中研发人员 56 人，占公司员工总数的 14.36%。公司共有核心技术人员曹镭、李云峰、王京松 3 人，占公司员工总数的 0.77%。上述核心技术人员的学历背景情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（四）核心技术人员”。

2、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

公司通过提供优良的研发条件、设置绩效考核机制等方式，鼓励研发及技术人员积极参与研究和产品创新，并以此维持核心技术人员的稳定性；同时，公司与前述核心技术人员均签订了《员工保密与竞业限制协议》，对其任职期间和离职后的保密、竞业和侵权事项进行了严格约定。报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生人员流失的情形。

为充分调动包括核心人员在内的研发团队积极性，吸引和留住优秀专业人才，有效地将股东利益、公司利益和技术研发团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，核心技术人员通过员工持股平台认购了公司股份。

3、报告期内核心技术人员的变动情况及对发行人的影响

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共 3 名，分别为曹镭、李云峰、王京松。报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

（三）研发投入和在研项目

1、报告期研发投入情况

报告期各期，公司的研发投入情况如下：

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 研发费用（万元） | 2,061.67 | 1,061.17 | 971.76 |
| 营业收入（万元） | 27,628.15 | 15,815.29 | 9,125.36 |
| 研发费用占营业收入比例 | 7.46% | 6.71% | 10.65% |

2、发行人正在从事的研发项目

目前，公司正在从事的研发项目及进展情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 研发进展 | 拟达到目标 |
|----|---|------|--|
| 1 | 电铸微细管的研发 | 在研 | 实现内径 0.08-0.24mm、外径 0.1-0.27mm、长度尺寸公差 $\leq\pm 0.01\text{mm}$ 、硬度 375-450HV、表面粗糙度 $Ra\leq 0.05\mu\text{m}$ |
| 2 | 芯片测试探针弹簧的研发 | 在研 | 实现线径 $\varphi 0.02\text{mm}$ 、外径 $\varphi 0.08\text{mm}$ 尺寸，满足尺寸公差 $\leq\pm 5\mu\text{m}$ 、表面粗糙度 $Ra\leq 0.03\mu\text{m}$ 、疲劳寿命 ≥ 100 万次、弹力波动 $\leq 3\%$ |
| 3 | 晶圆检测探针加工工艺的研发 | 在研 | 实现表面粗糙度 $Ra\leq 0.05\mu\text{m}$ 、尺寸公差 $\leq\pm 0.5\mu\text{m}$ 、锥度误差 $\leq 1\mu\text{m}/\text{m}$ 、批量合格率 $\geq 99\%$ ，适配 7nm 及以下先进制程 |
| 4 | 高精度钨合金 Kelvin 头组合铣刀的研发 | 在研 | 实现镜面级表面光洁度、尺寸公差 $\leq\pm 2\mu\text{m}$ ，刀具寿命提升 30% |
| 5 | 高精度背轴回收系统自动收集导管的研究 | 在研 | 研发自动收集导管，实现损耗率 $\leq 1\%$ 、切削油排出速度 $\geq 5\text{ml}/\text{s}$ 、吸附成功率 $\geq 99.9\%$ |
| 6 | 高精度极小钨铜合金探针铣面加工工艺的研发 | 在研 | 实现镜面级表面光洁度、加工合格率 $\geq 99\%$ |
| 7 | 医用钨钨合金消融头微小孔精准加工设备改造的研发 | 在研 | 改造设备实现无导套加工，孔径公差 $\leq\pm 0.02\text{mm}$ 、表面粗糙度 $Ra\leq 0.4\mu\text{m}$ 、合格率 $\geq 99.6\%$ |
| 8 | 48Pd-42Cu-10Ni 合金材料研发 | 在研 | 研发无银抗沾锡合金材料，实现维氏硬度 $\geq 450\text{HV}$ 、电阻率 $\leq 14\mu\Omega\cdot\text{cm}$ 、抗沾锡测试 ≥ 5000 次 |
| 9 | 钨基电接触合金材料研发 | 在研 | 开发符合 ASTM B540-21 标准的 P7 钨基合金材料，实现维氏硬度 330-400HV、电阻率 $\leq 31.6\mu\Omega\cdot\text{cm}$ 、接触电阻 $\leq 50\text{m}\Omega$ |
| 10 | 高端贵金属棒料表面缺陷综合抑制与精密成形关键技术研究 | 在研 | 实现表面缺陷综合抑制率 $\geq 95\%$ ，表面粗糙度 $Ra\leq 0.1\mu\text{m}$ （医疗级）、 $Ra\leq 0.2\mu\text{m}$ （芯片级），尺寸公差 $\leq\pm 0.01\text{mm}$ ，成品合格率 $\geq 98\%$ ，材料利用率 $\geq 95\%$ ，生产效率提升 $\geq 20\%$ |
| 11 | $Ra\leq 0.4\mu\text{m}$ 级半导体测试探针皇冠头超精加工关键技术研发 | 在研 | 实现皇冠头锥面粗糙度 $Ra\leq 0.4\mu\text{m}$ ，尺寸精度 $\leq\pm 2\mu\text{m}$ |
| 12 | 超导级低损耗银铜合金 | 在研 | 实现电阻率 $2-3\mu\Omega\cdot\text{cm}$ 、抗拉强度 880-930MPa、 |

| 序号 | 项目名称 | 研发进展 | 拟达到目标 |
|----|----------------------------|------|---|
| | (10%Ag)关键制备技术研发 | | 维氏硬度 250-300HV，导电率≥80% IACS；批量合格率≥98%、材料利用率≥95% |
| 13 | 精密测试探针 SK4 材料底柱头精密加工工艺的研发 | 在研 | 实现 Ra≤0.4μm、尺寸精度≤±3μm、CPK≥1.33 |
| 14 | 医疗贵金属弹簧圈的研发 | 在研 | 产品无菌，污染指数≤90，环氧乙烷灭菌残留量≤10μg/g，细菌内毒素含量≤20EU/件，产品物理性能应满足标准 YY/T 1748 的要求，产品的化学性能应满足 GB/T 14233.1 的要求 |
| 15 | 超细铂钨合金丝生产工艺的研发 | 在研 | 实现线材直径 0.02-0.05mm、尺寸公差 ≤±2μm、抗拉强度≥1100MPa，表面光滑无缺陷，生物相容性符合 ISO 10993 医用植入级要求 |
| 16 | 超细铂铱合金丝生产工艺的研发 | 在研 | 实现线材直径 0.02-0.05mm、尺寸公差≤ ±2μm、抗拉强度≥1100MPa，表面光滑无缺陷，生物相容性符合 ISO 10993 医用植入级标准 |
| 17 | 高精密钽合金多点接触 Kelvin 皇冠头探针的研发 | 在研 | 实现多点对称 Kelvin 四线法接触，接触区锥面 Ra≤0.1μm，尺寸公差≤±2μm，产品合格率≥97%，生产效率提升≥15% |
| 18 | 精密探针加工用同轴无损伤后轴夹头研发 | 在研 | 实现夹持同轴度≤0.005mm、重复定位精度≤2μm、使用寿命≥50 万次，适配 Φ0.1-Φ0.5mm 微细探针，夹持无划伤、无压痕、无变形；探针零件报废率下降≥60%、装夹时间缩短≥20% |
| 19 | AI 质量检测预测模型研发 | 在研 | 基于视觉检测算法实现不良检出率≥99%、漏检率<1%，基于结构化数据的良品分类模型预测准确率≥90%，提升≥50%人工质检效率，实现缺陷自动识别、分级、溯源与质量隐患提前预测，满足高端探针规模化生产的高精度、标准化智能质量检测需求 |

（四）合作研发情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在合作研发。

（五）保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

1、技术不断创新的机制和创新安排

（1）完善研发体系及管理制度

公司持续健全研发体系和研发管理制度。公司高度重视市场需求对于研发工作的重要作用，在研发初期即坚持以市场为导向的研发策略，在研发立项过程中进行认真深入的市场调研，广泛收集客户的需求，充分论证项目的可行性。除此之外，公司也会根据未来市场趋势主动进行新产品和新技术的研发积累，为未来的市场需求做充分准备。

公司不断加强对研发过程的组织和管理，坚持以市场为导向进行研发组织及

安排。公司建立的各项制度严格落实到产品立项、设计、制造、验证评估、转量产等各个环节，严谨周密的项目管理机制能够从制度层面保证技术创新的有序开展及持续规范。

（2）加大研发投入力度

公司自成立以来，对微细精密零件领域核心技术的发展持续跟踪并深入调研，同时加大研发投入力度，对产品技术不断进行研发创新，使得产品性能和技术水平都得到了显著提升。为了保证企业的持续稳定发展，公司在报告期内不断加大研发投入力度，为公司的技术创新和人才培养等创新机制奠定了物质基础。

（3）加强知识产权管理

公司高度重视知识产权管理，制定了专门的知识产权管理制度，持续跟踪行业的技术动态，检索分析总结相关的专利技术信息，对公司专利权进行撰写修改、申请及跟踪管理。公司通过专利申请打造了自有知识产权体系。

（4）建立人才培养与激励机制

公司高度重视人才的培养和研发团队的建设。一方面，公司通过校园招聘和社会招聘不断引进专业人才，逐步壮大研发团队。另一方面，公司定期和不定期地举行教育与培训工作，同时鼓励员工参与行业协会和科研机构举办的各种培训活动，对员工进行专业化培训，加速人才的成长，为公司未来业务发展打下基础。

公司还建立了相应的绩效机制以激励研发人员的主观能动性，保证研发团队的创新性、凝聚力和稳定性。公司将部分研发人员纳入股权激励范围，将研发人员的个人利益与公司长远发展相结合，增强公司研发骨干的归属感和责任意识。

2、技术储备

公司的技术储备情况参见本节之“八、发行人核心技术和研发情况”之“（一）核心技术情况”之“1、核心技术概述”及“（三）研发投入和在研项目”之“2、发行人正在从事的研发项目”。

九、环境保护和安全生产

（一）环境保护情况

1、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

报告期内，公司主要从事微细精密零件的生产，生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力如下：

| 污染物类型 | 主要处理措施及处理能力 |
|-------|--|
| 废气 | 主要废气为清洗废气、注塑废气、无组织废气等。针对清洗类废气和注塑废气的处理，公司先采用密闭装置进行收集，将收集的废气经“光催化氧化+二级活性炭吸附”装置处理，最后将尾气通过 30m 高排气筒排放，最终可达到排放标准。针对无组织废气的处理，公司将加强车间的通风来保证空气的流动性，从而达到排放标准。 |
| 废水 | 公司在运营过程中所产生的废水主要是生活污水。废水经化粪池处理后纳入污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中达标后排放。因此，废水对周围水环境的影响不大。 |
| 固废 | 废金属边角料，废品、废塑料、废电缆线、一般废包装材料经收集后委托专业公司处置，分类存放在一般固废仓库内；生活垃圾委托环卫部门统一清运；废清洗剂、危险废包装桶、废切削液、废活性炭、废机油、含油抹布、手套暂时在厂内贮存，定期委托专业公司进行安全处置 |
| 噪声 | 公司对生产过程中可能产生的污染物采取了各种行之有效的环境保护措施，不会因本期项目的实施而使周边环境质量下降，符合国家相关政策。 |

2、环保合规情况

报告期内，发行人及其子公司不存在其他因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到环保行政主管部门处罚的情形。

2026 年 1 月 15 日，浙江省公共信用信息平台出具《企业专项信用报告》，2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司在生态环境领域不存在违法违规情况。

（二）安全生产情况

报告期内，公司安全生产的相关制度及政策得到了有效执行，公司在生产经营过程中遵守安全生产相关的法律、法规及规范性文件的规定，安全生产设施及防范措施符合相关标准，具备安全生产条件，不存在违反安全生产管理相关法律、法规及规范性文件的行为，无重大安全生产事故，无安全生产违法的不良记录，也不存在因违反安全生产相关法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。

2026 年 1 月 15 日，浙江省公共信用信息平台出具《企业专项信用报告》，

2023年1月1日至2025年12月31日，公司在安全生产领域不存在违法违规情况。

十、境外经营情况

2021年11月18日，发行人在日本东京设立了全资子公司日本金连接（ゴールドリンク株式会社），截至本招股说明书签署日，日本金连接的注册资本为26,500万日元，主要从事探针弹簧、探针套筒的研发、生产和销售。发行人已就投资设立日本金连接以及历次追加投资事项取得嘉兴市发展和改革委员会出具的境外投资项目备案通知书，并取得了浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》。

2024年12月27日，公司在中国香港设立全资子公司香港金连接科技有限公司，主要从事贵金属棒材的生产、销售，注册资本3,000.00万港元，发行人已取得嘉兴市发展和改革委员会出具的境外投资项目备案通知书和浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。

日本金连接、香港金连接截至2025年末的资产情况以及2025年度的盈利情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司情况”之“（一）控股子公司情况”的相关内容。

截至本招股说明书签署日，除上述情况外，发行人未有其他在境外从事生产经营活动或持有境外资产的情况。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据及相关财务会计信息，非经特别说明，均引自经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2026）4453号《审计报告》。

本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关财务报告及审计报告全文。

一、合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 194,043,590.42 | 170,540,638.15 | 59,632,243.58 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 51,122,476.66 | - |
| 应收账款 | 80,078,921.10 | 57,268,834.61 | 28,479,071.33 |
| 预付款项 | 711,160.47 | 1,818,931.20 | 406,117.50 |
| 其他应收款 | 905,941.84 | 1,385,600.04 | 106,942.67 |
| 存货 | 46,172,910.52 | 45,482,858.01 | 45,644,275.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 1,622,848.27 |
| 其他流动资产 | 1,573,546.43 | 2,095,568.02 | 4,770,928.77 |
| 流动资产合计 | 353,486,070.78 | 329,714,906.69 | 140,662,427.81 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 6,559,198.56 | 5,363,868.82 | 4,824,007.81 |
| 固定资产 | 323,995,623.44 | 312,814,591.84 | 182,150,505.53 |
| 在建工程 | 1,448,610.34 | 1,845,364.92 | 97,967,001.45 |
| 使用权资产 | 3,864,112.44 | 1,730,313.22 | 14,431,237.74 |
| 无形资产 | 4,410,152.98 | 4,137,295.50 | 4,303,287.22 |
| 长期待摊费用 | 3,924,093.95 | 2,368,062.12 | 472,253.27 |
| 递延所得税资产 | 5,726,664.08 | 4,620,200.04 | 1,448,840.03 |
| 其他非流动资产 | 6,766,063.48 | 2,026,173.34 | 1,806,746.96 |
| 非流动资产合计 | 356,694,519.27 | 334,905,869.80 | 307,403,880.01 |
| 资产总计 | 710,180,590.05 | 664,620,776.49 | 448,066,307.82 |

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 43,146,500.00 | 62,321,979.74 | 56,198,318.22 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付账款 | 27,470,835.64 | 22,392,673.10 | 19,930,960.24 |
| 合同负债 | 314,712.44 | 49,243.05 | 10,823.18 |
| 应付职工薪酬 | 6,979,740.63 | 6,857,461.97 | 5,716,032.23 |
| 应交税费 | 9,042,441.84 | 4,287,348.58 | 152,176.43 |
| 其他应付款 | 119,394.58 | 115,172.17 | 57,041.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,108,199.76 | 7,430,123.82 | 8,041,012.50 |
| 其他流动负债 | 40,884.74 | 4,201.36 | 1,407.01 |
| 流动负债合计 | 95,222,709.63 | 103,458,203.79 | 90,107,771.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 165,496,862.55 | 171,496,862.55 | 139,296,862.55 |
| 租赁负债 | 1,874,545.03 | 775,283.96 | 554,018.81 |
| 长期应付款 | 166,765.85 | 258,602.19 | 320,793.36 |
| 递延收益 | 31,142,734.18 | 29,335,564.84 | 8,891,807.54 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 198,680,907.61 | 201,866,313.54 | 149,063,482.26 |
| 负债合计 | 293,903,617.24 | 305,324,517.33 | 239,171,253.55 |
| 所有者权益 （或股东权益）： | | | |
| 股本 | 40,945,882.00 | 40,945,882.00 | 37,714,285.00 |
| 资本公积 | 295,038,462.82 | 295,038,462.82 | 152,603,392.82 |
| 其他综合收益 | -2,175,906.87 | -468,432.00 | 38,259.23 |
| 盈余公积 | 11,934,828.98 | 5,228,753.63 | 4,535,144.54 |
| 未分配利润 | 70,533,705.88 | 18,551,592.71 | 14,003,972.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 416,276,972.81 | 359,296,259.16 | 208,895,054.27 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 416,276,972.81 | 359,296,259.16 | 208,895,054.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 710,180,590.05 | 664,620,776.49 | 448,066,307.82 |

（二）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 276,281,474.98 | 158,152,931.80 | 91,253,648.73 |
| 减：营业成本 | 163,382,087.60 | 116,838,704.93 | 66,343,054.84 |
| 税金及附加 | 1,897,641.32 | 1,203,838.38 | 342,585.91 |
| 销售费用 | 5,304,639.39 | 4,235,990.94 | 4,228,645.29 |
| 管理费用 | 22,848,367.43 | 19,657,710.18 | 12,523,184.22 |
| 研发费用 | 20,616,720.12 | 10,611,710.03 | 9,717,640.89 |
| 财务费用 | 6,011,625.68 | 6,686,570.78 | 3,094,917.73 |
| 其中：利息费用 | 6,757,750.60 | 7,791,586.57 | 4,388,506.07 |
| 利息收入 | 1,062,794.74 | 1,014,570.41 | 1,329,263.93 |
| 加：其他收益 | 13,840,165.89 | 12,469,016.56 | 7,888,068.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,556,597.52 | 311,491.28 | -253,555.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,181,055.39 | 391,925.72 | 6,301.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | -111,307.80 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,199,033.98 | -1,473,422.13 | -1,511,738.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,202,944.00 | -4,633,439.35 | -8,323,264.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -185,754.95 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 68,215,178.87 | 5,294,990.17 | -7,196,870.46 |
| 加：营业外收入 | 376.13 | 542.69 | - |
| 减：营业外支出 | 2,428.83 | 268.50 | 30,262.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,213,126.17 | 5,295,264.36 | -7,227,133.04 |
| 减：所得税费用 | 9,524,937.65 | 54,035.24 | -2,469,678.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,688,188.52 | 5,241,229.12 | -4,757,454.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | 58,688,188.52 | 5,241,229.12 | -4,757,454.68 |
| 终止经营净利润 | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,688,188.52 | 5,241,229.12 | -4,757,454.68 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,707,474.87 | -506,691.23 | 78,187.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,707,474.87 | -506,691.23 | 78,187.65 |

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 六、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列） | 56,980,713.65 | 4,734,537.89 | -4,679,267.03 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 56,980,713.65 | 4,734,537.89 | -4,679,267.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.43 | 0.14 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.43 | 0.14 | -0.13 |

（三）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,801,111.42 | 144,151,503.03 | 107,178,073.54 |
| 收到的税费返还 | 2,870,630.68 | 7,168,872.00 | 18,956,221.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,491,007.19 | 30,140,662.10 | 12,168,999.29 |
| 经营活动现金流入合计 | 305,162,749.29 | 181,461,037.13 | 138,303,294.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,522,991.79 | 75,584,978.99 | 58,650,475.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,205,858.52 | 46,711,514.28 | 39,292,651.90 |
| 支付的各项税费 | 19,893,487.97 | 2,516,767.66 | 3,307,310.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,438,330.61 | 9,526,354.49 | 4,570,526.62 |
| 经营活动现金流出合计 | 210,060,668.89 | 134,339,615.42 | 105,820,964.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,102,080.40 | 47,121,421.71 | 32,482,330.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 313,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,125,603.70 | 66,474.30 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 70,035.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 105,620.60 |
| 投资活动现金流入合计 | 314,125,603.70 | 15,136,509.30 | 105,620.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,167,402.14 | 60,551,063.14 | 129,336,661.83 |
| 投资支付的现金 | 293,000,000.00 | 65,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出合计 | 349,167,402.14 | 125,551,063.14 | 129,336,661.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,041,798.44 | -110,414,553.84 | -129,231,041.23 |

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 145,666,667.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 53,000,000.00 | 110,499,633.37 | 158,695,744.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入合计 | 53,000,000.00 | 256,166,300.37 | 158,695,744.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,269,633.37 | 68,178,881.98 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,020,972.28 | 8,306,795.58 | 24,929,252.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,238,660.93 | 5,170,907.12 | 16,810,215.61 |
| 筹资活动现金流出合计 | 87,529,266.58 | 81,656,584.68 | 96,739,467.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,529,266.58 | 174,509,715.69 | 61,956,276.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,028,063.11 | -308,188.99 | 117,217.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,502,952.27 | 110,908,394.57 | -34,675,216.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,540,638.15 | 59,632,243.58 | 94,307,459.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,043,590.42 | 170,540,638.15 | 59,632,243.58 |

二、会计师事务所审计意见和关键审计事项

（一）会计师事务所审计意见

本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕4453 号），其审计意见具体如下：“我们认为，金连接财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金连接 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）关键审计事项

关键审计事项是天健会计师根据职业判断，认为对 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的财务报表审计最为重要的事项。报告期内，与财务会计信息相关的重大事项如下：

1、收入确认

（1）事项描述

公司营业收入主要来自于芯片测试探针零件产品的生产与销售。报告期内，公司实现营业收入 9,125.36 万元、15,815.29 万元及 27,628.15 万元，其中 2024 年度和 2025 年度营业收入较上一年度分别增长 73.31%和 74.69%。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，天健会计师将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- 3) 按月度、产品、客户等对营业收入及毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；
- 4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户结算单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等；
- 5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；
- 6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；
- 7) 对主要客户实施现场走访等核查程序，以评估收入确认的真实性；

8) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、应收账款减值

(1) 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 3,184.16 万元、6,212.66 万元和 8,613.90 万元，坏账准备分别为 336.25 万元、485.78 万元和 606.01 万元，账面价值分别为 2,847.91 万元、5,726.88 万元和 8,007.89 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，天健会计师将应收账款减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款减值，实施的审计程序主要包括

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层

对坏账准备的计算是否准确；

6) 检查应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

在审计工作中，天健会计师确定了可接受的重要性水平，以便能够评价财务报表整体是否公允反映。天健会计师以发行人以下指标进行了选择和判断，具体情况如下：整体重要性水平是利润总额 5%，实际执行重要性水平是整体重要性水平的 50%。

公司利润总额为财务报表使用者特别关注的财务报表项目，因此选取利润总额作为财务报表整体重要性水平的计算基数。

四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营能力评价

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。

（二）合并财务报表范围及其变化情况

报告期内，本公司合并财务报表范围及其变化情况如下表所示：

| 公司名称 | 子公司类型 | 是否纳入合并财务报表范围 | | |
|-------|-------|--------------|------------|------------|
| | | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
| 北京金连接 | 全资 | 是 | 是 | 是 |
| 日本金连接 | 全资 | 是 | 是 | 是 |
| 香港金连接 | 全资 | 是 | 是 | 否 |

注：香港金连接设立于2024年12月27日

五、主要会计政策和会计估计

（一）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（二）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被

转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》

关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损

失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（三）应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|--|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对 |

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------|---------|-------------|
| | | 照表，计算预期信用损失 |

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|------------|----------------|-----------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

3、按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

（四）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4、周转材料的摊销方法

周转材料按照一次转销法进行摊销。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去

至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（五）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 5 | 2.38-9.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-6 | 5 | 15.83-23.75 |

（七）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|--------|-------------------------------|
| 房屋及建筑物 | 主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

（八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；

2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（九）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|-------|---------------------|------|
| 土地使用权 | 按产权登记期限确定使用寿命为 50 年 | 直线法 |
| 软件 | 按预期受益期限确定使用寿命为 3 年 | 直线法 |

3、研发支出的归集范围

（1）人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员

的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

（3）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

（4）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

（5）委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

（6）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十）职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十一）收入

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时

时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

公司销售芯片测试探针零件、射频互连部件等产品，属于在某一时点履行的

履约义务，在客户取得产品控制权时确认收入。公司收入确认模式区分内销及外销，具体如下：

（1）内销

1) 客户签收：公司负责发货并运输，产品发出到达对方指定地点，经客户签收并获取签收单据或取得签收对账单后确认收入；

2) 寄售模式：客户按照合同约定对公司的寄售产品进行领用并定期提供领用清单，取得客户提供的产品领用清单后确认收入。

（2）外销

FOB、EXW 和 CIF 模式：公司以产品完成报关手续并取得提单（海运）后或者按报关单出口日期（空运）确认收入。

（十二）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关

或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十三）递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5、同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（十四）租赁

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计

算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（十五）重大会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

报告期内，公司不存在重大会计政策变更的情形。

2、会计估计变更

报告期内，公司不存在重大会计估计变更的情形。

六、非经常性损益

（一）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的非经常性损益情况进行了核验，出具了天健审[2026]4456号《关于浙江金连接科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。报告期内，本公司非经常性损益具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -0.04 | -18.58 | -2.98 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 736.73 | 651.44 | 607.24 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 112.56 | 6.65 | 0.91 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 2.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -0.17 | 0.03 | -0.04 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - |
| 非经常性损益合计 | 849.09 | 641.54 | 605.11 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | 127.39 | 96.24 | 90.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - | - |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 721.69 | 545.31 | 514.34 |

（二）非经常性损益影响

单位：万元

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|--|----------|---------|----------|
| 归属于公司普通股股东的净利润（A） | 5,868.82 | 524.12 | -475.75 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额（B） | 721.69 | 545.31 | 514.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5,147.13 | -21.18 | -990.09 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于公司普通股股东的净利润的比例（B/A） | 12.30% | 104.04% | -108.11% |

报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。2023 年度公司未实现盈利，2024 年度和 2025 年度归属于公司普通股股东的非经常性损益净额占归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为 104.04%和 12.30%，2024 年度占比较高主要系受益于行业整体回暖，公司当期净利润实现扭亏为盈，归属于公司普通股股东的净利润规模相对较小所致。报告期内，公司经营成果对非经常性损益不存在重大依赖。

七、主要税种、税率及享受的税收优惠政策

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴 | 1.2% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.50%、20%、23.20% |

注：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 | | |
|--------|---------|---------|---------|
| | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
| 浙江金连接 | 15% | 15% | 15% |
| 日本金连接 | 23.20% | 23.20% | 23.20% |
| 香港金连接 | 16.50% | 16.50% | - |
| 北京金连接 | 20% | 20% | 20% |

注：中国香港法团适用两级制利得税税率：应评税利润不超过 2,000,000 港元的部分，税率为 8.25%；应评税利润超过 2,000,000 港元的部分，税率为 16.50%

（二）税收优惠及批文

1、增值税优惠

（1）公司所属行业为国家鼓励出口类行业，根据《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）规定，对出口货物享受增值税“免、抵、退”税收优惠政策，出口退税率按国家税务总局规定执行。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税[2023]17 号）的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税额。公司为集成电路相关企业，符合按可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税额的优惠政策。

2、企业所得税优惠

（1）2022 年 12 月 24 日，公司获得浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202233002976，有效期三年）；2025 年 12 月 19 日，公司再次取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202533009002，有效期三年）。报告期内，公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

（2）根据财政部、税务总局公告（[2022]13 号）《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局公告（财税[2023]6 号）《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局公告（财税[2023]12 号）《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策》，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。北京金连接于

报告期内享受上述税收优惠政策。

3、研发费用加计扣除

根据财政部、税务总局公告〔2023〕7号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。报告期内，公司享受上述税收优惠政策。

（三）税收优惠对公司盈利能力的影响

报告期内，发行人享受的税收优惠情况及对公司盈利能力的影响如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------|----------|---------|---------|
| 所得税税率优惠金额 | 708.82 | 221.52 | 1.90 |
| 研发费用加计扣除优惠金额 | 204.94 | 148.35 | 143.58 |
| 增值税加计抵减优惠金额 | 267.94 | 366.46 | 97.10 |
| 税收优惠小计 | 1,181.71 | 736.34 | 242.58 |
| 利润总额 | 6,821.31 | 529.53 | -722.71 |
| 税收优惠占利润总额比例 | 17.32% | 139.06% | -33.57% |

注：所得税税率优惠金额的计算公式为：应纳税所得额*（25%-实际适用的所得税税率）

2023 年度公司利润总额为负，2024 年度和 2025 年度发行人税收优惠金额占同期利润总额的比重分别为 139.06%和 17.32%，2024 年度占比较高主要系当期公司刚刚扭亏为盈，利润总额相对较低所致。总体而言，公司对税收优惠不存在重大依赖。

八、主要财务指标

（一）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2025.12.31/ 2025 年度 | 2024.12.31/ 2024 年度 | 2023.12.31/ 2023 年度 |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍） | 3.71 | 3.19 | 1.56 |
| 速动比率（倍） | 3.20 | 2.71 | 0.98 |
| 资产负债率（合并，%） | 41.38 | 45.94 | 53.38 |

| 主要财务指标 | 2025.12.31/ 2025 年度 | 2024.12.31/ 2024 年度 | 2023.12.31/ 2023 年度 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产负债率（母公司，%） | 40.30 | 45.70 | 53.31 |
| 利息保障倍数 | 11.09 | 1.68 | -0.65 |
| 应收账款周转率（次） | 3.73 | 3.37 | 2.60 |
| 存货周转率（次） | 2.79 | 2.05 | 1.36 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 10,914.87 | 4,213.97 | 1,500.02 |
| 归属于发行人股东的净利润（万元） | 5,868.82 | 524.12 | -475.75 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 5,147.13 | -21.18 | -990.09 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.46 | 6.71 | 10.65 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 2.32 | 1.15 | 0.86 |
| 每股净现金流量（元） | 0.57 | 2.71 | -0.92 |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | 10.17 | 8.77 | 5.54 |

具体计算公式如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产-一年内到期的非流动资产）÷流动负债

资产负债率=负债总额÷资产总额

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均账面余额

存货周转率=营业成本÷存货平均账面余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+（利息支出-利息收入）+固定资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销

研发投入占营业收入比重=当期研发投入÷当期营业收入

每股经营活动的现金流量=经营活动现金流量净额÷期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于公司普通股股东权益合计额÷期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司加权平均的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下表所示：

| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
|----------------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2025 年 | 15.13% | 1.43 | 1.43 |
| | 2024 年 | 2.13% | 0.14 | 0.14 |
| | 2023 年 | -2.23% | -0.13 | -0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通 | 2025 年 | 13.27% | 1.26 | 1.26 |
| | 2024 年 | -0.09% | -0.01 | -0.01 |

| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
|---------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 股股东的净利润 | 2023 年 | -4.65% | -0.26 | -0.26 |

计算公式如下：

$$\textcircled{1} \text{ 加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i + M_0 - E_j \times M_j + M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\textcircled{2} \text{ 基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i + M_0 - S_j \times M_j + M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\textcircled{3} \text{ 稀释每股收益 (EPS)} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i + M_0 - S_j \times M_j + M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

九、经营成果分析

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入 | 27,628.15 | 15,815.29 | 9,125.36 |
| 营业成本 | 16,338.21 | 11,683.87 | 6,634.31 |
| 营业利润 | 6,821.52 | 529.50 | -719.69 |
| 利润总额 | 6,821.31 | 529.53 | -722.71 |
| 净利润 | 5,868.82 | 524.12 | -475.75 |
| 扣非后净利润 | 5,147.13 | -21.18 | -990.09 |

报告期内，公司营业收入保持高速增长，营业收入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，2023-2025 年度公司营业收入复合增长率为 74.00%，实现高速增长。报告期内，公司营业收入的增长主要得益于以下因素：全球半导体市场尤其是 GPU、CPU、ASIC 等高端芯片需求爆发，带动测试耗材市场持续扩容，公司凭借核心技术导入国内外知名客户的供应链。同时，公司产品品类持续

完善，与优质客户协同深化，共同增强了营业收入的持续增长动力。

2023 年度及 2024 年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负，主要系：①2023 年度，受全球半导体行业周期性下行影响，下游市场需求放缓，公司产能利用率处于较低水平，对当期盈利水平形成一定制约；②2024 年半导体市场逐步复苏，公司坚定看好半导体行业长期发展前景，积极推进产能扩建与战略布局，加大了对生产设备的资本投入，并相应扩充生产人员规模；加之 2024 年新厂房竣工投入使用，新增固定资产折旧及人员薪酬支出上升，2024 年度公司盈利能力虽有所提升，但仍未实现扣非盈利。

2025 年度，全球半导体行业特别高端芯片实现快速增长，带动公司芯片测试探针零件产品需求大幅上升。随着公司营业收入和经营规模实现较快增长，产能利用率快速提升，规模效应进一步扩大，带动毛利率有所回升。2025 年度，公司实现营业收入 27,628.15 万元，同比上升 74.69%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,147.13 万元，公司盈利能力大幅提升。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务收入 | 24,294.28 | 87.93% | 14,157.86 | 89.52% | 8,467.90 | 92.80% |
| 其他业务收入 | 3,333.87 | 12.07% | 1,657.44 | 10.48% | 657.46 | 7.20% |
| 合计 | 27,628.15 | 100.00% | 15,815.29 | 100.00% | 9,125.36 | 100.00% |

报告期内，公司营业收入主要来自于芯片测试探针零件等微细精密零件的销售收入。报告期内，公司的营业收入分别为 9,125.36 万元、15,815.29 万元和 27,628.15 万元，其中主营业务收入占比约 85%以上，报告期内公司主营业务突出。公司其他业务收入为生产芯片测试探针零件过程中产生的贵金属废沫，该部分收入占营业收入的比例较小。

2024 年度和 2025 年度，公司营业收入较上年分别增长 6,689.93 万元和 11,812.85 万元，增幅分别为 73.31%和 74.69%。报告期内，公司营业收入呈大幅增

长趋势，主要系芯片探针测试零件产品的收入大幅增长，具体分析如下：

（1）下游市场需求持续增长，带动测试探针零件收入提升

随着人工智能、高性能计算等新兴应用的快速发展，全球半导体行业特别是 GPU、CPU、ASIC 等高端芯片领域实现快速增长，芯片测试环节的重要性日益凸显，带动半导体测试探针零部件等核心测试耗材需求稳步提升。

根据沙利文咨询的研究数据，全球半导体测试探针零部件市场规模从 2020 年的 39.8 亿元增至 2024 年的 52.7 亿元，复合年增长率为 7.3%；预计到 2029 年将进一步提升至 104.9 亿元，2025–2029 年复合增长率有望达到 13.2%。中国市场方面，2020 年至 2024 年间，国内市场规模从 5.6 亿元增长至 9.9 亿元，复合年增长率为 15.3%；受益于本土封测产能扩张与核心零部件国产化进程推进，预计到 2029 年有望增至 34.9 亿元，2025–2029 年复合增长率将达 26.3%，中国市场的全球影响力持续增强。

伴随 AI/HPC 芯片向高频、高功率及高集成度方向演进，测试探针市场需求迎来“量价齐升”机遇：在数量层面，AI/HPC 芯片 I/O 密度的指数级增长及 2.5D/3D 堆叠架构带来的更长测试工时，直接推升了芯片测试探针及插座的需求量，以提升芯片测试效率；在质量层面，AI/HPC 芯片测试环境的复杂性，对测试探针零件的机械及电气性能、高频次测试稳定性提出了更为严格的标准，这一需求倒逼探针产品在核心材料、精密制造工艺上全面升级，进而提升芯片测试产品附加值。

因此，AI 算力需求的持续增长及产品快速迭代，驱动测试探针零件进入技术持续革新、量价齐升的全新增长周期，也为探针零件企业带来了广阔的市场发展空间。

（2）核心技术自主与高端市场突破，推动市场份额提升

高端测试探针零件市场长期由国际领先企业主导。近年来，在全球半导体产业链供应链安全性、稳定性日益受到重视的背景下，下游客户对核心测试耗材的国产化、自主可控需求持续增强。芯片测试探针是确保芯片性能与可靠性的关键耗材，而探针零件作为测试探针的核心组件，其关键材料、精密工艺与制造技术的自主可控，对完善国内半导体产业链、保障产业安全具有重要战略意义。

公司通过持续研发投入，已实现精密芯片测试探针零件加工至后处理、特种

合金材料的全流程自主可控，构建了垂直一体化的技术体系。公司产品在关键工艺、精度及可靠性等方面已全面对标国际先进水平，成为国内少数具备高端芯片测试探针零件规模化生产能力的企业。

凭借上述技术优势与稳定可靠的批量交付能力，公司已陆续导入多家国内外知名客户供应链体系。随着国产化进程的深入及高端芯片的迭代发展，公司在全球市场的份额持续提升。根据沙利文咨询发布的行业报告显示，2024 年公司在测试探针零件行业的市占率位居全球第五位，亦是唯一跻身全球前五的中国本土测试探针零件厂商。

（3）产品品类完善与客户结构优化，增强持续增长动力

作为国内芯片测试探针关键零部件领域的先行者，公司已建立起覆盖不同材质、多种类的产品矩阵，具备快速响应不同客户需求的综合供应能力。凭借丰富产品品类与可靠的品质，公司已与 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等行业知名客户建立了稳定合作，客户结构不断优化。

随着半导体测试需求向多样化、高性能方向发展，公司持续加强研发投入，深化与知名客户的协同开发，进一步提升在高复杂度、高附加值产品上的供应比例。优质客户的拓展与产品结构的升级，共同推动了芯片测试探针零件收入的稳步提升。

2、主营业务收入构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别列示如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 芯片测试探针零件 | 22,385.63 | 92.14% | 12,112.76 | 85.56% | 6,583.11 | 77.74% |
| 射频互连部件 | 1,469.90 | 6.05% | 1,771.30 | 12.51% | 1,679.97 | 19.84% |
| 其他 | 438.75 | 1.81% | 273.80 | 1.93% | 204.82 | 2.42% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务收入分别为 8,467.90 万元、14,157.86 万元和 24,294.28 万元，其中芯片测试探针零件的收入占比分别为 77.74%、85.56%和 92.14%，系公司主营业务收入的主要来源。其他收入主要系公司与芯片测试探针零件搭配使用

的绝缘件产品、特种高性能合金材料及医疗器械精密零件产品等，报告期各期收入占比较低。

报告期内，公司各类主要产品销售收入变动的原因如下：

（1）芯片测试探针零件

1) 芯片测试探针零件的收入分类

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司芯片测试探针零件的收入分类情况如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 钽合金测试探针零件 | 11,081.30 | 49.50% | 7,116.84 | 58.75% | 4,262.63 | 64.75% |
| 铍铜测试探针零件 | 5,094.82 | 22.76% | 2,555.59 | 21.10% | 1,170.69 | 17.78% |
| 磷青铜测试探针零件 | 5,490.86 | 24.53% | 1,934.60 | 15.97% | 918.86 | 13.96% |
| 其他芯片测试探针零件 | 718.65 | 3.21% | 505.73 | 4.18% | 230.94 | 3.51% |
| 合计 | 22,385.63 | 100.00% | 12,112.76 | 100.00% | 6,583.11 | 100.00% |

报告期内，公司芯片测试探针零件主要包括钽合金测试探针零件、铍铜测试探针零件、磷青铜测试探针零件，各期占比超过 95%以上。

2) 芯片测试探针零件销量、单价情况

报告期内，公司芯片测试探针零件分产品的销量、单价情况如下：

| 项目 | | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 钽合金测试探针零件 | 销售收入（万元） | 11,081.30 | 7,116.84 | 4,262.63 |
| | 销售数量（万件） | 7,108.20 | 4,319.87 | 2,463.78 |
| | 销售单价（元/件） | 1.56 | 1.65 | 1.73 |
| 铍铜测试探针零件 | 销售收入（万元） | 5,094.82 | 2,555.59 | 1,170.69 |
| | 销售数量（万件） | 9,489.62 | 4,617.85 | 2,085.88 |
| | 销售单价（元/件） | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| 磷青铜测试探针零件 | 销售收入（万元） | 5,490.86 | 1,934.60 | 918.86 |
| | 销售数量（万件） | 7,346.17 | 2,782.91 | 1,233.61 |
| | 销售单价（元/件） | 0.75 | 0.70 | 0.74 |

①钽合金测试探针以其优良的导电性、高硬度、高耐磨性、高强度等特性，

是目前高端芯片测试领域的优选探针产品，其在重复高频测试中仍可保持接触稳定、阻抗低、磨损小，确保了信号传输的精准性，主要应用于 GPU、CPU、ASIC 等芯片对间距、密度、频率及可靠性要求极高的测试场景。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，钽合金测试探针零件产品的收入分别为 4,262.63 万元、7,116.84 万元和 11,081.30 万元，占芯片测试探针零件产品收入的比例为 64.75%、58.75%和 49.50%，是公司芯片测试探针零件收入的主要来源及重点发展业务方向。

报告期各期，受益于下游市场需求释放、公司主要客户自身销售放量及半导体国产化机遇，公司把握市场机遇并持续扩充产能，钽合金测试探针零件销量快速提升，2024 年和 2025 年销量同比分别增长 75.33%和 64.55%。价格方面，报告期内，公司为提升自产钽合金棒材的使用比例并结合下游需求、原材料价格波动情况，主动调整产品定价以抢占市场份额。报告期内，在销量快速放量的带动下，公司钽合金测试探针零件销售收入实现大幅增长。

②2023 年度、2024 年度和 2025 年度，铍铜测试探针零件产品的收入分别为 1,170.69 万元、2,555.59 万元和 5,094.82 万元，占芯片测试探针零件产品收入的比例为 17.78%、21.10%和 22.76%。铍铜测试探针凭借其优异的导电性、导热性、高弹性、良好可加工性及耐磨性，并兼具成本优势，在芯片测试领域应用极为广泛。受公司产能持续扩张及下游市场需求上升的积极影响，公司铍铜芯片测试探针零件销量持续上升，2024 年度和 2025 年度，铍铜芯片测试探针零件销量较上年分别上涨 121.39%和 105.50%，带动铍铜芯片测试探针零件的收入上涨。

③2023 年度、2024 年度和 2025 年度，磷青铜测试探针零件产品的收入分别为 918.86 万元、1,934.60 万元和 5,490.86 万元，占芯片测试探针零件产品收入的比例为 13.96%、15.97%和 24.53%。公司磷青铜测试探针零件主要为探针套筒，报告期内，该产品收入增长较快，主要系公司依托在探针套筒领域的核心技术优势，可为客户配套供应成套芯片测试探针零件，有效满足其一体化采购需求，从而带动客户采购规模扩大，推动销售收入实现显著增长。

（2）射频互连部件

公司的射频互连部件主要包括微细精密连接器零件及线缆组件等，2023 年度、

2024 年度和 2025 年度，公司射频互连部件收入分别为 1,679.97 万元、1,771.30 万元和 1,469.90 万元，占主营业务收入比重分别为 19.84%、12.51%和 6.05%。

3、主营业务收入按销售区域分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分情况如下：

单位：万元

| 地区 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 境内 | 21,743.55 | 89.50% | 11,824.82 | 83.52% | 6,622.43 | 78.21% |
| 其中：华东 | 20,587.01 | 84.74% | 11,107.05 | 78.45% | 6,052.98 | 71.48% |
| 华南 | 985.30 | 4.06% | 547.43 | 3.87% | 326.03 | 3.85% |
| 其他 | 171.24 | 0.70% | 170.35 | 1.20% | 243.41 | 2.87% |
| 境外 | 2,550.73 | 10.50% | 2,333.03 | 16.48% | 1,845.48 | 21.79% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

注：上述境外收入包括中国港澳台地区的收入

报告期内，公司产品以境内销售为主，境内销售收入分别为 6,622.43 万元、11,824.82 万元和 21,743.55 万元，各期占比分别为 78.21%、83.52%和 89.50%。从国内市场来看，公司内销主要集中在华东和华南地区，主要系该等区域为国内半导体测试探针及射频互连部件的核心产业集群地，产业链配套完善，与公司产品的下游应用领域高度契合。

报告期内，公司亦积极开拓境外市场，境外销售收入分别为 1,845.48 万元、2,333.03 万元和 2,550.73 万元，各期占比分别为 21.79%、16.48%和 10.50%。

4、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司销售收入均为直销，不存在经销等非直销销售方式。

5、主营业务收入按季度分析

报告期内，公司主营业务收入按季度划分的情况如下：

单位：万元

| 季度 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 一季度 | 3,916.41 | 16.12% | 2,394.67 | 16.91% | 2,022.08 | 23.88% |
| 二季度 | 5,853.97 | 24.10% | 3,276.47 | 23.14% | 2,014.87 | 23.79% |

| 季度 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-----|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 三季度 | 7,270.13 | 29.93% | 4,125.15 | 29.14% | 1,981.48 | 23.40% |
| 四季度 | 7,253.77 | 29.86% | 4,361.56 | 30.81% | 2,449.47 | 28.93% |
| 合计 | 24,294.28 | 100.00% | 14,157.86 | 100.00% | 8,467.90 | 100.00% |

报告期内，公司的主营业务收入分布并不具有明显的季节性，第一季度销售占比相对较低，主要是春节假期等因素影响所致。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况及变动分析

报告期内，公司营业成本结构如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务成本 | 13,137.75 | 80.41% | 10,098.27 | 86.43% | 5,945.61 | 89.62% |
| 其他业务成本 | 3,200.46 | 19.59% | 1,585.60 | 13.57% | 688.70 | 10.38% |
| 合计 | 16,338.21 | 100.00% | 11,683.87 | 100.00% | 6,634.31 | 100.00% |

报告期内，公司主营业务成本按产品构成，具体如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 芯片测试探针零件 | 11,309.53 | 86.08% | 8,227.60 | 81.48% | 4,363.22 | 73.39% |
| 射频互连部件 | 1,337.40 | 10.18% | 1,505.00 | 14.90% | 1,353.71 | 22.77% |
| 其他 | 490.82 | 3.74% | 365.68 | 3.62% | 228.68 | 3.85% |
| 合计 | 13,137.75 | 100.00% | 10,098.27 | 100.00% | 5,945.61 | 100.00% |

报告期内，主营业务成本与主营业务收入的增幅基本一致。报告期内，公司各产品主营业务成本的占比与主营业务收入结构基本相符。

2、主营业务成本构成按类别构成情况

报告期内，公司主营业务成本包括直接材料、直接人工、制造费用和委外加工费，具体构成情况如下所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 直接材料 | 2,614.61 | 19.90% | 2,103.91 | 20.83% | 1,779.82 | 29.93% |
| 直接人工 | 3,266.69 | 24.86% | 2,582.22 | 25.57% | 1,532.42 | 25.77% |
| 制造费用 | 4,476.90 | 34.08% | 4,037.22 | 39.98% | 1,970.90 | 33.15% |
| 委外加工 | 2,779.54 | 21.16% | 1,374.93 | 13.62% | 662.47 | 11.14% |
| 合计 | 13,137.75 | 100.00% | 10,098.27 | 100.00% | 5,945.61 | 100.00% |

公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用及委外加工费用构成。报告期内，公司主营业务成本分别为 5,945.61 万元、10,098.27 万元和 13,137.75 万元。公司的直接材料主要为钼片、铍铜棒料、磷青铜毛细金属管等；直接人工主要来自于生产人员工资、津贴、补贴、社保公积金和福利费等；制造费用主要为设备折旧费、房屋折旧费等费用；委外加工费主要为公司产品电镀环节的委外加工费用。

报告期内，公司主营业务成本构成占比存在小幅波动，公司主营业务成本项目构成变动与产品销售结构整体匹配，其中 2024 年度，公司主营业务成本构成中直接材料占比有所下降，主要系原材料钼片采购价格下降，及更具成本优势的自产钼合金棒材应用比例提升所致；2025 年度，公司主营业务成本构成中委外加工费用占比上升，主要系需委外电镀加工的铍铜及磷青铜测试探针零件产品销售收入占比提高所致。

（三）毛利及毛利率分析

1、综合毛利构成及变动分析

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|--------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务毛利 | 11,156.53 | 98.82% | 4,059.58 | 98.26% | 2,522.30 | 101.25% |
| 其他业务毛利 | 133.41 | 1.18% | 71.84 | 1.74% | -31.24 | -1.25% |
| 综合毛利 | 11,289.94 | 100.00% | 4,131.42 | 100.00% | 2,491.06 | 100.00% |

报告期内，公司毛利的主要来源为主营业务毛利，公司主营业务突出，各期

主营业务毛利分别为 2,522.30 万元、4,059.58 万元和 11,156.53 万元，占公司综合毛利的比例分别为 101.25%、98.26%和 98.82%。公司其他业务主要系贵金属废沫收入，报告期内其他业务收入毛利较低。

2、主营业务毛利构成及变动分析

报告期内，公司按产品类别划分的主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 芯片测试探针零件 | 11,076.10 | 99.28% | 3,885.17 | 95.70% | 2,219.89 | 88.01% |
| 射频互连部件 | 132.51 | 1.19% | 266.30 | 6.56% | 326.26 | 12.94% |
| 其他 | -52.07 | -0.47% | -91.88 | -2.26% | -23.86 | -0.95% |
| 合计 | 11,156.53 | 100.00% | 4,059.58 | 100.00% | 2,522.30 | 100.00% |

报告期内，公司毛利主要来源于芯片测试探针零件，芯片测试探针零件的实现毛利分别为 2,219.89 万元、3,885.17 万元和 11,076.10 万元，占主营业务毛利的比例分别为 88.01%、95.70%和 99.28%，随着公司芯片测试探针零件收入规模的增长，毛利贡献亦随之上升。

3、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司各主营业务毛利率及其销售收入占比情况如下：

| 产品类别 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 毛利率 | 销售收入占比 | 毛利率 | 销售收入占比 | 毛利率 | 销售收入占比 |
| 芯片测试探针零件 | 49.48% | 92.14% | 32.07% | 85.56% | 33.72% | 77.74% |
| 射频互连部件 | 9.01% | 6.05% | 15.03% | 12.51% | 19.42% | 19.84% |
| 其他 | -11.87% | 1.81% | -33.56% | 1.93% | -11.65% | 2.42% |
| 合计 | 45.92% | 100.00% | 28.67% | 100.00% | 29.79% | 100.00% |

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司主营业务毛利率分别为 29.79%、28.67%和 45.92%，主营业务毛利率的波动主要受公司报告期内整体产能利用率、产品结构变化和各类产品毛利率变动的影响。

2023 年度和 2024 年度，公司主营业务毛利率相对偏低，主要系：①受全球半导体行业周期性下行影响，公司产能利用率严重不足，致使单位产品分摊的固

定成本较高；②公司提前布局推进产能扩建，加大设备采购及人员扩充力度，且自2024年公司搬迁至新厂房，新增固定资产折旧与生产人员薪酬支出显著增长。

2025年度，公司主营业务毛利率快速提升，主要得益于公司高毛利率的芯片测试探针零件销售规模及占比快速增长，公司产能利用率提升，加之降本增效持续深化，带公司主营业务毛利率恢复至正常合理水平。

4、分产品类别毛利率变动分析

（1）芯片测试探针零件毛利率变动分析

报告期内，公司芯片测试探针零件按产品类型分类的销售毛利率的具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025年度 | | 2024年度 | | 2023年度 | |
|------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 | 毛利 | 毛利率 |
| 钽合金测试探针零件 | 7,478.38 | 67.49% | 3,798.20 | 53.37% | 2,187.58 | 51.32% |
| 铍铜测试探针零件 | 1,372.05 | 26.93% | -60.09 | -2.35% | -51.83 | -4.43% |
| 磷青铜测试探针零件 | 1,996.09 | 36.35% | 171.73 | 8.88% | 89.42 | 9.73% |
| 其他芯片测试探针零件 | 229.58 | 31.95% | -24.68 | -4.88% | -5.28 | -2.29% |
| 合计 | 11,076.10 | 49.48% | 3,885.17 | 32.07% | 2,219.89 | 33.72% |

报告期内，公司芯片测试探针零件，尤其是钽合金芯片测试探针产品，毛利率保持在较高水平，具体分析如下：

① 技术领先与定价优势

长期以来，高端芯片测试探针零件市场主要由国际厂商主导，国产替代需求迫切。公司深耕微细精密零部件领域多年，已建立起覆盖核心工艺全流程的自主研发体系，并成为国内少数实现高端芯片测试探针零件规模化量产的企业。公司主要产品芯片测试探针零件的性能参数已全面对标甚至部分超越主要竞争对手产品，由于原有客户采用的国外竞品价格一般相对较高，公司在替代国外竞品过程中亦可获得较高的溢价。

② 一体化生产与成本控制

公司掌握了钽合金棒材的自主制备技术，相关材料性能达到或部分优于进口同类产品，实现了从核心原材料到成品的一体化生产，目前公司钽合金芯片测试

探针零件主要采用自产钽合金棒材，有效降低了原材料采购成本及外部供应链依赖。同时，公司通过搭建起完整的自主刀具研发制造体系，实现关键刀具的自产替代，显著降低了耗材成本。在此基础上，公司持续进行生产工艺改进与管理经验积累，不断提升了加工精度与产品良率，并在规模效应带动下进一步提高了设备产能利用效率，使得公司在产品生产中能够有效控制成本，维持较高的毛利率水平。

③高行业壁垒与产品持续迭代

作为国内少数具备测试探针零件规模化制造能力的企业，公司可实现最小直径 0.03mm、尺寸公差 $\pm 2\mu\text{m}$ 的测试探针零件稳定批量生产，并能够在最小直径 0.04mm 的探针顶柱头完成复杂几何结构的镜面级加工，产品参数已全面对标甚至部分超越国外竞争对手产品，相关技术路线系公司长期的技术研发投入与迭代而来，技术壁垒较高。与此同时，公司积极推进微细零件产品迭代升级，推出行业内较为领先的产品，持续提升产品附加值，使得公司毛利率维持较高水平。

综上，公司凭借技术领先优势、有效的成本控制能力及持续的产品迭代升级，构建了较强的产品溢价能力与成本管控，使得公司芯片测试探针零件产品，尤其是钽合金探针零件产品，毛利率维持较高水平。

1) 钽合金测试探针零件

报告期内，钽合金测试探针零件的平均销售单价、平均单位成本以及毛利率情况如下：

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 |
|-----------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 变动率 | 金额 | 变动率 | 金额 |
| 销售价格（元/件） | 1.56 | -5.37% | 1.65 | -4.78% | 1.73 |
| 单位成本（元/件） | 0.51 | -34.02% | 0.77 | -8.79% | 0.84 |
| 毛利率 | 67.49% | 提高 14.12 个百分点 | 53.37% | 提高 2.05 个百分点 | 51.32% |

报告期内，钽合金测试探针零件的毛利率分别为 51.32%、53.37%及 67.49%，呈稳步上升趋势。

2024 年度，钽合金测试探针零件毛利率小幅上升，主要系原材料钽片采购价格下降，及更具成本优势的自产钽合金棒材应用比例提升所致。2025 年度，钽合

金测试探针零件毛利率较 2024 年度上升 14.12 个百分点，主要系：2025 年度，在市场需求增长的背景下，公司订单规模持续扩大，规模化生产效应逐步提高，且叠加核心刀具自产替代及工艺优化带来的良率提升，钽合金芯片测试探针零件产品单位固定成本进一步摊薄，单位成本较上年下降 34.02%，导致 2025 年度钽合金测试探针零件的毛利率同步提升。

2) 铍铜测试探针零件

报告期内，铍铜测试探针零件的平均销售单价、平均单位成本以及毛利率情况如下：

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 |
|-----------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 变动率 | 金额 | 变动率 | 金额 |
| 销售价格（元/件） | 0.54 | -2.99% | 0.55 | -1.39% | 0.56 |
| 单位成本（元/件） | 0.39 | -30.74% | 0.57 | -3.36% | 0.59 |
| 毛利率 | 26.93% | 提高 29.28 个百分点 | -2.35% | 提高 2.08 个百分点 | -4.43% |

报告期内，铍铜测试探针零件的毛利率-4.43%、-2.35%和 26.93%。2023 年度及 2024 年度，公司铍铜测试探针零件产品的毛利率处于相对较低水平，主要系：公司在相关生产设备方面持续投入，且受半导体行业周期性下行影响，产能未能得到充分利用，导致单位成本较高。2025 年度，受该产品销售收入增长驱动，规模效应显现，单位生产成本显著降低，毛利率较上年提升 29.28 个百分点。

3) 磷青铜测试探针零件

报告期内，磷青铜测试探针零件的平均销售单价、平均单位成本以及毛利率情况如下：

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 |
|-----------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 变动率 | 金额 | 变动率 | 金额 |
| 销售价格（元/件） | 0.75 | 7.52% | 0.70 | -6.67% | 0.74 |
| 单位成本（元/件） | 0.48 | -24.90% | 0.63 | -5.79% | 0.67 |
| 毛利率 | 36.35% | 提高 27.48 个百分点 | 8.88% | 下降 0.86 个百分点 | 9.73% |

报告期内，磷青铜测试探针零件的毛利率 9.73%、8.88%和 36.35%。2025 年度，磷青铜测试探针零件的毛利率上升 27.48 个百分点，主要系：一方面，2025 年度随着下游客户对磷青铜测试探针零件的产品技术指标要求的提升，其技术复杂度

与附加值有所增加，带动平均销售单价同比上升 7.52%；另一方面，随着产销规模扩大，单位产品分摊的固定成本下降，共同推动单位生产成本同比下降 24.90%。在上述价格上升与成本下降的双重因素影响下，该产品 2025 年度毛利率显著提升。

（2）射频互连部件毛利率变动分析

报告期内，公司射频互连部件业务的毛利率分别为 19.42%、15.03%和 9.01%。报告期内，公司射频互连部件的毛利率有所下滑，主要系下游消费电子行业需求结构性放缓，且该业务并非公司战略聚焦方向，资源配置与工艺优化相对有限所致。

5、同行业可比上市公司毛利率比较分析

报告期内，公司芯片测试探针零件毛利率与可比上市公司毛利率比较情况如下：

| 公司名称 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| Leeno | 52.18% | 49.67% | 50.21% |
| WinWay | 45.26% | 43.70% | 37.06% |
| 和林微纳 | 44.88% | 33.66% | 27.98% |
| 可比公司平均 | 47.44% | 42.34% | 38.42% |
| 本公司 | 49.48% | 32.07% | 33.72% |

注 1：以上数据均来自可比上市公司披露的招股书或定期报告

注 2：和林微纳选取半导体测试探针产品毛利率

目前上市公司中不存在与公司芯片测试探针零件产品完全可比的上市公司，公司选取了主营业务产品与芯片测试耗材相关的 Leeno、WinWay、和林微纳，Leeno 与和林微纳主营业务为芯片测试插座和测试探针，WinWay 主营测试插座。报告期内，不同可比公司在销售产品类型与产业链环节等均存在一定差异，因此毛利率存在一定差异。

2023 年度和 2024 年度，公司芯片测试探针零件业务毛利率低于同行业可比公司平均水平，主要系：①受全球半导体行业周期性波动及公司前瞻性产能布局策略共同影响，2023 年度和 2024 年度，公司产能利用率偏低，单位成本较高，公司芯片测试探针零件毛利率水平尚未充分释放；②双方业务结构与所处发展阶段不同所致，可比公司 Leeno 和 WinWay 主要通过自产核心探针零件，完成了从

关键部件到成品芯片测试插座/探针的垂直整合，有效控制了生产成本，加之长期积累的产销规模优势带来的成本摊薄效应，因此可比公司毛利率相对较高。

2025 年度，受益 AI 芯片与先进封装市场需求的高速增长，公司芯片测试探针零件收入显著增加，带动产能利用率提升并回归至合理较高水平。2025 年度，公司芯片测试探针零件毛利率处于同行业上市公司毛利率区间内，不存在异常。

（四）期间费用分析

报告期内，各期间费用金额及占营业收入比重如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 销售费用 | 530.46 | 1.92% | 423.60 | 2.68% | 422.86 | 4.63% |
| 管理费用 | 2,284.84 | 8.27% | 1,965.77 | 12.43% | 1,252.32 | 13.72% |
| 研发费用 | 2,061.67 | 7.46% | 1,061.17 | 6.71% | 971.76 | 10.65% |
| 财务费用 | 601.16 | 2.18% | 668.66 | 4.23% | 309.49 | 3.39% |
| 合计 | 5,478.14 | 19.83% | 4,119.20 | 26.05% | 2,956.44 | 32.40% |

报告期内，公司期间费用合计金额为 2,956.44 万元、4,119.20 万元和 5,478.14 万元，整体呈上升趋势，主要系公司规模扩大，整体费用增加所致。

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用具体明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 职工薪酬 | 424.59 | 80.04% | 338.52 | 79.92% | 348.35 | 82.38% |
| 广告宣传费 | 43.70 | 8.24% | 42.82 | 10.11% | 32.12 | 7.60% |
| 差旅费 | 37.87 | 7.14% | 25.18 | 5.94% | 25.58 | 6.05% |
| 折旧与摊销 | 9.98 | 1.88% | 4.27 | 1.01% | 2.87 | 0.68% |
| 业务招待费 | 4.61 | 0.87% | 3.04 | 0.72% | 4.46 | 1.06% |
| 办公费 | 2.86 | 0.54% | 3.20 | 0.76% | 1.71 | 0.40% |
| 其他 | 6.86 | 1.29% | 6.56 | 1.55% | 7.78 | 1.84% |
| 合计 | 530.46 | 100.00% | 423.60 | 100.00% | 422.86 | 100.00% |
| 销售费用率 | 1.92% | | 2.68% | | 4.63% | |

报告期内，公司销售费用的金额分别为 422.86 万元、423.60 万元和 530.46 万元，占各期营业收入的比例分别为 4.63%、2.68%和 1.92%。公司销售费用主要由职工薪酬、广告宣传费和差旅费构成，占比 95%以上。

报告期内公司与可比上市公司销售费用率比较情况如下表：

| 公司名称 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| Leeno | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| WinWay | 7.51% | 8.00% | 9.67% |
| 和林微纳 | 3.81% | 4.43% | 6.78% |
| 可比公司平均 | 5.66% | 6.22% | 8.22% |
| 本公司 | 1.92% | 2.68% | 4.63% |

数据来源：Wind、上市公司披露的定期报告或招股说明书

报告期内，公司销售费用率分别为 4.63%、2.68%和 1.92%，低于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司凭借产品核心竞争力与市场口碑获取订单，且公司客户集中度较高、主要客户关系稳定，销售资源投入相对较少。相较之下，可比公司产品以芯片测试插座及测试探针为主，其产品均需依据客户芯片参数进行高度定制化开发，销售各阶段需涉及频繁的沟通与技术对接，因此销售费用投入规模较大，导致可比公司销售费用率整体高于发行人。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用具体明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 职工薪酬 | 1,084.50 | 47.47% | 958.13 | 48.74% | 770.66 | 61.54% |
| 折旧及摊销 | 451.89 | 19.78% | 340.43 | 17.32% | 145.45 | 11.61% |
| 中介服务费 | 292.53 | 12.80% | 303.78 | 15.45% | 131.42 | 10.49% |
| 办公费 | 371.59 | 16.26% | 287.47 | 14.62% | 89.75 | 7.17% |
| 差旅费 | 34.80 | 1.52% | 31.19 | 1.59% | 24.72 | 1.97% |
| 业务招待费 | 29.72 | 1.30% | 28.42 | 1.45% | 80.61 | 6.44% |
| 其他 | 19.80 | 0.87% | 16.35 | 0.83% | 9.72 | 0.78% |
| 合计 | 2,284.84 | 100.00% | 1,965.77 | 100.00% | 1,252.32 | 100.00% |
| 管理费用率 | 8.27% | | 12.43% | | 13.72% | |

报告期内，公司管理费用的金额分别为 1,252.32 万元、1,965.77 万元和 2,284.84 万元，占各期营业收入的比例分别为 13.72%、12.43%和 8.27%。公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、中介服务费和办公费构成，占比 90%以上。

报告期内，公司管理费用整体呈现上升趋势，主要原因为：（1）公司因业务规模扩张、完善职能部门的岗位设置，相应增加中后台部门员工及管理人员数量，职工薪酬也随之增长；（2）随着 2024 年度新建办公楼投入使用及相应办公设备等增加，导致折旧摊销费用相应上升；（3）报告期内，公司因经营管理和上市规范化需要，聘请中介机构提供服务，向中介机构支付的咨询服务费用、审计费用增加所致。

报告期内公司与可比上市公司管理费用率比较情况如下表：

| 公司名称 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| Leeno | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| WinWay | 6.19% | 6.41% | 5.84% |
| 和林微纳 | 4.74% | 5.95% | 10.33% |
| 可比公司平均 | 5.47% | 6.18% | 8.09% |
| 本公司 | 8.27% | 12.43% | 13.72% |

数据来源：Wind、上市公司披露的定期报告或招股说明书

报告期内，公司管理费用率分别为 13.72%、12.43%和 8.27%，由于公司整体规模较小，正处于快速发展阶段，导致管理费用率较同行业可比公司偏高。随着公司收入规模的扩大，管理费用率逐渐降低。

3、研发费用分析

（1）研发费用结构及分析

报告期内，公司的研发费用构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 职工薪酬 | 804.65 | 39.03% | 595.38 | 56.11% | 563.76 | 58.01% |
| 直接投入 | 437.50 | 21.22% | 223.76 | 21.09% | 234.45 | 24.13% |
| 折旧与摊销 | 377.13 | 18.29% | 193.15 | 18.20% | 130.85 | 13.47% |
| 委外研发费 | 351.09 | 17.03% | - | 0.00% | - | 0.00% |

| 项目 | 2025 年度 | | 2024 年度 | | 2023 年度 | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 燃料动力费 | 40.18 | 1.95% | 19.71 | 1.86% | 21.68 | 2.23% |
| 其他 | 51.12 | 2.48% | 29.16 | 2.75% | 21.02 | 2.16% |
| 合计 | 2,061.67 | 100.00% | 1,061.17 | 100.00% | 971.76 | 100.00% |
| 研发费用率 | 7.46% | | 6.71% | | 10.65% | |

报告期内，公司研发费用分别为 971.76 万元、1,061.17 万元和 2,061.67 万元，研发费用占当期收入的比例分别为 10.65%、6.71%和 7.46%。报告期内公司持续投入开展新产品、新技术的研发，研发费用金额呈上涨趋势，研发费用主要由职工薪酬、直接投入、折旧摊销费和委外研发费等构成。

1) 职工薪酬

报告期内，公司研发人员的职工薪酬分别为 563.76 万元、595.38 万元和 804.65 万元。研发费用中职工薪酬主要系从事研发活动人员的工资、奖金、社会保险费、住房公积金等。报告期内，公司持续加大研发投入，职工薪酬金额随着公司研发人员扩充及工资水平提高而呈现增长趋势。

2) 直接投入

报告期内，公司研发费用直接投入分别为 234.45 万元、223.76 万元和 437.50 万元。公司研发费用直接投入主要系公司研发项目所耗用的直接材料投入。报告期内，公司持续深化在特种高性能合金材料及芯片测试探针领域的技术纵深，并积极研发布局高精密医疗器械零部件及晶圆测试探针零件行业，公司在相关领域均实现多项技术突破，持续构建公司核心技术壁垒，公司不断加大研发投入，研发耗用直接投入有所增加。

3) 折旧与摊销

报告期内，公司研发费用中的折旧与摊销分别为 130.85 万元、193.15 万元和 377.13 万元，主要为研发活动相关的机器设备折旧和长期资产摊销。报告期内，研发费用中的折旧与摊销金额有所增加，主要系公司为推进新产品与新工艺研发，相应购置专用设备导致折旧额增长所致。

4) 委外研发费

2025 年度，公司研发费用委外研发费为 351.09 万元，主要系公司基于长远战略布局及产业链延伸的考量，为拓展芯片测试探针零件的产品类型，丰富产品矩阵，补齐公司芯片测试探针零件的空缺，对芯片测试探针微弹簧项目进行委外研发。

报告期内，公司高度重视研发创新，不断加大研发投入以提高产品竞争力，保持了较高的研发投入，为公司持续产品创新和技术积累打下坚实基础。公司通过自主研发构建高精度先进生产工艺技术平台、自动化收集与清洗技术平台以及超细高性能钼合金棒制备平台的三大平台技术，以上平台协同作用，形成了公司可持续的技术壁垒与核心竞争力。

（2）研发费用率与同行业可比上市公司比较

报告期内，公司研发费用率与同行业上市公司比较情况如下表所示：

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| Leeno | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| WinWay | 5.30% | 5.99% | 6.30% |
| 和林微纳 | 7.30% | 10.01% | 25.26% |
| 平均 | 6.30% | 8.00% | 15.78% |
| 本公司 | 7.46% | 6.71% | 10.65% |

数据来源：Wind、上市公司披露的定期报告或招股说明书

报告期内，公司研发费用率分别为 10.65%、6.71%和 7.46%，公司研发费用率总体处于同行业可比公司研发费用率区间，高于 WinWay，低于和林微纳。2023 年度和 2024 年度，公司研发费用略低于同行业上市公司平均水平，主要系和林微纳研发费用率较高，和林微纳自 2023 年以来研发人员数量、研发支出等大幅增加，且当期销售规模较小，因此研发费用率相对较高。

（3）研发项目情况

报告期内，公司研发投入的主要项目情况，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | 预算 | 截至报告期末状态 |
|----|-------------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 1 | 芯片测试探针弹簧的研发 | 387.64 | 2.95 | - | 420.00 | 进行中 |

| 序号 | 项目名称 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 预算 | 截至报告期末状态 |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2 | 电铸微细管的研发 | 296.62 | 48.81 | - | 400.00 | 进行中 |
| 3 | 高精密钽合金 Kelvin 头探针的研发 | - | 273.82 | - | 280.00 | 已完结 |
| 4 | 高精密探针直皇冠头高效加工工艺的研发 | 236.13 | - | - | 275.00 | 进行中 |
| 5 | 偏 Kelvin 头芯片测试探针顶柱头的研发 | - | - | 202.66 | 200.50 | 已完结 |
| 6 | 高精密探针套筒圆弧收口工艺的研发 | 202.56 | - | - | 239.50 | 进行中 |
| 7 | 铂钨合金棒材生产工艺的研发 | 53.42 | 68.11 | 64.21 | 292.00 | 已完结 |
| 8 | 晶圆检测探针加工工艺的研发 | 184.32 | - | - | 280.00 | 进行中 |
| 9 | 高精密 TP 类探针头功能区提升技术的研发 | 78.33 | 80.07 | - | 163.50 | 已完结 |
| 10 | 镀铜 Kelvin 头探针的研发 | - | 152.35 | - | 150.00 | 已完结 |

4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用具体明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 675.77 | 779.16 | 438.85 |
| 减：利息收入 | 106.28 | 101.46 | 132.93 |
| 汇兑损益 | 26.74 | -14.03 | -1.57 |
| 手续费 | 4.93 | 4.99 | 5.13 |
| 合计 | 601.16 | 668.66 | 309.49 |

报告期内，公司财务费用的金额分别为 309.49 万元、668.66 万元和 601.16 万元，占各期营业收入的比例分别为 3.39%、4.23%和 2.18%。公司财务费用主要由利息支出构成，系银行贷款相关利息费用支出，2024 年度利息费用有所上升，主要系 2024 年度公司新厂区基建项目完工转固，相应贷款的利息费用不再进行资本化，计入当期财务费用所致。

（五）利润表其他主要项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 房产税 | 128.58 | 82.22 | - |
| 法人事业税 | 16.08 | 9.56 | 16.64 |
| 印花税 | 14.29 | 17.29 | 6.85 |
| 城市维护建设税 | 11.64 | - | - |
| 土地使用税 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |
| 教育费附加 | 4.78 | - | - |
| 地方教育附加 | 3.18 | - | - |
| 车船税 | 0.59 | 0.89 | 0.35 |
| 其他税金（海外） | 0.22 | - | - |
| 合计 | 189.76 | 120.38 | 34.26 |

报告期内，公司税金及附加的发生金额分别为 34.26 万元、120.38 万元和 189.76 万元，主要为房产税、法人事业税、印花税、城市维护建设税和土地使用税等。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 427.57 | 231.22 | 84.44 |
| 与收益相关的政府补助 | 688.48 | 649.18 | 607.24 |
| 增值税加计抵减 | 267.94 | 366.46 | 97.10 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 合计 | 1,384.02 | 1,246.90 | 788.81 |

报告期内，公司其他收益主要为与日常经营相关的各项政府补助及增值税加计抵减。

报告期内，公司计入递延收益的政府补助分摊计入当期损益的情况如下：

单位：万元

| 项目 | 计入当期损益的金额 | | | 备注 |
|---------------------|-----------|---------|---------|-------|
| | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | |
| 半导体精密探针零件制造项目设备投入补助 | 188.55 | 94.74 | 32.21 | 与资产相关 |
| 2024 年省级产业链协同创新项目补助 | 80.49 | 47.69 | - | 与资产相关 |

| 项目 | 计入当期损益的金额 | | | 备注 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | |
| 1 亿件半导体精密探针零件产品（生产线）技改项目补助 | 41.91 | 41.91 | 41.11 | 与资产相关 |
| 年产 4800 万件半导体精密探针零件制造技改项目补助 | 27.94 | 20.96 | - | 与资产相关 |
| 国家制造业新型技术改造城市试点项目资金 | 75.29 | 12.55 | - | 与资产相关 |
| 半导体精密探针零件制造项目补助 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 与资产相关 |
| 土地红线外水电工程补助 | 2.26 | 2.26 | - | 与资产相关 |
| 合计 | 427.57 | 231.22 | 84.44 | - |

报告期内，公司直接计入其他收益的政府补助情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 | 备注 |
|------------------------|---------------|-------|
| 2025 年度 | | |
| 人才补助资金 | 325.00 | 与收益相关 |
| 国家专精特新重点“小巨人”企业高质量发展奖补 | 269.00 | 与收益相关 |
| 人才引育奖励资金 | 20.00 | 与收益相关 |
| 质量管理奖补资金 | 20.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 14.69 | 与收益相关 |
| 扩大产能补助 | 13.46 | 与收益相关 |
| 区级配套补助 | 13.46 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 12.88 | 与收益相关 |
| 合计 | 688.48 | - |
| 2024 年度 | | |
| 科技发展专项资金 | 219.00 | 与收益相关 |
| 专精特新小巨人 | 200.00 | 与收益相关 |
| 新材料认定奖励 | 150.00 | 与收益相关 |
| 研发补助 | 50.93 | 与收益相关 |
| 商务专项资金 | 10.79 | 与收益相关 |
| 鼓励企业扩大有效投资补助 | 10.00 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 8.47 | 与收益相关 |
| 合计 | 649.18 | - |
| 2023 年度 | | |
| 科技发展专项资金 | 256.00 | 与收益相关 |

| 项目 | 金额 | 备注 |
|-------------------|---------------|-------|
| 证监局备案辅导验收补助 | 200.00 | 与收益相关 |
| 研发补助 | 92.06 | 与收益相关 |
| 技术创新与新智造类项目补助 | 15.00 | 与收益相关 |
| 瞪羚企业补助 | 10.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业规模奖励补贴 | 10.00 | 与收益相关 |
| 首次通过高新技术企业复审一次性补助 | 10.00 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 14.18 | 与收益相关 |
| 合计 | 607.24 | - |

3、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 118.11 | 39.19 | 0.63 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 237.55 | -8.04 | -25.99 |
| 合计 | 355.66 | 31.15 | -25.36 |

公司权益法核算的长期股权投资收益为所持有的麦克凯利的 25% 股权所确认的投资损益，处置交易性金融资产取得的投资收益为公司远期结售汇业务到期所确认的投资损益以及废料销售嵌入衍生金融工具所确认的损益。

4、信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失（损失以“-”列示）情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失： | -119.90 | -147.34 | -151.17 |
| 其中：坏账损失 | -119.90 | -147.34 | -151.17 |
| 资产减值损失： | -420.29 | -463.34 | -832.33 |
| 其中：存货跌价损失 | -420.29 | -463.34 | -832.33 |
| 合计 | -540.20 | -610.69 | -983.50 |

公司严格按照会计政策计提各项减值准备，计提情况与资产质量的实际情况一致，各项资产的减值准备计提充分。报告期内，公司信用减值损失主要为应收

账款的坏账损失，公司资产减值损失主要为存货跌价损失。

5、资产处置收益

报告期内，公司的资产处置收益情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 固定资产处置收益 | - | -18.58 | - |
| 合计 | - | -18.58 | - |

2024 年度，公司资产处置收益为-18.58 万元，金额较小，主要系固定资产处置损失。

6、公允价值变动损益

2024 年度，公司公允价值变动损益为-11.13 万元，系公司期末持有的交易性金融资产的公允价值变动。

7、营业外收入与支出

报告期内，公司营业外收入分别为 0 万元、0.05 万元和 0.04 万元，营业外支出分别为 3.03 万元、0.03 万元和 0.24 万元。报告期内，公司营业外收入和营业外支出整体金额较小，对公司的经营业绩影响不大。

（六）主要税种纳税情况

1、增值税缴纳情况

报告期内，公司应缴及实缴增值税的情况如下：

单位：万元

| 期间 | 期初未交数 | 本期已交数 | 期末未交数 |
|---------|---------|-----------|---------|
| 2023 年度 | -446.38 | -1,024.03 | -430.06 |
| 2024 年度 | -430.06 | -294.40 | -125.77 |
| 2025 年度 | -125.77 | 909.42 | 232.46 |

2、所得税缴纳情况

报告期内，公司应缴及实缴企业所得税情况如下：

单位：万元

| 期间 | 期初未交数 | 本期已交数 | 期末未交数 |
|---------|---------|---------|--------|
| 2023 年度 | -250.98 | -225.36 | -29.68 |
| 2024 年度 | -29.68 | 51.12 | 241.73 |
| 2025 年度 | 241.73 | 918.28 | 386.59 |

报告期内，公司主要税种为增值税和企业所得税，公司严格遵守国家及地方的税收法律法规，依法缴纳税款，不存在与纳税相关的重大违法违规情况。

十、资产质量分析

报告期各期末，公司资产结构具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产 | 35,348.61 | 49.77% | 32,971.49 | 49.61% | 14,066.24 | 31.39% |
| 非流动资产 | 35,669.45 | 50.23% | 33,490.59 | 50.39% | 30,740.39 | 68.61% |
| 合计 | 71,018.06 | 100.00% | 66,462.08 | 100.00% | 44,806.63 | 100.00% |

报告期各期末，公司总资产分别为 44,806.63 万元、66,462.08 万元和 71,018.06 万元，公司总资产的规模随着经营规模的扩大而逐步增加。

报告期内，2024 年末流动资产较上年末增长较多主要系一方面随着行业回暖，收入增长导致期末应收账款有所增加，另一方面公司于 2024 年度进行 C 轮融资，导致期末货币资金等有所增加。总体来看，报告期内公司资产构成及变化情况与公司生产经营活动相适应，资产结构合理。

（一）流动资产构成分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 19,404.36 | 54.89% | 17,054.06 | 51.72% | 5,963.22 | 42.39% |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 8.49% | 5,112.25 | 15.51% | - | - |
| 应收账款 | 8,007.89 | 22.65% | 5,726.88 | 17.37% | 2,847.91 | 20.25% |
| 预付款项 | 71.12 | 0.20% | 181.89 | 0.55% | 40.61 | 0.29% |

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 其他应收款 | 90.59 | 0.26% | 138.56 | 0.42% | 10.69 | 0.08% |
| 存货 | 4,617.29 | 13.06% | 4,548.29 | 13.79% | 4,564.43 | 32.45% |
| 其他流动资产 | 157.35 | 0.45% | 209.56 | 0.64% | 477.09 | 3.39% |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | 162.28 | 1.15% |
| 流动资产合计 | 35,348.61 | 100.00% | 32,971.49 | 100.00% | 14,066.24 | 100.00% |

公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货及其他流动资产，各期末上述资产占流动资产比重分别为 98.48%、99.03%和 99.54%。上述资产的具体情况如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 库存现金 | - | - | - | - | - | - |
| 银行存款 | 19,404.36 | 100.00% | 17,054.06 | 100.00% | 5,963.22 | 100.00% |
| 其他货币资金 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 19,404.36 | 100.00% | 17,054.06 | 100.00% | 5,963.22 | 100.00% |

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 5,963.22 万元、17,054.06 万元和 19,404.36 万元，占流动资产比例分别为 42.39%、51.72%和 54.89%。报告期内，公司货币资金由银行存款构成。

2024 年末，公司货币资金较上年末增加 11,090.84 万元，增幅为 185.99%，主要系一方面公司经营规模扩大与盈利能力增强带动经营活动现金净流入增加，另一方面公司成功完成 C 轮融资并增加了银行借款，导致公司货币资金上升。

2025 年末，公司货币资金较上年末增加 2,350.30 万元，主要系公司持有的部分结构性存款到期赎回所致。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|-------|------------|---------|------------|---------|------------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 结构性存款 | 3,000.00 | 100.00% | 5,000.00 | 97.80% | - | - |
| 点价权 | - | - | 112.25 | 2.20% | - | - |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00% | 5,112.25 | 100.00% | - | - |

报告期内，公司交易性金融资产主要为结构性存款，通过购买风险较低的结构性存款有效提高公司资金的使用效率。公司交易性金融资产中的点价权主要系公司向励福环保销售钕合金废沫有权按未来指定点价日的价格进行结算，存在期末未结算的废料销售所致。

3、应收账款

（1）应收款项变动情况

报告期各期末，公司应收账款相关变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 /2025 年度 | 2024.12.31 /2024 年度 | 2023.12.31 /2023 年度 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 应收账款账面价值 | 8,007.89 | 5,726.88 | 2,847.91 |
| 营业收入 | 27,628.15 | 15,815.29 | 9,125.36 |
| 占营业收入比例 | 28.98% | 36.21% | 31.21% |

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 2,847.91 万元、5,726.88 万元和 8,007.89 万元，占流动资产比例分别为 20.25%、17.37%和 22.65%，公司期末应收账款账面价值呈逐年增长趋势，主要系应收账款随营业收入规模的增长而逐年扩大。

（2）应收款项坏账计提情况及同行业对比

1) 账龄分析

报告期各期末，发行人应收账款的账龄分布情况如下：

单位：万元

| 类别 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 8,428.41 | 97.85% | 6,028.30 | 97.03% | 2,997.80 | 94.15% |
| 1-2 年 | 1.12 | 0.01% | - | - | 186.36 | 5.85% |

| 类别 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 2-3年 | - | - | 184.36 | 2.97% | - | - |
| 3年以上 | 184.36 | 2.14% | - | - | - | - |
| 合计 | 8,613.90 | 100.00% | 6,212.66 | 100.00% | 3,184.16 | 100.00% |

公司应收账款主要为1年以内的应收账款，账龄分布情况良好。

2) 应收账款坏账准备

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

| 种类 | 2025.12.31 | | | | |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项计提坏账准备 | 184.36 | 2.14% | 184.36 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备 | 8,429.54 | 97.86% | 421.65 | 5.00% | 8,007.89 |
| 合计 | 8,613.90 | 100.00% | 606.01 | 7.04% | 8,007.89 |

单位：万元

| 种类 | 2024.12.31 | | | | |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项计提坏账准备 | 184.36 | 2.97% | 184.36 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备 | 6,028.30 | 97.03% | 301.41 | 5.00% | 5,726.88 |
| 合计 | 6,212.66 | 100.00% | 485.77 | 7.82% | 5,726.88 |

单位：万元

| 种类 | 2023.12.31 | | | | |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项计提坏账准备 | 186.36 | 5.85% | 186.36 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备 | 2,997.80 | 94.15% | 149.89 | 5.00% | 2,847.91 |
| 合计 | 3,184.16 | 100.00% | 336.25 | 10.56% | 2,847.91 |

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

| 账龄 | 2025.12.31 | | | 2024.12.31 | | | 2023.12.31 | | |
|------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 8,428.41 | 421.42 | 5.00% | 6,028.30 | 301.41 | 5.00% | 2,997.80 | 149.89 | 5.00% |
| 1-2年 | 1.12 | 0.22 | 20.00% | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 8,429.54 | 421.65 | 5.00% | 6,028.30 | 301.41 | 5.00% | 2,997.80 | 149.89 | 5.00% |

报告期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 336.25 万元、485.77 万元和 606.01 万元，占应收账款账面余额的比例分别为 10.56%、7.82%和 7.04%。公司按单项计提坏账准备的应收账款主要系应收林泰精密电子（宁波）有限公司相关款项，因其经营状况不佳，预计期后收回的可能性极低，全额计提坏账。

3) 同行业对比分析

公司应收账款坏账准备计提比例与可比上市公司比较情况如下表：

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
|--------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Leeno | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| WinWay | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 和林微纳 | 5% | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% |
| 本公司 | 5% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% |

注 1：以上同行业上市公司数据系根据其公开披露的定期报告或招股说明书内容所得

注 2：WinWay 采用存续期间预期信用损失进行衡量，按照逾期天数分类披露信用损失率，未披露具体的计提比例

综上所述，公司各个账龄段应收账款坏账准备计提政策与同行业可比公司相应账龄段应收账款坏账准备计提政策基本相同或者更为谨慎，不存在重大差异，公司坏账准备计提政策具有谨慎性和合理性。

(3) 应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款前五名情况如下：

单位：万元

| 期末 | 序号 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
|------------|----|---------------------|----------|------------|--------|
| 2025.12.31 | 1 | Smiths Interconnect | 4,553.18 | 52.86% | 227.66 |
| | 2 | 韬盛科技 | 1,648.77 | 19.14% | 82.44 |
| | 3 | 日拓电子 | 349.70 | 4.06% | 17.49 |

| 期末 | 序号 | 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
|------------|----|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 4 | 迪克微 | 329.64 | 3.83% | 16.48 |
| | 5 | Bel Fuse, Inc. | 328.81 | 3.82% | 16.44 |
| | 合计 | | 7,210.10 | 83.70% | 360.51 |
| 2024.12.31 | 1 | Smiths Interconnect | 3,939.72 | 63.41% | 196.99 |
| | 2 | 日拓电子 | 435.05 | 7.00% | 21.75 |
| | 3 | Bel Fuse, Inc. | 308.49 | 4.97% | 15.42 |
| | 4 | S&B Packaging, Inc. | 207.11 | 3.33% | 10.36 |
| | 5 | 和林微纳 | 194.60 | 3.13% | 9.73 |
| | 合计 | | 5,084.97 | 81.85% | 254.25 |
| 2023.12.31 | 1 | Smiths Interconnect | 1,244.15 | 39.07% | 62.21 |
| | 2 | 捷策创 | 318.17 | 9.99% | 15.91 |
| | 3 | S&B Packaging, Inc. | 293.30 | 9.21% | 14.66 |
| | 4 | 韬盛科技 | 253.73 | 7.97% | 12.69 |
| | 5 | 林泰精密电子（宁波）有限公司 | 168.01 | 5.28% | 168.01 |
| | 合计 | | 2,277.36 | 71.52% | 273.48 |

注 1: Smiths Interconnect: 包含同一控制下的 SMITHS INTERCONNECT AMERICAS, INC.与安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司两家，汇总披露

注 2: Bel Fuse, Inc.: 包含同一控制下的东莞创宝达电器制品有限公司及 Cinch Connectivity Solutions, Inc.两家，汇总披露

截至报告期末，公司应收账款对应客户主要为国内外知名企业，客户整体实力较强、资信状况良好，相关款项不能收回的风险较低。

（4）应收账款期后回款情况

公司报告期各期末应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

| 报告期末 | 应收账款余额 | 期后回款金额 | 期后回款比例 |
|-------------|----------|----------|--------|
| 2025年12月31日 | 8,613.90 | 8,383.38 | 97.32% |
| 2024年12月31日 | 6,212.66 | 6,028.30 | 97.03% |
| 2023年12月31日 | 3,184.16 | 2,999.80 | 94.21% |

注：期后截至 2026 年 4 月 30 日

报告期各期末，公司应收账款期后回款比例分别为 94.21%、97.03%和 97.32%，公司应收账款回款情况良好。

4、预付款项

报告期各期末，公司预付款项账龄结构如下：

单位：万元

| 类别 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 71.12 | 100% | 181.89 | 100% | 40.61 | 100% |
| 合计 | 71.12 | 100% | 181.89 | 100% | 40.61 | 100% |

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 40.61 万元、181.89 万元和 71.12 万元，占流动资产的比例分别为 0.29%、0.55%和 0.20%，占比较小，公司的预付款项主要为预付给供应商的货款、展会费及委外研发费等。

报告期各期末，公司预付款项按对象归集的前五名情况如下：

单位：万元

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 占预付款项总额比例（%） | 款项性质 |
|-----------------------------------|---------------|------|--------------|----------|
| 2025年12月31日 | | | | |
| Nippon Tokushukan MFG. Co., Ltd. | 12.88 | 1年以内 | 18.11 | 材料款 |
| 上海追跃精密机械有限公司 | 8.15 | 1年以内 | 11.45 | 材料款 |
| 赛勉管理咨询（上海）有限公司 | 7.55 | 1年以内 | 10.62 | 展会费 |
| Informa Markets Manufacturing LLC | 7.42 | 1年以内 | 10.43 | 展会费 |
| SEMI Southeast Asia Pte Ltd | 6.83 | 1年以内 | 9.60 | 展会费 |
| 合计 | 42.82 | - | 60.22 | - |
| 2024年12月31日 | | | | |
| リネックステクニカルサポート（LINEX 技术咨询有限公司） | 138.70 | 1年以内 | 76.25 | 委外研发费 |
| 高岛高速直线制造公司 | 9.12 | 1年以内 | 5.02 | 设备款 |
| 赛勉管理咨询（上海）有限公司 | 7.47 | 1年以内 | 4.10 | 展会费 |
| アンゼンユソウカ（安全运输株式会社） | 6.10 | 1年以内 | 3.36 | 房租 |
| 杭州同顺实业有限公司 | 2.55 | 1年以内 | 1.40 | 货款 |
| 合计 | 163.94 | - | 90.13 | - |
| 2023年12月31日 | | | | |
| Carlton-Bates Company | 11.26 | 1年以内 | 27.73 | 材料款 |
| 上海新文海国际货运代理有限公司 | 8.82 | 1年以内 | 21.71 | 进口税费及代理费 |
| SEMI Southeast Asia Pte Ltd | 4.36 | 1年以内 | 10.74 | 展会费 |

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 占预付款项总额比例（%） | 款项性质 |
|------------------|--------------|------|--------------|------|
| 杭州同顺实业有限公司 | 4.34 | 1年以内 | 10.67 | 材料款 |
| Regus Japan K.K. | 2.65 | 1年以内 | 6.53 | 房租 |
| 合计 | 31.43 | - | 77.39 | - |

截至报告期末，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

5、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款的情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他应收款账面余额 | 111.37 | 153.17 | 33.98 |
| 减：坏账准备 | 20.77 | 14.61 | 23.28 |
| 其他应收款账面价值 | 90.59 | 138.56 | 10.69 |

报告期内，公司其他应收款账面价值分别为10.69万元、138.56万元和90.59万元，占流动资产的比例分别为0.08%、0.42%和0.26%。

（1）其他应收款款项性质分类

报告期各期末，其他应收款项余额具体构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 104.60 | 60.45 | 32.74 |
| 应收暂付款 | 6.77 | 92.72 | 1.24 |
| 合计 | 111.37 | 153.17 | 33.98 |

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为33.98万元、153.17万元和111.37万元，公司其他应收款主要系押金保证金和应收暂付款。2024年末应收暂付款较大主要系公司向苏美达国际技术贸易有限公司预付88.00万元设备采购款，后因合同取消产生的应收退款所致。2025年末押金保证金较上年末增长较多主要系当期香港子公司新增厂房租赁支付相关押金所致。

（2）其他应收款账龄分析

报告期各期末，公司按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：万元

| 期末 | 账龄 | 账面余额 | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 |
|------------|------|--------|---------|-------|---------|
| 2025.12.31 | 1年以内 | 51.57 | 46.31% | 2.58 | 5.00% |
| | 1-2年 | 50.43 | 45.28% | 10.09 | 20.00% |
| | 2-3年 | 2.51 | 2.25% | 1.25 | 50.00% |
| | 3年以上 | 6.86 | 6.16% | 6.86 | 100.00% |
| | 合计 | 111.37 | 100.00% | 20.77 | 18.65% |
| 2024.12.31 | 1年以内 | 143.67 | 93.80% | 7.18 | 5.00% |
| | 1-2年 | 2.59 | 1.69% | 0.52 | 20.00% |
| | 2-3年 | - | - | - | 50.00% |
| | 3年以上 | 6.91 | 4.51% | 6.91 | 100.00% |
| | 合计 | 153.17 | 100.00% | 14.61 | 9.54% |
| 2023.12.31 | 1年以内 | 4.05 | 11.92% | 0.20 | 5.00% |
| | 1-2年 | 1.78 | 5.25% | 0.36 | 20.00% |
| | 2-3年 | 10.84 | 31.90% | 5.42 | 50.00% |
| | 3年以上 | 17.31 | 50.93% | 17.31 | 100.00% |
| | 合计 | 33.98 | 100.00% | 23.28 | 68.53% |

报告期各期末，公司长账龄其他应收款主要为房屋租赁的押金保证金。

（3）其他应收款前五名

报告期各期末，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占比 (%) | 坏账准备 |
|-------------|---|-------|-------|------|--------|-------|
| 2025年12月31日 | | | | | | |
| 1 | CASTLE PEAK INVESTMENTS NO.4 LIMITED (青山投资四号有限公司) | 押金保证金 | 39.24 | 1年以内 | 35.24 | 1.96 |
| 2 | アンゼンユソウカ(安全运输株式会社) | 押金保证金 | 32.25 | 1-2年 | 28.96 | 6.45 |
| 3 | 嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司 | 押金保证金 | 16.38 | 1-2年 | 14.71 | 3.28 |
| 4 | 沈晨 | 押金保证金 | 4.53 | 3年以上 | 4.06 | 4.53 |
| 5 | 叶内敏之 | 应收暂付款 | 4.48 | 1年以内 | 4.02 | 0.22 |
| 合计 | | | 96.88 | - | 86.99 | 16.44 |
| 2024年12月31日 | | | | | | |
| 1 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 应收暂付款 | 88.00 | 1年以内 | 57.46 | 4.40 |
| 2 | アンゼンユソウカ(安全运输株式 | 押金保证金 | 33.29 | 1年以内 | 21.73 | 1.66 |

| 序号 | 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占比 (%) | 坏账准备 |
|-------------|-----------------------|-------|--------|-----------|--------|-------|
| | 会社) | | | | | |
| 3 | 嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司 | 押金保证金 | 16.38 | 1年以内 | 10.70 | 0.82 |
| 4 | 沈晨 | 押金保证金 | 4.53 | 3年以上 | 2.95 | 4.53 |
| 5 | Regus Japan K.K. | 押金保证金 | 4.23 | 1-2年、3年以上 | 2.76 | 2.16 |
| 合计 | | | 146.43 | - | 95.60 | 13.57 |
| 2023年12月31日 | | | | | | |
| 1 | 嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司 | 押金保证金 | 22.88 | 2-3年、3年以上 | 67.34 | 17.46 |
| 2 | Regus Japan K.K. | 押金保证金 | 4.59 | 1年以内、1-2年 | 13.52 | 0.50 |
| 3 | 沈晨 | 押金保证金 | 4.53 | 3年以上 | 13.32 | 4.53 |
| 4 | 代扣代缴个人社保公积金 | 应收暂付款 | 0.85 | 1年以内 | 2.50 | 0.04 |
| 5 | 北京嘉海物业管理有限责任公司 | 押金保证金 | 0.74 | 3年以上 | 2.18 | 0.74 |
| 合计 | | | 33.59 | - | 98.85 | 23.26 |

截至报告期末，其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

6、存货

（1）存货构成及变动情况

报告期各期末，公司存货的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 账面价值 | 比例 | 账面价值 | 比例 | 账面价值 | 比例 |
| 原材料 | 2,466.63 | 53.42% | 2,106.72 | 46.32% | 1,562.28 | 34.23% |
| 在产品 | 391.61 | 8.48% | 371.38 | 8.17% | 493.67 | 10.82% |
| 库存商品 | 1,362.27 | 29.50% | 1,810.84 | 39.81% | 2,320.52 | 50.84% |
| 发出商品 | 254.69 | 5.52% | 148.80 | 3.27% | 140.19 | 3.07% |
| 委托加工物资 | 142.10 | 3.08% | 110.55 | 2.43% | 47.78 | 1.05% |
| 合计 | 4,617.29 | 100.00% | 4,548.29 | 100.00% | 4,564.43 | 100.00% |

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,564.43 万元、4,548.29 万元和 4,617.29 万元，占流动资产比例分别为 32.45%、13.79%和 13.06%。公司存货主要由库存商品、原材料、在产品构成，报告期各期末，上述三项存货金额合计占公

司存货账面价值的比例分别为 95.88%、94.30%和 91.41%。报告期各期末，公司存货账面价值基本保持稳定，具体分析如下：

1) 原材料

公司原材料主要为钯片钎铜棒材、磷青铜毛细金属管等。公司通常采用“以销定产、以产定购”的方式进行生产和采购，为了保证订单交期，公司会保有一定量的原材料。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司原材料分别为 1,562.28 万元、2,106.72 万元和 2,466.63 万元，占存货的比例分别为 34.23%、46.32%和 53.42%，呈上升趋势，主要系随着销售规模的扩大，公司增加了关键原材料的储备应对客户需求的增长。

2) 在产品

公司在产品主要为尚未完工的芯片测试探针零件等。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司在产品分别为 493.67 万元、371.38 万元和 391.61 万元，占存货的比例分别为 10.82%、8.17%和 8.48%，占比较为稳定。

3) 库存商品

报告期各期末，公司库存商品分别为 2,320.52 万元、1,810.84 万元和 1,362.27 万元，呈下降趋势，主要系一方面随着半导体行业的复苏，客户订单有所恢复，消耗了前期所备的部分库存；另一方面前期未消耗的部分库存由于库龄较长计提跌价导致账面价值有所减少。

4) 发出商品

发出商品主要为寄存在客户自有仓库的产品，通常需要维持一定的安全库存水平，并根据客户的领用消耗情况及时补充库存。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司发出商品分别为 140.19 万元、148.80 万元和 254.69 万元，占存货的比例分别为 3.07%、3.27%和 5.52%，占比较低。

5) 委托加工物资

公司将部分产品生产过程中所需的电镀工序委托给专业外协电镀厂商，以实现专业分工及公司成本的最优化而产生。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司委托加工物资分别为 47.78 万元、110.55 万元和 142.10 万元，占存货的比例分

别为 1.05%、2.43%和 3.08%，占比较低。

（2）存货跌价准备计提情况

1) 2025 年度

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 139.70 | 62.43 | - | 7.80 | - | 194.34 |
| 在产品 | 86.98 | 19.34 | - | 54.68 | - | 51.64 |
| 库存商品 | 953.25 | 333.30 | - | 198.13 | - | 1,088.42 |
| 发出商品 | 2.24 | 0.66 | - | 2.24 | - | 0.66 |
| 委托加工物资 | 8.64 | 4.56 | - | 8.64 | - | 4.56 |
| 合计 | 1,190.82 | 420.29 | - | 271.49 | - | 1,339.63 |

2) 2024 年度

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 132.10 | 36.72 | - | 29.12 | - | 139.70 |
| 在产品 | 150.77 | 78.07 | - | 141.85 | - | 86.98 |
| 库存商品 | 807.58 | 337.66 | - | 191.99 | - | 953.25 |
| 发出商品 | 3.47 | 2.24 | - | 3.47 | - | 2.24 |
| 委托加工物资 | 8.13 | 8.64 | - | 8.13 | - | 8.64 |
| 合计 | 1,102.04 | 463.34 | - | 374.56 | - | 1,190.82 |

3) 2023 年度

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 85.17 | 71.60 | - | 24.67 | - | 132.10 |
| 在产品 | 49.65 | 123.06 | - | 21.95 | - | 150.77 |
| 库存商品 | 189.58 | 627.62 | - | 9.62 | - | 807.58 |
| 发出商品 | 2.20 | 1.92 | - | 0.65 | - | 3.47 |
| 委托加工物资 | - | 8.13 | - | - | - | 8.13 |
| 合计 | 326.60 | 832.33 | - | 56.88 | - | 1,102.04 |

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，报告期末按照存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为1,102.04万元、1,190.82万元和1,339.63万元，占存货余额的比例分别为19.45%、20.75%和22.49%。报告期内，公司存货跌价准备计提比例较高，主要系报告期初公司战略备货较多，叠加半导体行业发展及技术迭代较快、周期性波动的特点，导致半导体行业下行周期中库存水平较高，周转较慢，且为应对部分原材料采购周期较长，公司适当加大原材料备货所致。总体来看，公司存货跌价准备计提充分、合理。

7、一年内到期的非流动资产

2023年末、2024年末和2025年末，公司一年内到期的非流动资产分别为162.28万元、0万元和0万元，占各期末流动资产比例分别为1.15%、0.00%和0.00%，主要系设备融资租赁业务中支付的保证金。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|--------|------------|------------|------------|
| 待抵扣增值税 | 129.04 | 204.56 | 430.06 |
| 待摊费用 | 28.31 | 5.00 | 10.87 |
| 预缴所得税 | - | - | 30.12 |
| 预缴都民税 | - | - | 6.04 |
| 合计 | 157.35 | 209.56 | 477.09 |

报告期各期末，公司的其他流动资产余额分别为477.09万元、209.56万元和157.35万元，占流动资产的比例分别为3.39%、0.64%和0.45%。公司的其他流动资产主要系待抵扣增值税进项税、预缴所得税及待摊费用。

（二）非流动资产构成分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 长期股权投资 | 655.92 | 1.84% | 536.39 | 1.60% | 482.40 | 1.57% |
| 固定资产 | 32,399.56 | 90.83% | 31,281.46 | 93.40% | 18,215.05 | 59.25% |
| 在建工程 | 144.86 | 0.41% | 184.54 | 0.55% | 9,796.70 | 31.87% |
| 使用权资产 | 386.41 | 1.08% | 173.03 | 0.52% | 1,443.12 | 4.69% |
| 无形资产 | 441.02 | 1.24% | 413.73 | 1.24% | 430.33 | 1.40% |
| 长期待摊费用 | 392.41 | 1.10% | 236.81 | 0.71% | 47.23 | 0.15% |
| 递延所得税资产 | 572.67 | 1.61% | 462.02 | 1.38% | 144.88 | 0.47% |
| 其他非流动资产 | 676.61 | 1.90% | 202.62 | 0.60% | 180.67 | 0.59% |
| 合计 | 35,669.45 | 100.00% | 33,490.59 | 100.00% | 30,740.39 | 100.00% |

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和使用权资产构成，报告期各期末，上述三项资产占非流动资产的比例分别为 95.82%、94.47%和 92.32%。

1、长期股权投资

2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司长期股权投资分别为 482.40 万元、536.39 万元和 655.92 万元，占各期末非流动资产比例分别为 1.57%、1.60%和 1.84%，系对公司参股的联营企业麦克凯利的投资。

2、固定资产

（1）固定资产构成情况与变动原因

报告期各期末，公司固定资产明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、固定资产原值 | | | |
| 房屋及建筑物 | 12,822.23 | 12,792.44 | - |
| 通用设备 | 460.66 | 423.67 | 214.44 |
| 专用设备 | 29,897.98 | 25,707.66 | 22,659.83 |
| 运输工具 | 512.08 | 402.19 | 303.06 |
| 合计 | 43,692.95 | 39,325.96 | 23,177.33 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 房屋及建筑物 | 821.26 | 317.99 | - |

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、固定资产原值 | | | |
| 通用设备 | 180.44 | 113.33 | 111.68 |
| 专用设备 | 9,991.71 | 7,404.70 | 4,719.81 |
| 运输工具 | 299.98 | 208.48 | 130.80 |
| 合计 | 11,293.38 | 8,044.50 | 4,962.28 |
| 三、固定资产减值准备 | | | |
| 房屋及建筑物 | - | - | - |
| 通用设备 | - | - | - |
| 专用设备 | - | - | - |
| 运输工具 | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值 | | | |
| 房屋及建筑物 | 12,000.98 | 12,474.44 | - |
| 通用设备 | 280.22 | 310.34 | 102.76 |
| 专用设备 | 19,906.26 | 18,302.96 | 17,940.02 |
| 运输工具 | 212.10 | 193.71 | 172.27 |
| 合计 | 32,399.56 | 31,281.46 | 18,215.05 |

报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为 18,215.05 万元、31,281.46 万元和 32,399.56 万元，占非流动资产的比例分别为 59.25%、93.40%和 90.83%。报告期内，公司固定资产账面价值呈上升趋势，主要系随着公司业务规模的扩大，公司新建了厂房，增加了数控车床等专用设备的采购，以扩大公司产能。

作为制造型企业，公司固定资产主要为与生产经营密切相关的专用设备。截至本招股说明书签署日，公司固定资产管理及运行状况良好，不存在减值迹象。

（2）固定资产折旧年限与同行业可比公司比较情况

报告期内，公司固定资产折旧方法、折旧年限及残值率与可比公司对比如下：

| 公司 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 |
|--------|--------|-------|---------|-----|
| Leeno | 建筑物 | 年限平均法 | 40 | - |
| | 机器设备 | 年限平均法 | 8 | - |
| | 其他设备 | 年限平均法 | 5 | - |
| WinWay | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 2-50 | - |

| 公司 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 |
|------|----------|-------|---------|-----|
| | 机器设备 | 年限平均法 | 1-10 | - |
| | 其他设备 | 年限平均法 | 2-15 | - |
| 和林微纳 | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% |
| | 机器机械设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% |
| | 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% |
| | 器具、工具、家具 | 年限平均法 | 5-10 | 5% |
| | 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% |
| 本公司 | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 5% |
| | 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% |
| | 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% |
| | 运输工具 | 年限平均法 | 4-6 | 5% |

数据来源：可比上市公司年度报告或招股说明书

由上表可知，公司的固定资产折旧政策与可比公司相比不存在重大差异。

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 新厂区基建项目 | - | - | 9,283.85 |
| 半导体芯片测试探针零件制造项目（生产线） | 112.79 | 10.77 | 512.85 |
| 零星工程 | 32.07 | 173.77 | - |
| 合计 | 144.86 | 184.54 | 9,796.70 |

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 9,796.70 万元、184.54 万元和 144.86 万元，占非流动资产比例分别为 31.87%、0.55%和 0.41%。2024 年末公司在建工程较上期末减少较多，主要系公司新厂区基建项目完工转固所致。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产分别为 1,443.12 万元、173.03 万元和 386.41 万元，占非流动资产比例分别为 4.69%、0.52%和 1.08%，为公司融资租赁的机器设备及租赁房屋。2024 年末使用权资产较上年末减少较多，主要系公司当期以自有资金清偿了全部融资租赁生产设备的剩余应付租金，相关资产从使用权资产转入固定资产所致。

单位：万元

| 2025.12.31 | | | | |
|------------|-----------------|---------------|------|-----------------|
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 |
| 专用设备 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 707.59 | 321.18 | - | 386.41 |
| 合计 | 707.59 | 321.18 | - | 386.41 |
| 2024.12.31 | | | | |
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 |
| 专用设备 | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | 332.97 | 159.94 | - | 173.03 |
| 合计 | 332.97 | 159.94 | - | 173.03 |
| 2023.12.31 | | | | |
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 |
| 专用设备 | 1,715.29 | 415.73 | - | 1,299.56 |
| 房屋及建筑物 | 557.31 | 413.75 | - | 143.56 |
| 合计 | 2,272.61 | 829.48 | - | 1,443.12 |

5、无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况及账面价值如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、无形资产原值 | | | |
| 土地使用权 | 386.47 | 386.47 | 386.47 |
| 软件 | 154.94 | 100.28 | 90.05 |
| 合计 | 541.41 | 486.75 | 476.52 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 土地使用权 | 30.27 | 22.54 | 14.81 |
| 软件 | 70.12 | 50.48 | 31.38 |
| 合计 | 100.39 | 73.03 | 46.20 |
| 三、无形资产减值准备 | | | |
| 土地使用权 | - | - | - |
| 软件 | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
| 四、无形资产账面价值 | | | |

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------|------------|------------|------------|
| 土地使用权 | 356.20 | 363.93 | 371.66 |
| 软件 | 84.82 | 49.80 | 58.67 |
| 合计 | 441.02 | 413.73 | 430.33 |

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 430.33 万元、413.73 万元和 441.02 万元，占非流动资产比例分别为 1.40%、1.24%和 1.24%。

截至本招股说明书签署日，公司无形资产不存在减值迹象，不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

6、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|------------|------------|------------|------------|
| 香港工厂装修工程 | 166.65 | - | - |
| 新厂房装修绿化工程 | 123.13 | 160.69 | - |
| 横滨研发中心装修工程 | 37.59 | 38.78 | - |
| 咨询费 | 61.44 | 34.33 | 47.23 |
| 其他 | 3.60 | 3.00 | - |
| 合计 | 392.41 | 236.81 | 47.23 |

报告期各期末，公司长期待摊费用的账面余额分别为 47.23 万元、236.81 万元和 392.41 万元，占非流动资产的比例分别为 0.15%、0.71%和 1.10%，占比较小，公司长期待摊费用主要为公司厂房装修绿化工程及咨询费的摊销余额。

7、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

报告期各期末，公司的递延所得税资产概况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 递延收益 | 3,114.27 | 467.14 | 2,933.56 | 440.03 | 889.18 | 133.38 |
| 资产减值准备 | 1,945.24 | 285.03 | 1,682.92 | 244.22 | 1,437.18 | 206.56 |
| 内部交易未实现 | 287.83 | 43.18 | 329.15 | 49.37 | 345.50 | 51.82 |

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 利润 | | | | | | |
| 可弥补亏损额 | 802.11 | 126.85 | 6.32 | 1.47 | 307.24 | 39.24 |
| 公允价值变动损益 | - | - | 11.13 | 1.67 | - | - |
| 经营租赁相关租赁负债 | 128.23 | 20.08 | 164.85 | 34.41 | 115.77 | 12.56 |
| 销售折扣暂时性差异 | 107.15 | 16.07 | - | - | - | - |
| 进项加计抵减 | - | - | - | - | 156.34 | 23.45 |
| 合计 | 6,384.85 | 958.35 | 5,127.92 | 771.17 | 3,251.22 | 467.02 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧税会折旧差异 | 2,355.74 | 364.60 | 1,821.22 | 273.18 | 2,035.97 | 305.40 |
| 经营租赁相关使用权资产 | 136.70 | 21.09 | 173.03 | 35.97 | 143.56 | 16.74 |
| 合计 | 2,492.44 | 385.69 | 1,994.25 | 309.15 | 2,179.53 | 322.13 |

（3）经抵销的递延所得税资产

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 385.69 | 572.67 | 309.15 | 462.02 | 322.13 | 144.88 |
| 递延所得税负债 | 385.69 | - | 309.15 | - | 322.13 | - |

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 144.88 万元、462.02 万元和 572.67 万元，占非流动资产比例分别为 0.47%、1.38%和 1.61%，主要系递延收益及资产减值准备确认的递延所得税资产。

8、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------|------------|------------|------------|
| 预付设备款 | 676.61 | 166.01 | 180.67 |
| 预付软件费 | - | 36.61 | - |
| 合计 | 676.61 | 202.62 | 180.67 |

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 180.67 万元、202.62 万元和 676.61 万元，占非流动资产比例分别为 0.59%、0.60%和 1.90%，主要系公司尚未到货的预付设备款。

（三）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力主要财务指标如下：

| 主要财务指标 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 3.73 | 3.37 | 2.60 |
| 存货周转率（次） | 2.79 | 2.05 | 1.36 |

注：应收账款周转率（次）=营业收入÷平均应收账款余额；存货周转率（次）=营业成本÷平均存货余额

1、应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司的对比情况如下：

| 公司名称 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| Leeno | 7.15 | 6.86 | 7.37 |
| WinWay | 3.94 | 4.29 | 2.97 |
| 和林微纳 | 4.15 | 3.53 | 3.15 |
| 平均值 | 5.08 | 4.89 | 4.50 |
| 本公司 | 3.73 | 3.37 | 2.60 |

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.60 次、3.37 次和 3.73 次，低于同行业可比公司的平均值，主要系可比公司 Leeno 的应收账款周转率较高，与可比公司 WinWay、和林微纳相对接近。报告期内，公司加强内部应收账款管理，公司应收账款周转率呈上升趋势。报告期各期末，公司应收账款账龄主要集中在 1 年内，发生坏账的风险较小。

2、存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司的比较情况如下：

| 公司名称 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| Leeno | 12.51 | 10.29 | 9.30 |
| WinWay | 5.38 | 4.89 | 3.44 |
| 和林微纳 | 5.72 | 4.65 | 2.90 |
| 平均值 | 7.87 | 6.61 | 5.21 |
| 本公司 | 2.79 | 2.05 | 1.36 |

报告期内，公司存货周转率分别为 1.36 次、2.05 次和 2.79 次，低于同行业可比公司平均水平。公司存货周转率整体偏低主要系一方面公司业务处于快速发展期，为保障对客户订单的及时交付能力，公司对关键原材料和产成品进行适当备货；核心原材料如铍铜棒材和磷青铜毛细金属管部分依赖进口，采购交期较长，需要提前采购并保有安全余量；贵金属钽的市场价格波动较大，公司通常在价格相对低位进行集中采购并建立安全库存，以控制成本；另一方面公司钽合金芯片测试探针零件需要经历从钽片到钽合金棒材，再加工成成品零件的多道工序，且铍铜等芯片测试探针零件需要委外电镀，整体生产周期相较于探针及测试插座的周期更长，存货周转较慢。

十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债情况分析

1、负债结构及变化趋势

报告期各期末，公司负债总额分别为 23,917.13 万元、30,532.45 万元和 29,390.36 万元。公司负债结构如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|-------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动负债 | 9,522.27 | 32.40% | 10,345.82 | 33.88% | 9,010.78 | 37.68% |
| 非流动负债 | 19,868.09 | 67.60% | 20,186.63 | 66.12% | 14,906.35 | 62.32% |
| 负债合计 | 29,390.36 | 100.00% | 30,532.45 | 100.00% | 23,917.13 | 100.00% |

报告期各期末，公司负债以非流动负债为主。其中，流动负债占负债总额的比例分别为 37.68%、33.88%和 32.40%，非流动负债占负债总额的比例分别为 62.32%、66.12%和 67.60%。

2、流动负债变化分析

报告期各期末，公司流动负债金额分别为 9,010.78 万元、10,345.82 万元和 9,522.27 万元。流动负债构成情况具体如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 4,314.65 | 45.31% | 6,232.20 | 60.24% | 5,619.83 | 62.37% |
| 应付账款 | 2,747.08 | 28.85% | 2,239.27 | 21.64% | 1,993.10 | 22.12% |
| 合同负债 | 31.47 | 0.33% | 4.92 | 0.05% | 1.08 | 0.01% |
| 应付职工薪酬 | 697.97 | 7.33% | 685.75 | 6.63% | 571.60 | 6.34% |
| 应交税费 | 904.24 | 9.50% | 428.73 | 4.14% | 15.22 | 0.17% |
| 其他应付款 | 11.94 | 0.13% | 11.52 | 0.11% | 5.70 | 0.06% |
| 一年内到期的非流动负债 | 810.82 | 8.51% | 743.01 | 7.18% | 804.10 | 8.92% |
| 其他流动负债 | 4.09 | 0.04% | 0.42 | 0.00% | 0.14 | 0.00% |
| 流动负债合计 | 9,522.27 | 100.00% | 10,345.82 | 100.00% | 9,010.78 | 100.00% |

公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和一年内到期的非流动负债等构成，具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 保证借款 | 2,006.55 | 5,731.79 | 5,619.83 |
| 信用借款 | 2,308.10 | 500.41 | - |
| 合计 | 4,314.65 | 6,232.20 | 5,619.83 |

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 5,619.83 万元、6,232.20 万元和 4,314.65 万元。2023 年以来公司更多地采用长期借款方式筹集日常经营所需资金，报告期内短期借款总体减少。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 材料款 | 1,912.71 | 1,358.28 | 696.90 |
| 设备工程款 | 793.34 | 859.15 | 1,281.21 |
| 费用款 | 41.04 | 21.84 | 14.99 |
| 合计 | 2,747.08 | 2,239.27 | 1,993.10 |

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 1,993.10 万元、2,239.27 万元和 2,747.08 万元，占各期末流动负债的比例分别为 22.12%、21.64%和 28.85%。公司应付账款主要为应付材料货款，随着公司经营规模扩大，原材料采购需求增加，应付账款总体呈增长趋势。

此外，报告期内，公司应付设备工程款主要系新厂房建设以及增加生产设备投资所致。报告期各期末，公司应付设备工程款分别为 1,281.21 万元、859.15 万元和 793.34 万元。

报告期内，公司应付账款账龄情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 1 年以内 | 2,746.95 | 99.99% | 2,239.26 | 100.00% | 1,993.10 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 0.13 | 0.00% | 0.01 | 0.00% | - | - |
| 2 至 3 年 | 0.01 | 0.00% | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,747.08 | 100.00% | 2,239.27 | 100.00% | 1,993.10 | 100.00% |

如上表所示，报告期各期末，应付账款余额基本均为账龄在 1 年以内的应付账款，账龄情况良好，公司能够及时付款，不存在大额应付账款长期拖欠的情形。

报告期各期末，公司应付账款前五名供应商情况如下：

单位：万元

| 时间 | 供应商名称 | 与公司关系 | 款项性质 | 应付账款金额 | 占期末应付账款比例 |
|------------|------------------|-------|------|----------|-----------|
| 2025.12.31 | 上海广弘实业有限公司 | 非关联方 | 加工费 | 1,203.48 | 43.81% |
| | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 625.39 | 22.77% |
| | 上海银木电器制造有限公司 | 非关联方 | 加工费 | 182.12 | 6.63% |
| | 励福（江门）环保科技股份有限公司 | 非关联方 | 货款 | 76.64 | 2.79% |

| 时间 | 供应商名称 | 与公司关系 | 款项性质 | 应付账款金额 | 占期末应付账款比例 |
|------------|-----------------|-------|------|-----------------|---------------|
| | 优耐特高精（上海）机床有限公司 | 非关联方 | 设备款 | 76.63 | 2.79% |
| | 合计 | | | 2,164.25 | 78.78% |
| 2024.12.31 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 690.27 | 30.83% |
| | 上海广弘实业有限公司 | 非关联方 | 加工费 | 447.07 | 19.96% |
| | 上海弋力机械科技有限公司 | 非关联方 | 货款 | 308.06 | 13.76% |
| | 上海银木电器制造有限公司 | 非关联方 | 加工费 | 134.60 | 6.01% |
| | 成都麦克凯利科技有限公司 | 非关联方 | 货款 | 80.51 | 3.60% |
| | 合计 | | | 1,660.51 | 74.15% |
| 2023.12.31 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 799.47 | 40.11% |
| | 嘉兴嘉建建设有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 448.93 | 22.52% |
| | 上海广弘实业有限公司 | 非关联方 | 加工费 | 147.58 | 7.40% |
| | 上海弋力机械科技有限公司 | 非关联方 | 货款 | 131.93 | 6.62% |
| | 北京福瑞长兴电子有限公司 | 非关联方 | 货款 | 117.67 | 5.90% |
| | 合计 | | | 1,645.58 | 82.56% |

（3）合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为 1.08 万元、4.92 万元和 31.47 万元，占公司流动负债的比例分别为 0.01%、0.05%和 0.33%，均为预收货款。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分类别列示如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬 | 660.03 | 659.86 | 540.30 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 37.95 | 25.89 | 31.30 |
| 合计 | 697.97 | 685.75 | 571.60 |

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 571.60 万元、685.75 万元和 697.97 万元，占公司流动负债的比例分别为 6.34%、6.63%和 7.33%。公司应付职工薪酬主要由短期薪酬构成，其变动与公司职工人数、薪酬标准及激励制度相关。报告期各期末，公司应付职工薪酬整体呈增长趋势，主要系公司经营规模扩大使得员工人数有所增长。

(5) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 企业所得税 | 386.59 | 241.73 | 0.44 |
| 增值税 | 361.51 | 78.79 | - |
| 房产税 | 109.65 | 82.22 | - |
| 法人居民税（日本） | 11.39 | 9.40 | - |
| 城市维护建设税 | 10.70 | - | - |
| 土地使用税 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |
| 教育费附加 | 4.49 | - | - |
| 印花税 | 3.36 | 5.25 | 3.11 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3.13 | 0.93 | 1.25 |
| 地方教育附加 | 2.99 | - | - |
| 合计 | 904.24 | 428.73 | 15.22 |

报告期各期末，应交税费期末余额分别为 15.22 万元、428.73 万元和 904.24 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.17%、4.14%和 9.50%。公司应交税费主要由企业所得税、增值税、房产税等构成。

(6) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款按性质分类如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 应付暂收款 | 11.94 | 11.52 | 5.70 |
| 合计 | 11.94 | 11.52 | 5.70 |

报告期各期末，其他应付款期末余额分别为 5.70 万元、11.52 万元和 11.94 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.06%、0.11%和 0.13%。

(7) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|------------|------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | 613.58 | 617.08 | 214.72 |

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 9.18 | 38.61 | 55.98 |
| 一年内到期的租赁负债 | 188.06 | 87.32 | 533.40 |
| 合计 | 810.82 | 743.01 | 804.10 |

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 804.10 万元、743.01 万元和 810.82 万元，占各期末流动负债的比例分别为 8.92%、7.18%和 8.51%，由一年内到期的长期借款、长期应付款以及租赁负债构成。报告期内，一年内到期的非流动负债总体保持稳定。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 待转销项税额 | 4.09 | 0.42 | 0.14 |
| 合计 | 4.09 | 0.42 | 0.14 |

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 0.14 万元、0.42 万元和 4.09 万元，主要系待转销项税额，金额较小。

3、非流动负债分析

报告期各期末，公司的非流动负债构成情况具体如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 长期借款 | 16,549.69 | 83.30% | 17,149.69 | 84.96% | 13,929.69 | 93.45% |
| 租赁负债 | 187.45 | 0.94% | 77.53 | 0.38% | 55.40 | 0.37% |
| 长期应付款 | 16.68 | 0.08% | 25.86 | 0.13% | 32.08 | 0.22% |
| 递延收益 | 3,114.27 | 15.67% | 2,933.56 | 14.53% | 889.18 | 5.97% |
| 非流动负债合计 | 19,868.09 | 100.00% | 20,186.63 | 100.00% | 14,906.35 | 100.00% |

公司非流动负债主要由长期借款、递延收益、租赁负债及长期应付款负债构成，具体分析如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|---------|------------|------------|------------|
| 抵押及保证借款 | 16,549.69 | 17,149.69 | 13,929.69 |
| 合计 | 16,549.69 | 17,149.69 | 13,929.69 |

报告期各期末，公司长期借款分别为 13,929.69 万元、17,149.69 万元和 16,549.69 万元，是非流动负债的主要构成部分。随着公司经营投入的不断扩大，报告期各期末公司长期借款余额大幅增加。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债分别为 55.40 万元、77.53 万元和 187.45 万元，主要系融资租赁设备及租赁房屋等形成。

（3）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款余额分别为 32.08 万元、25.86 万元和 16.68 万元，主要系分期购置的固定资产款项。报告期内，公司不存在逾期未偿还的长期应付款。

（4）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 889.18 万元、2,933.56 万元和 3,114.27 万元，主要系公司收到的与资产相关的政府补助。

（二）偿债能力分析

报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率、息税折旧摊销前利润、利息保障倍数等主要偿债能力指标如下表所示：

| 指标 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍） | 3.71 | 3.19 | 1.56 |
| 速动比率（倍） | 3.20 | 2.71 | 0.98 |
| 资产负债率（合并，%） | 41.38 | 45.94 | 53.38 |
| 资产负债率（母公司，%） | 40.30 | 45.70 | 53.31 |
| 指标 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |

| | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 10,914.87 | 4,213.97 | 1,500.02 |
| 利息保障倍数 | 11.09 | 1.68 | -0.65 |

具体计算公式如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产-一年内到期的非流动资产）÷流动负债

资产负债率=负债总额÷资产总额

息税折旧摊销前利润=利润总额+（利息支出-利息收入）+固定资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

1、短期偿债能力分析

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.56、3.19 和 3.71，速动比率分别为 0.98、2.71 和 3.20。报告期内随着盈利能力不断增强，公司流动比率和速动比率不断提高，偿债能力亦不断加强。总体而言，公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力，公司的流动性风险较低。

报告期各期末，公司与同行业可比上市公司流动比率和速动比率情况对比如下：

| 公司名称 | 流动比率（倍） | | | 速动比率（倍） | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2025 年末 | 2024 年末 | 2023 年末 | 2025 年末 | 2024 年末 | 2023 年末 |
| Leeno | 9.72 | 14.68 | 16.11 | 9.40 | 14.19 | 15.43 |
| WinWay | 2.55 | 2.78 | 2.43 | 2.21 | 2.37 | 1.84 |
| 和林微纳 | 4.18 | 5.30 | 7.34 | 3.62 | 4.39 | 6.10 |
| 平均值 | 5.48 | 7.59 | 8.63 | 5.08 | 6.98 | 7.79 |
| 本公司 | 3.71 | 3.19 | 1.56 | 3.20 | 2.71 | 0.98 |

数据来源：同花顺、上市公司披露的定期报告。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均值，主要系公司目前仍处于快速发展阶段，报告期内增加较多的厂房、土地及设备投资所致。

2、资产负债率分析

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 53.38%、45.94%和 41.38%，资产负债率（母公司）分别为 53.31%、45.70%和 40.30%。报告期内，公司业务规模不断扩大，盈利能力不断提升，资产负债率指标亦不断改善。

报告期各期末，公司与同行业可比上市公司资产负债率（合并）情况如下表

所示：

| 公司名称 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|--------|------------|------------|------------|
| Leeno | 7.67% | 5.30% | 4.43% |
| WinWay | 28.74% | 26.91% | 28.43% |
| 和林微纳 | 16.80% | 14.15% | 11.16% |
| 平均值 | 17.74% | 15.45% | 14.67% |
| 本公司 | 41.38% | 45.94% | 53.38% |

数据来源：Wind、上市公司披露的定期报告或招股说明书。

由上表所示，报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 53.38%、45.94% 和 41.38%，呈下降趋势。报告期内，公司资产负债率整体高于同行业可比上市公司平均水平的原因在于公司仍处于发展阶段，存在较多的厂房、土地及设备资本支出，虽报告期内存在一定的股权融资，但仍主要依靠债务融资所致。随着公司盈利能力的持续提升以及公司成功 IPO 完成股权融资，公司资产负债率预计将持续改善。

3、息税折旧摊销前利润

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 1,500.02 万元、4,213.97 万元和 10,914.87 万元。报告期内，随着公司盈利能力的不断提高，息税折旧摊销前利润逐年增长。

4、偿债能力的其他因素分析

公司银行资信状况良好，无任何不良记录，且没有或有负债、表外融资等影响偿债能力的事项。

综上，公司秉持稳健的财务政策，负债规模与资产规模相适应，偿债能力较强。本次发行后，将更有助于公司改善财务结构，扩大经营规模，进一步降低财务风险和经营风险。

（三）股利分配情况

报告期内，公司进行了一次股利分配，具体情况如下：

公司于 2023 年 1 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议和 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利润分配相关事宜的议

案》，同意向全体股东派发现金红利 2,000 万元。该次现金分红已于 2023 年 2 月全部支付完毕。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,510.21 | 4,712.14 | 3,248.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,504.18 | -11,041.46 | -12,923.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,452.93 | 17,450.97 | 6,195.63 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.81 | -30.82 | 11.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,350.30 | 11,090.84 | -3,467.52 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19,404.36 | 17,054.06 | 5,963.22 |

1、经营活动产生的现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量基本情况

报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,780.11 | 14,415.15 | 10,717.81 |
| 收到的税费返还 | 287.06 | 716.89 | 1,895.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,449.10 | 3,014.07 | 1,216.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,516.27 | 18,146.10 | 13,830.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,852.30 | 7,558.50 | 5,865.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,020.59 | 4,671.15 | 3,929.27 |
| 支付的各项税费 | 1,989.35 | 251.68 | 330.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,143.83 | 952.64 | 457.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,006.07 | 13,433.96 | 10,582.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,510.21 | 4,712.14 | 3,248.23 |

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,248.23 万元、4,712.14 万元和 9,510.21 万元。报告期内，公司经营情况良好，经营活动产生的现金流量净额呈上升趋势。

（2）净利润与经营活动产生的现金流量净额对比情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额具体形成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 净利润（A） | 5,868.82 | 524.12 | -475.75 |
| 加：资产减值准备 | 420.29 | 463.34 | 832.33 |
| 信用减值准备 | 119.90 | 147.34 | 151.17 |
| 固定资产折旧、使用权资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,423.69 | 2,944.07 | 1,870.25 |
| 无形资产摊销 | 27.43 | 24.93 | 15.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 72.95 | 37.73 | 30.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | 18.58 | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.04 | - | 2.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | 11.13 | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 748.50 | 752.87 | 404.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -230.67 | -45.84 | -1.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -110.65 | -317.14 | -142.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - | -100.80 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -490.73 | -462.14 | -1,638.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,077.72 | -3,151.31 | 927.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,738.34 | 3,764.30 | 1,370.72 |
| 其他 | - | 0.15 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额（B） | 9,510.21 | 4,712.14 | 3,248.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额（B-A） | 3,641.39 | 4,188.02 | 3,723.98 |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异的变动主要受折旧摊销、客户与供应商的收付款周期以及存货对资金的占用情况等因素的影响。

（3）营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金对比情况

报告期内，公司营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金的对比情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,780.11 | 14,415.15 | 10,717.81 |

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入 | 27,628.15 | 15,815.29 | 9,125.36 |
| 现金收入比 | 1.04 | 0.91 | 1.17 |

如上表所示，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为 1.17、0.91 和 1.04，销售回款情况良好。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司各期投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 31,300.00 | 1,500.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 112.56 | 6.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,412.56 | 1,513.65 | 10.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,616.74 | 6,055.11 | 12,933.67 |
| 投资支付的现金 | 29,300.00 | 6,500.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 34,916.74 | 12,555.11 | 12,933.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,504.18 | -11,041.46 | -12,923.10 |

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,923.10 万元、-11,041.46 万元和-3,504.18 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系一方面公司正处于快速发展时期，为了适应不断扩张的业务规模，公司购置设备、土地及建造厂房所形成的投资活动现金支出；另一方面，为提升资金使用效益，公司利用闲置资金购买结构性存款所形成的投资活动现金支出。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司各期筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------|---------|-----------|---------|
| 吸收投资收到的现金 | - | 14,566.67 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 11,049.96 | 15,869.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 25,616.63 | 15,869.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,826.96 | 6,817.89 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 702.10 | 830.68 | 2,492.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.87 | 517.09 | 1,681.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,752.93 | 8,165.66 | 9,673.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,452.93 | 17,450.97 | 6,195.63 |

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 6,195.63 万元、17,450.97 万元和-3,452.93 万元。公司筹资活动现金流入主要为银行借款及股权融资款，筹资活动现金流出主要为偿还借款及分配股利或偿付利息支出。

（五）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求

未来可预见的重大资本性支出主要为公司本次募集资金项目，募集资金投向详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

除此之外，发行人无可预见的重大资本性支出计划。

公司重大资本性支出主要围绕主营业务进行，扩大公司的规模，符合公司战略发展方向，能够强有力地促进公司主营业务的发展和经营业绩的提高，不存在跨行业投资的情况。

（六）流动性风险分析

报告期内，公司的流动性相关指标如下：

| 项目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 资产负债率（合并） | 41.38% | 45.94% | 53.38% |
| 流动比率（倍） | 3.71 | 3.19 | 1.56 |
| 速动比率（倍） | 3.20 | 2.71 | 0.98 |

总体来看，公司资产负债率较低，流动比率和速动比率维持在较为合理的水平，货币资金较为充裕，偿债能力较强。因此，公司流动性风险总体较低，不存在已经或可能产生的流动性重大变化或风险趋势。

（七）持续经营能力风险分析

1、公司在持续经营方面面临的主要风险因素

公司在持续经营方面面临的主要风险因素包括客户集中度高的风险、原材料价格波动风险、汇率波动的风险等，具体详见本招股说明书“第三节 风险因素”。

2、管理层对公司持续经营能力的自我评判

半导体及医疗等高科技领域一直是国家大力支持的行业。公司未来将继续致力于微细精密零件的研发、生产和销售，依托在芯片测试探针零件领域形成的先进技术工艺、研发实力和行业地位，逐步探索微细精密零件产品在下游医疗等领域的横向拓展，努力发展成为全球领先的微细精密零件供应商。

未来几年，公司将充分依托国家对半导体芯片行业、先进制造业的政策支持，凭借现有的研发、客户、品牌、市场等优势，紧紧围绕公司战略规划，继续做大做强，实现新增年产 4.30 亿件半导体芯片检测用探针零件扩产项目及年产 550.00 万件医疗器械精密零件制造基地建设项目的落地。同时，公司将持续加大研发投入，保持产品品质和市场优势地位，紧跟行业技术前沿，进一步提高公司产品的市场占有率。

基于公司所处行业发展趋势与公司未来经营计划，公司管理层认为，公司所处的芯片测试探针零件行业具有良好的发展前景，下游行业需求旺盛且具有较强的增长潜力。公司行业地位居前，具有技术、品牌等优势。报告期内，公司经营成果稳定增长，财务状况良好，在可预见的未来，公司具有持续经营能力。

十二、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项¹

（一）重大投资事项

报告期内，公司不存在重大对外投资事项。

（二）资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额分别为 12,933.67 万元、6,055.11 万元和 5,616.74 万元，主要是公司为满足业务扩展

¹重大的标准与《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》中的标准一致。

需求,新建厂房及购置生产设备所发生的资本性支出。具体情况详见本节之“(四)现金流量分析”之“2、投资活动产生的现金流量分析”。

(三) 重大资产业务重组情况

报告期内,公司未发生重大资产业务重组事项。

(四) 重大股权收购合并事项

报告期内,公司未发生重大股权收购合并事项。

十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

1、成立子公司

为拓展医疗器械业务领域,公司于2026年1月21日出资设立全资子公司浙江金连接医疗器械有限公司,注册资本为人民币5,000万元,于2026年1月21日在嘉兴市市场监督管理局经济技术开发区分局登记注册,取得统一社会信用代码为91330401MAK5P4F6X1的营业执照。

2、2026年2月,股东股份转让

2026年1月29日,惟明投资与远宁之鑫、杭州科祥、远宁合丰、夏卫芳、陈伟、闵诗阳、原永丹签订《股份转让协议》,约定将其持有公司1,028,572股股份以每股61.0562元的价格转让给上述7名受让人,其中远宁之鑫受让378,839股、杭州科祥受让169,431股、远宁合丰受让169,431股、夏卫芳受让169,431股、陈伟受让84,716股、闵诗阳受让33,886股、原永丹受让22,838股。

2026年1月29日,海南嘉旭与原永丹、陈莉莉签订《股份转让协议》,约定将其持有公司100,000股股份以每股61.0562元的价格转让给上述2名受让人,其中原永丹受让74,585股、陈莉莉受让25,415股。

2026年2月26日,发行人就前述股份转让事项变更股东名册。

3、2026年3月,对员工实施股权激励

2026年3月,曹镭与公司员工骆爱群签署《关于嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业(有限合伙)之合伙份额转让协议》,将其持有的奥斯贝申2.0417万元财产

份额转让给骆爱群，以实施股权激励。双方约定转让税费由骆爱群承担，但未对骆爱群的服务期进行限制。2026年4月30日，奥斯贝申完成上述财产份额转让的工商变更登记。

2026年3月，因实际控制人曹镭通过转让奥斯贝申财产份额的方式对骆爱群进行股权激励，公司一次性确认股份支付费用59.16万元。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的或有事项。

（三）重大担保、诉讼等事项

截至本招股说明书签署日，公司存在作为原告且已完结的诉讼，详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”。除此之外，公司不存在其他需要披露的重大担保、诉讼事项。

（四）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十四、盈利预测信息

报告期内，公司未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概述

（一）募集资金投资项目的的基本情况

经公司第二届董事会第五次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，公司拟公开发行不超过1,365.00万股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市，发行股份占发行后总股本的比例不低于25.00%，实际募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资金额 |
|----|------------------|------------|-------------|
| 1 | 半导体芯片检测用探针零件扩产项目 | 48,831.12 | 48,831.12 |
| 2 | 医疗器械精密零件制造基地建设项目 | 23,658.61 | 23,658.61 |
| 3 | 研发中心升级项目 | 5,135.00 | 5,135.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | | 102,624.73 | 102,624.73 |

本次发行上市募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后再予以置换。若公司本次发行实际募集资金净额多于上述项目资金需求总额，则多出部分将在履行法定程序后用于补充流动资金或其他与主营业务相关的项目资金需求。若本次实际募集资金不能满足募投项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。

（二）本次募集资金使用管理制度

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更与管理等内容进行了明确规定。公司将严格按照上述法规和制度使用和管理募集资金。

（三）募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目有助于公司提升产能、丰富产品结构并提高研发实力。

公司将通过“半导体芯片检测用探针零件扩产项目”巩固行业地位，扩大市场份额；通过“医疗器械精密零件制造基地建设项目”丰富公司产品结构和客户类型；通过“研发中心升级项目”增强公司研发实力，提高前沿技术积累；通过“补充流动资金项目”提高公司资金流动性及公司抗风险能力。本次募集资金投资项目将增强公司的综合竞争力，是推进公司未来发展规划及经营战略的重要举措。

（四）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

本次募集资金投资项目均围绕公司业务投向科技创新领域。

公司主要产品芯片测试探针零件的性能参数已全面对标甚至部分超越主要竞争对手产品，技术水平与市场地位居于国际前列。公司将通过“半导体芯片检测用探针零件扩产项目”继续巩固行业地位，扩大市场份额。该项目是公司未来几年主营业务实现高速发展的重要驱动因素。

公司产品亦积极向医疗器械领域拓展，公司将通过“医疗器械精密零件制造基地建设项目”加深与国内外知名医疗器械企业的合作，优化医疗器械精密零件的制造工艺，逐步扩大电生理领域的销售规模。

从事微细精密制造的企业需要通过技术的不断迭代来保持行业竞争力。公司通过“研发中心升级项目”提前布局测试探针零件、新材料、医疗器械精密零件等方面的前沿技术，将增加技术储备、增强创新能力，进一步巩固行业壁垒。

（五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）半导体芯片检测用探针零件扩产项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为浙江金连接和金连接医疗，建设期为 30 个月，本项目总投资 48,831.12 万元。本项目将利用公司现有部分厂房并新建约 10,500 平方米生产厂房，拟购置先进的生产、检测设备，并配备相关生产人员。项目建成达产后，将实现年产 4.3 亿件芯片测试探针零件的产能。具体投资明细情况如下表所示：

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算（万元） | 占投资比例 |
|-----|---------|-----------|---------|
| 1 | 工程建设费用 | 45,997.10 | 94.20% |
| 1.1 | 建筑工程费 | 3,990.00 | 8.17% |
| 1.2 | 设备购置及安装 | 42,007.10 | 86.03% |
| 2 | 预备费 | 1,379.91 | 2.83% |
| 3 | 铺底流动资金 | 1,454.10 | 2.98% |
| 合计 | | 48,831.12 | 100.00% |

2、项目实施选址及土地

本项目拟使用公司现有生产场地的厂房并在嘉兴市秀洲区华云路购置土地、新建厂房作为项目实施地点。

本项目用地尚未完全落实。其中，现有生产场地已取得《不动产权证书》（浙（2024）嘉开不动产权第 0008044 号）。拟新购置土地部分，发行人已与嘉兴市秀洲区人民政府嘉北街道办事处签署了《项目投资协议》并初步约定了用地事宜，根据有关法律规定取得该用地还需履行相应手续。

3、项目实施进度安排

本项目计划分阶段实施完成，包括场地建设及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证与试运行阶段，建设期为 30 个月。具体安排如下：

| 建设阶段 | 建设期（月） | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~21 | 22~24 | 25~27 | 28~30 |
| 初步设计 | | | | | | | | | | |
| 场地建设及装修 | | | | | | | | | | |
| 设备购置及安装 | | | | | | | | | | |
| 人员招聘及培训 | | | | | | | | | | |
| 系统调试及验证 | | | | | | | | | | |
| 试运行 | | | | | | | | | | |

4、项目备案及环保情况

本项目已在嘉兴经济技术开发区完成备案或项目基本信息登记，并已取得《备案通知书》（项目代码：2512-330451-07-02-159847）及《基本信息表》（项

目代码：2603-330451-04-01-960798）

本项目已在嘉兴市生态环境局完成环境影响评价，并已取得《环境影响登记表备案通知书》（备案编号：嘉环（经开）登备【2026】14号、嘉环（经开）登备【2026】28号）

5、项目的必要性

（1）提升国产芯片测试探针零件份额，为我国芯片产业的战略安全与核心竞争力提供坚实支撑

半导体产业是数字经济发展的基石，其产业链的自主可控直接关乎国家信息安全与战略竞争力。作为半导体后道封测的核心环节，芯片测试是确保芯片性能与可靠性的最终关口，而精密测试探针正是这一关口的“精密触角”，其性能直接决定了测试的准确性、效率与成本，其中探针的核心零部件更是其整体性能与可靠性的根本基石。过去一段时间，全球高端芯片测试探针零件市场被日本、美国等国的少数企业高度垄断，国内企业在该领域的高端产品存在显著技术差距与产业空白，形成严重的进口依赖，已成为制约我国半导体产业链安全与升级的潜在瓶颈。

从国家战略与产业安全视角看，出口管制和贸易摩擦加剧使得高端半导体设备与核心零部件的供应不确定性陡增。测试探针零件作为测试探针的关键零部件，其稳定供应直接关系到国内封测产能的连续运转。面对外部可能的技术与供应链限制，实现高端测试探针的自主可控，是打通半导体产业链、保障产业安全运行的必然要求。国家在规划产业政策中，持续强调要强化芯片制造、封测及配套材料、设备的全链条攻关。本项目的实施，正是响应国家号召，旨在通过扩建芯片测试探针零件产能，突破精密加工、特殊材料处理等核心技术壁垒，提升国产芯片测试探针零件份额的同时，维护我国芯片测试环节自主安全，为芯片产业的发展提供坚实保障。

（2）突破公司现有产品的产能瓶颈，满足市场需求

作为芯片测试环节的核心耗材，高精密芯片测试探针的市场需求持续旺盛，且对产品的接触精度、导电稳定性、耐用性及高频性能提出了前所未有的严苛要求，也带动了芯片测试探针零件需求的快速增长。凭借可靠的产品性能与一致性

的交付质量，公司已成功进入 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等众多国内外主要芯片测试耗材企业供应链，订单量随之快速攀升。然而，公司现有产能已趋于饱和，生产场地与高端制造设备均面临瓶颈，这不仅对现有客户订单的及时交付与质量稳定性构成压力，更制约了公司抓住市场机遇、向更高端探针零件产品拓展的战略步伐。

通过半导体芯片检测用探针零件扩产项目的建设，公司将通过扩大生产场地，引进先进的精密加工与检测设备，并招聘有经验的技术与生产人才，系统性提升公司在高精密、高性能探针零件产品上的规模化制造与快速迭代能力。项目建成后，不仅能够保障公司对核心客户日益增长订单的稳定、高质量交付，巩固既有合作关系，而且将使公司有能力承接更多测试探针零件生产任务，以满足市场需求，最终在半导体产业链的关键支撑环节建立起坚实的市场领导地位。

6、项目的可行性

（1）国家产业政策支持

芯片测试探针是半导体产业中不可或缺的基础元件，它构成了芯片封装后最重要的一次全功能测试的核心物理接口。而我国已将芯片产业列为国家战略性新兴产业的核心领域，坚持自主可控和进口替代的发展方向，通过加大研发投入、优化产业生态、突破关键核心技术，不断提升芯片自给率，保障产业链供应链安全稳定。芯片行业作为支撑数字经济、智能社会建设的基石，将成为推动我国科技自立自强和经济高质量发展的重要引擎。半导体芯片检测用探针零件扩产项目的实施顺应产业政策指导和行业发展趋势，充分践行国家关于促进电子行业高质量发展战略，符合国家产业政策方向。

（2）公司优质的客户资源及稳定的合作关系为项目实施提供保障

半导体测试行业为探针零部件供应商设立了极为严苛的认证标准。作为直接决定芯片测试良率与成本的关键环节，客户对测试探针的电性能一致性、微观尺寸精度、使用寿命及大规模稳定交付能力有着近乎严苛的要求，并建立了涵盖研发能力、量产品控、失效分析响应速度及供应链管理的多维度长效评估体系，认证流程复杂且壁垒高筑。一旦通过认证进入其供应链，双方将形成深度绑定的战略协作关系，新竞争者难以轻易切入。

公司凭借在精密零部件领域的长期深耕，已成功进入 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳等众多国内外主要芯片测试企业供应链，并通过持续的技术迭代、稳定的批量化交付与高效的客户需求响应，赢得了核心客户的高度认可。这些客户高度重视供应链的安全、稳定与协同进化，因此对已认证的合格供应商，尤其是具备同步研发与快速扩产能力的伙伴，会尽可能保证长期稳定的合作关系并优先赋予其参与下一代产品开发与份额提升的机会。公司现有的优质客户群不仅为本次产能扩建提供了明确的市场需求保障，其行业影响力所带来的品牌效应，更将有力助推公司新客户的开拓，为本项目的成功实施与产能消化奠定了坚实的市场基础。

（二）医疗器械精密零件制造基地建设项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为金连接医疗，建设期为 30 个月，本项目总投资 23,658.61 万元。项目将购置土地，并新建约 23,600.00 平方米生产厂房及配套设施，拟购置高端飞秒激光机等先进的生产、检测设备，并配备相关生产人员。项目建成达产后，将实现年产 550 万件医疗器械精密零件产品的产能，进一步拓展公司产品应用领域。具体投资明细情况如下表所示：

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算（万元） | 占投资比例 |
|-----|---------|-----------|---------|
| 1 | 工程建设费用 | 22,168.00 | 93.70% |
| 1.1 | 土地购置 | 847.00 | 3.58% |
| 1.2 | 建筑工程费 | 8,160.00 | 34.49% |
| 1.3 | 设备购置及安装 | 13,161.00 | 55.63% |
| 2 | 预备费 | 665.04 | 2.81% |
| 3 | 铺底流动资金 | 825.57 | 3.49% |
| | 合计 | 23,658.61 | 100.00% |

2、项目实施选址及土地

本项目用地尚未完全落实，公司将在嘉兴市秀洲区华云路购置土地、新建厂房作为项目实施地点。发行人已与嘉兴市秀洲区人民政府嘉北街道办事处签署了《项目投资协议》并初步约定了用地事宜，根据有关法律规定取得该用地还需履行相应手续。

3、项目实施进度安排

本项目计划分阶段实施完成，包括土地购置及初步设计、场地建设及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证与试运行阶段建设期为 30 个月。具体安排如下：

| 建设阶段 | 建设期（月） | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | 16~18 | 19~21 | 22~24 | 25~27 | 28~30 |
| 土地购置及初步设计 | | | | | | | | | | |
| 场地建设及装修 | | | | | | | | | | |
| 设备购置及安装 | | | | | | | | | | |
| 人员招聘及培训 | | | | | | | | | | |
| 系统调试及验证 | | | | | | | | | | |
| 试运行 | | | | | | | | | | |

4、项目备案及环保情况

本项目已在嘉兴经济技术开发区完成基本信息登记，并已取得《基本信息表》（项目代码：2603-330451-04-01-960798）

本项目已在嘉兴市生态环境局完成环境影响评价，并已取得《环境影响登记表备案通知书》（备案编号：嘉环（经开）登备【2026】28号）

5、项目的必要性

（1）丰富产品结构，培育新的业务增长点并提升抗风险能力

公司是一家主要从事微细精密制造的高新技术企业，致力于为不同领域客户提供具备国际竞争力的微细精密零件。依托建立的微细零件精密加工能力及高端金属材料制备技术，公司已构建起领先的技术平台与稳定的规模化生产供应能力。为拓展更具韧性的成长空间，公司正将这一经过验证的精密制造平台，向技术壁垒高、发展稳定的高端医疗器械领域延伸，产品积极向各类植入式或介入式精密医疗器械的核心功能部件领域拓展，以强化长期竞争优势与抗风险能力。

本项目的建设，公司将系统性地把公司在超精密加工、特种材料及过程管控方面的核心能力，迁移至“植入与介入”这一高端医疗制造领域。通过建设符合医疗标准的洁净产线，扩大各类植入式或介入式精密医疗器械的核心功能部件的

产能，进一步丰富公司的产品结构。这不仅是对公司产品结构的根本性优化与升级，更是公司核心能力在精密制造领域的纵深拓展，将为公司开辟技术护城河深、客户粘性强的全新增长曲线，进而培育公司新的业务增长点。

通过本项目的实施，公司将逐步从专注于精密探针零件的企业向跨领域的高端精密制造企业方向发展。通过拓展产品和客户类型，提升自身抗风险能力。

（2）推动国内高端医疗器械精密零件产业升级，发展新质生产力

我国虽已成为全球医疗器械生产与消费的重要市场，但在高端医疗器械精密零件领域，长期依赖海外供应商的技术与工艺，尤其在复杂结构件、高生物相容性材料部件等关键环节受制于人，产业链自主性与安全性面临挑战。医疗器械精密零件涵盖材料科学、精密加工、表面处理等多重技术维度，对工艺稳定性、一致性与洁净度要求极高，形成了较高的技术与认证壁垒。

本项目的建设，公司通过对已验证的成熟工艺进行产能扩充，构建“工艺固化—精度管控—规模交付”的高效供应链条，将显著提升国内高端医疗器械零件在供货稳定性、成本竞争力与质量一致性方面的整体水平。项目建成后，公司将依托本地化服务与快速响应优势，逐步参与全球市场竞争，打破海外企业对医疗器械精密零件的市场垄断，提升我国在高端医疗器械精密零件领域的市场参与度。项目对于推动国内高端医疗器械精密零件产业升级，发展新质生产力，具有重要的战略价值与现实意义。

6、项目的可行性

（1）国家产业政策支持

医疗器械精密零件是医疗器械产业中的重要部分，为进一步实现我国上述产品的自主化开发及应用，国家出台了一系列相关政策促进我国医疗器械精密零件的发展。2023年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，明确将“高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用”等高端医疗器械列入鼓励类产业；2025年7月，国家药监局发布《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告（2025年第63号）》明确指出医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料医疗器械等是塑造医疗器械新质生产力的关键领域，

全力支持高端医疗器械重大创新，促进更多新技术、新材料、新工艺和新方法应用于医疗健康领域，更好满足人民群众健康需求，提升我国高端医疗器械国际竞争力。医疗器械精密零件制造基地建设项目的实施顺应产业政策指导和行业发展趋势，充分践行国家关于促进医疗器械行业高质量发展战略，符合国家产业政策方向。

（2）公司丰富的技术储备和完善的质量控制体系是本项目顺利实施的基础

公司长期积累的完善生产和质量控制体系，为本项目的顺利投产与达效奠定了坚实基础。卓越的产品品质是公司在高端医疗器械精密零件这一高精领域立足的基石，公司始终将产品质量视为自身发展的根本。作为国内极少数同时掌握核心原材料研制与精密零件全流程制造能力的企业，公司实现了从高端特种合金材料到高端医疗器械精密零件的垂直整合与自主可控，建立了稳定的批量供应保障体系。为满足医疗器械对高端精密零件性能的严苛要求，公司不仅引入了行业领先的生产设备、工艺检测设备，还构建了超高标准的洁净生产环境与贯穿全程的质量管控体系。

在医疗器械精密零件领域，公司已建立精细化的生产体系和质量保障体系，取得了《医疗器械质量管理体系认证证书（GB/T42061-2022/ISO13485:2016）》，适用于临时心脏起搏电极导线、一次性使用心脏射频消融导管、一次性使用固定弯型心脏电生理标测导管电极接头的生产和销售。

截至本招股说明书签署日，公司电生理产品已实现规模化销售并得到了客户的充分认可。

（3）下游市场规模巨大，为产能消化提供良好保证

受全球人口整体增长、发达地区人口老龄化程度加剧、医疗技术不断进步、医疗产品升级换代、人们对健康的重视程度提高等众多因素影响，医疗器械行业市场规模呈现持续增长的趋势。2019年到2024年，我国医疗器械市场规模从6,235亿元增长至9,417亿元，期间年复合增长率为8.6%，其增速高于全球医疗器械市场同期增速，预计到2030年将达到13,260亿元。医疗器械市场规模的持续增加将为产业链上游的关键精密零件带来了持续且庞大的配套需求。

电生理医疗器械是用于诊断和治疗心律失常（尤其是房颤等复杂心律失常）

的核心工具。在人口老龄化加速、心律失常患病率持续攀升的背景下，电生理医疗器械市场已成为心血管介入器械领域增长最为稳健的赛道之一。从全球市场来看，电生理医疗器械行业呈现稳步增长的态势。北美地区长期占据全球最大的市场份额，欧洲市场得益于完善的公共卫生体系和较高的手术渗透率紧随其后。亚太地区则被视为未来增长的重要引擎，主要由中国、印度等新兴市场的庞大患者群体、医疗资源投入持续增加以及居民健康意识提升所驱动。

因此，当前及未来可预见的巨大市场需求，将为本项目新增医疗器械精密零件产品产能提供充分的消化空间，有助于项目的顺利实施。

（三）研发中心升级项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为浙江金连接，建设期为24个月，项目总投资5,135.00万元。本项目将在公司现有研发中心的基础上，购置国内外先进研发和检测仪器装置，引进一批高水平研发人才，完善与公司业务发展相适应的高效技术创新平台。项目的建成将有利于进一步提高公司先进技术储备，巩固公司在行业内地位。具体投资明细情况如下表所示：

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算（万元） | 占投资比例 |
|-----|---------|----------|---------|
| 1 | 工程建设费用 | 3,000.00 | 58.42% |
| 1.1 | 设备购置费 | 3,000.00 | 58.42% |
| 2 | 基本预备费 | 90.00 | 1.75% |
| 3 | 研发费用 | 2,045.00 | 39.82% |
| 3.1 | 研发人员工资 | 1,625.00 | 31.65% |
| 3.2 | 其他研发费用 | 420.00 | 8.18% |
| 合计 | | 5,135.00 | 100.00% |

2、项目实施选址及土地情况

本项目在公司现有场地实施，未新增建筑面积。

3、项目实施进度安排

| 建设阶段 | 建设期（月） | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 项目设计及准备 | | | | | | | | | | | | |

| 建设阶段 | 建设期（月） | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 设备购置及安装 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 人员招聘及培训 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 项目试运行及验收 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

4、项目备案及环保情况

本项目已在嘉兴经济技术开发区完成备案，并已取得《备案通知书》（项目代码：2601-330451-07-02-985459）

本项目已在嘉兴市生态环境局完成环境影响评价，并已取得《环境影响登记表备案通知书》（备案编号：嘉环（经开）登备【2026】24号）

5、项目的必要性

在当前半导体检测、高端医疗设备等下游领域技术迭代加速的背景下，企业的竞争本质已演变为精密制造与核心材料制造技术储备的深度竞争。下游客户对关键零件在性能极限、长期可靠性等方面的要求日益提升，这直接考验微细精密制造行业内的企业在前沿技术上的预见性与沉淀能力。经过多年持续研发投入，公司在微细精密制造领域成功打破国外厂商长期的技术与市场垄断，产品在核心工艺、精度及可靠性等关键指标方面已达到国际一流水平，具有较强的市场竞争力与议价能力。公司若后续缺乏在超细高性能钽合金丝制造平台、高精度先进生产工艺技术平台，以及自动化收集与清洗技术平台的持续投入与储备，可能将难以应对未来产品的升级挑战，更无法在客户提出前瞻性需求时提供可靠的解决方案，从而在产业链中陷入被动。因此，积极开展相关精密零件的研发项目，核心目标在于系统性地构建面向未来的先进技术储备库，并以此为基础精准对接与引领客户需求。

本项目的建设，公司将通过专项研究，加大探针零件产品、医疗器械零件、贵金属材料等产品及技术方面研发力度，为公司提供具有自主知识产权的技术支撑。项目的建成将有利于进一步提高公司先进技术储备，巩固公司在行业内地位，并扩大市场份额。

6、项目的可行性

公司已构建一支经验深厚、结构合理的技术研发团队，为核心技术突破与产品产业化提供坚实保障。研发团队具备覆盖需求分析、技术攻关、产品开发至产业化落地的全生命周期管理能力，并可深度参与客户产品定义与规划环节，体现了从技术执行向协同创新的能力跃升。在持续研发实践中，团队形成了高效协同、专业扎实的跨领域技术融合体系，核心成员均拥有二十年以上精密加工领域实践经验，尤其在微米级精度零件研发中积淀了丰富的研发经验。这种以应用为导向、依赖长期经验的技术路径，使团队能够深刻理解精密设备、刀具特性与复杂材料性能，在面对钽合金、铍铜等难加工材料时，能通过持续试错与参数优化实现技术突破，从而支撑公司在高壁垒领域的持续创新。

公司研发团队人员专业覆盖机械、自动化、数控与材料等多学科，其中拥有高级工程师、中级工程师及多等级数控技工的骨干。公司研发人员配置合理，形成以资深技术专家为核心的人才梯队。公司研发团队依托成熟的研发管理体系与标准化流程，在芯片测试探针零件、医疗器械零件等高端领域已实现多项技术突破，持续构筑核心技术壁垒。公司核心团队深耕行业二十余年，确保了研发方向与产业需求的紧密衔接。综上，公司研发团队不仅具备深厚的行业经验与跨领域攻坚能力，更通过体系化协作与知识传承，为项目规划与战略实施提供了可靠的技术支撑与人才保障。

（四）补充流动资金

公司本次公开发行拟使用募集资金 25,000 万元用于补充流动资金，本项目不涉及备案及环境影响评价等事项。

报告期内，公司收入规模快速扩张，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金也迅速增加，公司除了要进行生产厂房建设、生产设备的购置等固定资产投资外，还需要大量流动资金采购原材料、支付人员工资等重要的日常生产经营活动。本次补充流动资金将成为公司业务拓展和日常营运方面的重要资金来源，对公司生产经营给予有力的支持。

三、未来发展规划

（一）公司战略目标

自成立以来，公司专注于微细精密零件制造。面对我国高端半导体测试探针及其核心材料长期依赖进口的产业现状，公司通过自主创新实现了关键零部件及材料环节的突破，成为产业链中重要的“补链者”与“强链者”，有效破解了在芯片测试探针这一供应链上的“卡脖子”难题，为我国芯片产业的战略安全与核心竞争力提升提供了坚实支撑。

短期来看，公司将始终致力于微细精密零件的研发、生产和销售，借助本次首发上市的契机，实现半导体芯片检测用探针零件扩产项目、医疗器械精密零件制造基地建设项目、研发中心升级项目的落地投产，实现扩大市场份额，丰富公司产品结构的目标。

长期来看，公司将充分依托国家对半导体芯片行业、先进制造业的政策支持，依托在芯片测试探针零件及医疗器械精密零件领域形成的先进技术工艺、研发实力和行业地位，加大对于新材料领域的研发投入，逐步探索微细精密零件产品在医疗等领域的应用，努力发展成为全球领先的微细精密零件供应商。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、可靠的产品交付品质为公司积累长期稳定的客户资源

精密零件加工对生产体系的稳定性、精确度有较高的要求。公司秉承“质量至上”的初心，严格遵守英国 UKAS ISO 9000:2000 质量管理体系，并专门设立 ISO 质量体系部和品保部，保障生产经营活动高质量运行。在芯片测试探针零件领域，经过多年持续创新研发，公司的技术实力、产品品质、制造能力获得了 Smiths Interconnect、Yokowo、Yamaichi、韬盛科技、和林微纳在内的知名芯片测试探针厂商的高度认可，并广泛应用于下游客户的高端产品系列，例如 Smiths Interconnect 的 davinci 系列测试插座，并最终应用于国内外主要芯片厂商的 GPU、CPU、ASIC 芯片的产品测试中。

在医疗器械精密零件领域，公司已建立精细化的生产体系和质量保障体系，并符合国际 ISO 13485 质量标准，已实现小规模销售并得到了客户的充分认可。

2、重视并持续加大研发投入有助于公司保持竞争优势

报告期内，公司研发费用分别为 971.76 万元、1,061.17 万元和 2,061.67 万元，最近三年研发投入占营业收入比例 7.79%。公司始终重视通过持续研发投入提高产品品质，同时重视优化关键工序及相应工艺，提高生产效率和产品良品率。基于从原材料至成品一体化生产的全流程技术，公司构建了三大核心技术平台：超细高性能钽合金丝制备平台、高精度先进生产工艺技术平台，以及自动化收集与清洗技术平台。以上平台协同作用，共同强化了公司在产品一致性、可靠性及生产效率方面的显著优势，形成了可持续的技术壁垒与核心竞争力。以上核心技术的综合运用，帮助公司产品在市场中保持竞争优势。

3、注重人才引进和培育为公司提供长期且稳定的人才队伍

随着公司业务规模的提升，优秀人才的引进和培养是关乎公司可持续发展的关键环节。公司具有一批经验丰富的生产、研发、销售队伍，并在日本、中国香港组建资深技术人才队伍。

为吸引和留住优秀人才，公司搭建了行业内较有竞争力的薪酬体系和激励机制。同时，公司也对人才的内部培养给予了充分重视，通过制定科学的晋升和绩效管理制度、定期对员工进行职业技术培训等，公司已打造出一批业务素质过硬、具有强大凝聚力且长期稳定的人才队伍。公司核心团队兼具国际化视野与本土化深耕能力，为公司可持续发展夯实人才基础。

（三）未来为保障战略规划拟采取的措施

1、不断提升公司的研发实力和技术水平

近年公司业务处于蓬勃发展期，现有的研发基础设施和人才规模已较难满足公司经营发展的需求。本次募集资金投资项目之一为“研发中心升级项目”，通过该项目的实施，公司将在现有研发中心的基础上，通过购置先进试验设备、引进行业优秀人才等方式进一步布局探针零件、新材料及医疗器械零件方面的深入研究。目标建成国内先进的研发中心，提升公司的研发实力和综合能力。

2、进一步强化公司的品牌影响力

公司将积极实施品牌策略，强调品牌在产品营销、市场拓展中的积极作用，

并结合良好的产品交付品质不断强化客户对公司品牌的认同感和忠诚度。同时，公司正处于业绩快速成长期，实现公开发行并上市亦将有助于公司品牌更快速广泛地被市场和客户所了解，从而进一步拓宽公司的业务和客户资源。

此外公司也将进一步加强市场开发力度，以欧美、亚太地区为核心，持续开拓优质客户。同时，公司亦将持续深化与客户之间的合作，基于客户需求开发出高品质的产品。

3、进一步完善公司治理和规范运作水平

公司将持续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求完善公司的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，为公司业务目标的实现奠定基础。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

报告期内，公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度以及专门委员会制度，公司股东会、董事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，切实履行了其应尽的职责与义务。报告期内，公司治理规范，不存在重大缺陷。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立了规范、有效的内部控制体系。管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

2026年3月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审【2026】4454号），并发表如下鉴证意见：“浙江金连接公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

三、发行人报告期内的违法违规行及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

报告期内，公司严格按照国家的有关法律法规开展经营活动，不存在因重大违法违规行为而被国家行政及行业主管部门进行处罚的情况。

四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。

报告期内，发行人及其子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，也不存在为其他单位或个人担保的情况。

五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力

自股份公司设立以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的研发、生产和销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

截至本招股说明书签署日，公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的全部生产系统、辅助生产系统和配套设施，包括机器设备、运输设备、办公设备等；公司具有独立的原材料采购和产品销售系统，不存在以自身资产、权益或信誉为股东及其关联企业的债务提供违规担保的情形，不存在公司的资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。公司合法拥有与生产经营有关的土地使用权及厂房、机器设备、商标、专利的所有权，不存在与股东共用的情形。

（二）人员独立

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事并聘请了独立董事，由董事会聘用高级管理人员。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司制订了完整、严格的员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩，公司劳动、人事及工资管理独立。

（三）财务独立

公司建立了规范、独立的财务会计制度，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立、完整的会计核算体系，能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预发行人资金使用的情况；发行人及子公司分别单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情况；公司及子公司作为独立纳税人进行纳税申报及履行纳税义务依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。

（四）机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东会、董事会等机构，并设有相应的办公机构和经营部门，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构依据《公司章程》和相关规章制度独立行使各自的职权。公司的生产经营、办公场所与实际控制人控制的其他企业、其他股东单位分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）业务独立

公司主营业务为微细精密零件的研发、生产和销售，公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的采购、生产、销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力和经营决策权，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。发行人与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易等情形。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定

公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；公司股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。

（七）其他影响公司独立持续经营能力的事项

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。公司经营环境稳定，不存在已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

发行人控股股东、实际控制人为曹镭。

截至本招股说明书签署日，除发行人及合并财务报表范围内子公司外，公司控股股东、实际控制人曹镭控制的其他企业情况如下：

| 企业名称 | 经营范围 | 实际经营主要业务 |
|------|---|-------------------|
| 奥斯贝申 | 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 除持有金连接股权外，未开展其他业务 |
| 扬州贝果 | 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 除持有金连接股权外，未开展其他业务 |

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未实际生产经营。综上，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与发行人之间可能出现的同业竞争，保持上市公司的独立性，维护发行人及股东的利益，公司控股股东、实际控制人曹镭先生出具了《关于避免新增同业竞争的承诺函》，具体内容参见招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（九）控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺”。

七、关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，截至本招股说明书签署日，公司的关联方及其关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-------|--|
| 1 | 曹镭 | 发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有发行人36.76%股份；通过员工持股平台嘉兴奥斯贝申控制发行人股本总额16.75%表决权，通过扬州贝果控制发行人股本总额0.84%表决权，实际控制发行人合计股本总额54.34%股份表决权。 |

控股股东、实际控制人曹镭的具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

（二）除控股股东之外直接或间接持有公司5%以上股份的其他股东

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-----------|--|
| 1 | 奥斯贝申 | 发行人实际控制人曹镭实际控制的合伙企业。曹镭持有8.92%份额并担任执行事务合伙人。奥斯贝申系直接持有发行人16.75%股份的股东 |
| 2 | 远宁奕鑫 | 直接持有发行人8.37%股份的股东 |
| 3 | 何烽 | 何烽直接持有发行人2.0934%股份；其控制的杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）系发行人股东远宁奕鑫、远宁之鑫的执行事务合伙人，远宁奕鑫持有发行人8.3734%股份，远宁之鑫持有发行人2.1588%股份；何烽持有发行人股东远宁合丰99.00%出资额，并为远宁合丰之执行事务合伙人远宁投资的实际控制人，远宁合丰持有发行人1.0673%股份。综上，何烽实际控制发行人13.6929%股份表决权。 |
| 4 | 浙创启晨、浙创新兴 | 浙创启晨持有发行人3.3186%股份，浙创新兴持有发行人2.1131%股份，上述两股东均为浙江省创业投资集团有限公司管理的私募基金 |

（三）公司董事、高级管理人员

公司董事、高级管理人员情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”。

（四）实际控制人、持有公司5%以上股份的自然人股东、公司董事、高级管理人员关系密切的家庭成员

公司实际控制人、持有公司5%以上股份的自然人股东、董事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括该等人员的配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，上述人员亦为公司的关联方。

（五）除前述企业、发行人及发行人子公司外，前述关联法人或关联自然人直接或间接控制的，或者前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

上述（一）至（四）项所述关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织为公司的关联方。具体如下：

| 序号 | 公司名称 | 关联关系 |
|----|----------------------|--|
| 1 | 扬州贝果 | 实际控制人曹镭配偶郑宽蘋担任执行事务合伙人的合伙企业 |
| 2 | 嘉兴市经开嘉北猫岛咖啡馆 | 实际控制人曹镭配偶郑宽蘋经营的个体工商户 |
| 3 | 丹东金连接 | 实际控制人曹镭持有 50.00% 股权并施加重大影响的企业 |
| 4 | 深圳市福田区维真信息咨询中心 | 曹镭子女配偶的父亲蒲维真经营的个体工商户 |
| 5 | 浙江致祥新材料有限公司 | 何烽持股比例 25%，并担任执行董事兼总经理的企业 |
| 6 | 远宁合丰 | 何烽持有远宁合丰 99.00% 的财产份额，何烽控制的远宁投资系远宁合丰的执行事务合伙人 |
| 7 | 杭州远宁投资管理有限公司 | 何烽控制的企业 |
| 8 | 杭州之聚投资管理合伙企业（有限合伙） | 何烽控制的企业 |
| 9 | 杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙） | 何烽控制的企业 |
| 10 | 杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 何烽控制的企业 |
| 11 | 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 何烽控制的企业 |
| 12 | 杭州有宁创业投资合伙企业（有限合伙） | 何烽控制的企业 |
| 13 | 杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙） | 何烽控制的企业 |
| 14 | 杭州远宁睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 何烽控制的企业 |
| 15 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 何烽担任董事长的企业 |
| 16 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 17 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 何烽担任董事的企业 （已于 2026 年 1 月 14 日卸任） |
| 18 | 杭州长乔旅游投资集团股份有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 19 | 杭州和兴碳纤维科技有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 20 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 21 | 上海宾酷网络科技股份有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 22 | 浙江诚鸿医疗投资管理股份有限公司 | 何烽担任董事的企业 |

| 序号 | 公司名称 | 关联关系 |
|----|--------------------|---|
| 23 | 苏州梦想人软件科技有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 24 | 杭州掌酷信息科技有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 25 | 浙江博艺网络文化有限公司 | 何烽担任董事的企业 |
| 26 | 绍兴徽凰进出口有限公司 | 何烽的弟弟何铁锋控制的企业 |
| 27 | 绍兴耐力体育文化传播有限公司 | 何烽的弟弟何铁锋控制的企业 |
| 28 | 邯郸市魏凰服饰有限公司 | 何烽的弟弟何铁锋控制的企业 |
| 29 | 上海万位数字技术股份有限公司 | 董事闵诗阳担任董事 |
| 30 | 广东通元精密电路有限公司 | 董事闵诗阳担任董事 |
| 31 | 杭州君岭教育科技股份有限公司 | 董事闵诗阳担任董事 |
| 32 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 发行人董事闵诗阳担任独立董事 |
| 33 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | 发行人董事闵诗阳担任独立董事 |
| 34 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 发行人董事闵诗阳担任独立董事 |
| 35 | 福建省上杭县古田梦培训服务有限公司 | 副董事长、副总经理官世炎之兄官世尤持股 40%并担任执行董事 |
| 36 | 上杭县古田镇农耕餐馆 | 副董事长、副总经理官世炎之兄官世尤经营的个体工商户 |
| 37 | 嘉善县李妹妹蔬菜铺 | 董事会秘书袁玉兰之母李妹妹经营的个体工商户 |
| 38 | 嘉兴博亚电子科技有限公司 | 财务总监俞晓静配偶之姐盛英红持股 70%并担任执行董事、经理；俞晓静配偶之姐盛莲红持股 30% |

（六）公司的子公司、参股公司

截至本招股说明书签署日，公司有 4 家控股子公司以及 1 家参股公司，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司情况”。

（七）报告期内曾经存在的关联方

公司报告期内曾存在的关联方是指在报告期内曾是公司的关联方，但在本招股说明书签署日与公司已不存在关联关系的自然人或法人，具体如下：

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 关联关系及变化情况 |
|----|----------|-------------------------|
| 1 | 韩广秀 | 报告期内曾担任发行人监事，因公司取消监事会卸任 |
| 2 | 张莹 | 报告期内曾担任发行人监事，因公司取消监事会卸任 |
| 3 | 王京松 | 报告期内曾担任发行人监事，因公司取消监事会卸任 |

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 关联关系及变化情况 |
|----|-------------------------|---|
| 4 | 李云峰 | 曾担任金连接有限董事，2022年8月12日卸任 |
| 5 | 北京蓝月谷文化传媒有限公司 | 曹镭之兄曹铀曾任董事的企业，已于2023年10月26日卸任 |
| 6 | 中唐科技有限公司 | 曹镭之兄曹铀曾任董事的企业，已于2023年10月26日卸任 |
| 7 | 北京乐雅瑞斯科技有限公司 | 原监事韩广秀控制的企业 |
| 8 | 山西中恒泰建筑工程有限公司 | 原监事韩广秀的配偶的父亲赵新建控制的企业 |
| 9 | 陕西逢高丰企业管理咨询有限公司 | 原监事王京松父亲王士发持股比例100%并担任执行董事兼总经理的企业 |
| 10 | 北京铭润华信商贸中心 | 原监事王京松父亲王士发经营的个体工商户 |
| 11 | 陕西强宇建设工程集团有限公司北京通州第一分公司 | 原监事王京松父亲王士发担任负责人的企业 |
| 12 | 上杭县古田镇乡土红家庭农场 | 副董事长、副总经理官世炎的哥哥官世尤经营的个体工商户，已于2024年10月注销 |
| 13 | 上杭县满山红印象酒店 | 副董事长、副总经理官世炎的哥哥官世尤曾控制的企业，已于2025年5月退出 |
| 14 | 龙岩市汇联旅游客运有限公司上杭古田分公司 | 副董事长、副总经理官世炎的哥哥的配偶张招英曾担任负责人的企业，已于2024年10月注销 |
| 15 | 嘉兴市瞳心贸易商行 | 董事会秘书袁玉兰配偶的母亲孙艳秋曾控制的企业，于2022年6月注销 |
| 16 | 北京市逐潮印象礼品店 | 曾担任金连接有限董事的李云峰的配偶的母亲张翠英曾经营的个体工商户，于2025年4月注销 |
| 17 | 杭州乐沣企业管理咨询有限公司 | 何烽担任董事的企业，已于2024年1月退出 |
| 18 | 深圳市三源色文化传播有限公司 | 何烽担任董事的企业，已于2023年12月停业 |
| 19 | 杭州和顺科技股份有限公司 | 何烽担任董事的企业，已于2024年7月29日卸任 |
| 20 | 杭州远宁睿浩投资管理合伙企业（有限合伙） | 何烽控制的杭州远宁投资管理有限公司曾控制的企业，于2022年10月退出。 |
| 21 | 上海稽远财务顾问工作室 | 何烽的配偶赵宁的母亲陈芳珍曾控制的企业，于2022年8月注销。 |

八、关联交易情况

（一）重大关联交易的判断标准及依据

参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本公司认定的重大关联交易主要包括：（1）与关联自然人发生的成交金额在30.00万元以上的交易；（2）与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.10%以上的交易，且超过300.00万元。

报告期内，公司不存在重大关联交易。

（二）关联交易简要汇总表

报告期内，公司关联交易情况汇总如下：

单位：万元

| 项目 | 交易内容 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 经常性关联交易 | 关联销售 | 3.14 | 12.56 | 7.04 |
| | 关联采购 | 282.77 | 227.60 | 12.48 |
| | 向关键管理人员支付薪酬 | 538.73 | 506.61 | 462.21 |
| 偶发性关联交易 | 关联担保 | 详见本节之“八、关联交易情况”之“（四）偶发性关联交易”之“1、关联担保” | | |

（三）经常性关联交易

1、关联销售

2023 至 2025 年，发行人主要向麦克凯利销售刀具并提供铂铱电极头的加工服务，报告期内关联销售金额分别为 7.04 万元、12.56 万元及 3.14 万元。

报告期内，发行人关联销售价格公允且占比较低，对公司生产经营不构成重大影响。

2、关联采购

2023 至 2025 年，发行人主要向麦克凯利采购磷青铜毛细金属管，采购金额分别为 12.48 万元、227.60 万元及 282.77 万元。

报告期内，发行人关联采购价格公允且占比较低，对公司生产经营不构成重大影响。

3、关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 关键管理人员薪酬 | 538.73 | 506.61 | 462.21 |

（四）偶发性关联交易

1、关联担保

报告期内，公司与关联方之间存在关联担保，公司均作为被担保方。具体情况如下：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 是否履行完毕 |
|----|--------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 1 | 曹镭 | 浙江金连接 | 22,000.00 | 2022.6.17 | 2030.6.17 | 否 |
| 2 | 曹镭、郑宽蘋 | 浙江金连接 | 3,000.00 | 2024.6.2 | 2025.06.01 | 是 |
| 3 | 曹镭、郑宽蘋 | 浙江金连接 | 5,000.00 | 2024.6.2 | 2024.06.06 | 是 |
| 4 | 曹镭、郑宽蘋 | 浙江金连接 | 3,000.00 | 2023.2.14 | 2024.2.13 | 是 |
| 5 | 曹镭、郑宽蘋 | 浙江金连接 | 3,000.00 | 2024.2.14 | 2025.2.13 | 是 |
| 6 | 曹镭、郑宽蘋 | 浙江金连接 | 3,000.00 | 2025.2.14 | 2026.2.13 | 是 |
| 7 | 曹镭、郑宽蘋 | 浙江金连接 | 2,000.00 | 2024.3.26 | 2025.3.26 | 是 |
| 8 | 曹镭 | 浙江金连接 | 40.00 | 2023.02.01 | 2026.01.31 | 是 |
| 9 | 曹镭 | 浙江金连接 | 40.00 | 2024.01.02 | 2029.01.01 | 否 |
| 10 | 曹镭 | 浙江金连接 | 40.00 | 2023.01.10 | 2026.01.09 | 是 |
| 11 | 曹镭 | 浙江金连接 | 83.00 | 2022.02.19 | 2025.01.17 | 是 |

报告期内发生的关联方担保均系公司控股股东、实际控制人曹镭及其配偶郑宽蘋为公司银行借款、分期付款购置车辆提供的无偿担保。

（五）关联方往来款余额

1、应收关联方款项

单位：万元

| 关联方 | 款项性质 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|------|-------|------------|------------|------------|
| 麦克凯利 | 应收账款 | - | 3.18 | - |
| 曹镭 | 其他应收款 | 0.54 | 0.55 | - |
| 张莹 | 其他应收款 | - | - | 0.39 |

2、应付关联方款项

单位：万元

| 关联方 | 款项性质 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
|------|-------|------------|------------|------------|
| 麦克凯利 | 应付账款 | 61.04 | 80.51 | 5.51 |
| 曹镭 | 其他应付款 | - | - | 0.07 |
| 俞晓静 | 其他应付款 | - | - | 0.005 |
| 李云峰 | 其他应付款 | 0.04 | - | 0.02 |
| 王京松 | 其他应付款 | - | 0.08 | - |

（六）关联交易对公司报告期内财务状况、经营成果、主营业务的影响

报告期内，公司发生的经常性关联交易主要系公司向关键管理人员支付薪酬、

向关联方采购原材料、销售产品及服务。报告期内，公司发生的偶发性关联交易主要系关联担保。

报告期内公司的关联交易已根据《关联交易管理制度》规定的董事会、股东会决策权限对相应的关联交易履行了内部决策程序，并由独立董事发表了独立意见。公司与关联方的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，未对公司财务状况、经营成果、主营业务造成重大不利影响。

九、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见

（一）关联交易履行的程序情况

自整体变更为股份有限公司、建立关联交易决策程序制度后，发行人按照《公司章程》及相关内部控制制度，对关联交易事项进行了审议和确认，具体情况如下：

（1）发行人于 2023 年 5 月 11 日分别召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易事项进行了审议。

（2）发行人于 2024 年 5 月 8 日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易事项进行了审议。

（3）发行人于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易事项进行了审议。

（4）发行人于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2026 年 4 月 22 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》。

发行人已发生关联交易的决策过程与公司章程相符。公司已召开董事会及股

东大会审议通过了报告期内的关联交易内容。

（二）独立董事关于关联交易的意见

2026年3月20日，第二届董事会第二次独立董事专门会议决议审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》。独立董事认为，公司与关联方之间发生的关联交易符合有关法律、法规的规定，符合公司整体利益，不会对公司产生重大不利影响。

十、确保关联交易公允和减少关联交易的措施

（一）制定完善并严格执行相关制度

公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定。

未来公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则，切实履行信息披露的有关规定，避免损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和全体董事、高级管理人员对规范和减少关联交易出具的承诺

控股股东、实际控制人曹镭、全体董事、高级管理人员、持股 5%以上股东已出具《关于减少和避免关联交易的承诺函》，详见招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（十）其他承诺事项”之“2、关于减少和避免关联交易的承诺”。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配情况

根据发行人 2026 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第六次会议和 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》，公司本次发行上市前留存的滚存未分配利润全部由发行上市后的新老股东共享。

二、发行人的股利分配政策

（一）公司章程中利润分配相关规定

根据发行人第二届董事会第六次会议和 2025 年年度股东会审议通过的上市后生效的《浙江金连接科技股份有限公司章程（草案）》，本次发行后，发行人将采取如下股利分配政策：

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

1、公司利润分配的形式

采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、公司现金形式分红的条件

公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：

（1）公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出；

（4）公司期末资产负债率不超过百分之七十；

（5）未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的或者本章程规定的不得分红的其他特殊情况。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上。

3、公司现金形式分红的比例和时间间隔

公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例（即为现金股利除以现金股利与股票股利之和）最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。

4、公司发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可以在满足上述现金分红的前提下，提出并实施股票股利分配方案。

5、公司利润分配的决策机制和程序

（1）利润分配预案应经公司董事会审议后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求。

6、公司利润分配政策调整的决策机制与程序

（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部环境发生变化，确需调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（2）公司调整利润分配政策，必须由董事会进行专题讨论，详细论证并说明理由。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、审计委员会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。

（3）利润分配政策调整应经董事会审议通过后方能提交股东会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细说明利润分配政策调整的原因。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。股东会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为了切实维护股东权益，保持公司股利分配政策的持续性和稳定性，公司于第二届董事会第六次会议对股东回报事宜进行了专项研究论证，修订了上市后生效的《公司章程（草案）》，并决议通过了《关于公司上市后未来三年股东回报规划的议案》，制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。经论证，该股东回报规划具有合理性。

（三）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前，公司根据《公司法》等规定，制定了利润分配政策。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规则，公司于2025年年度股东会审议通过了本次发行上市完成后生效的《公司章程（草案）》，进一步明确了公司的利润分配原则、分配形式、分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整程序，并明确了每年的现金分红比例，加强了对中小投资者的利益保护。

（四）现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制

关于公司现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制，参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”之“（一）公司章程中利润分配相关规定”的相关内容。

（五）公司长期回报规划以及规划制定时的主要考虑因素

为保障公司股东的合法权益，向股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，公司在综合考虑未来盈利能力、经营发展规划、重大资金支出、股东的合理预期及外部融资环境等因素的前提下制定了长期回报规划。

三、特别表决权股份、协议控制的特殊安排

公司未针对特定股东设置特别表决权股份，公司股东亦不存在协议控制的特殊安排情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

公司重大合同是指报告期内公司已履行及截至本招股说明书签署日正在履行的，对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。公司结合自身业务特点、财务状况以及对公司未来生产经营的影响，确定了各类重大合同的标准。具体情况如下：

（一）销售合同

报告期内公司与子公司已履行及截至本招股说明书签署日正在履行的重要销售框架协议及单笔合同金额在 1,000 万元以上的销售合同如下：

| 序号 | 客户名称 | 合同名称 | 合同金额及标的 | 签订日期 | 有效期至 | 履行情况 |
|----|-------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|------|
| 1 | 安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司 | 商品及/或服务框架协议 | 以订单为准 | 2025.5.9 | 2030年5月8日 | 正在履行 |
| 2 | 安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司 | 采购订单 | 金额：1,949.27万元； 标的：探针零件 | 2025.8.27 | - | 已履行 |
| 3 | 安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司 | 采购订单 | 金额：1,565.39万元； 标的：探针零件 | 2026.1.16 | - | 已履行 |
| 4 | 安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司 | 采购订单 | 金额：2,872.39万元； 标的：探针零件 | 2026.3.12 | - | 正在履行 |
| 5 | 安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司 | 采购订单 | 金额：1,422.00万元； 标的：探针零件 | 2026.4.8 | - | 正在履行 |
| 6 | 安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司 | 采购订单 | 金额：1,213.33万元； 标的：探针零件 | 2026.6.5 | - | 正在履行 |
| 7 | 浙江日拓电子股份有限公司 | 销售框架协议 | 以订单为准 | 2020.1.1 | 2022.12.31，期满无异议有效期自动续一年 | 正在履行 |
| 8 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 销售框架协议 | 以订单为准 | 2020.1.1 | 2022.12.31，期满无异议有效期自动续一年 | 正在履行 |
| 9 | 东莞创宝达电器制品有限公司 | 买卖主协议 | 以订单为准 | 2021.12.29 | 2022.12.28，自动续展12个月 | 已履行 |
| 10 | 东莞创宝达电器制品有限公司 | 买卖主协议 | 以订单为准 | 2024.1.1 | 有效期一年，自动续展12个月 | 正在履行 |
| 11 | 苏州韬盛电子科技有限公司 | 销售框架协议 | 以订单为准 | 2020.1.1 | 2022.12.31，期满无异议有效期自动续一年 | 正在履行 |
| 12 | 励福（江门）环保科技股份有限公司 | 金属回收合同 | 以结算单为准 | 2024.10.29 | 2029年9月30日 | 正在履行 |

| 序号 | 客户名称 | 合同名称 | 合同金额及标的 | 签订日期 | 有效期至 | 履行情况 |
|----|---|---------|---------|-----------|------------------------------|------|
| 13 | ヨコオプレジジョン株式会社（Yokowo） | 取引基本契約書 | 以报价单为准 | 2026.3.1 | 2026年3月1日起为期一年，期满无异议有效期自动续一年 | 正在履行 |
| 14 | STARBURST TECHNOLOGY CO., LTD.（日月昌科技有限公司） | 采购合约书 | 以订单为准 | 2026.4.10 | 自签署日生效，有效期五年，期满无异议有效期自动续一年 | 正在履行 |

（二）采购合同

报告期内公司与子公司已履行及截至本招股说明书签署日正在履行的重要采购框架协议及单笔合同金额在 1,000 万元以上的采购合同如下：

| 序号 | 供应商名称 | 合同名称 | 合同金额及标的 | 签订日期 | 履行情况 |
|----|---------------------|--------|-------------------------------------|------------|------|
| 1 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 设备购买合同 | 金额：1,260.8 万元 标的物：16 台西铁城数控车床 | 2022.5.17 | 履行完毕 |
| 2 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 设备购买合同 | 金额：6,619.20 万元 标的物：84 台西铁城数控车床 | 2022.5.16 | 履行完毕 |
| 3 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 设备购买合同 | 金额：2,298.00 万元 标的物：30 台西铁城数控车床 | 2025.1.10 | 履行完毕 |
| 4 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 设备购买合同 | 金额：10,500.00 万元 标的物：140 台西铁城数控车床 | 2025.12.23 | 正在履行 |
| 5 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 设备购买合同 | 金额：9,360.00 万元 标的物：130 台西铁城数控车床 | 2026.2.6 | 正在履行 |
| 6 | 津特机械贸易（上海）有限公司苏州分公司 | 设备购买合同 | 金额：13,680.00 万元 标的物：190 台西铁城数控车床 | 2026.6.1 | 正在履行 |
| 7 | 励福（江门）环保科技股份有限公司 | 采购框架协议 | 以订单为准 | 2022.1.1 | 正在履行 |
| 8 | 贵研金属（上海）有限公司 | 采购框架协议 | 以订单为准 | 2021.1.1 | 正在履行 |
| 9 | 贵研国贸有限公司 | 采购框架协议 | 以订单为准 | 2022.1.1 | 正在履行 |

注：贵研国贸有限公司已更名为上海贵研实业发展有限公司

（三）借款合同

报告期内公司与子公司已履行及截至本招股说明书签署日正在履行的金额在 1,000 万元以上的借款合同如下：

| 序号 | 贷款银行 | 合同编号 | 金额（万元） | 期限 | 担保情况 | 履行情况 |
|----|------|------|--------|----|------|------|
|----|------|------|--------|----|------|------|

| 序号 | 贷款银行 | 合同编号 | 金额 (万元) | 期限 | 担保情况 | 履行情况 |
|----|-------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------|
| 1 | 招商银行嘉兴分行 | IR2206060000020 | 1,400.00 | 2022.6.6-2023.6.6 | - | 已履行 |
| 2 | 建设银行嘉兴科技支行 | HTZ330630000GDZC2022N004 | 19,000.00 | 2022.6.17-2030.1.16 | 曹镭提供最高额保证担保；发行人以不动产、设备提供抵押担保 | 正在履行 |
| 3 | 招商银行嘉兴分行 | IR2208030000041 | 1,000.00 | 2022.8.4-2023.8.3 | 曹镭、郑宽蘋提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 4 | 建设银行嘉兴科技支行 | HTZ330630000LDZJ2022N02T | 1,500.00 | 2022.9.15-2023.9.14 | 曹镭提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 5 | 招商银行嘉兴分行 | IR2307060000092 | 1,100.00 | 2023.7.7-2024.7.6 | 曹镭、郑宽蘋提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 6 | 招商银行嘉兴分行 | IR2308080000106 | 1,000.00 | 2023.8.10-2024.8.9 | 曹镭、郑宽蘋提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 7 | 建设银行嘉兴科技支行 | HTZ330630000LDZJ2023N03P | 1,500.00 | 2023.10.7-2024.10.6 | 曹镭提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 8 | 建设银行嘉兴科技支行 | HTZ330630000LDZJ2023N04C | 1,000.00 | 2023.12.25-2024.12.24 | 曹镭提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 9 | 招商银行嘉兴分行 | IR2407020000010 | 1,100.00 | 2024.7.2-2025.7.1 | 曹镭、郑宽蘋提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 10 | 建设银行嘉兴科技支行 | HTZ330630000LDZJ2024N023 | 1,500.00 | 2024.9.14-2025.9.13 | 曹镭提供最高额保证担保 | 已履行 |
| 11 | 建设银行嘉兴科技支行 | KJLJ2025KJDF0001 | 1,000.00 | 2025.9.25-2026.9.25 | 曹镭提供最高额保证担保 | 正在履行 |
| 12 | 交通银行嘉兴开发区支行 | 604D260002 | 8,600.00 | 2025.12.31-2032.12.31 | 发行人以设备提供抵押担保 | 正在履行 |
| 13 | 交通银行嘉兴开发区支行 | 604D260032 | 7,600.00 | 2026.05.09-2033.05.09 | - | 正在履行 |

（四）工程施工合同

报告期内公司与子公司已履行及截至本招股说明书签署日正在履行的金额在 1,000 万元以上的工程施工合同如下：

| 序号 | 施工方 | 施工项目 | 签订日期 | 项目总价 (万元) | 履行情况 |
|----|----------------|-------------------------|-----------|--------------|------|
| 1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 土建、水电安装、消防、暖通、抗震支架等工程施工 | 2022.3.13 | 5,788.00 | 已履行 |
| 2 | 嘉兴市中元幕墙有限公司 | 玻璃幕墙、干挂铝板幕墙、干挂石材幕墙等施工 | 2022.9.1 | 1,350.00 | 已履行 |
| 3 | 浙江嘉兴克林斯普装饰有限公司 | 室内装修工程施工 | 2024.1.22 | 1,680.00 | 已履行 |

注：嘉兴市中元幕墙有限公司已更名为嘉兴嘉建建设有限公司；浙江嘉兴克林斯普装饰有限

公司已更名为浙江克林斯普建设工程有限公司

上述重要合同均按照合同约定执行，不存在对发行人生产经营及本次发行上市产生重大影响的潜在风险。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

三、诉讼或仲裁事项

（一）发行人的诉讼或仲裁事项

报告期内，公司存在一项作为原告的买卖纠纷诉讼案件，具体情况如下：

1、案件经过

2022年8月，公司向林泰精密电子(宁波)有限公司(以下简称“林泰公司”)、慈溪市林泰探针厂(以下简称“林泰厂”)销售探针零件。由于林泰公司和林泰厂经营不善，经公司多次催收货款后，截至2024年底尚有184.36万元货款未收到。

公司于2025年4月对林泰公司、林泰厂及其他当事人就买卖合同纠纷向嘉兴市秀洲区人民法院提起诉讼，本案已于2025年10月20日开庭审理。

2025年11月，浙江省嘉兴市秀洲区人民法院出具(2025)浙0411民初4625号《民事判决书》，判决林泰公司、林泰厂向公司支付货款共计184.36万元及逾期付款利息。沈乾国、邓宇分别对上述债务在1.10万元及96.18万元内承担补充赔偿责任。林泰公司、林泰厂、沈乾国、邓宇未向发行人履行前述付款义务。邓宇不服一审判决，于2025年12月5日向嘉兴市中级人民法院提起上诉。

2026年5月27日，浙江省嘉兴市中级人民法院出具(2026)浙04民终681号《民事判决书》，判决结果为驳回上诉，维持原判。

2、案件对公司的影响

上述案件所涉及货款184.36万元占公司营业收入比例较低，且公司已按照会计准则的要求就上述应收款共计184.36万元项全额计提坏账准备。该案件对公司未造成重大影响。

截至本招股说明书签署日，除上述诉讼外，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

（二）发行人控股股东、实际控制人、子公司，发行人董事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人、子公司，以及发行人的董事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

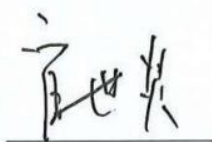
一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

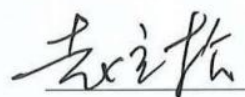
全体董事：



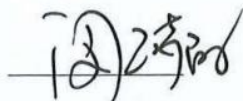
曹 镭



官世炎



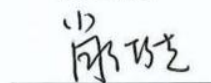
赵立松



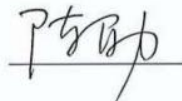
闵诗阳



胡旭微



肖佳佳



陈自力

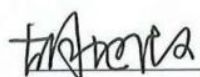
浙江金连接科技股份有限公司

2026年6月25日

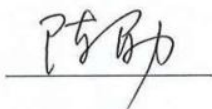


本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

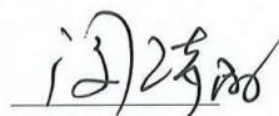
全体审计委员会委员：



胡旭微

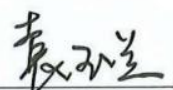


陈自力



闵诗阳

除董事外的高级管理人员：



袁玉兰



俞晓静



浙江金连接科技股份有限公司

2026年6月25日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：



曹 镭



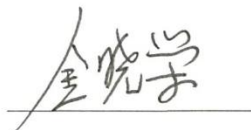
浙江金连接科技股份有限公司

2026年6月25日

三、保荐机构（主承销商）声明

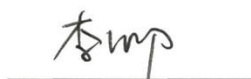
本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：




金晓荣

保荐代表人：

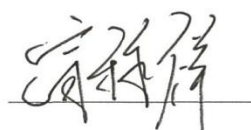


李娜



张崇军

法定代表人：



高稼祥

长江证券承销保荐有限公司
2026年6月25日



保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读浙江金连接科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理：


高稼祥



保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读浙江金连接科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长：


王承军


长江证券承销保荐有限公司
2016年6月15日

四、发行人律师声明

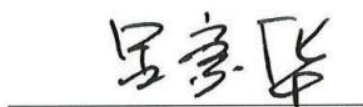
本所及经办律师已阅读浙江金连接科技股份有限公司招股说明书，确认浙江金连接科技股份有限公司招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认浙江金连接科技股份有限公司招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

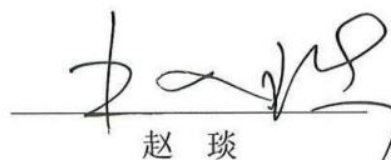


章靖忠


经办律师：



吕崇华



赵琰



冯晟



王凯迪





地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江金连接科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕4453 号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕4454 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江金连接科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：




吕安吉




巩方森

天健会计师事务所负责人：




程志刚

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年六月二十五日



资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读《浙江金连接科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，确认招股说明书与本机构出具的《资产评估报告》（坤元评报（2021）818号）内容无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对浙江金连接科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述资产评估报告内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



潘文夫

王苗燕

资产评估机构负责人：



俞华开





地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江金连接科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2021〕627号、天健验〔2021〕628号、天健验〔2021〕629号、天健验〔2021〕789号、天健验〔2022〕216号、天健验〔2025〕65号、天健验〔2025〕66号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江金连接科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：




吕安吉




巩方森

天健会计师事务所负责人：




程志刚

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年六月二十五日



第十二节 附件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- （九）内部控制鉴证报告；
- （十）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （十一）股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- （十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- （十三）募集资金具体运用情况；
- （十四）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

（一）查阅地点

1、浙江金连接科技股份有限公司

联系地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区华云路 111 号

联系人：袁玉兰

联系电话：0573-83693388

2、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联系地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层

联系人：李娜、张崇军

联系电话：021-65779433

（二）查阅时间

除法定节假日以外的周一至周五上午 9:00—11:00，下午 2:30—4:30。

三、与投资者保护相关的承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员曹镭承诺

“自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如遇除权除息事项，发价作相应调整，下同）；发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股

份锁定期限 12 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。其中，“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准，“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份；若此前年度净利润情况未触发对应延长锁定期条件的，则当年触发延长锁定期时不额外累计未触发年度拟延长的锁定期。

在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在担任公司董事和/或高级管理人员任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内将继续遵守前述限制。

在本人作为发行人核心技术人员期间，如本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后四年内减持，每年转让的股份不超过本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份的 25%，减持比例可累积使用。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

2、公司股东、实际控制人控制企业奥斯贝申、扬州贝果承诺

“自发行人股票上市之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如本企业直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如遇除权除息事项，发价作相应调整，下同）；发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本企业直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持

股份锁定期限 12 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。其中，“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准，“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份；若此前年度净利润情况未触发对应延长锁定期条件的，则当年触发延长锁定期时不额外累计未触发年度拟延长的锁定期。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本企业同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。”

3、担任公司董事和高级管理人员的股东官世炎、赵立松承诺

“自发行人股票上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人直接持有的发行人股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如遇除权除息事项，发价作相应调整，下同）；发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人直接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在担任公司董事和/或高级管理人员任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内将继续遵守前述限制。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

4、公司股东、董事闵诗阳承诺

“自本人取得发行人股份之日（即公司股东名册变更之日）起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准，以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如本人直接持有的发行人股份在锁定期满后 24 个月内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价（如遇除权除息事项，发价作相应调整，下同）；发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，本人直接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在担任公司董事任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内将继续遵守前述限制。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

5、申报前 12 个月内新增股份股东夏卫芳、远宁合丰承诺

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业在发行人本次发行申报 12 个月前已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

自本人/本企业在发行人本次发行申报前 12 个月内新增取得发行人股份之日（即公司股东名册变更之日）起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以

孰晚之日为准），本人/本企业不转让或者委托他人管理该等新增取得的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人/本企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人/本企业同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

6、申报前 12 个月内新增股东原永丹、陈伟、陈莉莉、远宁之鑫、杭州科祥承诺

“自本人/本企业取得发行人股份之日（即公司股东名册变更之日）起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以孰晚之日为准），本人/本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人/本企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人/本企业同意按照该等规定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

7、其他股东何烽、王建南、高雁峰、杨熙春、徐荣兵、邱友红、吴铮、浙创启晨、浙创新兴、远宁奕鑫、吉六零、浙嘉产装、嘉欣丝绸承诺

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本企业已直接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

如法律法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本人/本企业持有的发行人股份的锁定期另有规定的，则本人/本企业同意按照该等规

定执行。

若因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有。若因未履行上述承诺事项给发行人和/或其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

（二）主要股东持股及减持意向承诺

1、控股股东、实际控制人曹镭承诺

“1、对于本次发行前本人持有的发行人股份，本人将严格遵守股份限制流通及自愿锁定承诺函，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范规定的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后24个月内，本人在满足以下条件的前提下，可进行减持：

（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、在锁定期届满后24个月内，本人将根据自身财务规划的需要，审慎制定股票减持计划。本人减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数，不超过发行人股份总数的2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。减持价格不低于本次发行的发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、本人减持发行人股份，将履行必要的信息披露义务。本人在减持所持有的发行人股份前3个交易日通知发行人并公告（若通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前15个交易日通知发行人并公告）。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿

损失。

6、以上承诺不适用于本人通过二级市场买入的发行人股份。”

2、直接持股 5%以上的股东奥斯贝申承诺

“1、对于本次发行前本企业持有的发行人股份，本企业将严格遵守股份限制流通及自愿锁定承诺函，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范规定的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后 24 个月内，本企业在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、在锁定期届满后 24 个月内，本企业将根据自身财务规划的需要，审慎制定股票减持计划。本企业减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。减持价格不低于本次发行的发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、本企业减持发行人股份，将履行必要的信息披露义务。本企业在减持所持有的发行人股份前 3 个交易日通知发行人并公告（若通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前 15 个交易日通知发行人并公告）。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。

6、以上承诺不适用于本企业通过二级市场买入的发行人股份。”

3、控股股东、实际控制人曹镛控制的企业扬州贝果承诺

“1、对于本次发行前本企业持有的发行人股份，本企业将严格遵守股份限制流通及自愿锁定承诺函，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范规定的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后24个月内，本企业在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、在锁定期届满后24个月内，本企业将根据自身财务规划的需要，审慎制定股票减持计划。本企业减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数，不超过发行人股份总数的2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。减持价格不低于本次发行的发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、本企业减持发行人股份，将履行必要的信息披露义务。本企业在减持所持有的发行人股份前3个交易日通知发行人并公告（若通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前15个交易日通知发行人并公告）。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。

6、以上承诺不适用于本企业通过二级市场买入的发行人股份。”

4、直接持股5%以上的股东远宁奕鑫承诺

“1、对于本次发行前本企业持有的发行人股份，本企业将严格遵守股份限

制流通及自愿锁定承诺函，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范规定的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后 24 个月内，本企业在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、在锁定期届满后 24 个月内，本企业将根据自身财务规划的需要，审慎制定股票减持计划。本企业减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。减持价格不低于本次发行的发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、在本企业及一致行动人合计持有发行人 5%以上股份期间内，本企业减持发行人股份，将履行必要的信息披露义务。本企业在减持所持有的发行人股份前 3 个交易日通知发行人并公告（若通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前 15 个交易日通知发行人并公告）。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。

6、以上承诺不适用于本企业通过二级市场买入的发行人股份。”

5、股东何烽承诺

“1、对于本次发行前本人持有的发行人股份，本人将严格遵守股份限制流通及自愿锁定承诺函，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范规

定的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后 24 个月内，本人在满足以下条件的前提下，可进行减持：

（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、在锁定期届满后 24 个月内，本人将根据自身财务规划的需要，审慎制定股票减持计划。本人减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数，不超过发行人股份总数的 2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。减持价格不低于本次发行的发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、在本人及一致行动人合计持有发行人 5%以上股份期间内，本人减持发行人股份，将履行必要的信息披露义务。本人在减持所持有的发行人股份前 3 个交易日通知发行人并公告（若通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前 15 个交易日通知发行人并公告）。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿损失。

6、以上承诺不适用于本人通过二级市场买入的发行人股份。”

6、股东何烽的一致行动人远宁之鑫、远宁合丰承诺

“1、对于本次发行前本企业持有的发行人股份，本企业将严格遵守股份限制流通及自愿锁定承诺函，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范规定的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后 24 个月内，本企业在满足以下条件的前提下，可进行减

持：（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、在锁定期届满后24个月内，本企业将根据自身财务规划的需要，审慎制定股票减持计划。本企业减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数，不超过发行人股份总数的2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。减持价格不低于本次发行的发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、在本企业及一致行动人合计持有发行人5%以上股份期间内，本企业减持发行人股份，将履行必要的信息披露义务。本企业在减持所持有的发行人股份前3个交易日通知发行人并公告（若通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前15个交易日通知发行人并公告）。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。

6、以上承诺不适用于本企业通过二级市场买入的发行人股份。”

7、股东浙创启晨、浙创新兴承诺

“1、对于本次发行前本企业持有的发行人股份，本企业将严格遵守股份限制流通及自愿锁定承诺函，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合届时法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范规定的方式进行减持，且承诺不会违反相关限制性规定。

2、在锁定期届满后24个月内，本企业在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如有延长锁定期的相关情形，则延长锁定期已届满。

3、在锁定期届满后24个月内，本企业将根据自身财务规划的需要，审慎制定股票减持计划。本企业减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数，不超过发行人股份总数的2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。减持价格不低于本次发行的发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、在本企业及一致行动人合计持有发行人5%以上股份期间内，本企业减持发行人股份，将履行必要的信息披露义务。本企业在减持所持有的发行人股份前3个交易日通知发行人并公告（若通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前15个交易日通知发行人并公告）。

5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。

6、以上承诺不适用于本企业通过二级市场买入的发行人股份。”

（三）稳定股价的措施和承诺

发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺如下：

“（一）启动股价稳定预案的条件

为维护广大股东利益、增强投资者信心、维护公司股价稳定，如果公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力或第三方恶意炒作等因素所致，在符合国家相关法律法规的前提下，公司将启动股价稳定措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件，且不会导致公司控股股东或实际控制

人履行要约收购义务。

（二）启动股价稳定预案的实施主体及措施

本预案中应采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东、实际控制人以及公司的董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员，其中，董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。

公司及相关主体将按照下述顺序采取一项或多项稳定公司股价措施：

- 1、公司回购股票；
- 2、公司控股股东、实际控制人增持公司股票；
- 3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；
- 4、其他证券监管部门认可的方式。

稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施。

（三）稳定公司股价的具体安排

1、公司回购公司股票的具体安排

公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的十个交易日内制订稳定公司股价具体方案，在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信息披露要求予以公告。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的方式回购公司社会公众股份。公司单次用于回购股份的金额不超过公

司上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 20%，一个会计年度内累计用于回购股份的金额不超过公司上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 40%，具体回购事项将在启动股价稳定措施时提前公告。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

2、公司控股股东、实际控制人增持公司股票的具体安排

当公司已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，则公司控股股东、实际控制人应在 3 个交易日内启动内部决策程序，就其增持公司股票的具体计划（包括拟买入的数量、价格区间、完成时间等）书面通知公司并由公司进行公告。公司控股股东、实际控制人将自公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以合法方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，单次用于增持股份的金额不超过其上一会计年度从公司获取税后现金分红金额的 20%，一个会计年度内累计用于增持股份的金额不超过其上一会计年度从公司获取税后现金分红金额的 40%，具体增持事项将在启动股价稳定措施时提前公告。增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，且不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务，增持股份行为及相关信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3、公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排

当公司、控股股东、实际控制人均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票收盘价仍低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，则公司董事、高级管理人员应在 3 个交易日内就其增持公司股票的具体计划（包括拟买入的数量、价格区间、完成时间等）书面通知公司并由公司进行公告。公司董事、高级管理人员将自公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，单次用于增持股份的金额不超过其上一会计年度从公司领取的税后薪酬金额的 20% 一个会计年度内累计用于增持股份的金额不低于上一会计年度从公司领取的税后薪酬金额的 40%，具体增持事项将在启动股价稳定措施时提前公告。

增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及相关信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

公司未来在聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

（四）稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形（就公司回购措施而言仅指如下第 1、第 2 所述情形），则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

- 1、公司股票连续五个交易日的收盘价均高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产；
- 2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；
- 3、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关责任主体继续增持公司股份将导致其和/或其一致行动人（依上市公司收购相关管理规则项下所界定）触发要约收购且不符合法定的免于发出要约申请情形或豁免要约方式增持股份情形的。

（五）稳定股价的具体承诺

公司承诺：本公司上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动股份稳定措施的具体条件后，公司将严格遵守并执行《稳定股价预案》。

公司控股股东、实际控制人承诺：发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人上一会计年度未经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，控股股东、实际控制人将严格按照《稳定股价预案》的要求，依法履行增持发行人股票的义务。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保该预案的实施，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。

（六）稳定公司股价承诺的约束措施

如公司未能履行稳定公司股价的承诺，则应在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。

如控股股东、实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的现金分红（如有）予以扣留，直至其履行增持义务。

如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的薪酬和应取得的分红（如有）予以扣留，直至其履行增持义务。”

（四）股份回购和股份买回的措施和承诺

1、发行人承诺

“1、本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司承诺将按如下方式依法回购公司本次公开发行至欺诈发行揭露日或者更正日期间投资者买入的且在回购时仍然持有的全部股票，但不包括下列股份：①对欺诈发行负有责任的本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持有的股票；②对欺诈发行负有责任的证券公司因包销买入的股票；③投资者知悉或者应当知悉本公司在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容后买入的股票。

若届时本公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易，本公司将在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个工作日内回购本次公开发行的新股，回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定。若届时本公司本次公开发行的新股已完成上市交易，本公司将在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个交易日内回购本次公开发行的新股，回购价格按照

《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》等法律法规的规定确定。

如实际执行过程中，本公司违反上述承诺的，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）根据届时中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定可以采取的其他措施。

3、上述承诺为本公司真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

2、控股股东、实际控制人曹镛承诺

“1、发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺将督促发行人依据其公开作出的相关承诺，在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定发行人存在上述情形后启动与股份回购有关的程序，回购发行人本次公开发行的新股，具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及章程等规定进行发行人内部审批程序和外部审批程序。在发行人召开股东会对回购股份作出决议时，本人及本人控制的发行人其他股东就该等回购事宜在股东会上投赞成票。

3、若发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人承诺将在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定发行人存在上述情形后依法回购本次发行至欺诈发行揭露日或者更正日期间本人及本人控制的发行人其他股东已转让的原限售股份（若有），但不包括下列股份：①对欺诈发行负有责任的本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持有的股票；②对欺诈发行负有责任的证券公司因包销买入的股票；③投资者知悉或者应当知悉本公司在证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容后买入的股票。

原限售股回购价格参照发行人回购价格确定。

4、如实际执行过程中，本人违反上述承诺的，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）根据届时中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定可以采取的其他措施。

5、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

（五）欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人承诺

“1、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。若届时公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易，回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；若届时公司本次公开发行的新股已完成上市交易，回购价格按照《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》等法律法规的规定确定；若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。

3、上述承诺为本公司真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

2、控股股东、实际控制人曹镭承诺

“1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市

的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。若届时公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易，回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；若届时公司本次公开发行的新股已完成上市交易，回购价格按照《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》等法律法规的规定确定；若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。

3、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过加快募投项目建设，强化募集资金的管理、提高公司销售收入，科学管控成本、费用，提高利润水平、严格落实现金分红政策、优化投资回报机制、增加公司投资价值等方式，提升资产质量，提高销售收入，从而增厚未来收益，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报，具体拟采取的措施如下：

1、加快募投项目建设，强化募集资金的管理

本次募投项目均围绕公司主营业务线开展。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

募集资金到位后，公司将严格按照《公司章程（草案）》和《公司募集资金管理制度（草案）》履行相应的使用审批程序，按照缓急轻重的原则安排募集资金继续投入，公司拟在资金的计划、使用、核算和风险防范方面强化风险管理，保证募集资金投资项目建设顺利推进并实现预期收益的前提下能产生最大效益回报股东。

2、提高公司销售收入，科学管控成本、费用，提高利润水平

公司本次发行完成后，公司资产和业务规模将大幅增加，公司综合竞争实力、抗风险能力、长远发展能力将显著提升，为公司加快发展和加强盈利能力提供了良好的机遇。公司将不断加大研发投入和强化升级自主创新能力，积极开拓市场，巩固和提升公司市场地位，推动公司业绩平稳、健康、持续发展。同时，公司将实行严格、科学的成本费用管理，不断提升管理水平，强化成本、费用的预算管理、额度管理和内控管理，严格按照公司管理制度履行管理层薪酬计提、发放的审议披露程序，全面有效的控制公司经营风险、管理风险，不断提升公司的利润水平。

3、严格落实现金分红政策、优化投资回报机制、增加公司投资价值

为切实保护投资者的合法权益，公司已在《公司章程（草案）》《公司上市后未来三年股东回报规划》中明确了持续、稳定的回报机制，并制定了投资者合法权益的保障条款。公司将按照上述规定，根据公司的经营业绩采取包括现金分红等方式进行股利分配，通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督，不断增加公司的投资价值。”

2、关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函

（1）控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹镛承诺

“（1）任何情形下，均不会滥用控股股东/实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

（2）将切实履行作为控股股东/实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（3）不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（4）将严格遵守公司的预算管理，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；

（5）不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（6）将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现；

（7）将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补

回报措施的执行情况相挂钩；

（8）将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（9）将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

本承诺出具日后，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。”

（2）发行人其他董事、高管承诺

“（1）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（2）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（3）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（4）全力支持及配合公司对董事和高级管理人员的职务消费行为进行规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定，严格遵守及执行公司相关制度及规定等；

（5）坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（6）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会及股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有表决权）；

（7）如公司拟实施员工股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力支持公司将员工股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会及股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有表决权）；

（8）若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本承诺存在不同要求，

本人将自愿无条件按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的要求予以承诺。

本承诺出具日后，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

承诺人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。”

（七）利润分配政策的承诺

发行人承诺如下：

“本公司将严格按照《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规、业务规则、上市后生效的《公司章程（草案）》及本公司制定的利润分配政策履行公司利润分配决策程序并实施利润分配。

若本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依法承担相应责任。”

（八）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人承诺

“1、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

3、上述承诺为本公司真实意思表示，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

2、发行人控股股东及实际控制人曹镛承诺

“1、发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将在中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定的方式或金额确定。

3、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

3、发行人其他董监高承诺

“1、发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将在中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定的方式或金额确定。

3、上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

（九）控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺

发行人及控股股东、实际控制人曹镛承诺：

“1、截至本承诺函签署之日，本人及本人近亲属（包括配偶、父母、子女、

兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）控制的其他企业（不含发行人及其下属企业，下同）未从事与公司及其子公司（指纳入公司合并报表的经营主体，下同）相同或相似的业务。

2、本人不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动。

3、自本承诺函签署之日起，若公司及其子公司未来开拓新的业务领域而导致本人及本人所控制的其他公司及企业所从事的业务与公司及其子公司构成竞争，本人将终止从事该业务，或由公司在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接和/或间接损失。

5、本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。”

（十）其他承诺事项

1、关于履行承诺约束措施的承诺

（1）发行人承诺

公司将严格履行招股说明书披露的承诺：（1）公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失；（3）公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。（4）公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分红等措施，用于承担前述赔偿责任。

（2）发行人控股股东、实际控制人承诺

如本人未履行相关承诺，承诺采取如下约束措施：

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得薪酬、分红或津贴，同时本人直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人应将出售发行人的股票收益所得上缴发行人。”

（3）发行人董事赵立松、官世炎、闵诗阳承诺

如本人未履行相关承诺，承诺采取如下约束措施：

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得薪酬、分红或其他收益，同时本人直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

6、如有关股份锁定的承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人应将出售发行人的股票收益所得上缴发行人。”

（4）发行人其他自然人股东承诺

如本人未履行相关承诺，承诺采取如下约束措施：

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得分红或其他收益，同时本人直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；

6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人应将出售发行人的股票收益所得上缴发行人。”

（5）发行人其他法人股东承诺

如本公司未履行相关承诺，承诺采取如下约束措施：

“1、本公司/本企业应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本公司/本企业因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本公司/本企业将停止从发行人处获得分红或其他收益，同时本公司/本企业直接或间接持有的发行人股票不得转让，直至本公司/本企业履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本公司/本企业未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承

承担赔偿责任；

6、如有关股份锁定、减持意向的承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本公司/本企业应将出售发行人的股票收益所得上缴发行人。”

（6）发行人其他董事承诺

如本人未履行相关承诺，承诺采取如下约束措施：

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得津贴，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

（7）发行人其他高级管理人员承诺

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得薪酬或津贴，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

（8）发行人核心技术人员承诺

“1、本人应当在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体

上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

3、如本人因未履行承诺获得收益的，则该等收益归发行人所有；

4、本人将停止从发行人处获得薪酬或津贴，直至本人履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止；

5、本人未履行相关承诺给发行人和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

2、关于减少和避免关联交易的承诺

（1）发行人控股股东、实际控制人曹镛承诺

“1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使股东权利；

2、在发行人股东会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

3、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属企业资金，也不在任何情况下要求发行人及其下属企业为本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保；

4、在与发行人及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

（2）发行人控股股东、实际控制人控制的奥斯贝申、扬州贝果承诺

“1、本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使股东权利；

2、在发行人股东会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

3、本企业及本企业控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属企业资金，也不在任何情况下要求发行人及其下属企业为本企业及本企业控制的其他企业提供任何形式的担保；

4、在与发行人及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

（3）发行人股东浙创启晨、浙创新兴承诺

“1、本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使股东权利；

2、在发行人股东会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

3、本企业及本企业控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属企业资金，也不在任何情况下要求发行人及其下属企业为本企业及本企业控制的其他企业提供任何形式的担保；

4、在与发行人及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

（4）发行人股东何烽、远宁奕鑫、远宁之鑫、远宁合丰承诺

“1、本人/本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公

公司章程》等有关规定行使股东权利；

2、在发行人股东会对有关涉及本企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

3、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属企业资金，也不在任何情况下要求发行人及其下属企业为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业提供任何形式的担保；

4、在与发行人及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

（5）发行人其他董事、高管承诺

“1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定行使股东权利；

2、在发行人股东会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

3、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属企业资金，也不在任何情况下要求发行人及其下属企业为本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保；

4、在与发行人及其下属企业的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则及正常的商业条款进行交易，并依法签订协议，履行合法程序，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和证券交易所股票上市等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

（十一）关于股东信息披露的专项承诺

发行人承诺：

“1、截至本专项承诺函出具之日，本公司股东包括曹镭、嘉兴奥斯贝申企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、赵立松、官世炎、王建南、杭州浙创启晨科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）、长三角吉六零科创走廊私募基金（上海）合伙企业（有限合伙）、浙嘉产装高端装备股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）、杭州远宁之鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、平湖市浙创新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）、何烽、高雁峰、杨熙春、徐荣兵、夏卫芳、杭州远宁合丰企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州科祥股权投资有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司、扬州贝果投资合伙企业（有限合伙）、邱友红、原永丹、陈伟、闵诗阳、陈莉莉、吴铮。前述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

2、本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。

3、本公司及本公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。

4、在本专项承诺函出具后至本公司股票上市持续期间，本公司将继续遵守前述承诺，不会作出任何与此相违的行为。

5、截至本专项承诺函出具之日，本公司股东不存在《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》规定的证监会系统离职人员情形。

6、本公司及本公司股东及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露股东信息，履行了信息披露义务。”